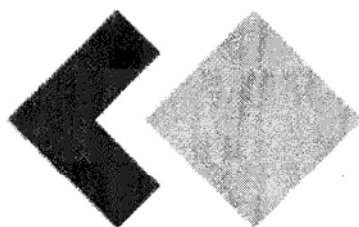


江苏东光微电子股份有限公司

JIANGSU DONGGUANG MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

(江苏省宜兴环科园绿园路 42 号)



D. G. M. E.

首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)

保荐人(主承销商)



东海证券有限责任公司

江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

声 明

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力, 仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型:	人民币普通股（A 股）
发行股数:	2,700 万股
每股面值:	人民币 1.00 元
每股发行价格:	[]元
预计发行日期:	[]年[]月[]日
拟上市的证券交易所:	深圳证券交易所
发行后总股本:	10,700 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺:	公司控股股东、实际控制人沈建平承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。 除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等 19 名自然人股东承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员沈建平、詹文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王全承诺：除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
保荐人（主承销商）:	东海证券有限责任公司
招股说明书签署日期:	2010 年 9 月 13 日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、根据发行人 2010 年 3 月 24 日召开的 2009 年年度股东大会决议，若本次股票发行成功，公司发行前滚存利润由发行后的新老股东共享。

二、本次发行前发行人总股本 8,000 万股，本次拟公开发行 2,700 万股，发行后公司总股本为 10,700 万股，全部为流通股。

公司控股股东、实际控制人沈建平承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。

除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等 19 名自然人股东承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。

作为公司股东的董事、监事、高管人员沈建平、詹文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王全承诺：除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

三、发行人特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：

1、行业周期波动风险

公司所属行业为半导体的子行业——半导体分立器件和集成电路行业。半导体产业是一个明显的周期性行业，在差不多 5 年的时间内就会历经从衰落到昌盛的一个周期；虽然我国属于新兴市场，半导体行业处于上升发展时期，预计在未来 5 年国内市场不存在明显的周期性，但如果未来全球及国内半导体行业的景气状况与预期相差过大，则公司发展将会受到一定的影响。

2、应收账款发生坏账的风险

近三年及一期期末，本公司应收账款账面余额分别为 5,785.59 万元、8,171.02

万元、8,757.02 万元和 9,094.45 万元，占营业收入的比例分别为 52.37%、56.33%、54.02%和 88.57%。截至 2010 年 6 月 30 日，1 年以内的应收账款账面余额为 9,038.66 万元，占应收账款账面余额比例为 99.39%。随着公司客户的日益多元化以及半导体市场竞争程度的加剧，若应收账款催收不力或因客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账的风险。

3、税收优惠政策变动的风险

报告期内公司享受如下优惠政策：①公司作为“对生产线宽小于 0.8 微米(含)集成电路产品的生产企业”，2007 年度、2008 年度免征企业所得税，2009 年度、2010 年度、2011 年度减半征收企业所得税。②公司购置国产设备享受抵免新增企业所得税优惠政策。近三年，上述税收优惠金额分别为 974.67 万元、608.84 万元和 397.66 万元。③公司被认定为高新技术企业，所得税自 2008 年起三年内将减按 15%的税率征收。由于该政策不得与“两免三减半”税收优惠政策叠加享受，公司未享受企业所得税减按 15%的税率征收。公司享受完毕企业所得税“两免三减半”的优惠政策后，如不能被继续认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，将对本公司盈利情况造成一定的影响。

4、可控硅产品转型的风险

公司生产的可控硅产品主要应用于摩托车、吸尘器、电动工具、电扇、空调、冰箱等终端产品。鉴于摩托车用可控硅产品毛利率逐年下降的情况，公司从 2008 年及时调整市场重点，着力扩大利润率更高的家用电器市场，摩托车用可控硅产品销售收入由 2007 年度的 1,162.50 万元降至 2010 年上半年的 53.46 万元，而毛利率较高的吸尘器、冰箱用可控硅产品销售收入由 2007 年的 128.69 万元升至 2010 年上半年的 1,320.45 万元，已达到全部可控硅销售收入的 53.54%。目前吸尘器、冰箱用可控硅是公司重点发展的产品。另外公司已成功研发出豆浆机用可控硅产品，并于 2010 年 3 月正式通过九阳股份的考核认证成为其指定线路板厂的合格供应商。

报告期内，公司可控硅销售情况如下表所示：

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
主营业务收入（万元）	2,466.37	3,955.13	4,610.30	5,367.98

毛利（万元）	1,061.56	1,700.28	1,741.30	2,129.95
毛利率（%）	43.04	42.99	37.77	39.68

报告期内，公司可控硅产品由毛利率较低的摩托车用产品向毛利率较高的家用电器产品转型，并取得了较好的效果，但如果家用电器可控硅市场发生变化，公司仍然存在可控硅产品转型不成功，影响公司盈利能力的风险。

5、VDMOS 生产线产能利用率不足的风险

报告期内，公司投资新建了年产 1 亿只产品的 VDMOS 生产线，截至 2010 年 6 月末，VDMOS 生产线的固定资产账面原值为 19,480.35 万元。VDMOS 产品具有广阔的市场前景，2009 年中国 MOSFET 市场的需求额达到了 235.7 亿元。公司生产的 VDMOS 自 2008 年投产以来，已通过多个客户认证，成功开拓了市场，目前已拥有客户一百多家，其中包括为戴尔、富士康、LG、松下、飞利浦、西门子等国际知名厂商配套的电源系列产品生产厂家，在市场上影响力较大，享有一定的知名度。2010 年公司承担了工业和信息化部电子发展基金招标项目，其项目产品 30A500V 的 VDMOS 将主要应用于水能、风能、太阳能蓄电等逆变电源领域。

虽然 VDMOS 产品市场前景较好，但是由于产品投产时间较短，市场开拓需要一定的时间，目前公司 VDMOS 生产线产能利用率不高，2008 年度至 2010 年上半年 VDMOS 生产线的产能利用率分别为 23.72%、50.18%和 62.25%，贡献的销售毛利分别为-322.92 万元、25.62 万元和 256.23 万元，如果公司未来市场开拓不力，不能提高公司 VDMOS 生产线的产能利用率，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

6、固定资产折旧增加的风险

最近三年及一期，公司固定资产折旧金额较大，分别为 467.71 万元、1,492.35 万元、2,365.50 万元和 1,357.68 万元。公司本次募集资金投资于新建半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目和新建半导体封装生产线项目，项目建成后每年新增固定资产折旧 1,268 万元。上述三个项目完全达产后，预计将新增年利润总额 8,118 万元，其中半导体防护功率器件生产线项目预计新增利润总额 2,748 万元，新型功率半导体器件生产线技改项目预计新增利

润总额 3,657 万元，半导体封装生产线项目预计新增利润总额 1,713 万元。

尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的市场调研和论证，但如果募投项目市场拓展不足，在固定资产折旧增加的同时，无法实现预期的投资收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。

7、净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在投资项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存在由于净资产收益率下降所引致的风险。

以上重大事项务请投资者予以特别关注，并请仔细阅读招股说明书中“**第四节 风险因素**”等有关章节。

目 录

第一节 释 义	11
第二节 概 览	15
一、发行人基本情况	15
二、控股股东及实际控制人简介	18
三、发行人的主要财务数据	18
四、本次发行情况	19
五、本次募集资金主要用途	20
第三节 本次发行概况	21
一、本次发行的基本情况	21
二、本次发行的有关当事人	22
三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系	23
四、本次发行上市有关重要日期	24
第四节 风险因素	25
一、行业风险	25
二、财务风险	27
三、VDMOS 生产线产能利用率不足的风险	28
四、技术风险	29
五、实际控制人变动的风险	29
六、募集资金投资项目的风险	30
七、对外担保风险	31
八、股市风险	31
第五节 发行人基本情况	32
一、发行人概况	32
二、发行人改制重组情况	32
三、发行人设立以来股本形成及其变化和重大资产重组情况	35
四、发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性	49
五、发起人的组织机构	50
六、发行人控股子公司的基本情况	54
七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	54
八、发行人的股本情况	56
九、员工及社会保障情况	59

十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.....	60
第六节 业务和技术	61
一、发行人的主营业务及其变化情况.....	61
二、发行人所处行业的基本情况.....	62
三、发行人在行业中的竞争地位.....	84
四、发行人主营业务的具体情况.....	98
五、发行人主要固定资产和无形资产.....	119
六、发行人技术研发情况.....	125
七、发行人质量控制情况.....	130
第七节 同业竞争与关联交易	133
一、同业竞争情况.....	133
二、关联方、关联关系和关联交易.....	134
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	141
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.....	141
二、董事、监事的提名和选聘情况.....	145
三、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况.....	145
四、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况.....	147
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及关联企业领取报酬情况.....	147
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.....	147
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.....	148
八、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其履行情况.....	148
九、公司董事、监事、高级管理人员任职资格.....	149
十、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	150
第九节 公司治理	152
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	152
二、发行人近三年及一期违法违规行为情况.....	162
三、发行人近三年及一期资金占用和对外担保的情况.....	162
四、发行人内部控制制度情况.....	162
第十节 财务会计信息	164
一、发行人最近三年及一期的财务报表.....	164

二、审计意见类型	172
三、财务报告的编制基础、合并财务报表范围	172
四、报告期公司采用的主要会计政策和会计估计	173
五、应予披露的分部信息	190
六、最近一年及一期收购兼并情况	192
七、最近三年及一期非经常性损益	192
八、最近一期末的主要资产情况	193
九、最近一期末的主要债项	194
十、股东权益	196
十一、现金流量情况	196
十二、期后事项、或有事项及其他重要事项	196
十三、财务指标	197
十四、盈利预测	199
十五、资产评估情况	199
十六、历次验资情况	199
第十一节 管理层讨论与分析	200
一、财务状况分析	200
二、盈利能力分析	226
三、资本性支出	256
四、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的较大差异比较	257
五、主要财务优势及困难	257
六、财务状况和盈利能力未来趋势分析	258
第十二节 业务发展目标	259
一、总体发展战略及目标	259
二、发行人当年和未来两年的发展计划	259
三、拟订发展计划所依据的假设条件	262
四、实施发展计划面临的主要困难	263
五、发展计划与现有业务关系	263
第十三节 募集资金运用	264
一、本次发行募集资金情况	264
二、募集资金投资项目情况	265
三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响	301
第十四节 股利分配政策	303
一、公司最近三年股利分配政策	303
二、最近三年实际股利分配情况	303
三、发行前滚存利润的分配安排	304

四、发行后的股利分配政策.....	304
第十五节 其他重要事项	305
一、有关信息披露和投资者关系的联系方式.....	305
二、重要合同.....	305
三、发行人对外担保的情况.....	317
四、发行人的诉讼与仲裁事项.....	318
五、关联方的重大诉讼与仲裁.....	318
六、涉及刑事诉讼的情况.....	319
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	320
第十七节 备查文件	326
一、备查文件.....	326
二、查阅时间和地点.....	326

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、股份公司、江苏东光	指	江苏东光微电子股份有限公司
宜兴东大	指	宜兴市东大微电子有限公司，系本公司的前身
中比基金	指	中国—比利时直接股权投资基金
东晨电子	指	宜兴市东晨电子科技有限公司
股东、股东大会	指	江苏东光微电子股份有限公司的股东、股东大会
董事、董事会	指	江苏东光微电子股份有限公司的董事、董事会
监事、监事会	指	江苏东光微电子股份有限公司的监事、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）	指	东海证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市天银律师事务所
发行人会计师	指	立信会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏东光微电子股份有限公司章程》
本次发行	指	发行人本次向社会公众发行 2,700 万股人民币普通股（A 股）的行为
A 股	指	境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元	指	人民币元
近三年	指	2007 年、2008 年、2009 年
近三年及一期、报告期	指	2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 1-6 月
近三年及一期末、报告期末	指	2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 6 月 30 日
分立器件	指	由单一的电路器件组成，被规定完成某种基本功

		能，并且其本身在功能上不能再细分的半导体器件
功率器件	指	是指应用半导体工艺制作的可承受或控制一定功率的半导体器件
防护器件	指	亦称保护器件，用以对昂贵的电路提供保护，以免受到突发的过高电压或过大电流损害
放电管	指	能释放浪涌电流，对设备起保护作用的元器件，在正常情况下，放电管因其特有的高阻抗及低电容特性，在它作为保护元器件接入线路中时，对线路的正常工作几乎没有任何不利的影响。当有害的瞬时过电压窜入时，放电管首先被击穿放电，其阻抗迅速下降，几乎呈短路状态，此时，放电管将有害的电流通过地线泄给大地，消除了有害的瞬时过电压和过电流，从而保护了线路及元器件。当过电压消失后，放电管又迅速恢复到高阻抗状态，线路继续正常工作。放电管可分为气体放电管和固体放电管
IC	指	Integrate Circuit 的缩写，集成电路
CSC	指	过电压过电流保护用 IC 的一个专有代号，用于一级防护
DP	指	过电压保护功率 IC 产品的一个专有代号，按照不同的电压和电流等级，可用于一级、二级和终端防护
一级防护	指	指从外线进入中心机房的第一级保护，该保护单元安装于配线架上，保护元件要承受雷电过电压和工频过电流的主要能量
二级防护	指	相对一级防护而言的，该防护器件安装于程控交换机用户板上，保护敏感集成电路免受过电压的侵袭

可控硅	指	又称晶闸管，是可控硅整流器的简称。被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能量转换的场合
1300X	指	一种 NPN 型双极晶体管，主要应用于电子节能灯、电子镇流器、充电器的开关电路中，其作用是与其他元器件配合使用，由加在晶体管基极上的脉冲信号来控制晶体管的“开”或“关”，形成一个无触点的电子开关，将直流电逆变成高频交流电。由于其功率较大，而且起开关作用，所以又称功率开关晶体管
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应晶体管
VDMOS	指	Vertical Double Diffused MOSFET，垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极晶体管
EAS	指	Single Pulse Avalanche Energy，单脉冲雪崩能量
ESD	指	Electrostatic Discharge，静电放电
场限环	指	一种为了获得更好的击穿电压重复性及一致性的结构设计
封装	指	将集成电路或者分立器件芯片装入特制的管壳或用材料将其包容起来，保护芯片免受外界影响而能稳定工作；同时便于连接使用
CSIA	指	中国半导体行业协会
SIA	指	美国半导体行业协会
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
CCID、赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司
UL	指	（美国）保险商实验室，该实验室主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务
RoHS	指	欧盟环境保护认证，通过该认证，指产品中不含

		对人体有害的 4 种重金属和 2 种阻燃剂
PAHS	指	欧盟有害物质认证，包含 18 种有害物质
旭日电子	指	宜兴市旭日电子有限公司
无锡盛泰	指	无锡市盛泰电子器件有限公司，公司关联方
南方涂装	指	江苏南方涂装环保股份有限公司
华微电子	指	吉林华微电子股份有限公司
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
华润华晶	指	无锡华润华晶微电子有限公司
中环股份	指	天津中环半导体股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司
深圳深爱	指	深圳深爱半导体有限公司
华为	指	华为技术有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
华为安捷信	指	深圳市华为安捷信电气有限公司
中兴新地	指	深圳市中兴新地通信器材有限公司
日海通讯	指	深圳日海通讯技术股份有限公司
八达通信	指	南京八达通信设备有限公司
新海宜	指	苏州新海宜通信科技股份有限公司
恒利通讯	指	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司
普天凯特	指	景德镇普天凯特通信设备有限公司
万马集团	指	浙江万马集团有限公司
世纪人	指	深圳市世纪人通讯设备有限公司
黄山电器	指	黄山电器有限责任公司
扬州晶来	指	扬州中芯晶来半导体制造有限公司
启东吉莱	指	启东吉莱电子有限公司

注：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

公司名称：江苏东光微电子股份有限公司

英文名称：Jiangsu Dongguang Micro-electronics Co.,Ltd.

注册资本：8,000 万元

法定代表人：沈建平

成立日期：1998 年 8 月 31 日

整体变更设立日期：2003 年 6 月 12 日

注册地址：江苏省宜兴环科园绿园路 42 号

经营范围：半导体器件、集成电路的开发，设计，制造，销售，推广应用。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

江苏东光微电子股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2003]41号《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》批准，由宜兴市东大微电子有限公司依法整体变更设立的股份公司。公司以截止2003年2月28日经审计的净资产22,675,311.12元按1：1的比例折为22,675,311.00股。2003年6月12日，公司在江苏省工商行政管理局领取了注册号为3200002102661的《企业法人营业执照》。目前，公司注册资本为8,000万元，法定代表人沈建平。

本公司是享受国家政策扶持的高新技术企业，系国内半导体分立器件和集成电路行业中防护功率器件、VDMOS 等领域细分市场的重要企业。主要产品涵盖四大系列：防护功率器件系列产品、VDMOS 系列产品、可控硅系列产品和 1300X 系列产品。产品广泛应用于通信设备、网络设备、数字电视、民用电路、摩托车、电动工具、家用电器、节能灯、消费电子、汽车电子、设备和仪表等领域。

公司不仅拥有一支能够跟踪和吸收国际先进技术、具备持续创新能力的研发团队，以自主创新作为企业发展的驱动力；同时，集芯片设计、芯片制造、封装测试、直销、售后服务于一体，以自主品牌在国内半导体分立器件和集成电路市场上建立了相当的影响力。

公司在半导体分立器件和集成电路诸多细分领域具有较强的技术优势、领先的市场地位和较高的市场占有率。公司的半导体防护功率器件被中国电信等基础电信运营商认定为其设备供应商的指定采购产品，因此在国内通讯用防护功率器件领域市场占有率多年来排名第一，2009 年该市场占有率达到 80%以上。

自成立以来，公司就坚持自主研发，不替国外品牌代工，走自主创新之路，力争打破半导体元器件领域国外技术垄断的格局。公司生产的 SA230-J 固体放电管填补了国内企业在半导体防护器件领域的产品空白，打破了国外企业在这一领域的长期垄断地位，并逐步替代了国外进口产品。

近年来，公司成功进入了可控硅产品应用的高端领域，是国内较早进入吸尘器用可控硅市场的企业，成功地打破了国外进口产品的垄断，目前在该应用领域的可控硅市场占有率较高，在国内可控硅生产企业中排名领先。

2006 年公司利用自主研发的“高压功率管生产工艺”专有技术实现了利用国产设备生产 1300X 系列产品，成为国内较早采用国产设备成功大规模生产同类型产品的企业。

公司生产的 VDMOS 产品为近年来公司新研发生产出的高端半导体功率器件产品，目前国内半导体行业中主要有江苏东光、华微电子、华润华晶、士兰微和中环股份等企业能够生产该类半导体功率器件并通过客户检测、成功投放市场。本公司的 VDMOS 产品于 2008 年 3 月开始投放市场，并取得了迅速发展，2008 年、2009 年、2010 年 1-6 月公司 VDMOS 产品的销量分别为 1,867.95 万只、4,349.50 万只、3,325.56 万只，拥有客户一百多家，其中包括为戴尔、富士康、LG、松下、飞利浦、西门子等国际知名厂商配套的电源系列产品生产厂家，在市场上影响力较大，享有一定的知名度。

2006年6月公司被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”；2007年8月国家发展和改革委员会、信息产业部、海关总署、国家税务总局联合

评定公司为“第一批国家鼓励的集成电路企业”；2008年9月江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合评定公司为“高新技术企业”；2007年10月公司获得中国质量管理体系认证中心和中国企业发展监督管理委员会授予“中国晶体管十强企业”；2009年12月获得江苏省民营科技企业协会颁发的“江苏省民营科技企业”。

公司历年来获得的技术奖项情况如下：

2001年，公司的“SA230-J”半导体放电管获江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，综合性能达到国际同期先进水平；“58S 半导体抑制栅”防护类功率集成电路于2001年被国家科技部列入第五批科技型中小企业创新基金项目；2002年获江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，2003年获国家级火炬计划项目证书；2002年，防护类功率集成电路“YDCLP200M-X 过电压过电流保护集成电路”被认定为国家电子信息产业发展基金第三批重点项目；“DSC3X00 网络安全保护用集成电路研究与开发”被信息产业部列入2007年度集成电路研究与开发专项资金使用计划；“DCLP19E 通信安全保护用集成电路的研究与开发”被信息产业部列入2008年度集成电路研究与开发专项资金使用计划；“高速网络用片式功率防护模块”获科学技术部科技型中小企业技术创新基金；2008年，公司“高速网络通信用功率集成电路”获国家火炬计划项目证书。

2009年，公司节能型电子电力器件 VDMOS 产业化项目被国家发改委和工信部列入2009年新增中央预算内投资计划项目；公司“支持下一代互联网高频传输低电容功率防护模块研究与产业”获2009年省科技成果转化专项资金；“低电容功率防护集成电路 DP”获2009年省高新技术产品称号。

2010年2月11日，中国半导体协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社联合发布了“第四届（2009年度）中国半导体创新产品和技术”评选结果，该项目评选共分六大类，有三十六家公司获选，其中半导体器件类获选项目仅有两个，江苏东光的“高速网络安全保护用功率防护模块 DP3X00”名列其中；2010年，公司承担了工业和信息化部电子信息产业发展基金招标项目，对新型电力电子器件——30A500V的功率MOSFET进行研发及产业

化。

未来公司还将继续扩大半导体防护功率器件市场的领先优势，加强 VDMOS 产品的技术研发和市场拓展力度、以产品结构调整来推动可控硅、1300X 系列功率器件盈利能力及市场占有率的提高，积极提升公司的封装能力，力争成为在细分市场上国际一流的半导体分立器件和集成电路供应商。

二、控股股东及实际控制人简介

公司控股股东及实际控制人为沈建平先生。

沈建平先生，男，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记，宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记，宜兴市林副业局副局长，宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记，宜兴东大董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。本次发行前，沈建平持有公司 34.70% 的股份，为公司控股股东及实际控制人，沈建平持有公司的股份不存在质押或者其他有争议的情况，沈建平除拥有公司股权外，无其他对外投资。

三、发行人的主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
总资产	437,690,161.53	481,847,560.55	447,990,415.13	329,901,025.57
流动资产	204,125,870.39	248,640,406.14	205,848,076.70	187,801,485.52
非流动资产	233,564,291.14	233,207,154.41	242,142,338.43	142,099,540.05
负债总额	181,599,072.95	240,728,056.20	230,032,302.41	131,725,169.06
流动负债	141,474,745.91	184,470,363.77	224,032,302.41	131,725,169.06
非流动负债	40,124,327.04	56,257,692.43	6,000,000.00	-
归属于母公司所有者权益	256,091,088.58	241,119,504.35	217,958,112.72	198,175,856.51

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	102,683,748.55	162,112,176.89	145,068,686.12	110,484,140.74
营业利润	17,736,052.41	22,342,433.68	19,900,159.98	29,600,781.09
利润总额	17,195,833.97	25,261,769.49	19,193,510.08	29,681,564.94
归属于母公司所有者的净利润	14,971,584.23	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	47,280,157.28	59,299,005.81	26,888,931.80	57,050,094.77
投资活动产生的现金流量净额	-14,151,589.90	-14,546,893.97	-67,883,331.45	-97,485,433.41
筹资活动产生的现金流量净额	-36,799,605.50	-28,407,732.24	40,114,462.97	75,011,956.12
期末现金及现金等价物净余额	70,008,364.62	73,689,944.44	57,349,343.10	58,229,279.78

（四）主要财务指标

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
每股净资产（元/股）	3.20	3.01	2.72	2.48
流动比率（倍）	1.44	1.35	0.92	1.43
速动比率（倍）	1.21	1.13	0.80	1.25
应收账款周转率（次）	1.15	1.91	2.08	1.78
存货周转率（次）	1.90	3.25	3.91	3.05
利息保障倍数（倍）	5.33	3.25	3.00	6.27
无形资产（除土地外）占净资产的比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益（元/股）	0.19	0.29	0.25	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.29	0.25	0.39
净资产收益率（加权平均）（%）	6.02	10.09	9.51	16.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）（%）	6.02	8.50	9.40	16.39
资产负债率（母公司）（%）	41.46	49.96	51.35	39.93

四、本次发行情况

- 1、股票种类：人民币普通股
- 2、股票面值：人民币 1.00 元
- 3、发行股数：2,700 万股
- 4、每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初

步询价结果和市场情况确定发行价格

5、发行方式：采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式

6、发行前每股净资产：3.20 元/股（按 2010 年 6 月 30 日经审计的数据计算）

7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

五、本次募集资金主要用途

发行人本次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，募集资金用于半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目和半导体封装生产线项目等 3 个项目，项目总投资额 18,082 万元。

根据项目的轻重缓急顺序，本次募集资金投入的时间进度及项目履行的批准情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	项目建设期	项目核准情况
1	半导体防护功率器件生产线项目	4,816.00	1 年	宜兴市发展和改革委员会 宜发改许（2010）73 号
2	新型功率半导体器件生产线技改项目	6,123.00	1 年	宜兴市发展和改革委员会 宜发改许（2010）72 号
3	半导体封装生产线项目	7,143.00	1.5 年	宜兴市发展和改革委员会 宜发改许（2010）74 号
合 计		18,082.00	-	-

本次募集资金与项目资金需求之间的缺口部分将由公司自筹解决；若有超出部分，将用于补充公司流动资金。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行股数、占发行后总股本的比例：2,700 万股，占发行后总股本的 25.23%

4、每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格

5、发行市盈率：

【 】倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

【 】倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

6、发行前每股净资产：3.20 元/股（按 2010 年 6 月 30 日经审计的财务数据基础上计算）

发行后每股净资产：【 】元/股（按 2010 年 6 月 30 日经审计的财务数据基础上考虑 A 股发行募集资金的影响）

7、市净率：【 】（按发行后每股净资产计算）

8、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

9、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

10、承销方式：由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销

11、预计募集资金总额：【 】

12、预计募集资金净额：【 】

13、发行费用概算

项目	金额
承销费用：	万元
保荐费用	万元
审计费用：	万元
律师费用：	万元
上市推介费用：	万元
合计：	

二、本次发行的有关当事人

1、发行人：	江苏东光微电子股份有限公司
法定代表人：	沈建平
注册地址：	江苏省宜兴环科园绿园路 42 号
电话：	0510—87138930
传真：	0510—87138931
联系人：	周玲燕
2、保荐人（主承销商）：	东海证券有限责任公司
法定代表人：	朱科敏
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼
电话：	021—50586660
传真：	021—50585607
保荐代表人：	王育贵、张静
项目协办人：	张宜生
项目组其他成员：	李华峰、班妮、郭婧、宋宁
3、副主承销商：	
法定代表人：	
注册地址：	
电话：	
传真：	
联系人：	
4、分销商：	
法定代表人：	
注册地址：	

电话：	
传真：	
联系人：	
5、发行人律师事务所：	北京市天银律师事务所
法定代表人：	朱玉栓
注册地址：	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 15 层
电话：	010—62159696
传真：	010—88381869
经办律师：	朱振武、吕宏飞
6、会计师事务所：	立信会计师事务所有限公司
法定代表人：	朱建弟
注册地址：	上海市南京东路 61 号 7 楼
电话：	021—63391166
传真：	021—63392558
经办注册会计师：	孙冰、郑斌
7、股票登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：	戴文华
注册地址：	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：	0755—25938000
传真：	0755—25988122
8、拟上市的证券交易所：	深圳证券交易所
法定代表人：	宋丽萍
注册地址：	深圳市深南东路 5045 号
电话：	0755—82083333
传真：	0755—82083667
9、主承销商收款银行：	
收款银行：	招商银行上海分行福州路支行
户名：	东海证券有限责任公司
账号：	2989078810006

三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市有关重要日期

询价推介时间	
定价公告刊登日期	
申购日期和缴款日期	
股票上市日期	

第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。

一、行业风险

（一）行业周期波动风险

半导体产业是一个明显的周期性行业，行业的周期通常也称为“硅周期”，通常持续 4-5 年。硅周期即是指半导体产业在差不多 5 年的时间内就会历经从衰落到昌盛的一个周期。一个典型的周期可以描述如下：第一阶段，需求下降，产能利用率低，价格下滑，投资锐减；第二阶段，需求稳定，产能利用率稳定，价格稳定，投资下滑以致投资不足；第三阶段，投资加大，信心膨胀，需求增长。这三个阶段构成一个循环。值得注意的是，半导体从设计到流水线生产，至少需要 2 年的时间。从短期来看，行业波动性较大，但是长期来看，周期性很明显。半导体行业的周期性波动有可能引致公司的经营风险。

从 2008 年开始，由于金融危机导致的终端需求下降，通过产业链进一步传导至上游，因此从 2008 年开始，半导体行业资本支出步入明显的下行周期。2009 年上半年，全球市场仍然在 2008 的基础上进一步衰退，但由于市场的不断复苏以及 2008 年四季度的低水平基数，2009 年四季度，市场摆脱下滑的态势开始正增长。由于 2009 年半导体市场处于周期性发展的低谷，因此预计 2010 年市场将会出现一个相对较高的增速，逐步从复苏进入景气阶段。

由于我国属于新兴市场，半导体行业处于上升发展时期，预计在未来 5 年国内市场不存在明显的周期性。此外，以功率晶体管为代表的高端、新兴分立器件和集成电路产品的需求增长，带动市场的产品结构快速升级。因此分立器件和集成电路市场在半导体行业整体衰退的情况下表现较为良好，有助于降低行业不景气对公司经营的影响。

但如果未来全球及国内半导体行业的景气状况与预期相差过大，则公司发展

将会受到一定的影响。

（二）行业利润水平下降的风险

总体上看，半导体分立器件和集成电路行业将经历价格下跌、利润率水平逐渐收敛的过程。根据产品周期理论，随着我国半导体分立器件和集成电路行业的逐步成熟，最终将进入技术成熟期后的价格自然下跌过程，利润率将回归全球行业平均利润水平。因此，公司未来可能面临产品利润水平下降的风险。

但在半导体分立器件和集成电路行业内部，利润率水平的变动呈现结构性特征。从发展趋势看，中低端的产品由于技术门槛低，竞争十分激烈，价格将加速下跌，利润空间收窄；甚至部分厂商会因重复生产、无序竞争、原材料价格波动等原因出现亏损。而越高端的产品，如 MOSFET、IGBT，技术壁垒越高、资金投入越大，进入者相对较少，利润率水平能在较长的一段时期内保持稳定，甚至随新兴市场需求的增長而有所上升。公司目前正在积极进行产品结构调整，开发高毛利率的高端产品以应对可能出现的上述情况。

（三）可控硅产品转型的风险

公司生产可控硅产品主要应用于摩托车、吸尘器、电动工具、电扇、空调、冰箱等终端产品。鉴于摩托车用可控硅产品毛利率逐年下降的情况，公司从 2008 年及时调整市场重点，着力扩大利润率更高的家用电器市场，摩托车用可控硅产品销售收入由 2007 年度的 1,162.50 万元降至 2010 年上半年的 53.46 万元，而毛利率较高的吸尘器、冰箱用可控硅产品销售收入由 2007 年的 128.69 万元升至 2010 年上半年的 1,320.45 万元，已达到全部可控硅销售收入的 53.54%。目前吸尘器、冰箱用可控硅是公司重点发展的产品。另外公司已成功研发出豆浆机用可控硅产品，并于 2010 年 3 月正式通过九阳股份的考核认证成为其指定线路板厂的合格供应商。

报告期内，公司可控硅销售情况如下表所示：

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
主营业务收入（万元）	2,466.37	3,955.13	4,610.30	5,367.98
毛利（万元）	1,061.56	1,700.28	1,741.30	2,129.95
毛利率（%）	43.04	42.99	37.77	39.68

报告期内，公司可控硅产品由毛利率较低的摩托车用产品向毛利率较高的家用电器产品转型，并取得了较好的效果，但如果家用电器可控硅市场发生变化，公司仍然存在可控硅产品转型不成功，影响公司盈利能力的风险。

二、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

近三年及一期期末，本公司应收账款账面余额分别为 5,785.59 万元、8,171.02 万元、8,757.02 万元和 9,094.45 万元，占营业收入的比例分别为 52.37%、56.33%、54.02%和 88.57%。截至 2010 年 6 月 30 日，1 年以内的应收账款账面余额为 9,038.66 万元，占应收账款账面余额比例为 99.39%。

随着公司客户的日益多元化以及半导体市场竞争程度的加剧，若应收账款催收不力或因客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账的风险。

（二）税收优惠政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税 [2009]69 号）的有关规定，公司作为“对生产线宽小于 0.8 微米（含）集成电路产品的生产企业”，2007 年度、2008 年度免征企业所得税，2009 年度、2010 年度、2011 年度减半征收企业所得税。公司购置国产设备享受抵免新增企业所得税优惠政策。近三年，上述税收优惠金额分别为 974.67 万元、608.84 万元和 397.66 万元。

此外，2008 年 9 月 24 日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据相关规定，公司企业所得税自 2008 年起三年内将减按 15% 的税率征收。由于该政策不得与“两免三减半”税收优惠政策叠加享受，公司尚未实际享受企业所得税减按 15% 的税率征收。

公司享受完毕企业所得税“两免三减半”的优惠政策后，如不能被继续认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，将对本公司盈利情况造成一定

的影响。

（三）主要经营性资产用于抵押借款的风险

为解决公司规模发展的资金需求，本公司以生产设备、房屋建筑物和土地使用权设置抵押，向银行申请借款。截至 2010 年 6 月 30 日，本公司的抵押借款余额为 4,580 万元，相应资产抵押情况如下：

资产类别	已设置的抵押	占期末资产的比例
生产设备	原值 4,104.24 万元	占生产设备原值的 18.04%
房屋	建筑面积 22,562.70 平方米	占公司已办妥房产证建筑面积的 100%
土地使用权	面积 92,031.60 平方米	占公司土地使用权面积的 100%

尽管截至 2010 年 6 月 30 日，公司的资产负债率处于正常水平，且抵押借款余额仅占短期借款期末余额的 49.25%，而短期借款余额占负债总额的 51.21%，但如果公司不能按期偿还银行借款，银行对抵押资产行使抵押权，可能对公司的正常生产经营造成一定影响。

三、VDMOS 生产线产能利用率不足的风险

报告期内，公司投资新建了年产 1 亿只产品的 VDMOS 生产线，截至 2010 年 6 月末，VDMOS 生产线的固定资产账面原值为 19,480.35 万元。VDMOS 产品具有广阔的市场前景，2009 年中国 MOSFET 市场的需求额达到了 235.7 亿元。公司生产的 VDMOS 自 2008 年投产以来，已通过多个客户认证，成功开拓了市场，目前已拥有客户一百多家，其中包括为戴尔、富士康、LG、松下、飞利浦、西门子等国际知名厂商配套的电源系列产品生产厂家，在市场上影响力较大，享有一定的知名度。2010 年公司承担了工业和信息化部电子发展基金招标项目，其项目产品 30A500V 的 VDMOS 将主要应用于水能、风能、太阳能蓄电等逆变电源领域。

虽然 VDMOS 产品市场前景较好，但是由于产品投产时间较短，市场开拓需要一定的时间，目前公司 VDMOS 生产线产能利用率不高，2008 年度至 2010 年上半年 VDMOS 生产线的产能利用率分别为 23.72%、50.18%和 62.25%，贡献的销售毛利分别为-322.92 万元、25.62 万元和 256.23 万元，如果公司未来市场开拓不力，不能提高公司 VDMOS 生产线的产能利用率，将会对公司的经营业绩造成

不利影响。

四、技术风险

（一）对技术人才依赖的风险

半导体分立器件和集成电路生产技术的发展迅猛，公司的发展很大程度上依赖于能否实现技术进步和是否拥有自己的先进技术。国内对于该部分人才的需求日益增长，对人才的争夺也日趋激烈。拥有一支稳定、高素质的技术人才队伍成为影响公司保持在行业中的领先地位的重要因素。

对此，公司采取多种方式稳定技术人才队伍：营造良好的企业文化使技术人才能力得到充分展现，个人价值目标和公司未来发展高度契合；同时，公司大力引进技术人才，努力形成老、中、青相结合的梯次分明的技术队伍，对于其中核心技术人员还适当吸收其入股公司成为公司股东，使其和公司利益保持高度地一致。但是，如果发生高级技术人员尤其是核心技术人员的离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员时，则仍将会对公司的生产经营造成一定的影响。

（二）技术失密的风险

目前在国内半导体分立器件和集成电路行业中只有少数厂家掌握了芯片设计的核心技术。公司是集芯片设计、芯片制造、封装测试、直销、售后服务于一体的半导体分立器件和集成电路生产企业，尤其在芯片设计上拥有较为强大的技术队伍。目前公司部分核心技术已经申请国家专利和著作权，但仍有部分技术不适宜通过申请专利的方式进行保护，诸如生产工艺、工序安排等。一旦公司核心技术外泄，公司的技术优势及市场竞争优势将受到削弱。

五、实际控制人变动的风险

本公司董事长兼总经理沈建平先生为公司实际控制人。本次发行前，沈建平先生直接持有公司股份 27,760,070 股，占总股本的 34.70%。本次发行后，持有公司 25.94%的股份，仍为公司第一大股东。由于沈建平先生持股比例较低，在公司上市之后存在其他股东利用二级市场收购公司股份，从而获得企业控制权的可能性。因此，公司存在发行上市后实际控制人变动的风险。

六、募集资金投资项目的风险

（一）募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济环境、市场供求、产业政策等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目的组织管理、设备供货衔接、安装调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如有不当，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。

（二）产能不能及时消化的风险

本次募集资金投资项目为：①半导体防护功率器件生产线项目，②新型功率半导体器件生产线技改项目，③半导体封装生产线项目。项目建成投产后，公司防护器件的产能将从现在的 1.3 亿只/年增加至 3.52 亿只/年，VDMOS 的产能将从现在的 1 亿只/年增加至 2.4 亿只/年，同时在现有封装产能 1.3 亿只/年的基础上增加封装产能 6.5 亿只/年作为配套。

虽然巨大的市场需求为本次募集资金投资项目的成功实施提供了有力的保障，但是若市场容量增速低于预期、或发行人市场开拓不力，募集资金投资项目将给发行人带来产能不能及时消化的风险。

（三）固定资产折旧增加的风险

最近三年及一期，公司固定资产折旧金额较大，分别为 467.71 万元、1,492.35 万元、2,365.50 万元和 1,357.68 万元。公司本次募集资金投资于新建半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目和新建半导体封装生产线项目，项目建成后每年新增固定资产折旧 1,268 万元。上述三个项目完全达产后，预计将新增年利润总额 8,118 万元，其中半导体防护功率器件生产线项目预计新增利润总额 2,748 万元，新型功率半导体器件生产线技改项目预计新增利润总额 3,657 万元，半导体封装生产线项目预计新增利润总额 1,713 万元。

尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的市场调研和论证，但如果募投项目市场拓展不足，在固定资产折旧增加的同时，无法实现预期的投资收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在投资项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存在由于净资产收益率下降所引致的风险。

七、对外担保风险

随着近几年经营规模的持续扩张，本公司对资金的需求量快速上升，为满足生产经营的资金需求，公司与资产质量优良、经营业绩良好的企业采取互保的方式获得银行贷款。截至本招股说明书出具日，公司对外担保金额为 1,500 万元，全部为对南方涂装的担保。上述担保事项根据公司章程等规定，已经履行了内部审批和决策程序，同时南方涂装为公司银行借款 1,000 万元提供担保，南方涂装的关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司银行借款 3,950 万元提供担保。上述公司与本公司均无关联关系。

尽管南方涂装的经营情况良好（详见本招股说明书“**第十五节 其他重要事项** /三、发行人对外担保情况/（一）发行人对外互保情况”），公司仍然存在因担保对象无法如期偿还本息而承担担保责任的风险。

八、股市风险

股票市场的交易价格受到诸多因素的影响，除公司的经营状况、盈利能力、发展前景以外，还取决于国家的宏观经济状况、金融政策、股市供求关系、国际政治经济变化和投资者投资心理等各种因素的影响，存在着股票的市场价格低于投资者买入股票时价格的风险，投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的认识。

第五节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：江苏东光微电子股份有限公司

英文名称：Jiangsu Dongguang Micro-electronics Co.,Ltd.

注册资本：8,000 万元

法定代表人：沈建平

成立日期：1998 年 8 月 31 日

整体变更设立日期：2003 年 6 月 12 日

注册地址：江苏省宜兴环科园绿园路 42 号

邮政编码：214205

电话：0510-87138930

传真：0510- 87138931

互联网网址：www.jsdgme.com

电子信箱：lyzhou@jsdgme.com

二、发行人改制重组情况

（一）设立方式

本公司系经江苏省人民政府苏政复[2003]41号《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》批准，由宜兴市东大微电子有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以截止2003年2月28日经审计的净资产22,675,311.12元按1：1的比例折为22,675,311.00股，剩余0.12元计入资本公积。2003年6月12日，公司在江苏省工商行政管理局领取了注册号为3200002102661的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

本公司的发起人为沈建平、詹文陆、徐志祥、林钢、陈俊标、李国华和钱旭锋，共七名自然人。

（三） 发行人改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司发起设立时，持有本公司 10%以上股份的主要发起人为沈建平、詹文陆和徐志祥。在公司改制设立前，沈建平除持有本公司 43.58%的股权外，无其他对外投资和从事其他业务；詹文陆除持有本公司 19.91%的股权外，无其他对外投资和从事其他业务；徐志祥除持有本公司 11.95%的股权外，无其他对外投资和从事其他业务。

（四） 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

由于本公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，因此本公司整体承继了宜兴东大的资产和业务。本公司设立时主要从事半导体器件、集成电路的开发、设计、制造和销售业务，本公司设立时拥有与上述业务相关的经营性资产，主要包括：生产经营场所（土地和厂房）、办公场所、生产设备、专利技术、商标和其他相关的经营性资产。本公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务在公司变更设立前后没有变化。

（五） 发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务与本公司成立前相比未发生变化。

（六） 发行人业务流程

本公司为有限责任公司整体变更设立，整体变更前后，公司业务流程未发生变化。具体业务流程详见本招股说明书“**第六节 业务和技术/四、发行人主营业务的具体情况/（三）主要经营模式**”。

（七） 发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司成立以来，主要发起人沈建平为公司的银行借款提供担保，公司向沈建平的妹妹沈建琴与他人共同控制的公司——无锡市盛泰电子器件有限公司销售产品，详见“**第七节 同业竞争与关联交易/二、关联方、关联关系和关联交易**”。

除此之外本公司在生产经营方面与主要发起人不存在其他关联关系。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人系有限责任公司整体变更设立，发行人前身宜兴东大的资产负债全部由发行人承继，货币资金、机器设备、房屋建筑物、无形资产等资产的产权变更手续已全部完成。上海万隆众天会计师事务所有限公司（现已更名为“国富浩华会计师事务所有限公司”）对发行人截至2003年4月22日申请变更设立登记的注册资本实收情况进行了审验，并出具了万会业字（2003）第819号《验资报告》。

（九）发行人独立运行情况

本公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与各股东完全分离、相互独立。公司具有独立完整的供应、生产及销售系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。

1、业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立对外签订合同，开展业务，形成了独立面向市场自主经营的能力，公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产独立

公司通过整体变更设立，所拥有的与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的机器设备、房屋、土地使用权、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他企业及个人提供担保的情形。

3、人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘请独立董事，由董事会聘用高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪。公司的人事及工资管理完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了经理层，建立了较为健全的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。公司设有独立的职能部门，组织结构健全，独立开展生产经营活动，在机构设置上与控股股东完全分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

5、财务独立

公司独立开设银行账号，基本开户银行为中国银行宜兴市环科园支行，账号为 03601948091001；公司设有独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计准则的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户。公司办理了独立的税务登记证，税务登记证号为宜国税登字 320282703536127 号，公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

三、发行人设立以来股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）发行人设立以来股本形成及其变化情况

1、1998年，宜兴东大设立

（1）宜兴东大设立基本情况

公司的前身为1998年8月31日成立的宜兴市东大微电子有限公司，由国营宜兴丝绸厂和李国华、林钢、赵永良三名自然人共同投资设立，注册资本为226万元。国营宜兴丝绸厂以房屋建筑物和机器设备等实物资产出资203万元，占注册资本的89.82%，李国华以现金出资9万元，占注册资本的3.98%，林钢和赵永良

各以现金出资7万元，各占注册资本的3.10%。江苏宜兴会计师事务所对国营宜兴丝绸厂用于出资的房屋建筑物和机器设备等实物资产进行了评估，并出具了宜会师评（98）第11号《关于国营宜兴丝绸厂部分资产评估报告书》，国营宜兴丝绸厂用以出资的房屋建筑物的评估价值为117.49万元，机器设备的评估价值为116.89万元，共计234.38万元。各股东约定，评估价值高于国营宜兴丝绸厂出资额的31.38万元作为宜兴东大对国营宜兴丝绸厂的负债。

本次出资已经江苏宜兴会计师事务所出具的苏宜会师报内字（1998）第126号《验资报告》验证。1998年8月31日，宜兴东大在宜兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3202821106190号的《企业法人营业执照》。

各股东的出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	国营宜兴丝绸厂	203.00	89.82	实物
2	李国华	9.00	3.98	货币
3	林钢	7.00	3.10	货币
4	赵永良	7.00	3.10	货币
合 计		226.00	100.00	-

国营宜兴丝绸厂原系全民所有制企业，1996年10月11日，宜兴市计划经济委员会和宜兴市经济体制改革委员会出具宜计经林（1996）237号《关于同意宜兴丝绸厂实行股份合作制的批复》，同意国营宜兴丝绸厂实行股份合作制。1997年5月20日，国营宜兴丝绸厂完成改制工作并在宜兴市工商行政管理局办理了工商变更登记，注册号为14281669-7，经济性质为股份合作制，法定代表人为沈建平，注册资金为340.80万元，住所为宜城镇分路口，经营范围：主营白厂丝、丝织品制造、丝线加工，兼营茧丝副产品制造。1999年7月29日，国营宜兴丝绸厂更名为宜兴丝绸厂。

（2）宜兴丝绸厂出资房屋、机器设备主要项目和后续使用情况

宜兴丝绸厂本次出资房屋和机器设备一直用于宜兴东大的生产经营。截止本招股说明书出具日，出资房屋和机器设备的使用情况如下表所示：

项目	单位	数量	评估价值（万元）	目前状态
房屋	仓库	-	115.86	在用

	水泥场地	-	-	1.00	
	围墙	-	-	0.63	
	小计	-	-	117.49	
机器设备	配电设备	套	1	10.54	在用
	制水设备	套	1	25.79	在用
	排风装置	套	1	0.56	在用
	储气罐	只	28	1.49	在用
	磨片机	台	1	2.01	在用
	抛光机	台	1	3.62	在用
	镀膜机	台	1	5.80	在用
	监控仪	台	1	3.72	在用
	高温扩散炉	台	4	32.47	在用
	电话机	台	1	0.37	在用
	光刻机	台	3	5.86	1 台在用，2 台报废
	烘箱	台	1	2.65	报废
	粘片机	台	6	4.32	报废
	测试仪	台	10	6.76	报废
	热电偶	台	1	0.29	报废
	显微镜	台	3	0.36	报废
	稳压器	台	1	0.38	报废
	真空泵	台	3	0.72	报废
	空气压缩机	台	1	0.23	报废
	电焊机	台	1	0.12	报废
	空调	台	5	2.70	报废
	超声清洗机	台	1	1.38	报废
	涂胶机	台	2	1.27	报废
	空调	台	1	0.36	报废
	冰柜	台	1	0.16	报废
	电视机	台	1	0.21	报废
	平板电炉	台	1	0.09	报废
	简易吊车	台	1	1.78	报废
	电热恒温调节器	台	1	0.88	报废
	小计	-	-	116.89	-
合计		-	-	234.38	-

2、2000年，宜兴东大股权转让

（1）本次股权转让基本情况

宜兴东大成立于 1998 年 8 月 31 日，当年未形成销售。1999 年处于产品研发和市场开拓阶段，销售收入较少，仅为 70.89 万元，当年亏损 101.64 万元。

2000 年初，宜兴东大业务仍然没有快速拓展，处于继续亏损的状态，而作为股东的宜兴丝绸厂自身也亏损严重，决定通过减员减负、盘活资产等方式摆脱困境。由于半导体行业并非宜兴丝绸厂的主业，且宜兴东大处于亏损状态，宜兴丝绸厂认为其经营风险较大，决定将其持有的宜兴东大全部股权予以转让。

2000 年 4 月 5 日，宜兴市东大微电子有限公司通过股东会决议，同意宜兴丝绸厂将其对宜兴东大的全部出资额 203 万元按 1:1 的价值转让给七名自然人，其中沈建平 80 万元、詹文陆 50 万元、徐志祥 30 万元、陈俊标 18 万元、林钢 11 万元、李国华 9 万元和徐桂玲 5 万元，同时赵永良将其对宜兴东大的全部出资额 7 万元按 1:1 的价值转让给林钢。沈建平、詹文陆、徐志祥、陈俊标、林钢、李国华和徐桂玲均已支付了全部转让款，2000 年 5 月 8 日，宜兴东大办理了工商变更登记手续。

转让完成后，各股东持股情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈建平	80.00	35.40
2	詹文陆	50.00	22.12
3	徐志祥	30.00	13.27
4	林钢	25.00	11.06
5	陈俊标	18.00	7.96
6	李国华	18.00	7.96
7	徐桂玲	5.00	2.21
合 计		226.00	100.00

2000年3月3日,宜兴丝绸厂召开了第一届股东代表大会第三次会议和第十二职工代表大会,审议通过了将宜兴丝绸厂持有的宜兴东大的股份全部转让给自然人持股。宜兴方正会计师事务所有限公司接受宜兴东大的委托,对宜兴东大的全部资产和负债进行了评估,并于2000年3月25日出具了宜方正评字(2000)第228号《资产评估报告》(以下简称“228号《资产评估报告》”)。截至2000年2月28日,宜兴东大的资产总额审计值为604.93万元,评估值为515.34万元;负债总额审计值为679.56万元,评估值为679.56万元;净资产审计值为-74.64万元,评估值为-164.22万元。宜兴丝绸厂上级主管部门宜兴市计划经济委员会(以下简称“宜兴市计经委”)对宜兴东大的资产进行了清查,并于2000年5月9日出具《关于宜兴东大微电子有限公司资产清查的报告》(以下简称“资产清查报告”),确

认宜兴东大资不抵债达164.22万元。宜兴市国有资产管理局于2000年6月8日出具了宜国评（2000）确认第25号《关于资产评估报告确认的批复》，对宜兴方正会计师事务所有限公司出具的（2000）第228号《资产评估报告》的评估结果进行了确认。

无锡市国有资产管理委员会于2004年3月17日出具锡国资委发[2004]2号《关于确认宜兴市东大微电子有限公司2000年股权转让的意见》对宜兴丝绸厂的上述股权转让行为进行了确认，江苏省人民政府办公厅于2004年5月13日出具苏政办函[2004]45号《江苏省人民政府办公厅关于确认宜兴市东大微电子有限公司股权转让的函》对宜兴丝绸厂的上述股权转让行为进行了确认：宜兴市东大微电子有限公司成立于1998年8月31日，注册资本226万元。2000年4月，公司实施改制，宜兴丝绸厂将其所持有的203万元出资额转让给沈建平等7名自然人。经核，该次转让符合有关法律、法规的规定，转让双方均按当时法律、法规要求办理了必要手续。现对该次股权转让予以确认。

（2）宜兴市计划经济委对宜兴东大的资产清查报告和评估报告之间的关系

根据1991年11月16日发布的《国有资产评估管理办法》（国务院令第91号）第十八条的规定“委托单位收到资产评估机构的资产评估结果报告书后应当报其主管部门审查；主管部门审查同意后，报同级国有资产管理行政主管部门确认资产评估结果”，江苏东光作为委托单位将宜兴方正会计师事务所有限公司出具的228号《资产评估报告》报送主管部门宜兴市计经委审查，为保证评估结果客观、准确，避免国有资产流失，宜兴市计经委成立了改制工作组财务清理组对宜兴东大资产进行了清理并出具了《资产清查报告》，确认宜兴东大资不抵债达164.22万元。宜兴市计经委对228号《资产评估报告》审查同意后，报宜兴市国有资产管理局确认资产评估结果。宜兴市国有资产管理局于2000年6月8日出具了宜国评（2000）确认第25号《关于资产评估报告确认的批复》，对宜兴方正会计师事务所有限公司出具的（2000）第228号《资产评估报告》的评估结果进行了确认。

因此，宜兴市计经委出具的《资产清查报告》是其作为宜兴东大主管部门对其所管理的国有资产的清理检查，是对228号《资产评估报告》结果的确认。

（3）沈建平等七名自然人的身份以及与宜兴丝绸厂、宜兴东大的关系

沈建平等七名自然人的身份以及与宜兴丝绸厂、宜兴东大的关系如下表所示：

序号	股东	该次股权转让发生时的身份	与宜兴东大的关系	与宜兴丝绸厂的关系
1	沈建平	宜兴东大总经理	宜兴东大董事长兼总经理	2000年4月前任宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记
2	林 钢	宜兴东大副总经理	宜兴东大副总经理	无
3	陈俊标	宜兴东大副总经理	宜兴东大副总经理	无
4	李国华	宜兴东大副总经理	宜兴东大副总经理	2000年4月前任宜兴丝绸厂工会主席
5	詹文陆	江苏省农行科技处干部	无	无
6	徐志祥	珠海经济特区东南实业公司总经理	无	无
7	徐桂玲	个体经营	无	无

（4）选择沈建平等七名自然人作为本次股权转让受让人的原因和依据

2000年3月，宜兴丝绸厂因亏损严重，决定通过减员减负、盘活资产等方式摆脱困境。在此背景下，宜兴丝绸厂股东代表大会、职工代表大会作出决议，决定将其持有的宜兴东大全部股权予以转让。因宜兴东大当时已资不抵债，寻找交易方较困难，宜兴丝绸厂基于维护职工利益、保持宜兴东大稳定及其后续经营的开展等考虑，向当时宜兴东大的经营层表达了向其转让股权的意愿。宜兴东大当时经营层全部成员沈建平、陈俊标、林钢、李国华因看好半导体产业未来的发展前景，表示愿意受让。因无足够的资金支付能力，宜兴东大经营层向宜兴丝绸厂推荐了对宜兴东大未来发展有帮助且愿意购买宜兴东大股权的詹文陆、徐志祥和徐桂玲3人受让部分股权。宜兴丝绸厂和上述七名自然人经平等协商后最终达成了股权转让协议。

宜兴东大净资产评估值为-164.22万元，宜兴丝绸厂其对宜兴东大的全部出资额203万元按1:1的价值对外转让，看好半导体行业发展前景的7名自然人受让了该部分股权，本次转让以国有股东的原始出资额为转让价格，没有损害国有股东的利益。

3、2003年，宜兴东大股权转让

2003年2月18日，宜兴东大通过股东会决议，同意股东詹文陆、林钢、徐志祥、陈俊标和李国华分别将其对宜兴东大的出资额5万元、2.5万元、3万元、3万元和5万元转让给沈建平，转让价格分别为12.50万元、6.25万元、7.50万元、7.50万元和12.50万元；公司股东徐桂玲将其对宜兴东大的出资额5万元转让给钱旭锋，转让价格10.50万元。2003年2月28日，宜兴东大办理了工商变更登记手续。本次股权转让价格是由转让方与受让方自行协商确定，因此不同股东之间的股权转让价格有所不同。

转让完成后，各股东持股情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈建平	98.50	43.58
2	詹文陆	45.00	19.91
3	徐志祥	27.00	11.95
4	林钢	22.50	9.96
5	陈俊标	15.00	6.64
6	李国华	13.00	5.75
7	钱旭锋	5.00	2.21
合 计		226.00	100.00

4、2003年，宜兴东大整体变更设立股份公司

根据2003年3月8日宜兴东大股东会决议及江苏省人民政府苏政复[2003]41号《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》，宜兴市东大微电子有限公司依法整体变更为江苏东光微电子股份有限公司。2003年3月12日，宜兴东大各股东签署了《发起人协议》，根据上海万隆众天会计师事务所有限公司（现已更名为“国富浩华会计师事务所有限公司”）出具的万会业字（2003）第337号《审计报告》，公司以2003年2月28日为基准日审定的净资产22,675,311.12元按1：1的比例折为22,675,311.00股，剩余0.12元计入资本公积，公司原股东出资比例不变。上海万隆众天会计师事务所有限公司（现已更名为“国富浩华会计师事务所有限公司”）出具万会业字（2003）第819号《验资报告》进行了验证。

2003年6月12日，公司在江苏省工商行政管理局领取了注册号为3200002102661的《企业法人营业执照》。

整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈建平	9,881,901	43.58
2	詹文陆	4,514,654	19.91
3	徐志祥	2,709,700	11.95
4	林钢	2,258,461	9.96
5	陈俊标	1,505,641	6.64
6	李国华	1,303,830	5.75
7	钱旭锋	501,124	2.21
合 计		22,675,311	100.00

5、2006年，江苏东光增资

（1）本次增资的基本情况

2005年12月12日，江苏东光通过股东大会决议，同意江苏东光增加注册资本至68,185,515元，其中原股东按原出资比例以截止2005年5月31日公司经审计的未分配利润20,000,000元转增公司股本20,000,000股；新股东中国—比利时直接股权投资基金以现金出资40,000,000元，按每股1.96元的价格增加公司股本20,408,163股；沈建平以现金出资10,000,000元，按每股1.96元的价格增加公司股本5,102,041股。本次增资已经上海立信长江会计师事务所有限公司出具信长会师报字（2005）第22918号《验资报告》进行验证。2006年1月19日，江苏东光办理了工商变更登记手续。

增资后，各股东持股情况如下：

序 号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈建平	23,699,941	34.76
2	中比基金	20,408,163	29.93
3	詹文陆	8,496,654	12.46
4	徐志祥	5,099,700	7.48
5	林钢	4,250,461	6.23
6	陈俊标	2,833,641	4.16
7	李国华	2,453,830	3.60
8	钱旭锋	943,125	1.38
合 计		68,185,515	100.00

公司就 2003 年整体变更和本次未分配利润转增股本涉及股东个人所得税的事项，于 2010 年 6 月 4 日向宜兴市地方税务局提交了《关于请求缓交个人所得税的请示》，请求缓缴因上述事项涉及的个人所得税，宜兴市地方税务局于 2010

年6月4日书面批复同意了该请示。

2010年6月5日，公司全体发起人出具《承诺函》，承诺：“当税务主管部门要求本人补缴上述个人所得税时，本人将根据税务主管部门的要求，及时足额缴纳上述税款；本人保证与做出本承诺的其他自然人按照当时各自持股比例全额承担江苏东光由此可能遭受的任何损失或支付的费用，并承担连带责任。”

（2）本次增资协议的主要内容

中比基金增资公司的协议主要内容如下：

①签约主体：甲方为沈建平、詹文陆、徐志祥、林钢、李国华、陈俊标、钱旭锋；乙方为中比基金。

②增资目的：甲方为扩大公司市场份额，购进新设备，引进乙方作为新的投资者对公司进行增资，并将增资款专项用于购买 VDMOS 生产线。

③增资方式：

A、公司未分配利润中的 2,000 万元按甲方原投资比例转增股本，转股比例为 1 元转 1 股，转股后股本共 42,675,311 股，每股净资产 1.77 元，其余账面未分配利润由增资后新老股东按新持股比例共同享有。

B、甲方沈建平先生及乙方均以 1.96 元/股的价格对公司增资。甲方沈建平增资 1,000 万元，其中 5,102,041 元计入实收资本，计为 5,102,041 股，剩余部分计入资本公积；乙方增资 4,000 万元，其中 20,408,163 元计入实收资本，计为 20,408,163 股，剩余部分计入资本公积。计入资本公积部分由增资后的新老股东按新持股比例享有。

④乙方权利：

A、赎回：起始日后 5 年内，如由于公司经营业绩不符合上市要求，或是仅由于政策原因而未能在上海、深圳等证券交易所上市，乙方可要求原股东或公司以现金形式赎回乙方所持全部股份，赎回价格为：赎回日公司账面净资产×乙方所持股权比例。

B、稳健持续经营保证：起始日后，如公司经营业绩连续两年净资产收益率

（扣除非经常性损益）低于 10%，则乙方有权要求原股东或公司以现金形式赎回乙方所持股权，赎回价格可为：4,000 万元+（4,000 万元×20%×起始日到赎回日天数/365-赎回日前乙方已分配的现金红利）。

C、反稀释条款：基于下列前提，乙方原则同意公司向国内外知名的主要原材料供应商、客户或产业战略合作者或其他投资者认可的投资者增发股份。前述前提条件包括但不限于：

a、新股东的投资溢价比应不低于乙方本次增资的溢价比；（本次乙方的投资溢价，双方确认为：1.96:1）

b、新股东的介入将不会使沈建平先生失去控制权并且不得使乙方所占股份低于 25%，除非经中比基金书面同意；

c、新股东同意公司于上海/深圳证券交易所发行或投资者认可的其他股票市场上市，并同意在上市发行条件成就时，积极促成公司股票上市；

d、新股东原则上应以对公司增资形式介入，而不是受让公司原有股东已持有之股份。

⑤公司股东大会权限调整：公司股东大会以特别决议通过的，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上（不包括四分之三）通过。

⑥公司董事会人员调整：公司董事会新增 7 名董事，总数为 12 名，其中 4 名独立董事。新增董事中，乙方直接委派 2 名董事并向股东大会推荐 2 名独立董事，沈建平先生委派 1 名董事，并向股东大会推荐 2 名独立董事。

（3）本次增资协议的履行情况

依据《增资协议》完成对公司的增资后，中比基金以实际履约行为对《增资协议》的部分内容予以变更，具体情况如下：

①中比基金已放弃基于《增资协议》约定的稳健持续经营保证条款，要求缔约对方或公司赎回股份的权利。

②《增资协议》关于公司股东大会作出特别决议的约定，已被公司股东大会

决议修改。公司现行有效的公司章程规定，股东大会作出特别决议应由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

③《增资协议》关于对公司董事会的调整未完全执行，当时增资完成后，公司董事会实际人数变更为 8 名董事，中比基金向公司推荐的两名候选人当选公司董事。2008 年 1 月后，公司董事会人数变更为 9 名董事，中比基金向公司推荐一名董事。

④《增资协议》关于公司董事会决策程序的约定，已被公司股东大会决议修改。公司现行有效的公司章程关于董事会决策程序的内容，与公司法的有关规定相一致。

2010 年 3 月 22 日，《增资协议》的原签约方沈建平、詹文陆、徐志祥、林钢、李国华、陈俊标、钱旭锋和中比基金共同签订《<增资协议>之补充协议》，签约方根据上述实际履行《增资协议》过程中对协议内容的变更，约定《增资协议》中与上述实际履约不一致的条款以及《增资协议》关于中比基金股权赎回约定的其他条款无效，该等无效条款不再履行，不能再恢复；该等条款视为从来不曾约定过，签约方无权依该等条款向对方提出任何主张或权利要求，而无论其据以提出主张或权利要求的行为发生在补充协议签订之前或之后。

2010 年 7 月 8 日，《增资协议》的原签约方沈建平、詹文陆、徐志祥、林钢、李国华、陈俊标、钱旭锋和中比基金共同签订《<增资协议>之补充协议二》，签约方确认，原协议第 8.5 条（反稀释条款）在江苏东光作出公开发行股票并上市的决议前，被双方有效执行。为支持江苏东光的发展壮大，双方确认不再执行原协议第 8.5 条，自本协议生效之日该条款对江苏东光及协议双方不再有任何法律约束力，各方无权依该条款向任一方提出任何主张或权利要求。

6、2007年，江苏东光增资

2007年4月30日，江苏东光通过股东大会决议，同意新股东丁达中以现金出资25,046,708.00元，按每股2.12元的价格增加公司股本11,814,485股，公司的总股本增加至80,000,000股。本次增资的作价依据为公司2006年经审计的每股净利润的9.34倍，本次增资已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2007）第

22925号《验资报告》进行验证。2007年5月28日，江苏东光办理了工商变更登记手续。

增资后，各股东持股情况如下：

序 号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈建平	23,699,941	29.63
2	中比基金	20,408,163	25.51
3	丁达中	11,814,485	14.77
4	詹文陆	8,496,654	10.62
5	徐志祥	5,099,700	6.37
6	林钢	4,250,461	5.31
7	陈俊标	2,833,641	3.54
8	李国华	2,453,830	3.07
9	钱旭锋	943,125	1.18
合 计		80,000,000	100.00

7、2007年，江苏东光股权转让

（1）股权转让基本情况

2007年6月26日，公司股东丁达中分别与白群、张志宏等12名自然人签订《股权转让协议》，将其持有的公司6,150,000股股份以2.12元/股的价格分别转让白群2,500,000股、张志宏1,500,000股、徐荣琇500,000股、何赛娟500,000股、李烈心300,000股、顾淑娟200,000股、吴燕200,000股、王全100,000股、沈克强100,000股、赖央央100,000股、唐金凤100,000股和施永才50,000股。

2007年6月26日，公司股东詹文陆、徐志祥、林钢和李国华分别与沈建平签订《股权转让协议》，分别将其持有的公司1,699,331股、1,019,940股、850,092股和490,766股股份以2.12元/股的价格转让给沈建平。

上述股权转让的作价依据为公司2006年经审计的每股净利润的9.34倍，股权转让款均已支付完毕。

2007年6月28日，江苏东光办理了工商变更登记手续。

转让完成后，各股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈建平	27,760,070	34.70
2	中比基金	20,408,163	25.51

3	詹文陆	6,797,323	8.50
4	丁达中	5,664,485	7.08
5	徐志祥	4,079,760	5.10
6	林钢	3,400,369	4.25
7	陈俊标	2,833,641	3.54
8	白群	2,500,000	3.13
9	李国华	1,963,064	2.45
10	张志宏	1,500,000	1.88
11	钱旭锋	943,125	1.18
12	徐荣琇	500,000	0.63
13	何赛娟	500,000	0.63
14	李烈心	300,000	0.38
15	顾淑娟	200,000	0.25
16	吴燕	200,000	0.25
17	王全	100,000	0.13
18	沈克强	100,000	0.13
19	赖央央	100,000	0.13
20	唐金凤	100,000	0.13
21	施永才	50,000	0.06
合 计		80,000,000	100.00

截至本招股说明书签署日，公司上述股权结构未再发生变化。

（2）丁达中以及 2007 年新增的其他自然人股东的身份情况

丁达中以及 2007 年新增的其他自然人股东的身份情况如下表所示：

序号	股东	身份职务
1	丁达中	宜兴市恒越冶金炉料有限公司总经理
2	白群	南通融汇房地产开发有限公司副总经理
3	张志宏	福建南平针织总厂工会干事（退休）
4	徐荣琇	江苏泰德工贸发展公司财务科长（退休）
5	何赛娟	宜兴市三江机电设备有限公司职员
6	李烈心	自由职业
7	顾淑娟	宜兴工商银行职员（退休）
8	吴燕	陶都房地产开发公司职员
9	王全	公司副总
10	沈克强	东南大学副教授、公司核心技术人员

11	赖央央	自由职业
12	唐金凤	自由职业
13	施永才	宜兴市八达电缆厂厂长

（3）上述股权转让的原因

①丁达中股权转让的原因

2007年5月，丁达中、白群、张志宏、何赛娟、徐荣琇、李烈心、顾淑娟、吴燕、唐金凤、赖央央、施永才共计11名自然人共同以丁达中的名义出资认购公司新增股份。2007年6月，公司了解上述情况后，要求上述股东清理委托持股。经上述11名自然人股东协商，约定丁达中将为其余10名股东代持的股份分别回转给相应股东。为此，丁达中分别与其余10名股东签订了《股权转让协议》，股权转让价格与增资价格相同（即2.12元/股），并办理了工商变更登记手续。

同时，为了协助公司保持核心管理层和技术骨干队伍的稳定，丁达中同意将自己持有的部分股权转让给公司副总经理王全和公司核心技术人员沈克强。为此，丁达中分别与王全和沈克强签订了《股权转让协议》，股权转让价格为2.12元/股，并办理了工商变更登记手续。

根据丁达中等股东出具的《情况说明》确认，上述股权转让均已签订《股权转让协议》，股权转让后不再存在任何委托持股情况，上述13名股东持有江苏东光的股权无任何纠纷或争议。

保荐人认为：发行人自然人股东之间存在的委托持股情形，已于2007年6月进行了清理。相关股东均签订了《股权转让协议》，并办理了工商备案手续。发行人自然人股东之间存在的委托持股情形已清理完毕，不存在权属纠纷。

②詹文陆、徐志祥、林钢和李国华股权转让的原因

2007年5月丁达中对公司增资后，公司股本增至8,000万元，实际控制人沈建平持股数量为23,699,941股，占总股本的比例从34.76%降为29.63%。为了加强对公司的控制权，维持公司经营稳定性，保证公司长期稳定发展，沈建平向詹文陆等部分股东表达了收购部分股权的意愿。鉴于公司成立以来，沈建平一直

作为公司的控股股东和实际控制人负责公司的生产经营，并取得了较好的业绩，经协商，詹文陆、徐志祥、林钢和李国华同意将各自持有的 1,699,331 股、1,019,940 股、850,092 股和 490,766 股股份以 2.12 元/股的价格转让给沈建平。此次股权转让后，沈建平的持有公司的股份数量增至 27,760,070 股，占总股本的比例增至 34.70%，其持股比例有所提高，达到了加强公司控制权的目的。

（二）发行人设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来，没有进行过重大资产重组。

四、发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性

（一）验资情况

自股份公司前身宜兴市东大微电子有限公司设立以来，共进行了四次验资，具体情况如下：

1、1998年8月21日，江苏宜兴会计师事务所对宜兴东大设立时各股东的出资情况进行了审验，并出具了苏宜会师报内字（1998）第126号《验资报告》，确认截至1998年8月21日止，宜兴东大已收到各股东投入的资本人民币226万元，其中实物资产203万元、货币资金23万元。

2、2003年4月25日，上海万隆众天会计师事务所有限公司（现已更名为“国富浩华会计师事务所有限公司”）对江苏东光微电子股份有限公司（筹）申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，并出具了万会业字（2003）第819号《验资报告》，确认截至2003年4月22日止，江苏东光（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（股本）合计人民币22,675,311元，各股东以拥有的宜兴东大2003年2月28日经审计的净资产22,675,311.12元，按1：1的比例折股出资，不足1元部分计入资本公积。

3、2005年12月31日，上海立信长江会计师事务所有限公司对江苏东光新增注册资本进行了审验，并出具了信长会师报字（2005）第22918号《验资报告》，确认截至2005年10月17日止，江苏东光已收到新老股东缴纳的新增注册资本人民

币45,510,204元，其中以货币出资25,510,204元，以未分配利润转增20,000,000元。

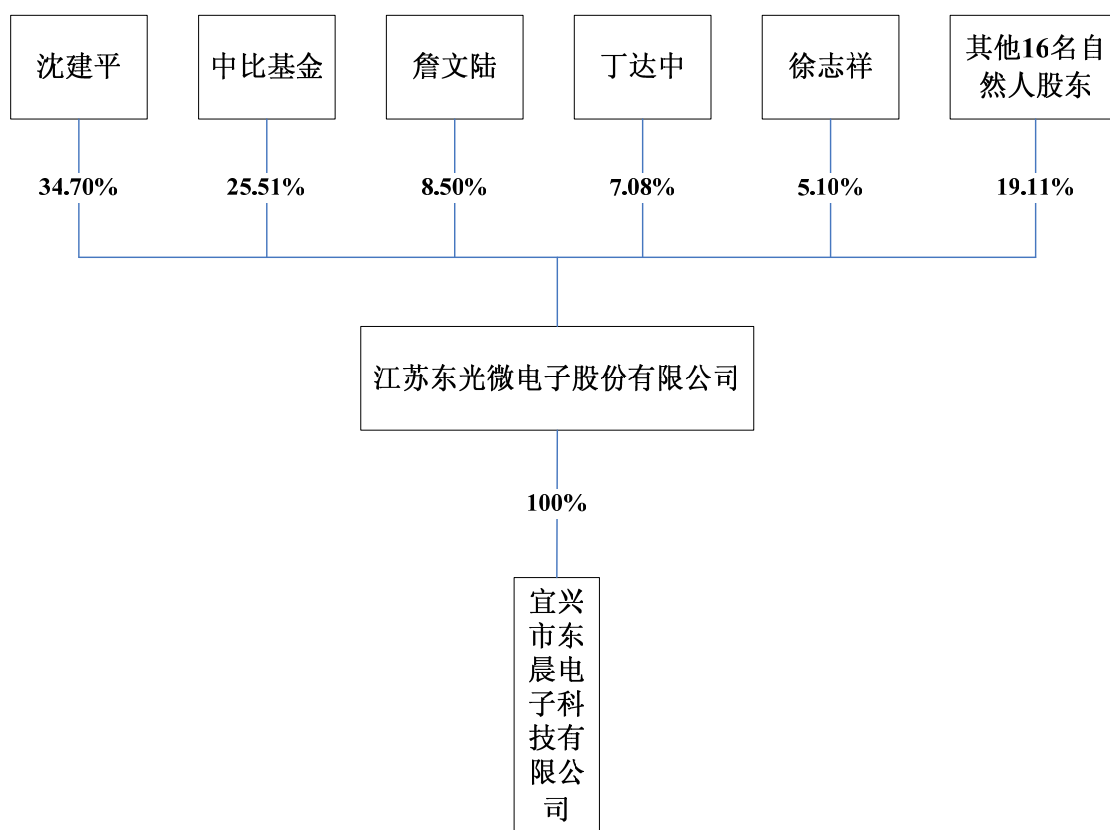
4、2007年5月19日，立信会计师事务所有限公司对江苏东光新增注册资本进行了审验，并出具了信会师报字（2007）第22925号《验资报告》，确认截至2007年5月18日止，江苏东光已收到丁达中缴纳的新增注册资本人民币11,814,485元，均为货币出资。

（二）公司设立时发起人投入资产的计量属性

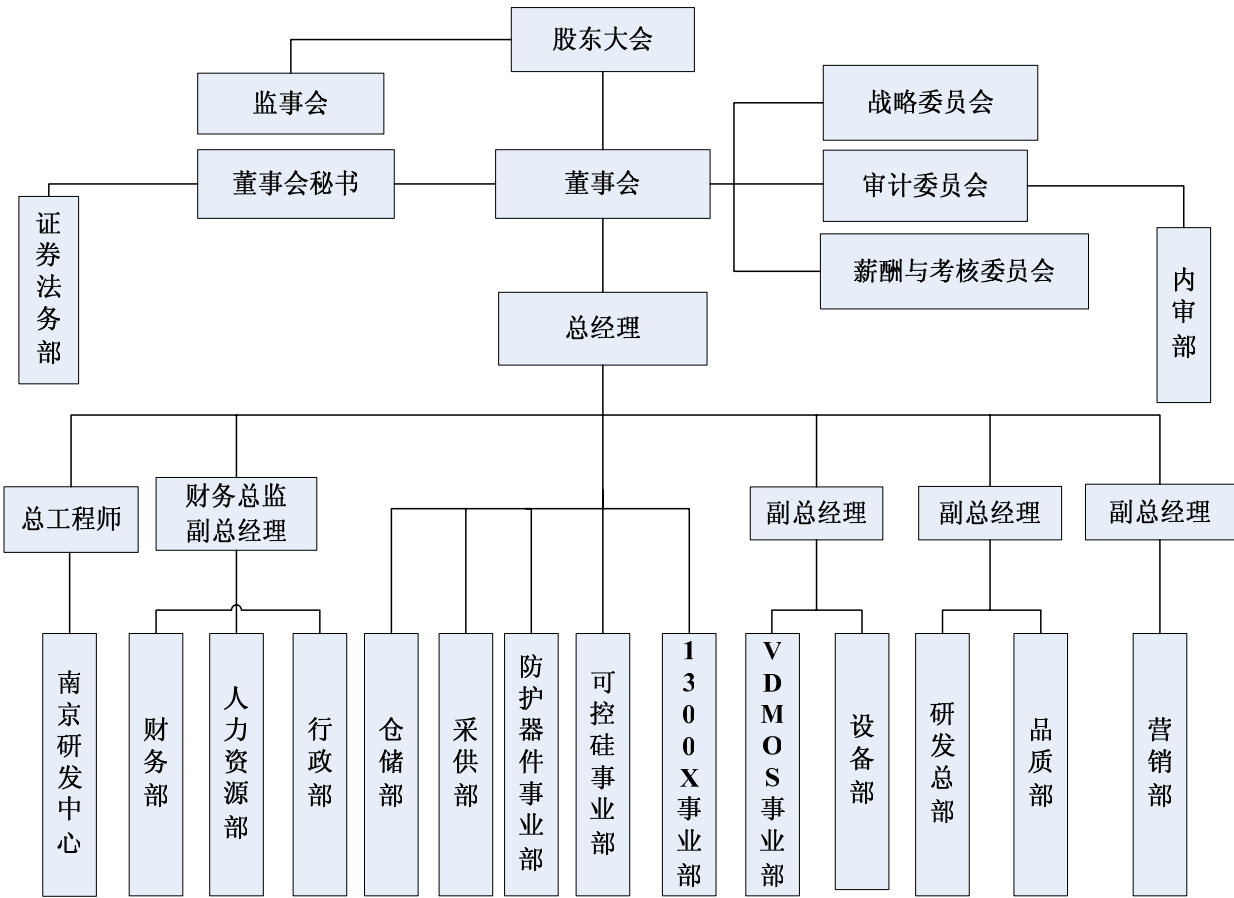
本公司是由有限责任公司整体变更方式设立的，公司设立时，以宜兴东大截至2003年2月28日经审计的净资产，按1：1 的比例折为22,675,311股。

五、发起人的组织机构

（一）公司外部组织结构图



（二）发行人内部组织结构



（三）发行人内设各部门的职能

部 门	主 要 职 责
南京研发中心	1、搜集了解公司现有产品及计划开发产品的市场、技术现状及发展趋势等方面的资料情报； 2、开展公司新产品的市场调研工作； 3、遵守公司关于技术保密工作的管理规定，管理好公司知识产权所属的技术内容，确保公司技术不泄露、不失密； 4、定期到公司现场进行技术指导； 5、对公司新开发产品的版图进行设计、对现有产品的版图进行改良； 6、配合研发总部做好公司的技术开发管理工作； 7、参加与公司相关行业协会及相关学术领域的学术讨论。
行政部	1、公司各类文稿的文印管理工作； 2、公司印章管理工作； 3、公司相关会议事宜的安排； 4、安全保卫管理工作；

	5、公司各类文书档案的管理工作； 6、公司车辆调度安排工作。
证券法务部	1、首次公开发行股票的准备工作和； 2、上市后证券策划运作和对外投资工作； 3、股票、债券的发行和管理事务，拟订和实施资本融资方案； 4、协助董事会秘书作好公司的信息披露、股东查询、定期报告等日常工作及筹备和组织召开股东大会和董事会，并起草有关会议资料； 5、搜集整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与本公司相关的法律政策和规定； 6、为本公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并处理有关法律文件的起草和法律事务； 7、参与公司各部门对外经济合同的签定工作； 8、指导和处理本公司系统各业务部门对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务； 9、处理本公司的非诉讼性经济案件； 10、组织实施全公司的普法教育工作。
财务部	1、日常财务核算，调配资金； 2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告； 3、组织编制收支计划、公司的月、季、年度营业计划和财务计划、公司经营报告资料以及年度预算资料汇总； 4、异常帐款的处理等工作； 5、公司现有资产的管理； 6、成本管理和成本分析； 7、税务及税法研究。
人力资源部	1、劳动用工管理制度； 2、员工招聘、人才招聘； 3、公司员工培训管理工作； 4、公司员工考勤、工资、奖金管理工作； 5、公司员工的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和生育保险的社会保险计划管理工作； 6、公司员工的考核晋升管理工作； 7、人事档案管理工作； 8、公司ERP网络管理工作。
营销部	1、公司产品的市场开发、产品销售的处理等工作； 2、制定公司年度销售计划； 3、制定产品的销售价格及价格策略； 4、销售发货审核、发货回单签收、销售发票签收管理工作； 5、新客户的市场开发工作； 6、客户资料档案，收集客户信息；定单（合同）管理和交货期的管理工作；客户质量反馈的处理工作和客户质量满意度的收集工作； 7、应收帐款的管理工作； 8、公司产品的运输和配送。

仓储部	1、负责做好物资仓储保管管理工作； 2、负责对进仓货物的验收和出库货物的清点工作； 3、负责材料发放管理，余料报告； 4、负责材料保管及个人使用的工具管理与账务； 5、负责对库建的规划与整理和安全维护； 6、负责库存物资的盘点工作； 7、负责物资、产品账、物、卡核对； 8、负责物资、产品的运送服务和管理工作； 9、负责物资、产品搬运、装卸工作。
采供部	1、各类物资的采购及入库管理工作； 2、制定公司各类生产物资的需求计划、储备计划、采购计划和资金计划； 3、落实公司大宗物资及主要原辅材料、产品委托外加工的采购招标工作； 4、供应商的管理、评审工作； 5、外加工单位的外协管理工作； 6、原材料、备品、备件及产成品等各类物资的储备管理。
研发总部	1、新产品、新技术及新工艺的开发工作； 2、拟制公司年度及近期新产品、新技术及新工艺的开发计划； 3、学习掌握新产品、新技术及新工艺开发所必须的技术知识和工作能力； 4、按计划完成公司下达的新产品、新技术及新工艺的开发计划； 5、搞好新产品、新技术及新工艺开发完成后的各项相关工作； 6、做好新产品的验证鉴定、新产品投产前的准备、各种技术文件准备及技术培训等方面的工作； 7、配合营销部门做好新产品的市场开发工作； 8、配合各事业部做好公司的技术管理工作。
品质部	1、原材料进厂检验、产品质量检验、可靠性试验； 2、公司产品生产过程检验工作、现场质量管理工作； 3、公司产品出库检验工作； 4、公司质量认证、内审工作、日常检查和客户工厂审查； 5、产品品质信息质量反馈工作； 6、供应商的审查、合格供应商的认定工作； 7、仪器仪表的采购、计量、车间洁净度的测量； 8、三废治理工作，确保达标排放。
设备部	1、设备的使用、检修、保养、封存管理工作； 2、设备的采购、验收； 3、组织设备操作、设备维修保养等方面的培训与考核工作； 4、动力配套设施的管理工作； 5、设备台帐管理； 6、检查各部门设备的操作、维修、保养工作，发现问题纠正改善； 7、设备的备件储备、入库、保管工作； 8、组织处理重大设备事故等工作。
VDMOS 事业部	1、完成公司及总经理下达的各事业部生产技术指标； 2、制定完成年度、季度及月度各项生产指标的计划和对策，并组织实施、检查和落实；
防护器件 事业部	3、负责产品实现的策划工作，根据工艺要求制订作业指导书；

可控硅事业部	4、负责公司产品生产、质量的数据统计和分析工作； 5、负责生产现场监督管理制度；
1300 事业部	6、负责生产安全管理制度。
内审部	1、建立内部控制制度并监督检查； 2、对各部门的财务收支及经济活动情况进行内部审计、监督； 3、审查财务账目和会计报表，对公司经理人和财务人员进行离任审计； 4、对有关合作单位和合作项目的财务审计； 5、协助各有关部门进行财务清理、整顿和提高。

六、发行人控股子公司的基本情况

截至本招股说明书签署日，本公司拥有一家全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司，无其他控股和参股子公司。

宜兴市东晨电子科技有限公司成立于 2009 年 12 月 1 日，注册资本及实收资本均为 1,800 万元人民币，法定代表人沈建平，主要生产经营地与注册地均为宜兴市新街街道百合工业园，经营范围：半导体、集成电路的技术设计、开发、推广应用、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司持有其 100%的股权。

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）发起人基本情况

本公司发起人为沈建平、詹文陆、徐志祥、陈俊标、林钢、李国华和钱旭锋七名自然人，基本情况如下：

股东	持股比例	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号码	住所
沈建平	34.70%	中国	否	32022319591205xxxx	江苏省宜兴市宜城街道南仓西村999-9号
詹文陆	8.50%	中国	否	32010619491127xxxx	南京市鼓楼区平家巷8号2幢201室
徐志祥	5.10%	中国	否	32010719480204xxxx	南京市玄武区文昌街2号新楼4舍601室
陈俊标	3.54%	中国	否	32022319650403xxxx	江苏省宜兴市新街镇堂前村是婆圩66号

林钢	4.25%	中国	否	32022319511122xxxx	江苏省宜兴市新街镇新乐村小桥999-1号
李国华	2.45%	中国	否	32022319500802xxxx	江苏省宜兴市宜城街道朝阳路111号301室
钱旭锋	1.18%	中国	否	32022319710429xxxx	江苏省宜兴市宜城街道丝绸花园72号104室

（二）持有5%以上股份的股东及实际控制人基本情况

持有本公司 5%以上股份的股东共有 5 名，分别为沈建平、中比基金、詹文陆、丁达中和徐志祥。

1、沈建平

沈建平先生持有本公司 34.70%的股份，为本公司主要发起人、控股股东、实际控制人。截至本招股说明书签署日，沈建平先生持有本公司的股份不存在质押或者其他有争议的情况。同时，沈建平先生除拥有本公司股权外，未持有其他任何公司或其他机构、组织的股权或权益。

沈建平先生为本公司董事长兼总经理，其简介详见本招股说明书“**第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员**”。

2、中比基金

中比基金持有本公司 25.51%的股份。中比基金成立于 2004 年 11 月 18 日，注册资本及实收资本均为壹亿欧元，法定代表人卢力，注册地及主要经营地均为北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 10 层，经营范围为对未上市企业进行股权投资；在一级市场认购中国政府发行的债券及其他固定收益债券；向被投资企业提供管理咨询；主管机关批准的其他业务。中比基金的股东构成如下：

股东名称	出资额（万欧元）	占注册资本的比例（%）
中方：		
全国社会保障基金理事会	1,500	15.00
国家开发银行	1,500	15.00
中国印钞造币总公司	1,300	13.00
国家开发投资公司	1,000	10.00
海通证券股份有限公司	1,000	10.00
广东喜之郎集团有限公司	1,000	10.00
中华人民共和国财政部	850	8.50
中方合计	8,150	81.50

外方：		
比利时富通银行	1,000	10.00
比利时政府	850	8.50
外方合计	1,850	18.50
合计	10,000	100.00

目前中比基金委托海富产业投资基金管理有限公司作为基金资产管理人，委托上海浦东发展银行作为基金资产托管人。

截至 2009 年 12 月 31 日，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，中比基金总资产 161,480.58 万元，净资产 114,641.20 万元，2009 年度实现净利润 55,997.86 万元。

3、詹文陆

詹文陆先生持有本公司 8.50% 的股份，为本公司主要发起人之一，其简介详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

4、丁达中

丁达中先生持有本公司 7.08% 的股份，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：32022319561025xxxx，住所：江苏省宜兴市宜城街道公园路 3 号 204 室。

5、徐志祥

徐志祥先生持有本公司 5.10% 的股份，为本公司主要发起人之一，其简介详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

八、发行人的股本情况

（一）本次发行前及发行后的股本情况

本次发行前，公司总股本为 8,000 万股，本次拟发行 2,700 万股，发行后公司总股本为 10,700 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25.23%。本次发行前后公司股本结构如下：

股东名称	发 行 前		发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
沈建平	27,760,070	34.70	27,760,070	25.94
中比基金	20,408,163	25.51	20,408,163	19.07

股东名称	发 行 前		发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
詹文陆	6,797,323	8.50	6,797,323	6.35
丁达中	5,664,485	7.08	5,664,485	5.29
徐志祥	4,079,760	5.10	4,079,760	3.81
林钢	3,400,369	4.25	3,400,369	3.18
陈俊标	2,833,641	3.54	2,833,641	2.65
白群	2,500,000	3.13	2,500,000	2.34
李国华	1,963,064	2.45	1,963,064	1.83
张志宏	1,500,000	1.88	1,500,000	1.40
钱旭锋	943,125	1.18	943,125	0.88
徐荣琇	500,000	0.63	500,000	0.47
何赛娟	500,000	0.63	500,000	0.47
李烈心	300,000	0.38	300,000	0.28
顾淑娟	200,000	0.25	200,000	0.19
吴燕	200,000	0.25	200,000	0.19
王全	100,000	0.13	100,000	0.09
沈克强	100,000	0.13	100,000	0.09
赖央央	100,000	0.13	100,000	0.09
唐金凤	100,000	0.13	100,000	0.09
施永才	50,000	0.06	50,000	0.05
本次公开发行的股票	-	-	27,000,000	25.23
总股本	80,000,000	100.000	107,000,000	100.000

（二）发行人前十名股东

本次发行前，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈建平	27,760,070	34.70
2	中比基金	20,408,163	25.51
3	詹文陆	6,797,323	8.50
4	丁达中	5,664,485	7.08
5	徐志祥	4,079,760	5.10
6	林钢	3,400,369	4.25
7	陈俊标	2,833,641	3.54
8	白群	2,500,000	3.13
9	李国华	1,963,064	2.45
10	张志宏	1,500,000	1.88

（三）前十位自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署之日，发行人前十位自然人股东在公司担任职务的具

体情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	在公司担任职务情况
1	沈建平	27,760,070	34.70	董事长兼总经理
2	詹文陆	6,797,323	8.50	董事
3	丁达中	5,664,485	7.08	-
4	徐志祥	4,079,760	5.10	副董事长
5	林钢	3,400,369	4.25	监事会主席
6	陈俊标	2,833,641	3.54	董事、副总经理
7	白群	2,500,000	3.13	-
8	李国华	1,963,064	2.45	监事
9	张志宏	1,500,000	1.88	-
10	钱旭锋	943,125	1.18	董事、副总经理、财务总监

（四）股东中的战略投资者持股及其简况

本公司不存在战略投资者。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间不存在关联关系，除控股股东外的其他股东之间不存在一致行动的其他协议或安排。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人沈建平承诺：对于所持有的江苏东光股份，自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。

除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等19名自然人股东承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员沈建平、詹文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王全承诺：除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个

月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

本次发行前各股东所持股份在上述承诺期限届满后可以上市流通和转让。

九、员工及社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

近三年及一期来，公司的员工人数保持相对稳定，公司员工2007年为532人，2008年为539人，2009年为590人，2010年6月30日为609人。

（二）员工专业结构

截至2010年6月30日，公司员工专业结构如下：

专 业	人 数	比 例（%）
管理人员	77	12.64
技术人员	104	17.08
销售人员	32	5.26
生产人员	396	65.02
合 计	609	100.00

（三）员工受教育程度

截至2010年6月30日，公司员工受教育程度如下：

学 历	人 数	比 例（%）
本科及以上	64	10.51
大专	183	30.05
大专以下	362	59.44
合 计	609	100.00

（四）员工年龄分布

截至2010年6月30日，公司员工年龄分布如下：

年 龄	人 数	比 例（%）
30 岁以下	237	38.92
31~40 岁	265	43.51
40 岁以上	107	17.57
合 计	609	100.00

（五）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

本公司员工实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家及地方政府的有关法律、法规规定，保障员工享受福利、养老保险、失业保险和工伤保险等各项社会保险，并定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险费用。

此外，公司已于 2010 年 2 月 22 日开立职工住房公积金账户，单位住房公积金代码 311201445，并从 2010 年 1 月起开始为员工缴纳住房公积金。根据公司为员工缴纳住房公积金的实际情况，控股股东沈建平先生出具了如下承诺：“如果发生江苏东光被要求为其员工补缴或补偿 2010 年之前年度应由其缴付的住房公积金的情况，本人将全额承担该费用，并保证江苏东光不会因此遭受任何损失。”

十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

1、公司全体股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员出具了股份流通限制和自愿锁定股份方面的《承诺书》，详见本节“**八、发行人的股本情况/（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺**”。

2、公司控股股东沈建平出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见“**第七节 同业竞争与关联交易/一、同业竞争情况**”。

3、就公司存在不规范使用票据的行为，公司控股股东沈建平出具了《承诺函》，详见“**第十一节 管理层讨论与分析/一、财务状况分析/（二）负债结构/2、流动负债构成/（2）应付票据分析**”。

4、就公司为其员工缴纳住房公积金的情况，公司控股股东沈建平出具了《承诺函》，详见本节“**九、员工及社会保障情况/（五）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况**”。

5、就 2003 年整体变更和本次未分配利润转增股本涉及股东个人所得税的事项，公司全体发起人出具《承诺函》，详见本节“**三、发行人设立以来股本形成及其变化和重大资产重组情况/（一）发行人设立以来股本形成及其变化情况/5、2006 年，江苏东光增资**”。

第六节 业务和技术

如无特别说明，本节数据资料均引自赛迪顾问《2008-2009 年中国分立器件市场研究年度报告》、《2009-2010 中国集成电路市场研究年度总报告》、《2008-2009 年中国半导体功率器件市场研究年度报告》、《2010 年中国半导体市场研究报告精华汇编》。

一、发行人的主营业务及其变化情况

本公司是享受国家政策扶持的高新技术企业，系国内半导体分立器件和集成电路行业中通讯用防护功率器件、VDMOS 等细分领域市场的重点企业。公司主营业务为半导体分立器件、集成电路的开发、设计、制造和销售，主要产品涵盖四大系列：包括防护功率器件系列产品，VDMOS 系列产品，可控硅系列产品，1300X 系列产品。产品广泛应用于通信设备、网络设备、数字电视、民用电路、摩托车、电动工具、家用电器、节能灯、消费电子、汽车电子、设备和仪表等领域。

公司在半导体分立器件和集成电路诸多细分领域具有较强的技术优势、领先的市场地位和较高的市场占有率。公司的半导体防护功率器件被中国电信等基础电信运营商认定为其设备供应商的指定采购产品，因此在国内通讯用防护功率器件领域市场占有率多年来排名第一，2009 年该市场占有率达到 80%以上。

公司于 2003 年用国产设备成功生产出可控硅产品并打入市场。在此之前，国内可控硅生产厂商多采用进口设备进行生产，而且大部分公司以 OEM 方式为国外厂商代工，因此公司的产品上市后依靠性价比的优势，迅速打开了市场。近年来，公司成功进入了可控硅产品应用的高端领域，是国内较早进入吸尘器用可控硅市场的企业，成功地打破了国外进口产品的垄断，目前在该应用领域的可控硅市场占有率较高，在国内可控硅生产企业中排名领先。

公司生产的 VDMOS 产品为近年来公司新研发生产出的高端半导体功率器件产品，目前国内半导体行业中主要有江苏东光、华微电子、华润华晶、士兰微和中环股份等企业能够生产该类半导体功率器件并通过客户检测、成功投放市

场。本公司的 VDMOS 产品于 2008 年 3 月开始投放市场，2008 年、2009 年、2010 年 1-6 月公司 VDMOS 产品的销量分别为 1,867.95 万只、4,349.50 万只、3,325.56 万只，拥有客户一百多家，其中包括为戴尔、富士康、LG、松下、飞利浦、西门子等国际知名厂商配套的电源系列产品生产厂家，在市场上影响力较大，享有一定的知名度。

自公司设立以来，主营业务没有发生变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）半导体分立器件和集成电路行业简介

公司所属行业为半导体行业的子行业——半导体分立器件和集成电路行业，从 2009 年全球半导体市场产品结构来看，集成电路和分立器件合计占到半导体市场容量的 90.2%。

半导体产业的发展始于分立器件，分立器件是半导体产业的最初产品。由于其具有诸多优良的特性，如：使用灵活性，可在众多线路中应用，低成本制作芯片的工艺，高成品率，特殊器件的不可替代性（如大功率、高反压、高频以及特殊工艺的分立器件）等，使分立器件长期以来作为半导体产品的基本支持。

半导体分立器件种类繁多，具有广泛的应用范围和不可替代性，并具有技术成熟、可靠性高、成本低且采购渠道和资源丰富等特点。尽管集成电路的发明和迅速发展使一些器件已集成进集成电路，使得分立器件与集成电路有了许多交叉领域，但在许多不能集成的功能中，半导体分立器件仍起着关键的作用。

集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构，其中所有元件在结构上已组成一个整体。集成电路具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好、成本低等优点，便于大规模生产。集成电路按集成度高低的不同可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路和超大规模集成电路。

半导体分立器件和集成电路在工业控制、消费电子、计算机与外设、网络通信、设备与仪器仪表、汽车电子、指示灯/显示屏、电子照明等方面得到了广泛的应用。

半导体分立器件和集成电路行业从产业的制造环节上来看，可分为芯片设计、芯片制造、封装测试几个步骤。目前全球主要的半导体分立器件和集成电路厂商由于其技术发展纯熟、规模化程度较高，因此大多专注于利润率较高的芯片设计环节，同时，为了降低制造成本，大的国际厂商多将芯片制造、封装等工序外包给代工厂生产，中国国内的许多半导体元器件厂家，即是通过为国际厂商做代工而发展起来的。

就半导体分立器件和集成电路制造的技术水平本身而言，芯片设计属于进入壁垒最高的环节，而封装的进入壁垒相对较低，因此，国内的半导体分立器件和集成电路企业多数以做封装为主，部分厂商主要为国际公司进行 OEM 的芯片制造，只有少数国内企业掌握了芯片设计的工艺技术。

封装测试行业作为国内半导体产业的主体，前几年其销售收入一直占产业整体规模的 70%以上，封装测试行业销售收入的增长对国内半导体产业整体规模的扩大起着极大的带动作用。近几年随着设计和芯片制造行业的迅猛发展，国内半导体价值链格局正在发生改变，其趋势是设计业和芯片制造业所占比重迅速上升，封装测试业比重则逐步下降，但封装测试行业仍占据国内半导体产业的半壁江山。2008 年中国内地半导体产业价值链格局为：芯片设计占 18%，芯片制造占 32%，封装测试占 50%。因此，我国半导体芯片设计业和制造业发展的相对滞后制约了我国半导体行业的健康发展。

（二）行业监督管理体制及主要法律法规

1、行业监管体制

行业主管部门工业和信息化部和中国半导体行业协会构成了半导体行业管理体系，各半导体制造企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

（1）行业主管部门

工业和信息化部是半导体行业的主管部门。工业和信息化部主要负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定行业法律、法规，发布行政规章，并负责行政执法和执法监督；组织制定行业技术政策、技术体制和技术标准，指导产品质量监督与管理；根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构、产品结构和企业结构调整等。

（2）行业自律组织

中国半导体行业协会（CSIA）是我国半导体行业的自律性组织和协调管理机构，该协会下设五个分会：半导体分立器件分会、半导体封装分会、半导体支撑业分会、集成电路分会和集成电路设计分会。

中国半导体行业协会主要职能包括贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业相关政策的咨询意见和建议；调查、统计、研究、预测本行业产业与市场；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准，并推动标准的贯彻执行；维护会员合法权益，反对不正当竞争，保护知识产权，促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善等。

本公司是中国半导体行业协会、江苏省半导体行业协会理事单位，公司董事长沈建平先生为江苏省半导体行业协会常务理事；同时本公司也是中国半导体行业协会分立器件分会的会员单位，公司副总经理陈俊标先生担任分立器件分会理事。

2、行业主要法律法规及政策

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国推出了一系列支持半导体产业发展的政策，主要如下：

主要政策	发布时间	发布部门	有关主要内容
《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）	2000.06.24	国务院	通过实施一系列的投融资政策、税收政策、产业技术政策、进出口政策、收入分配政策、人才吸引与培养政策等优惠政策，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展，力争到2010年使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平，并使我国集成电

			路产业成为世界主要开发和生产基地之一，同时进一步缩小与发达国家在开发和生产技术上的差距。
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）	2000.11.12	财 政 部 国家税务 总 局 海 关总署	贯彻落实国发（2000）18号文，具体落实在增值税、关税、企业所得税等税收方面对软件产业和集成电路产业的优惠政策。
国务院办公厅关于进一步完善软件产业和集成电路产业发展政策有关问题的复函（国办函[2001]51号）	2001.09.20	国务院办 公厅	通过设立风险投资基金、简化进出口通关程序、支持企业积极参与国际竞争和国际合作、加强对人才培养、创新教育模式等政策，进一步为软件产业和集成电路产业发展创造良好政策环境。
《国家产业技术政策》（国经贸技术[2002]444号文）	2002.06.21	国家经贸 委，财 政 部，科 技 部，国家税 务总局	“深亚微米集成电路、新型元器件”列入我国的重点产业技术发展方向。
《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》（财建[2005]132号）	2005.03.23	财政部、 信息产业 部、国家 发展改革委	由中央财政预算安排，划拨专项用于支持集成电路产业研究与开发活动的资金，用于无偿资助集成电路企业的研发活动。
《江苏省信息产业“十一五”规划》	2006.07.25	江苏省信 息产业厅	通过加大财税扶持力度、构建人才高地、激励创新创业、加快产业结构调整、提高国际化水平、加强行业管理等措施促进鼓励新型元器件、集成电路企业的发展。
《信息产业“十一五”规划》	2007.03.01	信息产业 部	完善集成电路产业链，形成以设计业为龙头、制造业为核心、设备制造和配套产业为基础，较为完整的集成电路产业链。 推动元器件产业结构升级。继续巩固我国在传统元器件领域的优势，加强引进消化吸收再创新和产业垂直整合，加快新型元器件的研发和产业化。
《关于发布第一批国家鼓励的集成电路企业名单的通知》（发改高技[2007]1897号）	2007.08.01	国家发改 委、信息 产业部、 海 关 总 署、国家 税务总局	94家企业（包括江苏东光） 被确认为“第一批国家鼓励的集成电路企业”。其中，江苏东光类别为“芯片制造（线宽小于0.8微米（含））”
《关于组织实施新型电力电子器件产业化专项有关问题	2007.10.05	国家发展 改革委	专项目标：提高新型电力电子器件技术和工艺水平，促进产业发展，满足市场需求，以技术进步和产业升级推进节能降耗；突破核

的通知》			心基础器件发展的关键技术，完善电力电子产业链，促进具有自主知识产权的芯片和技术的推广应用；培育骨干企业，增强企业自主创新能力。支持重点中包括绝缘栅双极晶体管（IGBT）、金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）的芯片设计、制造、封装测试和模块组装的产业化。
《集成电路产业“十一五”专项规划》	2008.01.08	信息产业部	继续落实和完善产业政策，着力提高自主创新能力，推进集成电路产业链各环节协调发展。以应用为先导、优先发展集成电路设计业；积极发展集成器件制造（IDM）模式，鼓励新一代芯片生产线建设，推动现有生产线的技术升级；提升高密度封装测试能力；增强关键设备仪器和基础材料的开发能力。
《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》	2008.01.08	信息产业部	新型元器件产业：以片式化、微型化、集成化、高性能化、无害化为目标，突破关键技术，调整产品结构；促进产业链上下游互动发展，着力培育骨干企业，推动产业结构升级。 大力发展新型半导体分立器件，重点发展半导体电力电子器件，包括纵向双扩散型场效应管 VDMOS，绝缘栅双极型晶体管 IGBT，静电感应晶体管系列 SIT、BSIT、SITH，栅控晶闸管 MCT，巨型双极晶体管 GTR 等。
《电子信息产业调整振兴规划》	2009.04.15	国务院	加快完善体制机制，改善投融资环境，培育骨干企业，扶持中小创新型企业，促进产业持续健康发展；加大财税、金融政策支持力度，增强集成电路产业的自主发展能力；实现电子元器件产业平稳发展；加快电子元器件产品升级；完善集成电路产业体系；在集成电路领域，鼓励优势企业兼并重组；继续保持并适当加大部分电子信息产品出口退税力度，发挥出口信用保险支持电子信息产品出口的积极作用，强化出口信贷对中小电子信息企业的支持。
《江苏省电子信息产业调整和振兴规划纲要》（苏政发〔2009〕76号）	2009.05.14	江苏省人民政府	实现产业结构明显优化的目标，构建集芯片设计、加工制造、封装测试于一体的产业链，提升产业配套能力。集成电路产业作为重点培育的产业之一，提高芯片产品的设计开发水平和自主创新能力，推进集成电路制造和封装业规模化发展。依托骨干企业，推进重点项目建设，提高芯片制造工艺水平。将自主创新和品牌建设作为重点任务之一，大力实施名牌战略，培育一批具有自主知识产权

			和一定规模实力的企业。在新型元器件领域，将高端功率器件和电路制造技术作为重点发展的关键技术之一。
--	--	--	--

半导体行业作为国家的支柱产业之一，长期以来受到各种国家政策的扶持。公司近年来亦获得过多个国家级专项基金的资助：“58S 半导体抑制栅”防护类功率集成电路于 2001 年被国家科技部列入第五批科技型中小企业创新基金项目；2002 年，防护类功率集成电路“YDCLP200M-X 过电压过电流保护集成电路”被认定为国家电子信息产业发展基金第三批重点项目；“DSC3X00 网络安全保护用集成电路研究与开发”被信息产业部列入 2007 年度集成电路研究与开发专项资金使用计划；“DCLP19E 通信安全保护用集成电路的研究与开发”被信息产业部列入 2008 年度集成电路研究与开发专项资金使用计划；2008 年“高速网络用片式功率防护模块”获科学技术部科技型中小企业技术创新基金；2009 年，公司节能型电子电力器件 VDMOS 产业化项目被国家发改委和工信部列入 2009 年新增中央预算内投资计划项目。2010 年，公司承担了工业和信息化部电子信息产业发展基金招标项目，对新型电力电子器件——30A500V 的功率 MOSFET 进行研发及产业化。

2008 年底，公司获准发行 2,000 万元的短期融资券，在全国首批 6 家获准发行短期融资券的中小企业中率先完成发售任务，也是江苏省中小企业发行融资券的“第一单”。

（三）行业市场现状

1、半导体行业市场整体现状

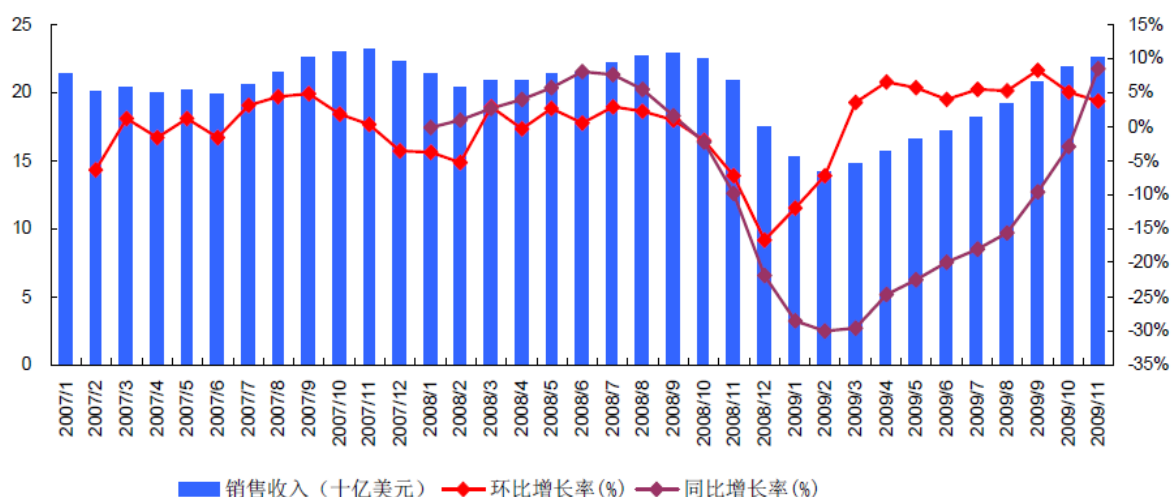
半导体行业是目前世界上发展最为迅速和竞争最为激烈的产业之一，也是全球电子信息的重要支柱产业。2008 年四季度，全球半导体市场开始受到金融危机的强烈冲击，美国半导体行业协会（SIA）的数据显示，2008 年全球半导体市场销售额为 2,486 亿美元，同比下跌了 2.8%。2009 年上半年全球半导体市场同比下滑达 24.8%，全球半导体市场受金融危机的影响继续加深。

自 2009 年四季度开始，半导体行业开始步出金融危机的影响，出现了复苏的迹象。全球半导体市场 11 月份销售额为 226 亿美元，环比上升 3.7%，连续

第 9 个月环比上升，同比增长 8.52%，14 个月来首次实现同比正增长。因此，从 2009 年全年来看，全球半导体市场规模 2,263.1 亿美元，市场同比下滑仅 9%。

2009 年 11 月份，美国半导体销售收入同比大幅增长 25.9%，11 月份美国地区的销售收入为 38.8 亿美元，创 2007 年以来新高，其强劲表现超出市场预期；亚太地区同比增长 12.8%，日本同比下降 5.3%，欧洲同比下降 4.9%。环比来看，欧洲增长 7.7%，欧洲恢复势头得以延续，美国环比增长 6.0%，亚太环比增长 2.4%，日本环比增长 2.7%。总体而言，各地环比增速都有所放缓，但同比势头不错。由于美国集中了全球绝大部分的 IC 设计，其市场走势可作为行业先行指标，当前美国市场的强劲表现预示着未来几个季度半导体市场能持续增长。

全球半导体市场销售额及增长率



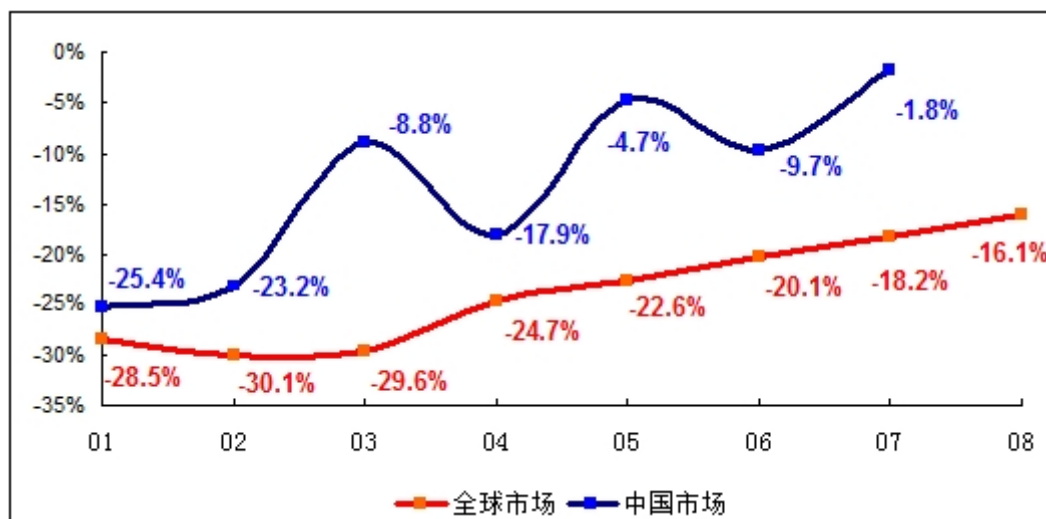
数据来源：SIA，兴业证券研发中心

根据上述趋势，可以预见 2010 年半导体市场会有同比大幅增长。总体而言，半导体市场步入上升通道的趋势已经确立，并将持续到 2012 年以后。另外，由于全球订单进一步转移，国内优势企业受益会更大。

根据中国半导体行业协会的统计数据，中国半导体市场的增速情况明显好于全球市场。从 2009 年前三季度的情况来看，全球市场仍然保持下滑趋势，但市场的下滑幅度逐月收窄，虽然仍然处于负增长的态势，但是可以看出，市场已经开始逐渐复苏。中国市场的发展与全球市场基本类似，虽然有一定波动，但市场的下滑幅度也呈现出逐渐收窄的趋势。市场从 1 月份-25.4%降幅收窄到 7 月份的

-1.8%。从发展速度上看，虽然同样处于下滑趋势中，但是中国市场的衰退幅度明显小于全球市场，尤其是三月份以来，中国市场已经基本能够保持在一位数的衰退幅度之内，外销复苏和内需拉动两方面利好让中国市场发展仍然明显好于全球市场。

2009 年 1-8 月全球及中国半导体市场增速对比



数据来源 SIA,CSIA200909

2、分立器件和集成电路行业现状

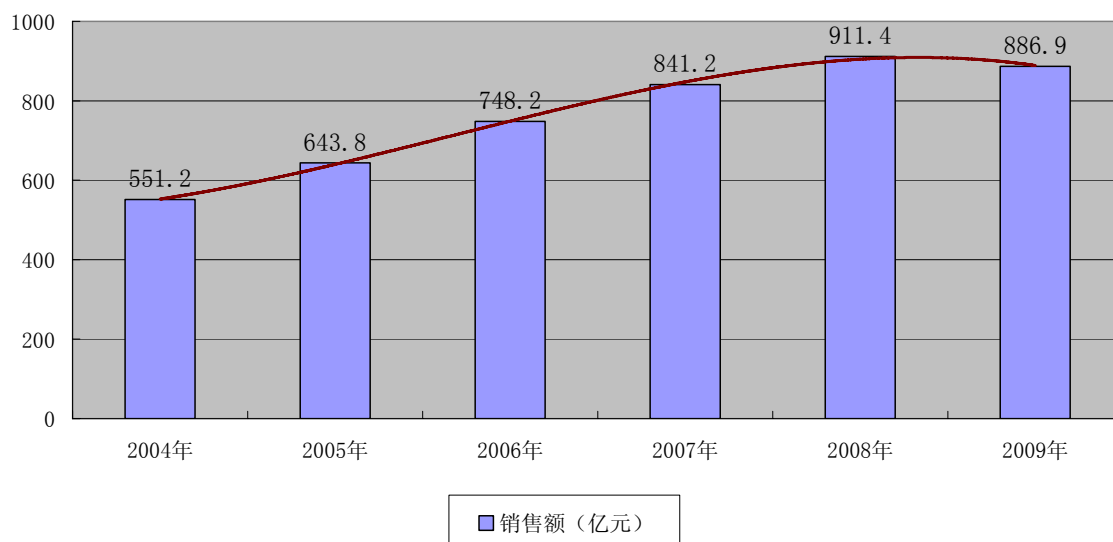
（1）分立器件行业

分立器件行业是高科技、资本密集型行业，作为半导体市场的重要组成部分，2008 年金融危机以来，分立器件市场亦受到半导体整体市场疲软的影响，但在功率器件市场快速增长及其他产品结构升级等有利因素的带动下，2008 年市场规模的增长明显高于半导体市场平均水平，销售额增至 176.9 亿美元，成为引人注目的产品市场。2009 年，金融危机的加深抑制了全球电子产品消费，影响了上游分立器件产业和市场的发展，全球分立器件市场从持续正增长下滑为明显负增长。

就中国半导体分立器件市场而言，受全球经济发展放缓等不利因素的影响，2009 年中国分立器件市场结束了近几年持续增长的发展势头，为 886.9 亿元，比 2008 年小幅下降 2.7%。但与世界其他主要市场相比，中国分立器件市场表现仍

相对较为突出，规模萎缩幅度远远低于全球平均水平，仍是全球最引人注目的市场之一。

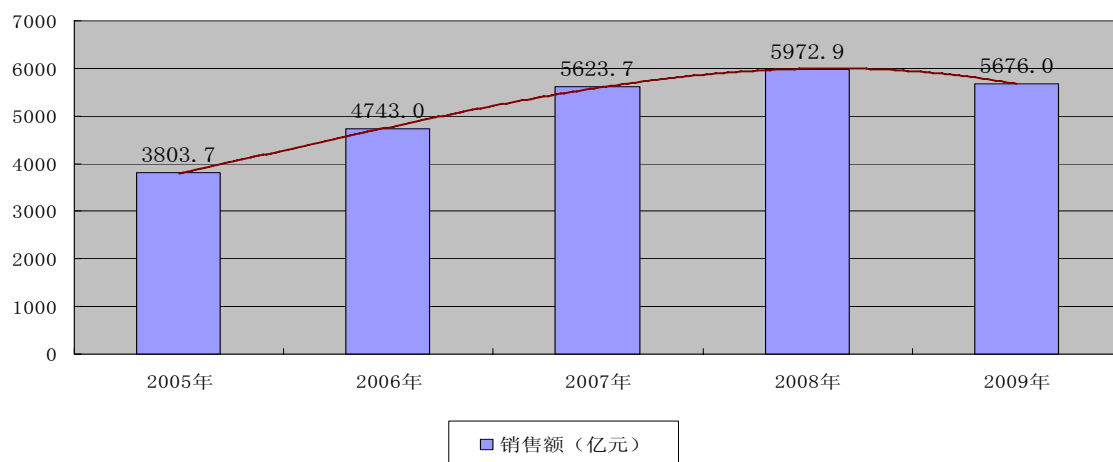
2004-2009年中国分立器件市场销售额与增长



（2）集成电路行业

由于受全球金融危机迅速波及实体经济的影响，2009 年全球集成电路市场规模为 1,900.6 亿美元，市场同比下滑 8.9%。在中国市场方面，在连续 5 年实现增长后，2009 年中国集成电路市场首次出现下滑，下滑的直接原因有两方面，一方面是下游产品对上游集成电路产品需求量下降，另一方面是集成电路产品价格的下降。但随着国家拉动内需政策的迅速制定与深入实施，以及国际市场环境的逐步回暖，2009 年国内集成电路行业呈现显著的触底回升势头。2009 年前 10 个月，无论全球市场还是中国市场都呈现出同比下降幅度逐渐减少的趋势，而到了 11 月份，市场则表现出强劲反弹的趋势，到了 12 月，全球市场同比增速接近 30%，中国市场增速则接近 40%。从 2009 年 2 季度以来，市场已经表现出明显的复苏迹象。2009 年全年中国集成电路市场实现销售额 5,676 亿元，比 2008 年同比下降 5.2%。

2005-2009年中国集成电路市场销售额规模



3、行业竞争格局

中国半导体分立器件和集成电路行业的竞争格局表现为以下几个特点：

（1）跨国公司在规模和实力上优势显著，处于绝对的行业领先地位

跨国公司通过产品进口输入、国内投资设厂两种方式参与国内市场竞争。A、半导体分立器件行业：日本厂商在消费电子、设备与仪器仪表应用领域处于霸主地位，同时在网络通信和指示灯/显示屏领域具有较强的综合实力，代表厂商有东芝（Toshiba）、瑞萨（Renesas）、罗姆（Rohm）等；欧美公司以功率器件产品为主，主要在网络通信、汽车电子、电源管理、计算机及外设等应用领域领先，以仙童（Fairchild）、意法半导体（ST）、安森美（On Semiconductors）等为代表。B、集成电路行业：欧美企业在计算机主机和通讯领域占据较大竞争优势，英特尔（Intel）和超微公司（AMD）几乎垄断了通用 CPU 市场，德州仪器（TI）、意法半导体（ST）和飞思卡尔（Freescale）在通信领域具有很强竞争力；韩国厂商在计算机存储器方面有明显竞争优势，代表企业有三星（Samsung）、海力士（Hynix）；日本厂商在消费电子领域具有很强的竞争力，代表企业有东芝（Toshiba）。

跨国公司在国内市场竞争力表现在以下两方面：

第一、外商进口产品占据国内主要市场份额。A、半导体分立器件：2008 年中国半导体分立器件市场整体销售额为 911.40 亿元，而中国分立器件企业实现销售收入为 149.50 亿元，即进口供给占到中国半导体分立器件市场销售额的 83.6%。同时，2008 年在国内市场占据优势竞争地位的仍是国际厂商，在前 20 大厂商中仅有长电科技、华微电子、华润华晶三家本土企业。从企业规模来看，2008 年前 20 大半导体分立器件厂商所占的国内市场份额比 2007 年小幅上升，为 66.60%。B、集成电路：2009 年中国集成电路市场销售额为 5,676 亿元，而中国集成电路企业销售额为 1,109 亿元，即进口供给占到中国集成电路市场销售额的 80.5%。2009 年中国集成电路市场前 20 大厂商除一家中国台湾企业联发科技（MTK）外，其他全部是外资企业，中国国内企业虽然已经取得一定的发展，但与这些领导企业相比仍然存在很大差距。从企业规模来看，2009 年前 20 大集成电路厂商占的国内市场份额为 65.60%，比 2008 年提高 1.60%。

第二、跨国厂商为了利用国内人力和原材料成本优势，纷纷以独资、合资的形式投资建立生产线，直接参与国内市场竞争。跨国公司凭借出色的技术实力、雄厚的资本、先进的管理经验，居于国内行业领先地位。

综合以上两点，跨国公司占据中国市场供应商的主力位置。

（2）内资企业是国内行业的主要力量，与跨国公司差距逐步缩小

除外商投资企业外，我国大量的分立器件和集成电路企业由国有资本和民营资本所投资。内资企业数量众多，规模、技术水平参差不齐，多数国内厂家还处于规模小、技术水平低、产业布局分散的状态，主要集中在低端产品领域进行竞争。部分厂家采用 OEM 或购买芯片进行后道封装的生产方式，尚缺乏核心竞争力。但国内厂商的整体实力在不断增强，目前，内资企业在高端产品、规模和技术上还不能和国际厂商全面抗衡，但是凭借成本优势已经在国内市场占有一定的市场份额，并逐步在个别产品或领域挤占国际厂商的市场份额。例如，内资厂商已实现节能灯领域的替代进口，包括华润华晶、华微电子、深圳深爱、江苏东光为代表的节能灯用 1300X 系列产品，就已经成功替代了摩托罗拉及飞利浦等厂商的产品；而在通讯防护集成电路领域，江苏东光的固体放电管也已在国内市场成功替代国外企业固体放电管产品；目前 VDMOS 也已经有包括江苏东光在内的

少数国内企业开始投产，随着国内企业在该产品项目上技术成熟度的提高，未来VDMOS产品有望成为国内企业实现替代进口的又一个突破口。

4、行业发展趋势

（1）分立器件行业

从近年全球分立器件市场的发展来看，一大突出特点是，功率器件产品成为最大的热门。功率器件能在高频工作时更节能节材，并且大幅减少设备体积和重量。事实上，功率技术已经成为保持分立器件产品活力的最主要动力。各类电子产品对功率变换、电源管理方面日益增长的需求构成功率晶体管产品最直接的市场增长点，并直接带动了整个分立器件市场的增长。随着市场对环保节能的日益重视，功率技术还将得到进一步的发展，并将成为推动全球分立器件市场持续发展的重要动力。

目前国内半导体分立器件行业的整体水平还比较低，生产能力主要集中于低端产品领域，而在以功率器件为代表的高技术、高附加值、市场份额更大的中高档产品领域，国外企业拥有绝对的竞争优势，国内市场所需产品大量依赖进口。随着国内半导体分立器件行业技术水平的提高和产业升级，实现高档产品替代进口将为国内半导体分立器件产业创造巨大的发展空间。

今后的半导体功分立器件发展方向从结构上看，随着电子产品体积越来越小，分立器件将向着复合型、模块方向发展。从性能上看，大电流、高速、高反压功率半导体分立器件拥有非常稳定的市场需求，由于其不易集成或集成成本太高，具有较强的不可替代性，今后仍是市场需求的主要品种。特别是随着分立器件的产品创新、制造技术的日趋成熟和应用技术的不断升级，功率半导体分立器件的产品格局发生着重大的转变，大电流、高速、高反压功率半导体分立器件将得到越来越广泛的应用，未来市场前景广阔。

另外，近年来追求节能和环保的趋势也对功率器件市场的蓬勃发展推波助澜，尤其是哥本哈根气候会议后中国承诺到2020年碳减排40%-45%。各种应用设计都朝向高效能和低耗电的要求靠近。节能意识的加强，再配合政府的财政补贴政策，空调、冰箱以及洗衣机等变频家用电器用半导体分立器件的市场空间

会越来越大。

（2）集成电路行业

从市场发展趋势来看，无论是全球市场还是中国市场，2010 年将会成为市场复苏的一年，2010 年市场在 2009 年的基础上实现超过 15%的增幅并不困难，具体来看，未来 3 年中国集成电路市场发展速度将保持在 10%以上。分领域来看，计算机领域仍将是未来带动市场发展最重要的领域，汽车电子和 IC 卡领域将保持较快的发展速度，其他领域将随着全球经济的好转而逐步复苏。未来智能手机、液晶电视、电子书、智能表、监控和医疗电子产品等将可能成为推动集成电路发展的热点产品。整体来看，2010 年中国集成电路市场将会步入新一轮的增长期，但市场的发展速度不会再现前几年的高速增长态势，平稳增长将成为未来中国集成电路市场发展的主要形式。

从产品技术趋势来看，集成电路行业仍然处于成长期，技术的不断更新和发展也是推动集成电路市场发展的主要因素之一。对于处理器来说，未来发展方向将以多核结构为主；对于存储器来说，将以更小的工艺尺寸和更高级的封装形式为主；对于模拟芯片和专用集成电路等产品来说，更注重功能方面的发展。此外，集成电路产品已经由提供参考设计（Reference Design）发展到向客户提供完整解决方案（Total Solution），这不仅缩短了下游厂商量产的时间，更降低了整机厂商的技术门槛。综合来看，未来集成电路产品的技术发展趋势除了集成电路本身的架构和工艺进步外，同时还包含了产品应用解决方案的提升。

5、行业进入壁垒

半导体分立器件和集成电路行业在中国市场中属于新兴行业，有国家产业政策的大力支持，具有良好的发展前景。但是随着行业投资强度和技术门槛越来越高，企业的资金实力和技术创新能力日益成为竞争的关键。

（1）技术壁垒

半导体分立器件和集成电路行业是技术密集型的行业，研发能力、工艺技术、品质控制水平和生产管理技术都非常重要，同时，由于下游产品更新换代较快，企业掌握的技术还需要不断创新和提高。研发与生产的有机结合、生产工艺的创

新和改良、品质控制的经验，主要来源于企业长时间、大规模的生产实践和积累，行业新进入者很难在短期内获得。

（2）资金壁垒

半导体分立器件和集成电路行业亦属于资本密集型的行业，需要在设备、净化厂房、技术研发、人力资源等方面有较高的资金投入。较大比例的生产和检测设备需要进口，且因产品配套化及生产规模化的要求，新进入本行业的企业需一次性投入大额固定资产投资。此外，高端产品的研发、试制、检测等亦需要雄厚的资金实力保障，进一步增加了行业新进入者的市场风险。

（3）市场资质壁垒

具备技术和资金的企业仍然不能畅通无阻，企业产品还必须获得进入市场的资质认定，如：国内行业标准、美国 UL 安全认证、欧盟 RoHS 认证、PAHS 认证、德国莱茵 TUV 安规认证等。另外，企业产品还需通过下游客户的供应商资质认定，这不仅是对产品质量和企业管理的考验，也是时间上的考验。下游客户经过多次、多批量的试用后才能确定合作关系，认证过程少则半年长则一年，但一旦获得认证双方的合作关系将会比较紧密。

6、市场供求状况

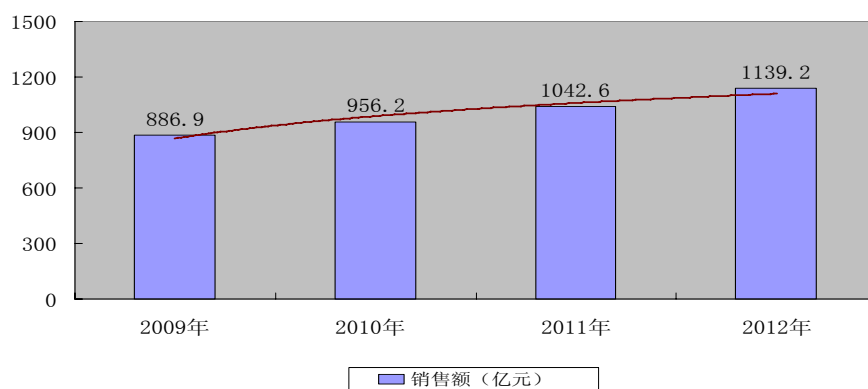
（1）半导体分立器件和集成电路市场需求将持续增长

由于全球经济逐步向好，2010 年半导体分立器件和集成电路市场回暖的趋势将更加明显，在产品升级和电子整机需求迅速回暖的带动下，分立器件和集成电路销售额和销量将呈现持续加速增长的势头。从销售额和销量的对比来看，2010 年之后，分立器件和集成电路市场产品结构升级将有所加快，因此销售额的增长势头将更加强劲。

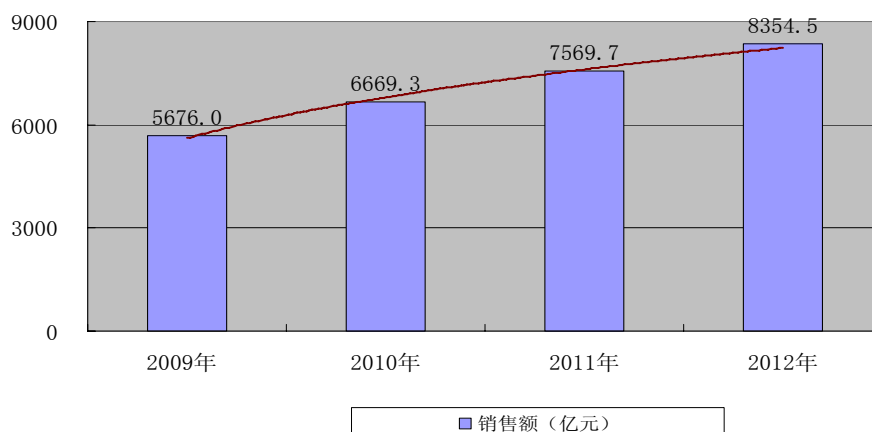
综合来看，2010 年以来，在全球半导体产业复苏与国内内需市场继续保持旺盛的双重带动下，预计国内半导体分立器件和集成电路行业将走出 2009 年的低谷并实现较大幅度的增长，预计 2010 年国内半导体分立器件和集成电路行业销售额增幅分别将达到 7.80%和 17.50%，规模将回复甚至超过 2008 年的水平。而从中长期来看，随着未来国内外市场的进一步回暖，国内半导体分立器件和集

成电路行业又将步入一轮新的增长期。预计未来三年中国半导体分立器件和集成电路市场规模将保持持续增长，其中分立器件到 2012 年可达到 1,139.20 亿元，比 2009 年增长 28.40%，集成电路到 2012 年可达到 8,354.50 亿元，比 2009 年增长 47.20%。

2010-2012年中国分立器件市场销售额规模预测



2010-2012年中国集成电路市场规模预测



（2）国内企业面临替代进口的巨大发展机遇

根据中国半导体行业协会对国内主要分立器件企业的统计，2008 年中国半导体分立器件市场整体销售额为 911.40 亿元，2008 年中国分立器件企业实现销售收入 149.50 亿元，即国内供给仅占我国市场总量的 16.40%；2009 年中国集成电路市场整体销售额为 5,676 亿元，而 2009 年中国集成电路企业实现销售额为

1,109.10 亿元，即国内供给仅占我国市场总量的 19.50%。上述情况说明中国半导体分立器件和集成电路企业整体实力仍然较弱，生产规模仍然较小，还远远不能满足国内市场需求，大部分产品需要从国外进口。但同时我国市场的总量性矛盾和结构性矛盾也表明，国内企业存在替代进口的巨大发展机遇。

7、行业利润水平及其变动

（1）总体上讲，半导体分立器件和集成电路行业将经历价格下跌、利润率水平逐渐收敛的过程。但在未来十年内，我国市场需求仍将保持较快速增长，利润率水平下降过程相对缓慢。

根据产品周期理论，随着我国半导体分立器件和集成电路行业的逐步成熟，最终将进入技术成熟期后的价格自然下跌过程，利润率将回归全球行业平均利润水平。但随着全球制造业向中国转移、上世纪九十年代兴起的网络通讯及 IT 技术革命，以及国内消费结构升级等积极因素作用，国内半导体分立器件和集成电路行业一直处于快速发展中，利润率虽有下降但仍然高于国际同期利润率水平。未来十年，由于国内市场容量巨大，仍将保持旺盛的增长需求，国内厂商的进口替代过程会进一步深化，利润率水平下降过程将相对缓慢。部分厂商甚至会出现因产品结构优化，而利润率水平上升的状况。

（2）半导体分立器件和集成电路行业内部，利润率水平的变动呈现结构性特征

半导体分立器件和集成电路中低端的产品由于技术门槛低，竞争十分激烈，价格将加速下跌，利润空间收窄；甚至部分厂商会因重复生产、无序竞争、原材料价格波动等原因出现亏损。而越高端的产品，如 MOSFET、IGBT 等，技术壁垒越高、资金投入越大，进入者相对较少，利润率水平能在较长的一段时期内保持稳定，甚至随新兴市场需求的增长而有所上升。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策扶持

半导体行业是我国信息产业化的支柱产业之一，国家政府出台了一系列鼓励半导体企业发展的政策，这些政策为我国半导体企业营造了良好的政策环境，在投融资、税收、产业技术、进出口、收入分配、人才吸引与培养、采购以及知识产权保护等方面都给予了大力支持，极大地调动了国内外各方面投资半导体产业的积极性，有力地促进了我国半导体产业的发展。

2007 年《信息产业“十一五”规划》中提出完善集成电路产业链，形成以设计业为龙头、制造业为核心、设备制造和配套产业为基础，较为完整的集成电路产业链。推动元器件产业结构升级，继续巩固我国在传统元器件领域的优势，加强引进消化吸收再创新和产业垂直整合，加快新型元器件的研发和产业化。

2008 年《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》中提出大力发展新型半导体分立器件，重点发展半导体电力电子器件，包括纵向双扩散型场效应管 VDMOS，绝缘栅双极型晶体管 IGBT，静电感应晶体管系列 SIT、BSIT、SITH，栅控晶闸管 MCT，巨型双极晶体管 GTR 等。

2009 年国务院发布了《电子信息产业调整振兴规划》，其中明确提出加快完善体制机制，改善投融资环境，培育骨干企业，扶持中小创新型企业，促进产业持续健康发展；加大财税、金融政策支持力度，增强集成电路产业的自主发展能力；实现电子元器件产业平稳发展；加快电子元器件产品升级；完善集成电路产业体系；在集成电路领域，鼓励优势企业兼并重组；继续保持并适当加大部分电子信息产品出口退税力度，发挥出口信用保险支持电子信息产品出口的积极作用，强化出口信贷对中小电子信息企业的支持。

（2）市场需求持续增长

国内下游产业需求的高速增长是推动我国半导体分立器件和集成电路行业发展的主要驱动因素之一。金融危机以来，虽然美国这个重要市场的需求增速减缓，但国内市场的高速增长在一定程度上对总需求做出了弥补。尤其是汽车电子、照明电子等新兴领域未来数年对半导体器件需求的年均增速均在 30% 左右，将是未来拉动半导体产业发展的重要动力。

（3）进口替代发展机会

逐渐加强的进口替代机会是半导体分立器件和集成电路产业发展的又一重要驱动力。前几年大量进口中高端产品是因为国内自身中高端产品生产能力极其有限，难以从国内下游中高端市场增长中受益，但近年国内半导体分立器件和集成电路制造产业结构向中高端发展，在部分领域开始逐步满足更多的国内中高端需求。从历史数据来看，在过去的几年里，我国半导体产品的自给率在逐年提升。国内企业因此能更多地从国内需求增长中受益。

目前国内半导体分立器件和集成电路市场主要被国际大厂商所占据，而国内制造厂商的供给在总量和结构上都远远不能满足国内市场需求，因此决定了国内企业存在进口替代的巨大发展机会。我国分立器件和集成电路企业随着技术水平的提高和产业升级，依靠我国巨大市场，凭借国内劳动力成本优势以及政策扶持，逐步在部分中高档产品领域实现替代进口是完全可行的。

2、不利因素

（1）跨国企业在国内投资设厂，加剧行业竞争

从 20 世纪 90 年代初开始，国际半导体巨头纷纷来华创办独资或合资企业，转移生产能力。跨国公司向我国本土转移生产线，更贴近中国市场，市场反应更加灵敏和迅速，同时利用国内廉价的原材料和劳动力资源，增强了自身的竞争能力。跨国公司再凭借其先进的技术、雄厚的资本以及灵活的经营方式，确立了市场领先地位，在竞争中处于较为有利的地位。

（2）中高端市场的进入壁垒高

国内半导体分立器件和集成电路企业在国内中低端市场逐步饱和的情况下，进入中高端市场是必然的选择。但是，国内企业进入高端市场在技术、资金和管理方面存在较高的行业壁垒。技术方面，跨国公司对高端技术转移的限制仍将继续。作为战略性产业，全球主要发达国家越来越重视半导体产业的发展，为保持其领先地位，国际半导体巨头仍会对关键技术装备、材料、高端设计和工艺技术向我国的转移进行严格控制，国内产业面临的技术挑战仍将长期存在。资金以及人员方面，除少数行业领先企业具有大规模投资并运营先进生产线的的能力外，绝大部分厂商并不具备相应的条件。这样的竞争格局决定了我国企业赶超跨国领先厂商是一个长期的、艰难的过程。

（五）行业基本特点

1、行业结构发展特点

从行业结构发展来看，我国半导体产业目前发展的三个主要特点，一是产业分布很集中，97%集中在长三角、珠三角和环渤海地区；二是行业整体发展水平还比较落后，低端产品大量出口、高端产品需大量进口；三是行业结构“头轻脚重”，位于中上游的设计、制造业占比很低，下游的封装业占比很高。

2、行业技术发展特点

目前国内半导体分立器件和集成电路行业的技术发展水平呈现不均衡状态。多数国内厂家还处于规模小、技术水平低、产业布局分散的状态，主要集中在低端产品领域进行竞争。部分厂家采用 OEM 或购买芯片进行后道封装的生产方式，尚缺乏核心竞争力。

从产品技术趋势来看，当今世界半导体分立器件和集成电路制造技术快速发展，部分高端功率器件产品技术含量及其制造工艺难度均不亚于超大规模集成电路，如 VDMOS、IGBT 等产品就是采用超大规模集成电路的微细加工工艺技术制作的。

为了适应市场需求的快速变化，通过采用新技术、不断改进材料、结构设计、制造工艺和封装等，分立器件和集成电路的性能不断提高，正朝着高频、宽带、高速、低噪声、大功率、大电流、高线性、大动态范围、高效率、高亮度、高灵敏度、低功耗、低成本、高可靠、微小型等方面不断发展。

同时，随着全社会对环保要求的日益提高，加大开发环保型产品的力度，实现更加“绿色”的生产，也是目前分立器件和集成电路普遍关注的焦点，而在保持较低成本和可靠质量的同时，实现无铅化生产则是其中的关键。

3、行业竞争特点

（1）马太效应日益凸显，资本运作成为规模扩张重要方式

半导体行业是典型的高投入行业。在“摩尔定律”的影响下，半导体产业技术升级的步伐从未减缓，同时伴随着研发与建厂支出的成倍增长。例如，业内主要厂商近年来纷纷投资建设 VDMOS 生产线，中环股份该项目投资总额为 60,960

万元，而华微电子该项目投资总额为 39,345 万元。与此同时，半导体行业又是一个高风险的行业，在这样的产业环境中，只有技术领先、资本雄厚的大型企业才有回旋余地。位居各个细分领域前茅的企业才有较稳固的地位。“大者恒大”的马太效应在半导体领域得到充分的体现。大企业的不断扩张是半导体产业中马太效应的重要表现，Intel、三星、意法半导体等世界半导体巨头，以及高通、博通、联发科等 IC 设计行业领导厂商无不是通过频繁的收购、兼并、重组来达到完善自身技术、进入新兴市场、消灭竞争对手等目的，并最终实现企业规模的迅速扩张。目前国内半导体企业也已经开始通过上市、收购等资本手段实现企业的发展。

（2）技术领先是企业生存并持续发展的重要保证

半导体行业是技术密集型行业，因此技术优势是半导体企业持续发展的核心竞争力。目前我国半导体企业规模、技术水平参差不齐，多数国内厂家还处于规模小、技术水平低、产业布局分散的状态，主要集中在低端产品领域进行竞争。部分厂家采用 OEM 或购买芯片进行后道封装的生产方式，不具备芯片研发设计的技术能力。这种代工生产企业（包括芯片制造与芯片封装）本身处于产业链的中下游，利润与附加值较低。而具备芯片设计能力的公司才处于产业链的上游，其生产的产品利润率高、附加值大，企业抗风险能力也较强。

随着生产技术的提高和企业的不断发展，我国半导体企业越来越重视技术研发，并在多个细分领域通过自主创新实现了替代进口，扩大了市场份额，提升了自主品牌的知名度。未来具备技术领先优势的企业才可能在日益激烈的市场竞争中胜出，进一步做大做强，向国际先进厂商看齐。

（3）产品可靠度、成本与服务网络成为竞争关键

分立器件和集成电路市场的成功要素包括产品可靠度、成本优势，以及服务网络。一方面，提供更具竞争力的产品价格是目前占据中低端市场最直接，也是最有效的手段，这就要求企业不断提升管理水平，提高产品的良率和产能利用率，以更加有效的压缩成本；另一方面，在竞争对手众多，可替代产品众多的市场环境下，除价格、性能以及可靠度等产品内在指标外，售前售后服务和技术支持也日益成为市场竞争的重点。国内的半导体分立器件和集成电路企业只有将产品可

靠度逐步提升、发挥成本优势，同时又具备广泛的销售服务网络，才可望持续受惠于迅速成长的国内市场。

4、行业的周期性、区域性、季节性特征

（1）行业的周期性

半导体产业是一个明显的周期性行业，行业的周期通常也称为“硅周期”，通常持续 4-5 年。硅周期即是指半导体产业在差不多 5 年的时间内就会历经从衰落到昌盛的一个周期。由于我国属于新兴市场，半导体分立器件和集成电路行业处于上升发展时期，预计在未来 5 年国内市场不存在明显的周期性。

（2）行业的区域性

目前我国半导体分立器件和集成电路企业主要集中在长三角、珠三角、京津环渤海等区域，这些地区呈现出明显的集聚和辐射带动效应。西部地区由于投资环境的改善、政策扶持及成本优势的体现，将会成为半导体分立器件和集成电路企业未来重要的投资区域。

（3）行业的季节性

半导体分立器件和集成电路行业具有一定的季节性特征，通常三、四季度为行业销售旺季，主要是因为圣诞节和春节电子产品消费需求的拉动，一季度为行业淡季。但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势。

（六）上下游行业发展状况及与所处行业的关联性

1、上游行业发展状况及关联性

单晶硅材料是发行人的上游行业，单晶硅材料行业技术水平的提升和产能的扩张，有利于企业的采购；相反，如果单晶硅材料供不应求，价格不断上升，则会对公司的盈利能力产生一定负面影响。

单晶硅又是以多晶硅为材料加工而成的，因此多晶硅价格的变化最终影响到半导体分立器件和集成电路行业的生产成本和盈利能力。

2008 年以来，金融危机引发了国外光伏市场的萎缩，导致了暂时性的产能过剩，多晶硅价格大幅下跌，2009 年多晶硅的价格最低跌至 50 美元/公斤，虽然后期走势有所反弹，但多晶硅价格一直处于较低水平。

2009 年底，国家发改委等十部门已将钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅和风电设备等列为产能过剩行业，原则上将不再批准扩大产能的项目。这将使多晶硅现货价格趋于稳定，未来价格快速上涨的风险降低，对半导体分立器件和集成电路行业构成有利影响。

2、下游行业发展状况及关联性

消费电子、计算机与外设、网络通信、设备与仪器仪表、汽车电子、指示灯/显示屏、电子照明等应用领域是发行人的下游，下游行业市场需求的的增长将直接带动本公司产品销售的增长。

从目前国内分立器件产品的市场应用结构看，其销售额主要分布在计算机及外设、网络通信、消费电子、汽车电子、指示灯/显示屏等应用领域，其中居于前三位的计算机及外设、网络通信、消费电子领域所占的市场份额超过 60%，分别为 30.4%、20.6%和 12.0%。从目前国内集成电路产品的市场应用结构看，计算机领域仍然是最大的应用，其比重将一直保持在中国集成电路市场 45%左右；其次是电子消费类和网络通信类，二者合计将占有超过 40%的市场比重。

近年来，我国半导体分立器件和集成电路下游行业市场需求量呈现高速增长的趋势。2009 年家电下乡政策的推出和 3G 网络建设推动了网络通信、消费电子领域市场的持续快速增长，同时汽车市场的快速增长和中国对小排量汽车的刺激政策也带动了汽车电子领域市场的快速发展。这些都带动了半导体分立器件和集成电路行业的增长。另外，近年来追求节能和环保的趋势也对功率器件市场（特别是 VDMOS 等高端功率器件市场）的蓬勃发展推波助澜，尤其是哥本哈根气候会议后，中国承诺到 2020 年碳减排 40%-45%，因此各种应用设计都朝向高效能和低耗电的要求靠近，能够有效降低能耗的功率器件产品（如 VDMOS）需求将不断增长。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）发行人特有的竞争力分析

1、以自主创新作为企业发展的驱动力

创新是企业的生命力。公司自成立以来就坚持自主研发，不替国外品牌代工，走自主创新之路，力争打破半导体元器件领域国外技术垄断的格局。公司的成长伴随着持续的技术创新和新产品的不断研发推广，在民族品牌替代进口方面做出了突出贡献，这也是公司能以一个业内中小厂商的规模逐步发展为行业细分市场重要企业并保持企业活力的主要原因。

公司以技术创新为驱动力，逐步发展出四大系列产品的过程如下：

（1）固体放电管产品填补国内空白，打破国外厂商垄断

公司成立伊始，与东南大学教授刘光廷先生（现公司核心技术人员、总工程师、南京研发中心主任）进行技术合作，在国内率先研制出防护用固体放电管，填补了国内企业在这领域的产品空白，打破了国外企业在这领域的长期垄断地位。公司生产的 SA230-J 固体放电管推出后，由于其与国外同类产品性能价格比上占有绝对优势，因此迅速占领市场，逐步替代国外进口产品。

国家信息中心信息网络评估部于 2003 年为公司出具了产品及市场分析意见：“公司主导产品 SA230-J 半导体放电管系公司于 1999 年自行研制成功，采取四层金属复合电极技术，填补了国内空白，被列入国家火炬计划项目，综合性能达到国际同期先进水平；2002 年，公司自主开发设计出 YDCLP200M 通信设备过电压过电流保护集成电路，各项技术指标和性能达到国外同类产品的水平，可以替代进口。”

公司在占有通信行业防护器件市场后，还不断进行技术完善和产品升级，一是对原有的产品进行技术更新，例如，SA230-J 放电管从研制成功起至今经历了四代技术更新（第一代：一硼一磷技术；第二代：二硼一磷技术；第三代：一硼二磷技术；第四代：埋层技术），产品的性能不断完善。二是不断研发出各种新型防护器件产品，其应用领域从单一的程控交换机领域向其他电子电器设备的防

护领域发展。例如，用于高速互联网安全防护的集成电路 DP3X00，是国内率先自行设计制造的该应用领域国产品牌防护类产品。在程控交换机二级防护领域，公司开发生产的 58S 型号产品适用于 48 伏固定电压的程控交换机，目前公司在此基础上又设计研发了 P61089 型号产品，其优点在于可编程，对各种电压的系统都可以保护。截止本招股说明书出具日，该产品芯片设计已完成，预计未来能取得较前代产品更为广阔的市场空间。

目前公司防护类器件产品已形成多样化、系列化格局，覆盖领域从公用、商用延伸到民用，市场前景广阔。未来公司在防护器件领域的目标即是发展成为国内产品最全面、最有竞争力的防护器件生产厂商。

（2）推广自主品牌可控硅产品，国内较早开拓吸尘器用领域

通过技术领先优势打开通讯用防护功率器件市场领域后，公司坚持走自有知识产权之路，凭借敏锐的市场感觉，注意到可控硅这一半导体产品具有广泛的应用市场，即开始研发相关的产品，于 2003 年用国产设备成功生产出可控硅产品并打入市场。在此之前，国内可控硅生产厂商多采用进口设备进行生产，而且大部分公司以 OEM 方式为国外厂商代工，因此公司的产品上市后依靠性价比的优势，迅速打开了市场。

近年来，公司产品成功进入了可控硅产品应用的高端领域，是国内较早进入吸尘器用可控硅市场的企业，成功地打破了国外进口产品的垄断。目前公司已经开发出豆浆机用可控硅并成功投放市场，同时还在继续开发洗衣机用等国内企业较少涉足的可控硅应用领域，力争在上述领域尽早实现替代进口的民族产业振兴目标。

（3）国内较早采用国产设备生产 1300X 产品的半导体企业

公司依靠自有技术走持续发展之路的第三步即是研发 1300X 系列产品。2006 年公司利用自主研发的“高压功率管生产工艺”专有技术实现了利用国产设备生产 1300X 系列产品，成为国内较早采用国产设备成功大规模生产同类型产品的企业，而绝大部分业内厂家均采用进口设备进行 1300X 系列产品的生产，因此公司依靠产品性价比的优势很快打开了该产品市场。现阶段公司 1300X 系列产

品的发展目标是进行产品结构调整，从节能灯用 1300X 转向开发工艺更复杂、毛利率更高的电源用 1300X 产品。

（4）进军半导体元器件高端产品——VDMOS

VDMOS 产品是半导体功率器件的高端产品，不仅需要高端的生产线设备，还需要掌握大量复杂的版图设计、工艺制造流程技术。

2005 年底，公司从奥地利微系统公司（AMS）引进一条 4 英寸 0.5 微米新型功率半导体器件生产线，用于生产 VDMOS、IGBT 系列产品。目前依托自身强大的科研力量，形成了一套具有完整自主知识产权的 VDMOS 生产技术，已成功开发出 18 种型号的系列产品，产品性能达到同行业先进水平。IGBT 产品现处于试制阶段，具体参数有待改进。

目前国内半导体企业中主要有江苏东光、华微电子、华润华晶、士兰微和中环股份等可以自主设计制造 VDMOS 芯片，并通过客户方检测认可将产品投放市场。

公司在上述自主设计生产 VDMOS 产品的企业中，亦属于领先投放市场、并具有相当市场影响力的企业。2008 年 1 月 14 日，公司即取得了第一张 VDMOS 的销售订单，目前已拥有一百多家 VDMOS 产品的客户。随着募集资金项目的实施，凭借公司 VDMOS 产品的性价比优势，公司在国内该市场的占有率会进一步提升。

总言之，公司依靠自主创新、坚持打民族自有品牌的经营策略，保持了企业发展至今的活力与生命力。

2、显著的成本优势

公司一直以来是在替代国外进口产品过程中发展起来的，凭着自主研发及完整的产品制造流程，结合严格科学的企业管理，通过同质价优的销售策略，迅速占领了市场。例如公司的代表性产品——电子电器设备用防护功率器件，凭借着多年研发能力的积累和低成本优势，目前在该类产品市场已逐渐取代跨国厂商，成为国内市场的主要供应商。

公司生产设备国产化程度较高，可控硅、1300X 系列产品均是依靠国产设备生产的成本优势成功打入市场的。

此外，公司的成本控制意识和能力较强，对已有产品不断精益求精进行工艺创新和改良，因此能始终保持显著的性能成本优势。例如公司近年来开发出的 VDMOS 系列产品，目前在第一代方案的基础上又改进了新的设计方案：采用了新的元胞结构，相对于采用其他元胞结构的器件，在抗 EAS 能力方面具有较大的优势；采用了多晶硅/体硅结构，大大提高了器件抗 ESD 能力；并通过优化元胞的尺寸及工艺，降低了产品的导通电阻和输入电容，降低了产品工作时的温升，提高了整机系统的转换效率；此外，还采用了尺寸较小的场限环作为其保护环。这样，在相同规格的条件下，产品芯片面积较上一代降低了 25%，有效地降低了单只管芯的成本。

3、垂直整合的一体化生产经营模式

公司目前采取集芯片设计、芯片制造、封装测试、直销、售后服务于一体的垂直整合的生产经营模式。

目前国内的半导体元器件生产企业，多数以做封装和测试为主，其购买芯片封装后向市场销售成品；或者从事芯片制造并销售芯片，上述企业分别处于与成品销售或芯片制造相割裂的地位。

半导体元器件产品的核心在于芯片设计和制造，公司具备完整的芯片设计和制造能力，并且在封装后采用自己的品牌直接向终端客户销售。公司“设计-制造-封装-销售”的一体化模式优于单纯的芯片销售和单纯的封装销售模式，不仅树立自己的品牌，又可以不断提高自身的研发、设计和生产能力，抵御市场风险能力更强。

单做封装的企业没有掌握芯片设计制造技术，在售后服务上难以做到位，对质量问题和性能改进的响应速度也不够快。单出售芯片的企业在封装方面不作把关，同时在配合客户根据其需要改进产品性能、修正技术参数方面比起芯片设计、制造、封装整体把关的企业来说要弱一些。

4、技术先进性优势

公司是拥有自主设计研发能力的厂商，自成立以来注重研发投入和技术革新，培养了一支能够跟踪和吸收国际先进技术、具备持续创新能力的研究开发团队。公司所拥有的专利、集成电路布图设计著作权和专有技术全部来自于公司研发团队，目前生产的主要产品都拥有自主知识产权。

公司历年来获得的技术奖项参见本招股书“**第二节 概览/一、发行人基本情况**”。

目前，公司重点投入的 VDMOS 产品本身即属于半导体功率器件中的高端产品，不仅需要高端的生产线设备，还需要掌握大量复杂的版图设计、工艺制造流程技术。公司能够在国内众多的半导体生产厂商中脱颖而出，率先研制出 18 个型号的 VDMOS 系列产品并于 2008 年 3 月即实现销售，显示了公司在技术领先方面的优势。同行业开发 VDMOS 产品的几家上市公司中，华微电子于 2008 年 11 月完成了新型功率半导体器件项目（即 VDMOS）的通线任务，目前部分品种已经批量投放市场。中环股份募投项目的功率器件生产线用于生产 MOSFET、肖特基二极管、整流二极管多个产品，2009 年 5 月完成建设了平面整流器件生产线建设并开始投产形成销售，6 月开发出适应于太阳能电池产业的大功率平面整流器件并开始投产，2009 年开始功率 6 吋芯片产品销售。（以上资料来源于华微电子 2008、2009 年年度报告，中环股份 2009 年年度报告）

5、自主品牌的影响力

产品在市场中的地位的提升关键靠品牌效应，品牌是一家企业技术、管理、装备、市场策略的综合体现。公司自成立以来秉承“立民族志气，创东光品牌”的经营理念，坚持走自有品牌路线，在市场上成功塑造了东光品牌的影响力。

公司在不断开发新的系列产品的过程中，依靠品牌知名度，用老产品带新产品，打开新产品市场，同时以技术过关、产品性能稳定作为保障。

2008 年金融危机对半导体生产企业造成了严重的不利影响，但公司把这次危机看作是一次挑战中的机遇。由于金融危机下的成本压力，许多过去一直采购进口功率器件的小家电生产企业为了在行业洗牌中维护企业的生存空间，开始了解并考虑国内品牌的功率器件。公司凭借长期以来树立的业内品牌知名度，很快

在珠江三角洲地区打开了小家电、家用电器领域的可控硅市场，也使公司在金融危机下成功进行了可控硅产品的结构调整，向高毛利率的产品市场发展。

6、敏锐的市场感觉和以品牌、技术推产品的直销策略

公司与国内主要半导体器件生产厂家，如华微电子、华润华晶等厂商相比，规模较小，不具备产量上的优势，但公司在激烈的市场竞争环节中，通过对市场的深入研究，不断开发新兴市场，采取关注高毛利的产品、在细分市场寻求突破的蓝海战略，成功在防护器件、可控硅以及 VDMOS 几个产品系列上做出了自己的特色。

公司在成立之初开发防护用固体放电管市场即是注意到当时该产品市场国内企业不关注，而国外厂商占据了绝对的市场份额。公司在该领域专注研发，最终成功开发出替代进口的产品，领先于国内其他厂商，至今占据绝对的市场优势。之后，公司陆续开发了可控硅、1300X、VDMOS 系列产品市场，均是关注到上述产品的巨大下游应用市场需求，同时，国内企业在这些产品上的竞争优势不够明显，因此，公司以技术研发为先导，快速开发出相应的产品并依托品牌优势打入市场。

在产品进入市场时，公司采取以品牌、技术推产品的直销策略，采取市场调研——销售人员主动上门推销——样品介绍——送样检测——取得订单——售后根据客户要求不断改进产品性能和工艺的销售流程，这样一个完整的直销流程使得公司能对客户提出的产品设计需求、性能改进进行快速响应，有利于保持客户的稳定性，明显优于采取代理销售模式的半导体器件生产厂家。

这种直销策略还可以在公司新老产品之间进行互相促进的协同作用，例如，1300X 和 VDMOS 产品的客户有重合性，因为在节能灯领域，1300X 产品由于能效转换率低，在推广节能减排、绿色照明的过程中，未来可能逐步被 VDMOS 产品所取代。公司注意到了这一市场未来发展方向，在 1300X 系列产品的营销过程中，也同时替公司的 VDMOS 产品做宣传，并成功发展出如晨怡(浙江)电子实业有限公司、杭州斌翔照明有限公司、安徽万德福电子有限公司等客户，因此能迅速打开 VDMOS 市场，在目前国内自主品牌的 VDMOS 产品当中，江苏东光很快具有了较高的影响力。

（二）发行人各主要产品的市场占有率及市场前景

从中国分立器件和集成电路市场的品牌结构来看，2009 年占据优势竞争地位的仍是国际厂商。公司作为一家中小规模的半导体分立器件和集成电路生产厂家，在资金实力、企业规模上与这些大公司有较大差距。但公司以敏锐的市场感觉，寻找新兴产品市场作为切入点，进行深入的研发，成功取得在细分市场上技术领先的优势，开辟了一片适合自身企业发展的蓝海。

公司于主要产品所在的细分市场上占有率情况及市场前景如下：

1、防护器件系列

公司在通讯领域防护器件市场占有绝对的优势地位，公司生产的 SA 系列半导体固体放电管在国内程控交换机一级保护（即总配线架保安单元）方面，市场占有率常年居于第一位，并呈逐年上升趋势，竞争优势非常显著。公司 DP 系列固体放电管主要应用于机顶盒、Modem、xDSL、路由器等民用器件防护；58S、P61089 功率集成电路应用于程控交换机二级防护（即用户板保护电路），在同类产品市场上也具有明显的领先优势。

不仅如此，公司产品得到了电信营运商的信赖，中国电信和网通的多个省局下文文明确要求本公司产品作为其设备供应商的指定采购产品。

公司	日期	文件	内容
中国电信集团公司	2000 年 8 月	《关于批准第二批国产半导体放电管在中国电信网上试用的通知》	规定采用江苏东光的 SA-230J 型半导体放电管
江苏省电信公司	2001 年 6 月	《关于总配线架（MDF）选型有关问题的通知》	指定江苏东光作为放电管产品 4 家合格供应商之一
陕西省电信公司	2002 年	《关于调整半导体放电管产品选型范围的通知》	指定江苏东光作为放电管产品 3 家合格供应商之一
中国网通集团河南省通信公司	2004 年 8 月	《关于转发〈关于进一步加强网络安全管理，预防雷电及强电侵袭工作的通知〉的通知》	指定江苏东光成为集成电路保安单元合格供应商
中国网通集团山西省通信公司	2005 年 8 月	《关于下达 MDF（总配线架）选型入围厂家名单的通知》	指定江苏东光（SA-230J 型放电管、YDCLP200M 集成电路）作为过压防护器件、集成电路保安单元芯片的合格供应商

其他省份电信企业虽没有明确下文必须采购江苏东光的防护器件产品，但是公司通过所合作的众多电信设备供应商，实际已间接取得了这些省份电信防护市场的领先优势。

长期以来，公司与电信运营商的国内主要设备供应商，如华为安捷信、中兴新地、日海通讯、八达通信、新海宜、恒利通讯、普天凯特、万马集团、世纪人等建立了良好的合作关系，产品质量得到充分认可，已成为他们的防护器件独家或主要供应商。

半导体行业协会对公司防护器件产品出具证明文件：2007 年——2009 年公司生产的通讯用防护器件在国内市场占有率持续排名第一，2009 年占有该领域市场份额达到 80%以上。

考虑到今后许多省市电信领域正在使用的气体放电管将逐步被固体放电管所替代，因此未来十年固体放电管将仍保持较高的需求量。同时，电信行业程控交换机系统对防护要求已经不仅仅局限于一级防护，二级防护越来越普遍，公司将以新产品 P61089 为突破点，进入程控交换机二级防护领域，替代国外进口产品。可见电信行业仍有增长潜力。

长期来看，防护类器件具有良好的市场前景。随着 3G 网络、宽带通讯、网络电视和计算机技术的发展，将直接带动半导体防护功率器件在程控交换机、机顶盒、Modem、ADSL、路由器、宽带交换设备等领域的应用。此外，国内半导体防护功率器件在家电、家用电路、电表等领域的应用非常少，而欧美发达国家在该些领域应用非常普遍。随着国内防护意识的不断加强和安防要求的提高，半导体防护功率器件在民用领域的应用将随之扩大。

此外，防护器件产品还拥有潜力巨大的海外市场。中兴通讯、华为是公司防护器件产品的固定客户，公司通过向中兴通讯、华为的指定供应商供货间接形成与上述两家公司的采购关系。近几年，中兴通讯、华为的海外销量稳步上升，在亚太、中东北非、南部非洲、独联体地区巩固了已有的市场地位，市场份额取得大幅提升，还在欧洲、拉丁美洲、北美地区取得了令人瞩目的战略突破，奠定了新的全球市场格局。中兴通讯、华为海外市场开拓力度的加大，对江苏东光半导体防护功率器件产品的需求具有直接拉动作用。

目前，公司防护器件产品产能远远不足满足市场需要，2009 年防护器件的产能利用率已达到 105.05%，因此公司拟利用募集资金进一步扩大防护器件产能，投产后将大大缓解产能不足的形势，有力支持公司市场占有率保持并进一步提升。

2、可控硅系列

公司单、双向可控硅产品具有三十余种型号，广泛应用于摩托车、吸尘器、电动工具、电扇、空调、冰箱等终端产品。

公司原以摩托车用可控硅作为可控硅系列主要产品，2007 年起，公司新开发出了吸尘器用可控硅产品，相比较而言吸尘器用可控硅毛利率明显高于摩托车用产品。因此自 2008 年起公司对可控硅的产品结构做了调整，逐步退出毛利率较低的摩托车市场，开始转向毛利率较高的家用电器、小家电应用领域可控硅产品市场。目前吸尘器用可控硅是公司重点发展的产品，2007 年—2009 年公司生产的吸尘器用可控硅市场占有率统计如下：

年份	公司销售吸尘器用可控硅 数量（万只）	全国吸尘器总产量 （万台）	公司该类产品市场占有率
2007 年	63.7	6,514.2	0.98%
2008 年	268.8	6,367.5	4.22%
2009 年	773.3	5,669.4	13.64%

（资源来源：公司统计数据，国家统计局数据）

由上表可见，公司在吸尘器用可控硅市场上占有率逐年迅速上升，考虑到吸尘器领域中约有 1/4 使用国内品牌的可控硅，那么在国内吸尘器用可控硅生产厂商中本公司的市场占有率排名更靠前。

公司于 2008 年起开始发展冰箱用可控硅市场，根据国家统计局数据，2009 年全国家用电冰箱总产量 5,930.5 万台，公司 2009 年销售冰箱用可控硅 643 万只，按每台冰箱使用一个可控硅，由此计算得出市场占有率达 10.8%。此外，考虑到只有节能型冰箱才会用到配置可控硅的“低功耗压缩机起动器”，而目前市场上还有相当一部分非节能冰箱，因此公司在冰箱用可控硅领域的实际市场占有率可能更高。日后随着节能冰箱的逐步推广，未来这一领域市场发展前景广阔。

此外，公司还不断开发豆浆机、洗衣机用等高端可控硅市场，上述应用领域由于对可控硅换向特性、温度特性、可靠性要求更高，市场一直被东芝（Toshiba）、瑞萨（Renesas）、意法半导体（ST）、恩智浦（NXP）等国外半导体器件制造商占领，公司研发团队通过长期研究、技改投入，掌握了洗衣机和豆浆机控制器所用可控硅产品制造核心技术，包括镓硼复合扩散技术、PN 结表面多层防护工艺技术、芯片表面多层金属化制造技术等，目前 BTA06、BTA12 等可控硅产品已通过九阳豆浆机认证考核成为其指定线路板厂的合格供应商，洗衣机用可控硅产品目前也已进入送样测试阶段。2010 年可控硅事业部将进一步完善工艺制造平台，为不断拓展新应用领域的市场提供必要的技术支持。

3、1300X 系列

公司 1300X 系列产品正式投产于 2006 年，主要应用于节能灯产品。2006 年即实现销售近 3,000 万只，2007 年销售量增长近 140%，达到 7,193 万只。目前国内市场上 1300X 产品竞争优势明显的主要是华微电子、华润华晶等大规模的半导体器件企业，与上述企业相比，公司在市场占有率方面不具有优势。

同样作为电力开关器件，VDMOS 与 1300X 双极功率器件相比具有诸多优良性能，如高输入阻抗、低驱动电流、开关速度快、工作频率高、有负的温度系数，热稳定性好，安全工作区大，高度线性的跨导、放大失真小等。VDMOS 功率器件因其性能先进，又具有明显的节能、功能驱动作用，在绿色电源、通信及计算机电源、变频调速、感应加热、新型家电、电动交通工具等领域都有巨大的应用前景。因此未来的发展趋势是 1300X 产品将被 VDMOS 产品逐步取代，但考虑到各应用领域的更换成本问题，这需要一个渐进的过程。

4、VDMOS 系列

2008 年，中国 MOSFET 市场需求量为 198.2 亿个，比 2007 年增长了 11.9%，市场需求额为 237.0 亿元，比 2007 年增长 10.9%。虽然 2009 年国内半导体行业受到金融危机的影响出现一定程度下降，但 2009 年中国 MOSFET 市场的需求额仍然达到了 235.7 亿元，仅比 2008 年市场需求额下降了 0.55%，下降程度远低于其他半导体器件产品市场。从绝对数来看，国内 MOSFET 市场需求额仍是一个巨大的空间。VDMOS 是 MOSFET 的一种主要结构形式，目前国内 MOSFET 市

场几乎等同于 VDMOS 市场。

而这一市场目前主要由国外厂商占据，国内半导体企业生产的 VDMOS 产品基本上投放市场不久，还没有形成规模，产品的品种和质量也与国外厂商存在一定的差距。但考虑到本土企业在产品价格上存在明显优势，未来这一市场存在着替代进口的重大机会。

就下游应用市场的发展来看，受计算机及游戏平台、上网本销售的推动，功率器件市场仍保持相对强势，而其中 VDMOS 用量相当可观。与消费市场相比，工业控制、电信行业受金融危机冲击相对小，加上政府大笔资金投入基础建设，因而需求不减反增。对要求更高能效的应用领域来说（例如网络服务器和电信应用），改善能源效率已经成为许多客户的重要目标。未来随着我国及全球经济的不断恢复，消费电子行业对 VDMOS 的需求将不断恢复，工业控制、电信行业、汽车电子行业则将保持较快的增长，计算机领域增速将不断回升。

此外，LED 照明也是 VDMOS 的一个重要应用领域。目前我国 VDMOS 用在照明产品上还主要集中在公用事业领域，民用领域很少。就照明应用而言，目前发展低碳经济已成全球共识，节能将在碳减排过程中发挥主导作用。目前，我国照明用电约占全国总用电量的 12%。与白炽灯和荧光节能灯相比，LED 照明在节能、环保方面具有十分显著的优势，因此未来 LED 照明将成为照明领域的发展趋势，同时也将促进 VDMOS 产品市场的发展。

公司 VDMOS 产品完全依靠自主核心技术研发制造，相比进口产品具有突出的成本优势，同时将随着下游市场的良好发展而不断扩展市场份额。公司 VDMOS 产品于 2008 年投产，在金融危机的不利形势下，VDMOS 产品 2008 年、2009 年、2010 年 1-6 月公司 VDMOS 产品的销量分别为 1,867.95 万只、4,349.50 万只、3,325.56 万只，占销售收入的比重从 13.43% 上升到 32.73%，并逐步发展出一百多家客户，在国内同行业企业中表现突出。

随着公司募投项目的进行和完成，VDMOS 生产线突破产能瓶颈，预计未来市场前景可观。

（三）主要竞争对手简要情况

不考虑国际大厂商在国内市场上的绝对优势地位，与国内企业相比，目前公司在各主要产品细分市场上的竞争对手情况如下：

1、防护器件系列

公司在通讯用防护器件领域长期以来保持市场占有率排名第一，市场份额极高，国外厂商目前已淡出该类产品市场，国内其他同类产品生产厂商与本公司相比尚不具备足够的竞争力。该领域的主要生产厂家包括常州市广达电子有限公司（原常州市江南放电管有限公司）、湖北汉光科技股份有限公司（原国营四四〇四厂）。

常州市广达电子有限公司（常州市江南放电管有限公司）是国内的主要放电管专业生产厂，其研发、制造的陶瓷气体放电管系列产品、半导体放电管系列产品主要在通信系统、通信电源、有线电视、计算机、调制解调器及其它电子设备上作过电压保护用，半导体二极管用在军工、航天、船舶、铁路、计算机、家用电器、仪器仪表等领域（以上资料来源于常州市广达电子有限公司公司网站）。

湖北汉光科技股份有限公司是由原电子工业部直属企业国营汉光电子工厂（国营 4404 厂）整体改制而成，注册资本 1.5 亿元，其主要生产经营的产品有：真空开关管、磁控管、大功率速调管、天线开关管、高能点火放电管、放电管电极等。产品应用于雷达、导航、通讯、航空航天、高能物理、广播电视、电力、冶金、矿山、汽车、照明、交通、数字医疗等领域（以上资料来源于湖北汉光科技股份有限公司网站）。

2、可控硅系列

公司在可控硅领域的竞争主要为黄山电器、扬州晶来、启东吉莱几家公司。

黄山电器有限责任公司是一家电力电子器件及芯片生产企业，近二十年的生产历史，主要产品有整流二极管、快恢复二极管、晶闸管 GPP 方片及塑封器件和功率半导体模块。现具有年产各种规格芯片一亿只，器件一千万只的能力（以上资料来源于黄山电器有限责任公司网站）。

扬州中芯晶来半导体制造有限公司是在原扬州晶来半导体（集团）有限责任公司改制的基础上，由日本国际电子贸易株式会社（日本）与扬州工业资产经营

管理有限责任公司合资组建的专业半导体器件设计、制造、经营的中日合资企业，公司注册资本：3,204 万美元，其中日方占 81%，中方占 19%。该公司产品有：NPN/PNP 型小信号晶体管、功率开关晶体管、高/低频大功率晶体管、达林顿晶体管、单/双向可控硅、大功率晶闸管/整流管、快速/调整二极管等。该公司有 4 英寸平面、台面生产线各一条，3 英寸生产线 3 条，年生产能力达 80 万片（按 4 英寸片计）（以上资料来源于扬州中芯晶来半导体制造有限公司网站）。

启东吉莱电子有限公司主要生产低频大功率晶体三极管、单双向可控硅，达林顿，年生产晶圆片 500,000 余片，各类管芯 2 亿多只（以上资料来源于启东吉莱电子有限公司网站）。

3、1300X 系列

公司 1300X 系列产品的主要竞争对手包括华微电子、深圳深爱、华润华晶等。

吉林华微电子股份有限公司于 2001 年在上海证券交易所上市，公司业务主要集中于传统双极型分立器件领域。主要产品包括彩电用、节能灯用和灯箱电源用三大系列功率晶体管。2009 年半导体分立器件部分的营业收入为 10.06 亿元，小型服务器及技术服务部分营业收入 0.14 亿元，其他部分营业收入 0.30 亿元。（以上资料来源于吉林华微电子股份有限公司 2009 年度年报）。

无锡华润华晶微电子有限公司是无锡华润微电子有限公司的主要成员企业，是中国规模领先、品牌优异的功率器件供应商，目前其产品主要包括彩色电视机、黑白电视机、VCD、电话机、收录机/收音机用晶体管、音响功率晶体管、节能灯电子镇流器用晶体管、高频放大晶体管、开关管、达林顿管、变容二极管、可控硅(闸流晶体管)、超高频，微波低噪声晶体管等。2008 年受基础能源及原材料价格上涨、传统产品降价等一系列负面因素影响，华润华晶销售收入 11.4 亿元，同比增长 12.6%（以上资料来源于无锡华润华晶微电子有限公司网站）。

深圳深爱半导体有限公司成立于 1988 年，生产双极型功率晶体管、达林顿管、可控硅、肖特基管等 20 多个品种，经不断技术改造，生产能力已达月产 4 英寸片 2 万片，年封装 2 亿只的规模。2008 年，以出口为导向的照明行业，受原材料和人力成本上升，以及人民币升值和美国次贷危机的影响，北美市场应用

产品订单大幅减少，因此以照明用晶体管为主要产品的深圳深爱销售收入出现 12.2% 的负增长，下滑为 5.2 亿元（以上资料来源于深圳深爱半导体有限公司网站）。

4、VDMOS 系列

目前国内半导体器件生产企业中主要有本公司、华微电子、华润华晶、士兰微和中环股份等生产 VDMOS，因此主要竞争对手为上述四家公司。

华微电子及华润华晶的介绍见 1300X 竞争对手部分描述。

杭州士兰微电子股份有限公司，于 2003 年在上海证券交易所上市，主营业务为集成电路芯片设计、半导体芯片制造、LED 芯片制造。公司有七条产品生产线，包括电源和功率驱动、混合信号与射频、数字音视频、MCU、安防监控、分立器件和 LED 器件。2009 年，该公司营业收入为 9.6 亿元，其中集成电路营业收入 4.4 亿元、器件 3.1 亿元、发光二极管 2 亿元、其他部分营业收入 0.6 亿元（以上资料来源于杭州士兰微电子股份有限公司 2009 年度年报）。

天津中环半导体股份有限公司，于 2007 年在深圳证券交易所上市，主营业务为传统高压整流器件、半导体材料和太阳能电池材料制造。2009 年，该公司半导体行业营业收入为 5.57 亿元，其中直拉硅片收入 1.30 亿元、区熔硅片 1.02 亿元、直拉单晶 0.96 亿元、高压硅堆 0.86 亿元、区熔单晶 0.50 亿元、硅桥式整流器 0.48 亿元、功率 6 吋芯片 0.21 亿元，其他部分营业收入 0.24 亿元。（以上资料来源于天津中环半导体股份有限公司 2009 年度年报）。

5、报告期公司产品销售价格和主要竞争对手的差异

报告期公司各产品平均单价如下：

产品	2010 年 1-6 月	2009 年	2008 年	2007 年
防护器件	0.44	0.45	0.47	0.48
VDMOS	1.01	0.96	1.04	-
可控硅	0.72	0.71	0.68	0.66
1300X	0.34	0.32	0.37	0.41

公司产品销售价格和主要竞争对手的差异情况如下：

产品	主要竞争对手	价格差异水平	备注
防护器件	常州广达电子有限公司	高于本公司同类产品 10%左右	主要系外购芯片封装销售，生产成本高于本公司
	湖北汉光科技股份有限公司	低于本公司 10%左右	主要产品为气体放电管。本公司防护器件以固体放电管为主，性能优于气体放电管
可控硅	黄山电器有限责任公司	无明显差别	
	扬州中芯晶来半导体制造有限公司	低于本公司同类产品 5%左右	小规格产品居多
	启东吉莱电子有限公司	无明显差别	小规格产品居多
1300X	吉林华微电子股份有限公司	无明显差别	
	无锡华润华晶微电子有限公司	无明显差别	
	深圳深爱半导体有限公司	无明显差别	
VDMOS	吉林华微电子股份有限公司	无明显差别	
	无锡华润华晶微电子有限公司	无明显差别	
	杭州士兰微电子股份有限公司	无明显差别	
	天津中环半导体股份有限公司	无明显差别	

资料来源：公司营销部收集的市场信息。

除上述主要竞争对手外，意法半导体（ST）公司、瑞萨（Renesas）等国外半导体器件制造商生产的可控硅产品价格高于国产同类产品 50%以上，仙童（Fairchild）、意法半导体（ST）公司、AUK 等国外半导体器件制造商生产的 VDMOS 产品价格高于国产同类产品 30%-50%。（资料来源：公司营销部收集的市场信息）

四、发行人主营业务的具体情况

（一）主要产品及用途

公司现有四大系列主要产品，包括：电子电器设备用防护功率器件系列，可控硅系列，1300X 系列以及 VDMOS 系列。

1、防护器件

防护器件亦称保护器件，用以对昂贵的电路提供保护，以免受到突发的过高电压或过大电流损害。利用这些元器件可使产品具有抗雷电浪涌（SURGE）、静电放电（ESD）、电瞬变（EFT），电感负载切换以及交流电源波动的能力。使得产品更加耐用可靠，从而降低了产品的修理、维护费用。

公司生产的电子电器设备用防护功率器件包括固体放电管、过电压过电流保护集成电路、过电压保护集成电路三大类。

（1）固体放电管

也称为半导体放电管，是一种微型化、高频化、高可靠性的特殊电力电子器件，它是基于晶闸管原理和结构的一种两端负阻器件。可以吸收突波，抑制过高电压，达到保护易损组件的目的。该器件是在硅单晶片两面同时掺杂同种杂质而形成。该器件的优点是导通电压小，几乎无热耗，可重复使用，能承受较大的冲击电流，响应快，使用安全、可靠，其性能优于其它瞬间过压保护元器件。主要应用于通信设备、计算机、家电等的雷电浪涌过压保护。

固体放电管主要产品图例如下：



SA230-J 半导体放电管



DP3X00

（2）过电压过电流保护 IC

应用于计算机网络、通信设备、家用电器的过电压和过电流保护。公司生产的该类产品的产品主要用在易受雷电浪涌和瞬间过压冲击的敏感电讯设备上，如：模拟和 ISDN 线卡，专用小程控交换机（PABX），总配线架（MDF），初级保护模块。

过电压过电流保护集成电路主要产品图例如下：

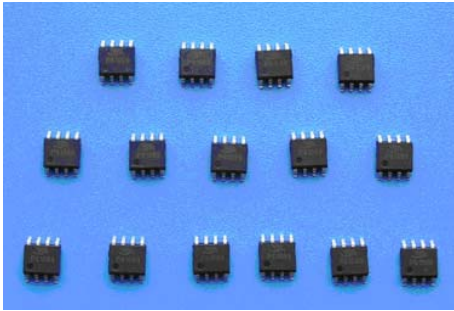


CSC 过电压过电流保护集成电路

（3）过电压保护 IC

是将两组具有放大门极的可控硅和二极管集成于一个芯片上的非对称过电压保护 IC，具有反应速度快，耐浪涌能力强的特点。主要应用于通讯设备的线卡（二级）保护。

过电压保护集成电路主要产品图例如下：



P61089 系列

目前公司在防护器件领域研发出的最新产品包括：

低电容功率防护模块——DP3X00，主要应用于第二代互联网、第三代移动通信、网络电视宽带交换接入设备及高频网络通讯终端等防雷保护领域，以保护设备和系统免受瞬间过电压的冲击和破坏；具有抗高浪涌、低泄漏、超低关态电容的特点，能够为下一代高频传输网络电压和频率提供极佳的线性度。本产品保障下一代互联网设备系统高速运行安全的同时可有效提高网络信号传输质量。

可编程半导体抗浪涌保护器件——P61089，主要应用于程控交换机的二级防护，该产品属于第四代抗浪涌保护器件。抗浪涌保护器件历经了气体放电管、TVS 二极管、THDTXX/THBTXX 系列半导体抗浪涌保护器件和可编程抗浪涌保护器件。与前几代半导体抗浪涌保护器件的性能相比，P61089 的性能大大提高。其特点在于可对保护电压进行硬件编程，因此可用在各种电压下，目前 P61089 几乎被所有的程控交换机用来对 SLIC 板实现保护，但基本上都是国外进口产品。

上述两种防护器件目前国内极少有厂商能够研制并生产，公司与上述产品相关的技术研究成果属国内领先。

2、可控硅

可控硅（SCR）也称作晶闸管，在电路中能够实现交流电的无触点控制，以小电流控制大电流，并且不像继电器那样控制时有火花产生，而且动作快、寿命长、可靠性好。在调速、调光、调压、调温以及其他各种控制电路中都有它的身影。

可控硅分为单向的和双向的。公司生产的单向可控硅主要包括如下型号：BT151、DCR02、DCR05、MRC100-8；双向可控硅产品主要包括如下型号：BT134、BT136、BT137、BTA06、BTA08、BTA12、BTA16、BTA26、BTA41。

可控硅主要产品图例如下：



3、1300X

半导体三极管也称为晶体管，顾名思义具有三个电极，是电子电路中最重要器件。三极管由两个 PN 结构成，共用的一个电极为三极管的基极（用字母 b 表示）。其他的两个电极为集电极（用字母 c 表示）和发射极（用字母 e 表示）。由于不同的组合方式，形成了一种是 NPN 型的晶体管，另一种是 PNP 型的晶体管。它最主要的功能是电流放大和开关作用。

1300X 系列双极型晶体管是一种 NPN 型的晶体管，主要应用于电子节能灯、电子镇流器、充电器的开关电路中，其作用是与其他元器件配合使用，由加在晶体管基极上的脉冲信号来控制晶体管的“开”或“关”，形成一个无触点的电子开关，将直流电逆变成高频交流电。由于其功率较大，而且起开关作用，所以又称功率开关晶体管。

功率开关晶体管具有开关速度快、工作可靠性高、高温特性好、开关损耗低、体积小等优点，应用较为广泛。

公司 1300X 系列产品包括以下四个型号：13002、13003、13005、13007。

主要产品图例如下：



4、VDMOS

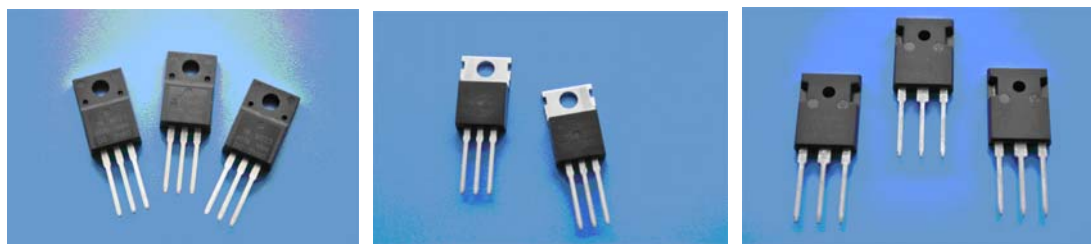
功率 MOSFET 是目前用量最大的功率器件，而 VDMOS 是功率 MOSFET 的一种主要结构形式。

VDMOS 又称垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管，其兼有双极晶体管的作用而性能又优于双极晶体管，无论是开关应用还是线形应用，VDMOS 都是理想的功率器件。VDMOS 主要应用于电机调速、逆变器、不间断电源、电子开关、高保真音响、汽车电器、平板电视、LED 照明和电子镇流器等。总体来看，计算机、工业控制、消费电子和网络通信是 VDMOS 应用的四大领域。

目前国内半导体企业中，主要有江苏东光、华润华晶、华微电子、士兰微和中环股份等公司能够自主研发生产该类半导体功率器件并通过客户检测、成功投放市场。本公司的 VDMOS 产品于 2008 年 3 月开始投放市场，2008 年、2009 年、2010 年 1-6 月公司 VDMOS 产品的销量分别为 1,867.95 万只、4,349.50 万只、3,325.56 万只，拥有客户一百多家，其中包括为戴尔、富士康、LG、松下、飞利浦、西门子等国际知名厂商配套的电源系列产品生产厂家，在市场上影响力较大，享有一定的知名度。

公司生产的 VDMOS 包括十八个型号的全系列产品：1N60，2N60，3N60，4N60，5N60，6N60，7N60，8N60，10N60，12N60，830，840，730，740，630，640，9N60 及 9N90，涵盖了低、中、高压各电压级别。

VDMOS 主要产品图例如下：



目前本公司生产的 VDMOS 产品的性能指标已达到国内外先进技术水平,以下对公司部分主要 VDMOS 产品的电参数与主流厂商的相关指标进行比较,由于各厂家测试仪器以及测试条件的不同, EAS (单脉冲雪崩能量)、ESD (静电放电) 等参数无法比较, 仅对相同电压、电流的产品作 R_{ds} (通态电阻)、 C_{iss} (电容) 作比较, 除江苏东光外, 其他各厂家产品的参数指标来源于各厂家公开信息:

(1) 600V/2A 产品 (江苏东光对应产品型号 2N60):

	$R_{ds(max)}(\Omega)$	$C_{iss}(typ.)(pF)$
仙童	4.7	180
ST	4.8	280
AUK	4.7	290
华润华晶	4.5	330
华微电子	5.0	380
江苏东光	4.3	270

(2) 600V/4A 产品 (江苏东光对应产品型号 4N60):

	$R_{ds(max)}(\Omega)$	$C_{iss}(typ.)(pF)$
仙童	2.5	710
ST	2.2	475
AUK	2.5	520
华润华晶	2.2	660
华微电子	2.5	710
江苏东光	2.2	520

(3) 600V/8A 产品 (江苏东光对应产品型号 8N60):

	$R_{ds(max)}(\Omega)$	$C_{iss}(typ.)(pF)$
仙童	1.2	965
ST	1.0	400
AUK	1.0	968
华润华晶	1.2	1123
华微电子	1.2	1380
江苏东光	1.2	965

(4) 500V/8A 产品 (江苏东光对应产品型号 840):

	Rds(max) (Ω)	Ciss(typ.) (pF)
仙童	0.8	790
ST	0.8	415
AUK	0.8	950
华润华晶	0.8	870
华微电子	0.8	1400
江苏东光	0.85	1300

在电压和电流相同的情况下，Rds、Ciss 值越低，产品性能越好，从上述四种产品的比较情况来看，公司的产品性能已接近国际主要半导体器件生产厂家，个别产品上述指标优于部分国际先进厂家。

此外，随着公司对 VDMOS 不断进行深入研究，公司生产的 VDMOS 产品型号品种更加齐全，技术优势更加明显。目前公司生产的 900V 的 VDMOS 产品、抗静电（ESD）的 VDMOS 产品、抗冲击（EAS）的 VDMOS 产品是工艺水平先进性较为突出的几种代表性产品：

（1）900V VDMOS 产品

900V 的 VDMOS 相对于 600V 的 VDMOS，由于器件内部形成的电压更高、电场更强，导致器件制造的合格率、成品的可靠性都低于 600V 的 VDMOS。因此该种 VDMOS 产品的制造工艺难度更大。

公司从外延片、场限环的优化方面入手，并采用表面钝化工艺，大大提高了 900V VDMOS 的合格率和可靠性。目前本公司的 900V VDMOS 已经成功系列化生产。

（2）抗静电的 VDMOS 产品

VDMOS 在制造、测试、存储、运输及装配过程中，仪器设备、材料及操作者都很容易因摩擦而产生几千伏的静电电压。当器件与这些带电体接触时，带电体就会通过器件引脚放电，使 VDMOS 栅氧化层介质击穿，导致器件失效。

因此，公司在制造工艺中引入了一种多晶硅 / 体硅结构，使之承受静电加在栅氧化层上的电压，泄放静电引起的电流，避免了器件栅氧化层介质击穿，提高 VDMOS 的抗静电能力。

目前该种抗静电工艺结构在公司 4N60 型号的 VDMOS 产品上试应用，且达

到设计效果，今后将在其他型号的产品上进行推广使用。

（3）抗冲击的 VDMOS 产品

由于 VDMOS 内部存在着寄生三极管结构，而且 VDMOS 应用领域决定了其工作在高压大电流的情况下，寄生三极管非常容易导通，从而发生二次击穿，导致器件烧毁。

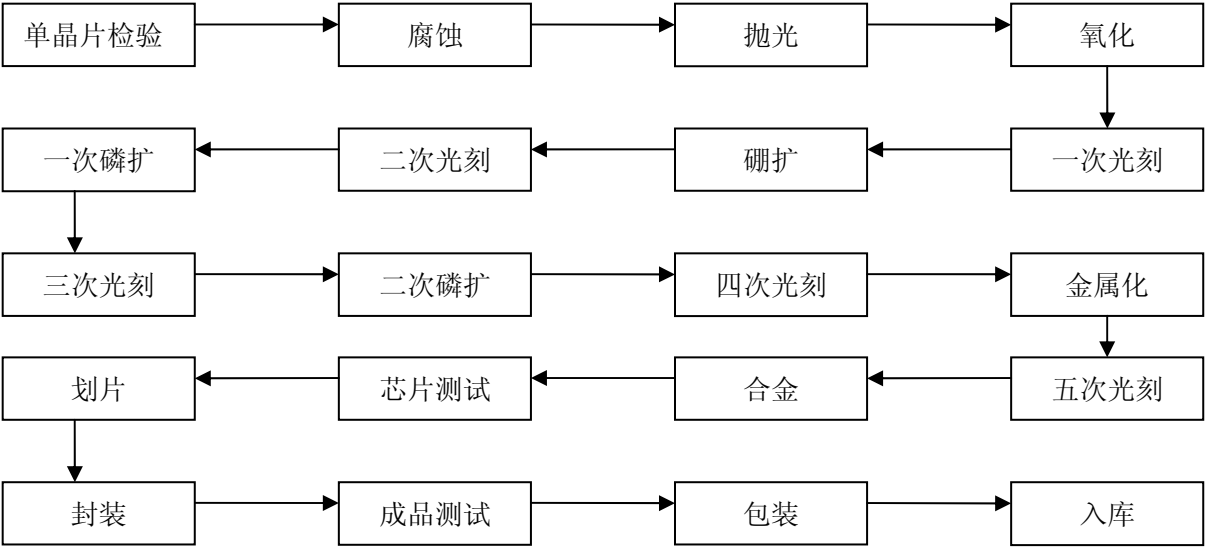
因此，公司提出了一种新的结构——P+深结与浅结注入结构（Deep and Shallow P+ Implant Structure），并在版图尺寸上进行设计调整，大大降低了寄生三极管导通可能性，改善了产品的抗冲击能力。目前该种抗冲击工艺结构在公司 4N60，8N60，12N60 型号的 VDMOS 版图上应用，并且达到设计效果。

公司 VDMOS 产品技术均为自主研发，以专有技术和集成电路布图设计著作权的形式存在，主要包括以下内容：

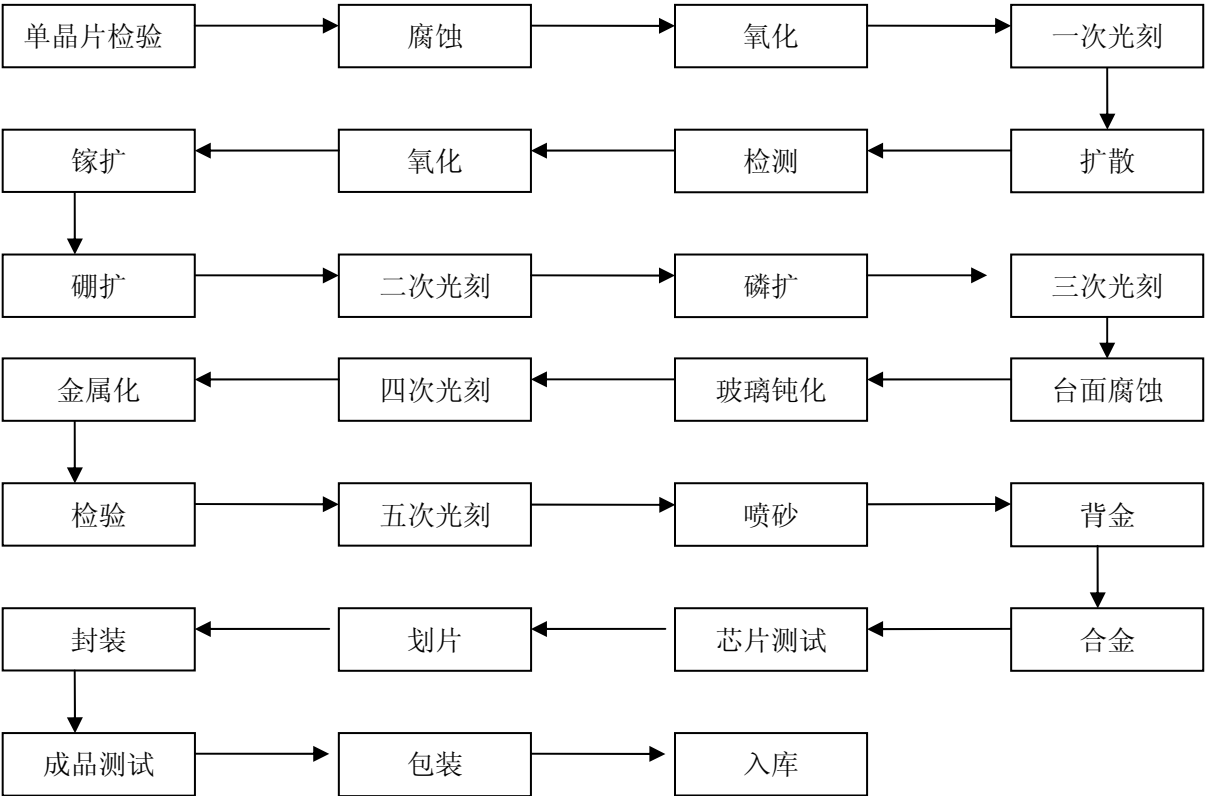
一、关键专有技术	技术特点
新型芯片设计技术	采用高密度设计和较少光刻次数的工艺技术，能够制造出相同性能的器件，降低了成本，提高了市场竞争力
栅源保护结构技术	增加了抗 EAS，ESD 能力，提高了产品的可靠性，合格率
缺陷密度控制技术	具有减少硅片缺陷密度的明显特点，保证了产品性能稳定
微细加工技术	采用高分辨率、全自对准的 Nikon 步进光刻机实现图形转移
精确掺杂	采用高能量、高速流的离子注入机进行精确掺杂
背面金属化技术	采用独特的背面金属化工艺方法，晶粒小，金属层附着性、均匀性好、电阻率低，产品可靠性高
二、集成电路布图设计著作权	——
DG5N60 中高压功率场效应管	——
DG2N60 功率场效应管	——
DG4N60 功率场效应管	——

（二）主要产品的工艺流程图

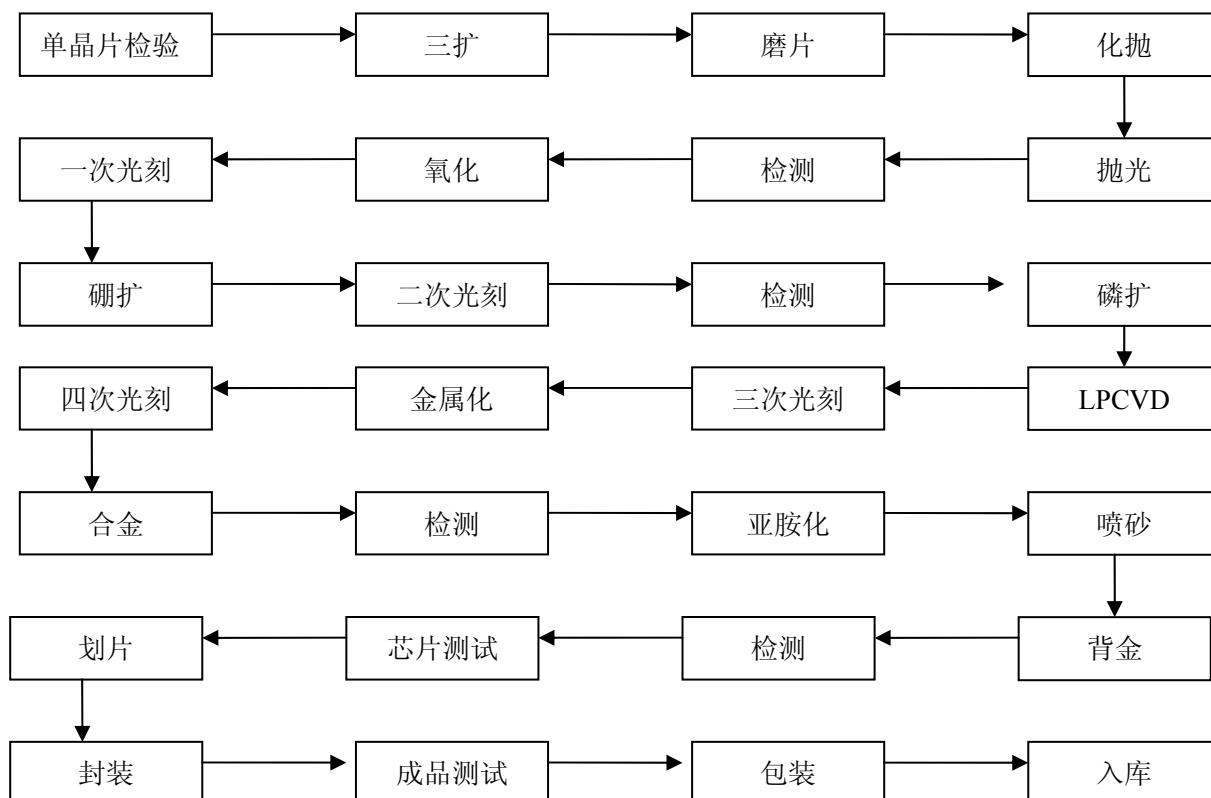
1、防护器件工艺流程图



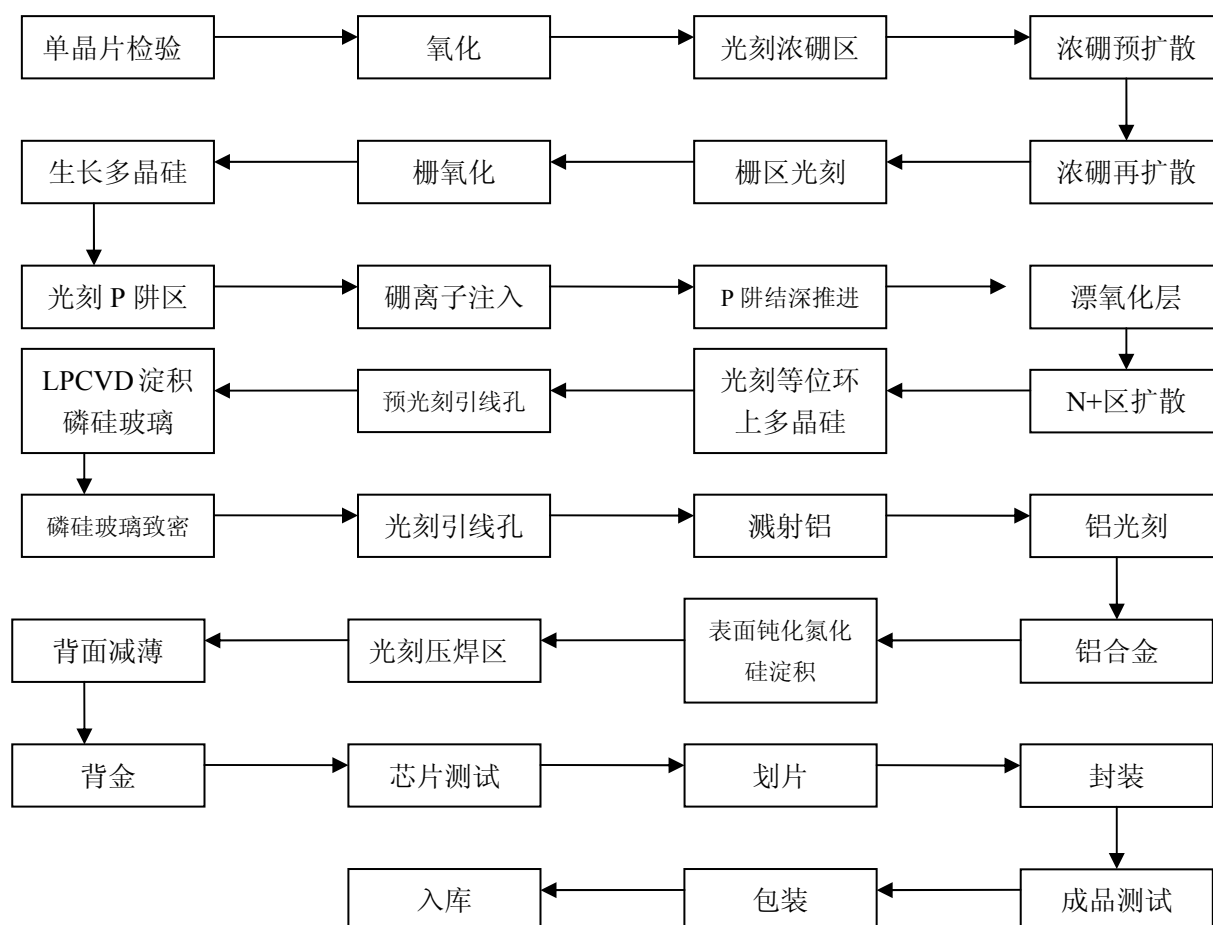
2、可控硅工艺流程图



3、1300X 工艺流程图



4、VDMOS 工艺流程图



（三）主要经营模式

1、采购模式

结合采购计划、生产及库存，公司直接向原材料供应商进行采购。公司有一套严格的合格供应商资质认定制度，采购范围严格限定在合格供应商内部。为保证供货的稳定性，主要的原辅材料供应商最少维持两家以上。同等品质情况下，主要根据价格、服务态度、供货期、售后服务质量、信用期等因素考虑采购。大额采购则在合格供应商中采用招投标方式进行遴选。另外，公司会进一步拓展供应渠道，不断降低采购成本。

2、生产模式

公司生产模式为年初根据库存情况和预计的市场需求制订年度产供销计划，再结合市场变化，逐步分解为季度计划及月度计划，并将计划下发到生产、供应、财务、仓库、质检等相关部门。生产车间根据销售状况、生产能力和库存状况，安排生产。公司每周都会组织产供销协调会，及时调整生产和销售计划。同时，考虑到产品生产期间相对较长，在 20 天到 75 天之间，因此在生产过程中，会根据成熟客户群的需求和新客户的开发进度，提前组织生产。

就封装环节而言，目前公司封装能力有限，2009 年防护器件中只有 SA 型号的放电管在公司内部自行完成封装，可控硅系列产品只有 13.80%由公司自行封装，1300X 系列产品仅有 0.09%由公司自行封装；其余的芯片均由委托专业封装企业进行外协封装加工，封装完成后再将成品交付本公司。

3、销售模式

公司全部产品均是以公司自有品牌向下游客户直接销售。公司坚持以品牌、技术推产品，采用市场调研——销售人员主动上门推销——样品介绍——送样检测——取得订单——售后根据客户要求不断改进产品性能和工艺的销售流程，这样一个完整的直销流程使得公司能对客户提出的产品设计需求、性能改进进行快速响应，有利于保持客户的稳定性，明显优于采取代理销售模式的半导体器件生产厂家。

这种直销策略还可以在公司新老产品之间进行互相促进的协同作用，例如，

1300X 和 VDMOS 产品的客户有重合性，因为在节能灯领域，1300X 产品由于能效转换率低，在推广节能减排、绿色照明的过程中，未来可能逐步被 VDMOS 产品所取代。公司注意到了这一市场未来发展方向，在 1300X 系列产品的营销过程中，也同时替公司的 VDMOS 产品做宣传，并成功发展出如晨怡(浙江)电子实业有限公司、杭州斌翔照明有限公司、安徽万德福电子有限公司等客户，因此能迅速打开 VDMOS 市场，在目前国内自主品牌的 VDMOS 产品当中，江苏东光很快具有了较高的影响力。

公司营销部在重要销售区域如浙江、广东、江苏等地还设立了办事处，负责其区域内的客户开发、客户维护、售后服务等工作。经过多年的营销实践和市场磨练，公司已具有一支有丰富营销经验和战斗力、熟悉国内外同类产品市场的营销队伍。

（四）发行人主要产品产销情况

1、主要产品产能及产能利用率

产品类别	项目	2010 年 1-6 月	2009 年	2008 年	2007 年
防护器件	产能(万只)	6,500.00	12,000.00	8,600.00	6,000.00
	产量(万只)	6,723.01	12,606.48	8,628.11	5,748.10
	产能利用率(%)	103.43	105.05%	100.33%	95.80%
可控硅	产能(万只)	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	产量(万只)	3,449.52	5,521.36	6,117.23	7,493.03
	产能利用率(%)	86.24	69.02%	76.47%	93.66%
1300X	产能(万只)	6,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00
	产量(万只)	3,687.07	8,925.69	9,150.46	7,815.76
	产能利用率(%)	61.45	74.38%	76.25%	78.16%
VDMOS	产能(万只)	5,000.00	10,000.00	8,000.00	N/A
	产量(万只)	3,112.53	5,018.46	1,897.86	N/A
	产能利用率(%)	62.25	50.18%	23.72%	N/A

注1：VDMOS2008年才开始投产，因此2007年没有数据，下同。

注2：2010年上半年的产能未考虑季节性因素的影响，按全年产能的一半计算；2010年上半年防护器件通过技改投入新增产能500万只。

从上表中可以看出，公司防护器件类产品已达到满产，可控硅和 1300X 由于近年来调整产品结构，逐步转向高毛利的产品领域，因此产能利用率出现波动。

VDMOS 于 2008 年初开始投产，最近两年产能利用率逐步提升，2009

年产能利用率为 50.18%。主要原因在于：首先，公司购买的这条进口生产线原用于生产 CMOS，CMOS 生产线的设备用于生产 VDMOS，有些工序的设备不适用，需要改造，还有些工序的设备需要添加，因此对个别设备的改造、调整也需要一定的时间；其次，VDMOS 生产线引进以后，公司技术人员需要有对生产线的熟悉过程，生产员工也需要进行相关培训；第三，VDMOS 产品在销售给客户的时候，每家客户都会对其各种性能参数指标进行检测，检测合格后才会下订单，有些还要经终端客户检测合格方可进行采购，这个过程往往需要半年，大的厂商甚至需要一年的时间。因此，2008 年投产当年的产能利用率只有 23.72%。但随着公司生产设备不断调试理想，VDMOS 产品性能、质量的改进和提高，客户对 VDMOS 产品检测程序的完成，VDMOS 的客户量和客户采购量不断提升，该生产线的产量也迅速上升，2009 年产能利用率为 50.18%，2010 年上半年产能利用率进一步上升为 62.25%。

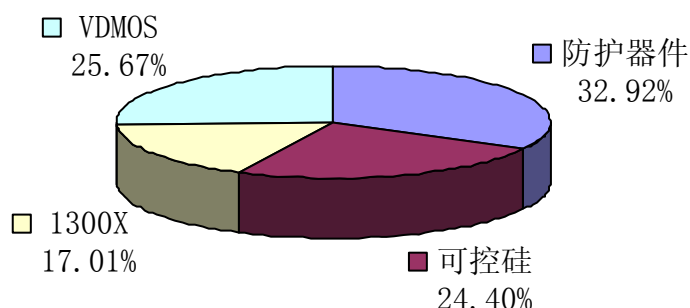
2、主要产品销量及产销率

产品类别	项目	2010 年 1-6 月	2009 年	2008 年	2007 年
防护器件	产量(万只)	6,723.01	12,606.48	8,628.11	5,748.10
	销量(万只)	7,046.85	11,878.31	8,794.72	5,636.64
	产销率 (%)	104.82	94.22	101.93	98.06
可控硅	产量(万只)	3,449.52	5,521.36	6,117.23	7,493.03
	销量(万只)	3,403.29	5,595.02	6,735.70	8,083.34
	产销率 (%)	98.66	101.33	110.11	107.88
1300X	产量(万只)	3,687.07	8,925.69	9,150.46	7,815.76
	销量(万只)	3,930.39	8,658.85	10,211.16	7,192.78
	产销率 (%)	106.60	97.01	111.59	92.03
VDMOS	产量(万只)	3,112.53	5,018.46	1,897.86	N/A
	销量(万只)	3,325.56	4,349.50	1,867.95	N/A
	产销率 (%)	106.84	86.67	98.42	N/A

3、主要产品的销售收入

主要产品	2010 年 1-6 月		2009 年		2008 年		2007 年	
	销售收入 (万元)	占营业收入 的比例	销售收入 (万元)	占营业收入 的比例	销售收入 (万元)	占营业收入 的比例	销售收入 (万元)	占营业收入 的比例
防护器件	3,090.41	30.10%	5,337.14	32.92%	4,167.56	28.73%	2,728.68	24.70%
可控硅	2,466.36	24.02%	3,955.13	24.40%	4,610.30	31.78%	5,367.98	48.59%
1300X	1,350.90	13.16%	2,757.20	17.01%	3,780.04	26.06%	2,951.76	26.72%
VDMOS	3,360.70	32.73%	4,161.74	25.67%	1,948.96	13.43%	N/A	N/A

2009年主要产品销售收入结构图



4、主要产品的销售单价及变动趋势

产品类别	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度
	平均单价 (元/只)	同比变动 (%)	平均单价 (元/只)	同比变动 (%)	平均单价 (元/只)	同比变动 (%)	平均单价 (元/只)
防护器件	0.44	-2.22	0.45	-4.26	0.47	-2.08	0.48
可控硅	0.72	1.41	0.71	4.41	0.68	3.03	0.66
1300X	0.34	6.25	0.32	-13.51	0.37	-9.76	0.41
VDMOS	1.01	5.21	0.96	-7.69	1.04	N/A	N/A

从上表中可以看出，报告期内，由于主要原材料单晶硅价格下跌，除可控硅自 2007 年开始调整产品结构后平均单价逐年上升外，其他几大主要产品单价均处于下跌趋势。特别是用于节能灯领域的 1300X 系列产品，在金融危机影响下，使用节能灯的企业和用户倾向于采用瓦数更低的小规格节能灯产品，相对价格也比较低，因此平均单价下降较多。2010 年起，公司开始调整 1300X 的产品结构，逐步发展毛利率较高的电源用 1300X 市场，使 1300X 销售单价有所提高。同时，2010 年起生产了更多大规格的 VDMOS 产品，使 VDMOS 产品单价较 2009 年有所上升。

5、报告期内向前十名客户销售情况

年份	前 10 名客户名称	销售金额 (万元)	占当期销售总额的比重
2010 年	深圳市杰坤电子有限公司	711.87	6.93%

1-6 月	常熟市天银机电有限公司	383.38	3.73%
	南京八达通信设备有限公司	333.21	3.24%
	深圳市盈源电子有限公司	308.25	3.00%
	浙江万马集团电子有限公司	291.14	2.84%
	深圳市中兴新地通信器材有限公司	279.07	2.72%
	深圳市申欣电子有限公司	264.43	2.58%
	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司	213.56	2.08%
	深圳欧陆通电子有限公司	207.98	2.03%
	晨怡（浙江）电子实业有限公司	202.95	1.98%
	合 计	3,195.83	31.12%
2009 年	深圳市中兴新地通信器材有限公司	688.42	4.25%
	晨怡(浙江)电子实业有限公司	615.70	3.80%
	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司	527.42	3.25%
	常熟市天银机电有限公司	506.65	3.12%
	深圳市申欣电子有限公司	482.82	2.98%
	浙江万马集团电子有限公司	425.58	2.63%
	余姚市天翔通讯器材有限公司	381.72	2.35%
	苏州市百瑞电子有限公司	373.02	2.30%
	绍兴创益照明电器有限公司	323.25	1.99%
	杭州钦远科工有限公司	316.07	1.95%
	合 计	4,640.65	28.63%
2008 年	深圳市中兴新地通信器材有限公司	724.09	4.99%
	晨怡(浙江)电子实业有限公司	720.01	4.96%
	江苏香江电信设备有限公司	655.81	4.52%
	重庆三木华瑞机电有限公司	383.79	2.65%
	苏州市百诺贸易有限公司	376.70	2.60%
	杭州德成电子有限公司	369.34	2.55%
	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司	362.67	2.50%
	宁波凯耀电器制造有限公司	326.93	2.25%
	杭州亮亮电子照明有限公司	319.26	2.20%
	深圳市申欣电子有限公司	318.18	2.19%
	合 计	4,556.79	31.41%
2007 年	重庆三木华瑞机电有限公司	599.32	5.42%
	晨怡(浙江)电子实业有限公司	573.07	5.19%
	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司	427.32	3.87%
	苏州市百诺贸易有限公司	393.64	3.56%
	无锡市盛泰电子器件有限公司	373.07	3.38%

	永康市法得电器有限公司	356.36	3.23%
	江苏金鼎电动工具集团有限公司	351.93	3.19%
	杭州德成电子有限公司	327.56	2.96%
	景德镇普天凯特通信设备有限公司	323.26	2.93%
	重庆力华自动化技术有限责任公司	276.73	2.50%
	合 计	4,002.25	36.22%

2009 年，前十大客户及其采购产品类型及占该客户采购品种的比重情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	采购产品类型							
		防护器件		VDMOS		可控硅		1300X	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1	深圳市中兴新地通信器材有限公司	688.42	100%	-	-	-	-	-	-
2	晨怡（浙江）电子实业有限公司	-	-	415.92	100%	-	-	199.78	40%
3	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司	441.89	100%	85.53	100%	-	-	-	-
4	常熟市天银机电有限公司	-	-	-	-	506.65	100%	-	-
5	深圳市申欣电子有限公司	-	-	-	-	482.82	50%	-	-
6	浙江万马集团电子有限公司	425.58	80%	-	-	-	-	-	-
7	余姚市天翔通讯器材有限公司	381.72	100%	-	-	-	-	-	-
8	苏州市百瑞电子有限公司	-	-	202.09	50%	170.94	80%	-	-
9	绍兴创益照明电器有限公司	-	-	242.90	70%	-	-	80.35	20%
10	杭州钦远科工有限公司	-	-	83.83	90%	-	-	232.25	80%
合计		1,937.61	-	1,030.26	-	1,160.40	-	512.38	-

2008 年，前十大客户及其采购产品类型及占该客户采购品种的比重情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	采购产品类型							
		防护器件		VDMOS		可控硅		1300X	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1	深圳市中兴新地通信器材有限公司	724.09	100%	-	-	-	-	-	-
2	晨怡（浙江）电子实业有限公司	-	-	199.82	100%	-	-	520.20	40%
3	江苏香江科技股份有限公司	655.81	100%	-	-	-	-	-	-
4	重庆三木华瑞机电有限公司	-	-	-	-	383.79	70%	-	-
5	苏州市百诺贸易有限公司	-	-	-	-	376.70	30%	-	-
6	杭州德成电子有限公司	-	-	128.34	40%	-	-	241.00	20%
7	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司	362.67	100%	-	-	-	-	-	-

8	宁波凯耀电器制造有限公司	-	-	-	-	4.62	30%	322.31	80%
9	杭州亮亮电子照明有限公司	-	-	-	-	-	-	319.26	70%
10	深圳市申欣电子有限公司	-	-	-	-	318.18	40%	-	-
合计		1,742.57	-	328.16	-	1,083.28	-	1,402.77	-

2007 年，前十大客户及其采购产品类型及占该客户采购品种的比重情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	采购产品类型							
		防护器件		VDMOS		可控硅		1300X	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1	重庆三木华瑞机电有限公司	-	-	-	-	599.32	90%	-	-
2	晨怡（浙江）电子实业有限公司	-	-	-	-	-	-	573.07	40%
3	宁波市镇海恒利通讯设备实业有限公司	427.32	100%	-	-	-	-	-	-
4	苏州市百诺贸易有限公司	-	-	-	-	393.64	20%	-	-
5	无锡市盛泰电子器件有限公司	-	-	-	-	373.07	100%	-	-
6	永康市法得电器有限公司	-	-	-	-	356.36	90%	-	-
7	江苏金鼎电动工具集团有限公司	-	-	-	-	351.93	100%	-	-
8	杭州德成电子有限公司	-	-	-	-	-	-	327.56	20%
9	景德镇普天凯特通信设备有限公司	323.26	100%	-	-	-	-	-	-
10	重庆力华自动化技术有限责任公司	-	-	-	-	276.73	-	-	-
合计		750.57	-	-	-	2,351.05	-	900.63	-

注：除无锡盛泰已于 2009 年 12 月 28 日注销和重庆力华自动化技术有限责任公司未获得信息外，报告期内公司前十大客户采购产品占该客户采购品种的比重数据均依据公司营销部门了解的情况填列。

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况。

其中，2007 年第五名客户无锡盛泰为公司关联方，详见“**第七节 同业竞争与关联交易/二、关联方、关联关系和关联交易/（一）关联方和关联关系**”。除此之外公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。

（五）发行人主要原材料和能源供应情况

1、报告期内主要原材料供应情况

本公司产品的主要原材料包括单晶硅片、极片、化学试剂、引线框架等，基本上全部在国内采购。其中单晶硅片、化学试剂用于各主要产品，极片用于夹持式放电管的封装，引线框架用于贴片式放电管、可控硅、1300X 的封装。

另外，由于目前公司自身的封装能力有限，2009 年防护器件产品中只有 SA 型号的放电管在公司内部自行完成封装，可控硅系列产品只有 13.80%由公司自行封装，1300X 系列产品仅有 0.09%由公司自行封装；其余的芯片均由专业封装企业进行委托封装加工，封装完成后再将成品交付本公司。

2、报告期内主要能源供应情况

公司生产主要耗用能源为电力、氧气和氮气。

近年来随着公司生产规模快速增长，耗用电力逐年增加。电力近年来价格基本稳定。本公司作为地方重点企业，属宜兴市少数几家重点能源保障企业之一。公司用电全部由江苏省电力公司宜兴供电公司提供。宜兴市供电公司是江苏省首批国电公司县级一流供电企业，完全有能力保障公司的电力供应。公司针对因自然灾害等原因可能导致的突然断电，采用了 UPS 电源提供不间断供电，能保证设备在一定时间内正常运行并进行正常关机。

氧气是反应性气体，在半导体器件制造过程中注入扩散炉炉管，在高温条件下，与硅片表面发生反应，生成氧化层，也用于干法去胶，在去胶设备中被电离成氧离子，与光刻胶反应生成气体。氮气是保护性气体，在许多半导体工艺中使用。

3、主要原材料、能源价格变动趋势

原材料类别	计量单位	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度
		平均单价（元）	同比变动（%）	平均单价（元）	同比变动（%）	平均单价（元）	同比变动（%）	平均单价（元）
单晶片 3'	片	19.80	-14.69	23.21	-28.38	32.41	1.06	32.07
单晶片 4'	片	34.26	-16.93	41.24	-30.60	59.42	1.94	58.29
4' 抛光片	片	N/A	N/A	100.25	-4.82	105.33	N/A	N/A
外延片	片	135.70	-3.98	141.33	-15.92	168.09	-4.53	176.07
化学试剂	升	8.370	0.00	8.37	-9.32	9.23	-1.8	9.40
配套试剂	升	36.16	0.00	36.16	-12.47	41.31	-12.09	46.99
化 学 试 剂	升	22.40	0.00	22.40	-1.75	22.80	N/A	N/A

MOS								
引线框架	只	0.13	8.33	0.12	-14.29	0.14	-6.67	0.15
极片	只	0.026	-7.14	0.028	-9.68	0.031	-6.06	0.033
电力	度	0.68	6.25	0.64	3.23	0.62	-3.13	0.64
氮气	吨	693.03	-1.12	700.85	0.99	693.99	1.50	683.76
氧气	吨	715.78	-0.30	717.95	0.003	717.93	0.006	717.89

注：公司 2010 年不再采购 4'抛光片，而是采购单晶片后自行批量加工。

单晶硅是芯片制造最主要的原材料，报告期内公司生产用的单晶硅采购单价随着制造单晶硅的多晶硅价格波动而波动，同时受到公司采购量的影响。报告期内其他原材料由于公司采购量的上升以及金融危机下原材料供应商竞争压力的增加而普遍呈现价格下降趋势。

4、各主要产品所用的主要原材料及能源占采购的比重情况

年份	原材料、能源	计量单位	当期平均单价(元)	采购金额（万元）	占当期原材料采购总额的比例（%）
2010 年 1-6 月	单晶片 3'	片	19.80	314	6.68
	单晶片 4'	片	34.26	185.54	3.95
	4'抛光片	片	N/A	N/A	N/A
	外延片	片	135.70	491.19	10.45
	化学试剂	升	8.37	95.15	2.03
	配套试剂	升	36.16	43.26	0.92
	化学试剂 MOS	升	22.4	82.9	1.76
	引线框架	只	0.13	22.99	0.49
	极片	只	0.026	237.32	5.05
	电力	度	0.68	510.99	10.87
	氮气	吨	693.03	77.66	1.65
	氧气	吨	715.78	4.68	0.1
	外协封装	只	0.18	2,210.78	47.05
	合计	-		4,276.47	90.01
2009 年	单晶片 3'	片	23.21	765.18	8.22
	单晶片 4'	片	41.24	562.47	6.04
	4'抛光片	片	100.25	28.49	0.31
	外延片	片	141.33	974.91	10.47
	化学试剂	升	8.37	217.08	2.33
	配套试剂	升	36.16	97.61	1.05
	化学试剂 MOS	升	22.40	154.76	1.66
	引线框架	只	0.12	99.77	1.07
	极片	只	0.028	611.09	6.56
	电力	度	0.64	1,031.76	11.08

	氮气	吨	700.85	147.66	1.59
	氧气	吨	717.95	7.02	0.08
	外协封装	只	0.17	3,777.00	40.56
	合计	-	-	8,474.80	91.02
2008 年	单晶片 3'	片	32.41	884.42	10.33
	单晶片 4'	片	59.42	323.71	3.78
	4'抛光片	片	105.33	223.32	2.61
	外延片	片	168.09	678.66	7.93
	化学试剂	升	9.23	192.70	2.25
	配套试剂	升	41.31	51.89	0.61
	化学试剂 MOS	升	22.80	112.74	1.32
	引线框架	只	0.14	304.92	3.56
	极片	只	0.031	447.18	5.22
	电力	度	0.62	956.04	11.17
	氮气	吨	693.99	121.77	1.42
	氧气	吨	717.93	5.95	0.07
	外协封装	只	0.19	3,256.00	38.04
	合计	-	-	7,559.30	88.32
2007 年	单晶片 3'	片	32.07	900.67	13.52
	单晶片 4'	片	58.29	382.22	5.74
	外延片	片	176.07	29.77	0.45
	化学试剂	升	9.40	190.88	2.87
	配套试剂	升	46.99	42.66	0.64
	引线框架	只	0.15	415.36	6.24
	极片	只	0.033	234.40	3.52
	电力	度	0.64	717.76	10.78
	氮气	吨	683.76	57.49	0.86
	氧气	吨	717.89	2.71	0.04
	外协封装	只	0.19	2,873.00	43.14
	合计	-	-	5,846.92	87.80

5、报告期内向前五名供应商采购情况

报告期内本公司向前五名供应商采购情况如下表所示：

年份	前 5 名供应商名称	主要供应品种	金额 (万元)	占当期总采购 额比例(%)
2010 年 1-6 月	宜兴市旭日电子有限公司	外加工	1,037	22.06
	无锡三日电子有限公司	外加工	526	11.20
	中国电子科技集团第四十六研究所	单晶片、外延片	380	8.09
	品捷电子(苏州)有限公司	外加工	364	7.75
	杭州海纳半导体有限公司	单晶片	306	6.51
	合 计	-	2,613	55.61

2009 年	宜兴市旭日电子有限公司	外加工	1,599	17.17
	无锡三日电子有限公司	外加工	739	7.94
	无锡勋达无线电厂	外加工	605	6.50
	杭州海纳半导体有限公司	单晶片	581	6.24
	南京国盛电子有限公司	外延片	564	6.06
	合 计	-	4,088	43.91
2008 年	宜兴市旭日电子有限公司	外加工	1,560	18.23
	无锡勋达无线电厂	外加工	707	8.26
	南京国盛电子有限公司	外延片	640	7.48
	洛阳单晶硅有限责任公司	单晶片	569	6.65
	无锡三日电子有限公司	外加工	491	5.74
	合 计	-	3,967	46.36
2007 年	无锡勋达无线电厂	外加工	1,336	20.06
	宜兴市旭日电子有限公司	外加工	1,123	16.86
	洛阳单晶硅有限责任公司	单晶片	540	8.11
	杭州海纳半导体有限公司	单晶片	526	7.90
	宁波康强电子有限公司	引线框架	239	3.59
	合 计	-	3,764	56.52

报告期内，本公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况，也不存在前五名供应商中有公司关联方的情况。

本公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

（六）环境保护、安全生产情况

1、污染排放物情况

半导体器件制造的污染程度较轻。公司对影响环境的因素进行了有效的管理和控制，达到了国家法规要求的标准。

公司生产过程中污染排放物、环保设施及过程控制情况详见下表：

污染排放物		产生点	处理措施
大气污染物	酸性废气 G1	清洗	经酸雾吸收塔，碱喷淋净化后 25m 排气筒排空
	酸性废气 G3	蚀刻、去胶	经酸雾吸收塔，碱喷淋净化后 25m 排气筒排空
	有机废气 G2	光刻	经活性炭吸收塔净化后 25m 排气筒排空
	有机废气 G4	封装	经活性炭吸收塔净化后

			25m 排气筒排空
	有机废气 G5	气相沉积	尾气燃烧后达标排放
水 污 染 物	酸碱废水	硅片清洗、光刻、刻蚀、去胶	进入酸碱废水处理系统
	研磨废水	CMP	进入研磨废水处理系统
	生活污水	职工生活	进入污水管网
	其它废水	再生废水、废气洗涤塔废水	进入酸碱废水处理系统
固体污 染物	污泥	污水站	环卫部门清运，填埋处理
	生活垃圾	职工生产、生活	环卫部门统一清理
	废液	光刻、刻蚀	有资质单位回收

2、环境达标情况

宜兴市环境保护局对公司现有业务进行核查，并于 2010 年 3 月 19 日出具了《证明》：“兹证明江苏东光微电子股份有限公司 2007 年 1 月 1 日至今，均能遵守环境保护的相关法律与法规，没有因违反有关环境保护的政策、法律法规和规范性文件而被环保主管部门处罚的情形。”

宜兴市环境保护局对发行人子公司东晨电子进行了核查，并于 2010 年 3 月 19 日出具了《证明》：“兹证明宜兴市东晨电子科技有限公司设立至今，均能遵守环境保护的相关法律与法规，没有因违反有关环境保护的政策、法律法规和规范性文件而被环保主管部门处罚的情形。”

五、发行人主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

发行人固定资产主要包括房屋建筑物、运输设备、电子设备、及其他设备等。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第 24716 号《审计报告》，截至 2010 年 6 月 30 日，公司固定资产原值 270,830,352.98 元，累计折旧 70,197,712.60 元，固定资产净值 200,632,640.38 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	43,361,187.37	8,924,587.75	34,436,599.62
运输设备	4,052,390.80	1,526,001.88	2,526,388.92
机器设备	219,372,207.72	56,850,094.38	162,522,113.34
电子设备	4,044,567.09	2,897,028.59	1,147,538.50

合计	270,830,352.98	70,197,712.60	200,632,640.38
----	----------------	---------------	----------------

截至 2010 年 6 月 30 日，固定资产不存在减值情况。

1、主要生产设备

公司主要运输设备、电子设备、其他设备的账面价值、成新率情况如下：

设备名称	数量/台（套）	取得方式	平均成新率
防护器件生产设备	119	购买	57.66%
可控硅生产设备	120	购买	54.19%
1300X 生产设备	85	购买	38.00%
VDMOS 生产设备	235	购买	78.80%

(1) 公司主要生产设备具体情况如下：（仅列出原值为十万元以上的生产设备）

生产线	序号	资产名称	数量 (台/ 套)	原值 (元)	净值(元)
防护器件生产线	1	镀膜机	3	580,315.85	29,015.79
	2	光刻机	16	1,258,493.16	680,185.77
	3	扩散炉	32	5,587,383.40	2,718,814.36
	4	制水设备	1	260,000.00	13,000.00
	5	测试仪	49	404,970.00	50,213.18
	6	光刻净化间	2	248,600.00	12,430.00
	7	精密自动划片机	2	400,000.00	20,000.00
	8	分立式测试仪	2	261,433.30	167,359.34
	9	冲击电流测试仪	11	151,200.00	7,560.00
	10	水电气系统	1	4,200,000.00	4,000,500.00
		小计	119	13,352,395.71	7,699,078.44
可控硅生产线	12	分选机	3	276,000.00	149,270.00
	13	腐蚀机	1	1,744,800.00	1,661,922.00
	14	光刻机	10	692,367.52	159,574.01
	15	划片机	4	1,102,415.40	408,784.22
	16	测试仪	56	625,826.01	184,996.22
	17	镀膜机	5	3,900,688.89	3,007,057.83
	18	二氧化硅抛光机	4	526,786.32	193,845.09
	19	净化空调	1	792,000.00	39,600.00
	20	扩散炉	22	1,409,666.66	383,128.07
	21	塑封模具	5	281,000.00	88,276.92
	22	塑料封装压机	1	246,000.00	82,410.00

	23	探针台	7	622,948.72	411,671.04
	24	制水设备	1	440,800.00	90,667.86
	小计		120	12,661,299.52	6,861,203.26
1300 生产线	25	清洗机	2	114,000.00	16,530.00
	26	单面光刻机	4	712,000.00	497,806.73
	27	分立式测试仪	2	324,576.00	139,567.68
	28	分选机	2	184,000.00	99,513.43
	29	光刻机	1	336,000.00	48,720.00
	30	净化房	1	1,530,000.00	678,799.86
	31	扩散炉	6	880,000.00	99,733.52
	32	气相沉积系统	1	580,000.00	84,100.18
	33	全自动测试配套	3	240,000.00	137,400.00
	34	数显匀胶机	6	150,000.00	17,000.00
	35	甩干机	1	168,000.00	24,360.00
	36	探针台	2	190,000.00	69,666.80
	37	图示仪	52	242,349.14	114,143.67
	38	研磨机	1	210,000.00	23,800.00
	39	自动划片机	1	500,000.00	366,406.16
	小计		85	6,360,925.14	2,417,548.03
VDMOS 生产线	40	氢气纯化器	1	2,726,611.68	1,998,095.25
	41	低温液体贮槽	1	656,000.00	480,724.91
	42	真空吸尘机组	1	320,800.00	235,086.34
	43	空气过滤器	1	438,840.00	321,587.37
	44	PVDF 工艺冷却水管道系统	1	1,149,103.68	842,077.50
	45	风机滤网机组	1	897,600.00	657,772.50
	46	冷水机组	3	1,447,000.00	1,060,379.71
	47	高效送风口	1	269,100.00	197,199.81
	48	冷却塔	3	213,500.00	156,455.48
	49	废气酸雾净化塔	2	550,000.00	403,046.83
	50	空压机及配套	3	240,700.00	167,582.16
	51	保温材料	1	342,485.15	250,977.29
	52	气体管道	2	3,575,237.94	2,743,845.74
	53	蒸汽管道系统	1	651,876.83	477,703.61
	54	组合式空调机组	3	438,000.00	320,971.74
	55	自循环风机	1	708,924.00	519,508.47
	56	特气供应系统	1	2,664,988.19	1,952,936.63
	57	MOS 工程配套水电气系统	1	7,888,207.00	5,780,576.74
	58	空调控制系统	1	2,398,800.00	2,284,857.00

59	空调机组	1	1,148,926.00	1,094,352.04
60	水处理设备	1	2,802,000.00	2,668,905.00
61	工艺冷却水管道系统	1	967,114.30	785,276.70
62	激光打标机	1	102,000.00	56,780.00
63	进口生产线一条	182	117,817,853.39	91,457,650.24
64	减薄机	1	1,092,449.92	1,040,558.56
65	CV 测试仪	1	310,392.01	295,648.39
66	炉管清洗机	1	138,000.00	131,445.00
67	LPCVD	5	3,840,000.00	3,657,600.00
68	分立器件测试仪	1	293,462.00	279,522.56
69	扩散炉	1	1,800,000.00	945,000.00
70	防静电装置地板	1	2,585,503.44	1,894,689.27
71	视频监控系统	4	266,195.00	195,071.06
72	MOS 线洁净室壁板系统	1	2,557,039.09	1,873,930.28
73	特气报警工程	1	810,040.00	657,735.62
74	传感器	1	110,427.35	102,777.96
75	特气、氧气、氮气管道系统	1	3,312,014.01	3,150,511.27
76	污水处理设备	1	5,350,000.00	5,095,874.98
	小计	235	172,881,190.98	136,234,714.01
	总计	559	205,255,811.95	153,212,543.74

2、房屋建筑物

序号	座落地址	房产证号	建筑面积 (平米)	取得 方式	他项权利 情况
1	宜兴市环科园绿园路 42 号	宜房权证宜城字第 A0025893 号	1,388.82	股东 投入	抵押
2	宜兴市环科园原丝厂 综合楼东幢（部分）	宜房权证宜城字第 A0026841 号	3,045.46	自建	抵押
3	宜兴市新街镇百合村 宜广公路南	宜房权证新街字第 AE000130 号	93.57	自建	抵押
4	宜兴市新街镇百合村 宜广公路南	宜房权证新街字第 AE000131 号	290.75	自建	抵押
5	宜兴市新街镇百合村 宜广公路南	宜房权证新街字第 AE000132 号	66.55	自建	抵押
6	宜兴市新街镇百合村 宜广公路南	宜房权证新街字第 AE000133 号	3,536.86	自建	抵押
7	宜兴市新街镇百合村 宜广公路南	宜房权证新街字第 AE000134 号	2,428.99	自建	抵押
8	宜兴市新街镇百合村 宜广公路南	宜房权证新街字第 AE000135 号	1,035.44	自建	抵押
9	宜兴市新街镇百合村	宜房权证新街字第	1,315.64	自建	抵押

	宜广公路南	AE000136 号			
10	宜兴市新街街道百合工业园	宜房权证宜城字第 1000012760 号	2,560.99	自建	抵押
11	宜兴市新街街道百合工业园	宜房权证宜城字第 1000012761 号	5,714.10	自建	抵押
12	宜兴市新街街道百合工业园	宜房权证宜城字第 1000012764 号	448.88	自建	抵押
13	宜兴市新街街道百合工业园	宜房权证宜城字第 1000012770 号	248.15	自建	抵押
14	宜兴市新街街道百合工业园	宜房权证宜城字第 1000012775 号	388.50	自建	抵押

（二）主要无形资产

1、土地使用权

序号	土地座落	面积(m ²)	终止日期	用途	类型	证书编号	他项权利
1	宜兴市宜城镇南河村	551.5	2051/11/6	城镇混合住宅用地	出让	宜国用(2003)字第 000548 号	抵押
2	宜兴市宜城镇南河村	1,271.6	2051/11/6	城镇混合住宅用地	出让	宜国用(2003)字第 000549 号	抵押
3	宜兴市新街镇百合村新街村	17,540.4	2053/1/20	工业用地	出让	宜国用(2003)字第 000596 号	抵押
4	宜兴市新街镇百合村	15,867.2	2055/11/17	工业用地	出让	宜国用(2006)字第 000089 号	抵押
5	宜兴市新街镇百合村	56,800.9	2057/6/26	工业用地	出让	宜国用(2009)第 28600002 号	抵押

2、注册商标



（1）发行人拥有“ ”图文注册商标：商标注册证号为第 4423303 号；核定使用商标第 9 类：半导体器件，集成电路，非照明用放电管，晶体管（电子），集成电路块，自动定时开关；磁性材料和器件、插头、插座及其他接触器（电接头），高低压开关板；注册有效期限自 2007 年 10 月 14 日至 2017 年 10 月 13 日。



(2) 发行人拥有“ 宣字”图文注册商标：商标注册证号为第 1408448 号；核定使用商品第 9 类：非照明用放电管，半导体器件，高低压开关板，插头，插座及其他接触器(电接头)，磁性材料和器件，自动定时开关；注册有效期限自 2010 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

3、专利权

(1) 已取得的专利

序号	专利类型	名称	申请日	专利号	期限
1	实用新型	荧光灯用电子启辉器	2007/2/15	ZL200720034793.4	10 年
2	实用新型	台面型固体放电管管芯	2007/2/15	ZL200720034792.X	10 年
3	实用新型	低电容过电压保护模块	2009/7/22	ZL200920233468.X	10 年

(2) 正在申请中的专利

a、已被受理的发明专利申请：低电容过电压保护模块，申请号为 200910034049.8，申请日期为 2009 年 8 月 19 日，受理日期为 2009 年 9 月 4 日。

4、集成电路布图设计著作权

发行人拥有的集成电路布图设计专有权如下：

序号	名称	申请日	证书号	登记号	期限
1	DLCPI80S 功率集成电路	2001/12/31	第 47 号	BS.01500041.9	10 年
2	YD-CLP200M-X 过电流过电压保护集成电路	2002/5/29	第 105 号	BS.02500050.0	10 年
3	DG5N60 中高压功率场效应管	2007/2/9	第 1805 号	BS.07500029.6	10 年
4	CSC1A02GT 过电流过电压保护集成电路	2007/2/14	第 1505 号	BS.07500043.1	10 年
5	P61089 可调型过电压保护集成电路	2008/4/24	第 1835 号	BS.08500148.1	10 年
6	DG2N60 功率场效应管	2008/4/24	第 1836 号	BS.08500149.X	10 年
7	DG4N60 功率场效应管	2008/4/24	第 1837 号	BS.08500150.3	10 年

(三) 资产许可使用及纠纷情况

公司不存在作为许可方，允许他人使用自己所拥有的知识产权、非专利技术等资产的情况；公司也不存在作为被许可方，使用他人的知识产权、非专利技术等资产的情况。

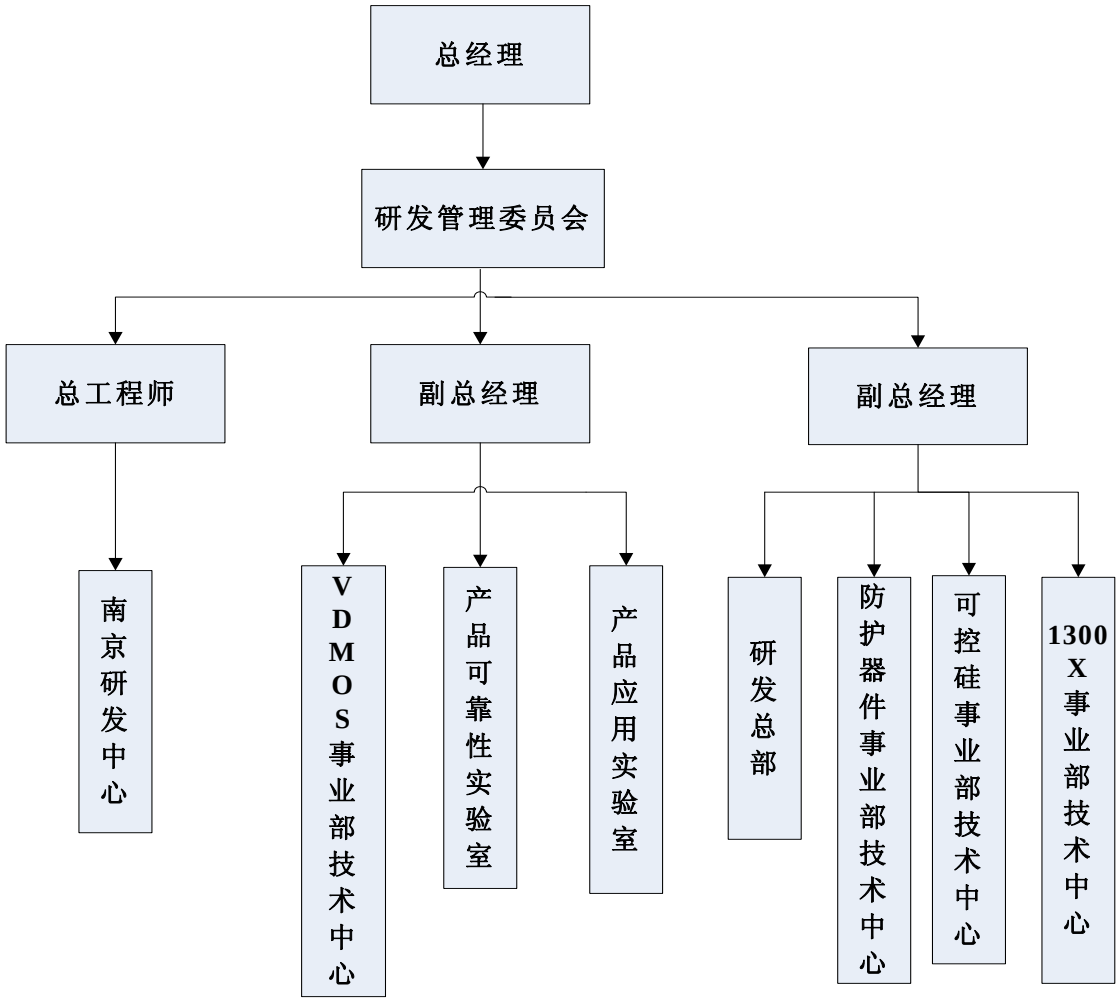
截至本招股说明书签署日，公司的知识产权、非专利技术、土地使用权等资产不存在纠纷或潜在纠纷。

六、发行人技术研发情况

（一）发行人技术概况

公司通过研发管理委员会对全公司的研发工作进行管理和规划，具有一整套促进研究开发的制度，拥有一批核心的技术人员，并组建了南京研发中心，由公司总工程师刘光廷教授领导，进行半导体器件新技术的研发。公司内部还设立了研发总部和四大产品的技术中心，由研发总部负责根据市场需求提出新的研发方向，设计研发思路，开发新产品；而四大系列产品的技术中心负责对各产品的性能和技术改进开展具体的研发实践工作。

公司研发组织结构图如下：



公司的研发团队共有 86 人，其中包括大学教授 3 人（其中两名为外聘专家）、研究员 2 人、高级工程师 6 人；从学历结构上来看包括博士 2 名、硕士 5 名。公司拟继续在国内半导体业界招聘多名高级专业技术人才，以进一步增强公司的研发力量。

（二）公司主要核心技术

	关键技术	技术特点
防护器件	版图优化设计	采用先进的器件仿真软件对器件的性能参数进行仿真，得到了器件的最优表面结构设计和最佳的布局，维持电流、击穿电压等参数得到了综合优化，从而使器件均匀开通，提高耐冲击能力。
	发射极短路点技术	采用发射极短路点结构得到最佳的阻断电压和通态电压的参数组合。
	线性缓变结技术	采用线性缓变深结和结终端技术使硼结满足平行平面结击穿条件，提高器件抗冲击能力。
	窄基区、高浓度掺杂技术	增加注入效率和大的输运系数，降低导通压降，提高对雷电浪涌响应速度和耐冲击能力。
	注入调节衬底电阻率技术	磷离子使得器件电压控制摆脱了对硅片衬底电阻率的强烈依赖性，使得击穿电压 V_{BR} 的精准控制成为可能。
	多重金属化技术	采用高真空电子束蒸发 Ti、Ni、Ag 三重金属的电极和真空合金等工艺结合，解决了金属层与硅片间接触电阻最小化和金属层粘附牢固度的问题，增强了器件的可靠性，提高器件抗冲击能力。
	漏电流的控制技术	采用了场氧化、主扩散掺 HCl 等新型表面钝化技术减少了器件的漏电流；表面用 LPCVD 淀积 Si_3N_4 ，有效地防止封装过程引入的离子沾污，保障产品漏电流低于规范值，减少了器件在电路中的功率损耗。器件绝缘电阻达到了优良的范围。
可控硅系列	镓硼复合扩散技术	采用该种扩散工艺形成的独特的载流子杂质浓度梯度分布 PN 结结构，既满足了器件高电压的要求，同时能承受大电流浪涌冲击
	PN 结表面多层防护工艺技术	对于界面所有电荷具有自动调节、补偿、屏蔽、消除作用，彻底消除了击穿电压突变现象，使器件在高温、高湿、强电场等恶劣条件下也能长时间工作；并且相比传统的 PN 结表面玻璃钝化防护工艺可提高 PN 结的击穿电压。
	芯片表面多层金属化制造技术	通过对多层金属材料的筛选以及各金属层厚度的优化匹配，形成的芯片表面多层金属化制造技术增强了器件抗热疲劳和大电流浪涌冲击能力，提高了器件的热稳定性和可靠性。
1300X 系列	三重扩散技术	保证有较厚的 N+ 层，使芯片具有较低的饱和压降和较高的反向击穿电压。
	高压钝化技术	终端采用平面分压环结构，在表面通过 LPCVD 生长一层 PSG，及铝上采用聚希亚胺钝化工艺，保证了较小的高温漏电及较高的反向击穿电压。
	多层金属化技术	保证了良好的欧姆接触和抗热疲劳的稳定性。
	抗饱和和网络技术	集成了有源抗饱和和网络，提高了产品的可靠性。

VDMOS 系列	新型芯片设计技术	采用高密度设计和较少光刻次数的工艺技术，能够制造出相同性能的器件，降低了成本，提高了市场竞争力
	栅源保护结构技术	增加了抗 EAS，ESD 能力，提高了产品的可靠性，合格率
	缺陷密度控制技术	具有减少硅片缺陷密度的明显特点，保证了产品性能稳定
	微细加工技术	采用高分辨率、全自对准的 Nikon 步进光刻机实现图形转移
	精确掺杂	采用高能量、高速流的离子注入机进行精确掺杂
	背面金属化技术	采用独特的背面金属化工艺方法，晶粒小，金属层附着性、均匀性好、电阻率低，产品可靠性高

（三）公司主要产品技术所处的阶段

本公司的四大系列产品均处于大批量生产阶段，技术和工艺处于成熟阶段。

（四）公司技术开发情况

1、正在从事的研发项目及进展

产品类别	项目名称	项目目的	目前进度
防护系列	低压 DP 系列放电管系列化	丰富产品规格成为全系列产品，拓展新的市场领域	研发成功，批量生产
	缩版、改进型 SA 放电管	提高性能，降低成本	小批量生产阶段
	P61089 可编程过电压保护集成电路	新产品计划，拓展新的市场领域	样品已试制成功，现进行工艺优化
	2D 型低电容模块	新产品计划	客户认证阶段
	微电容 DP 系列	完善产品系列	优化设计，试样阶段
可控硅系列	双台面工艺可控硅芯片	提高合格率，降低生产制造成本	小批量生产阶段
	大电流可控硅 S6065J 研制	完善产品系列，替代进口	小批量供货阶段
	漏电保护及电源保护用可控硅 MCR100-8/C106/BT150	完善产品系列	客户认证阶段
	1600V 大电流可控硅	完善产品系列，拓展应用领域	设计阶段
1300X 系列	电源用双基区功率开关晶体管	降低器件工作时的温升，提高耐电流能力	工艺优化阶段
VDMOS、IGBT 系列	4N60,8N60,12N60 抗 EAS 能力	提高产品可靠性，合格率	全面推进，批量生产阶段
	4N60 抗 ESD 能力	提高产品可靠性，合格率	批量生产阶段
	2N60,4N60 芯片高密度化	降低成本	批量生产阶段
	抗 EAS，ESD 能力，芯片高密度化，三者集成	提高性能，降低成本	实现抗 EAS，芯片高密度化的集成，三者的集

			成进入试样阶段
	低压 MOSFET	产品系列化	优化设计，完善工艺阶段
	中高压 MOSFET	产品系列化	小批量生产阶段
	IGBT 的开发	打破国外垄断	试样阶段

2、研发费用

近三年及一期公司研发投入情况如下：

单位：元

年度	研究开发费用	营业收入	研发费用占营业收入比重
2007 年	7,122,976.80	110,484,140.74	6.45%
2008 年	7,461,613.34	145,068,686.12	5.14%
2009 年	8,440,090.94	162,112,176.89	5.21%
2010 年 1-6 月	4,278,828.70	102,683,748.55	4.17%

（五）技术创新机制

为了提高企业自主技术创新的能力，公司建立一系列促进科研的制度和措施。

（1）设立南京研发中心，形成独立的研发机构，充分保证人员、资金到位。进一步规范研发开发工作的管理程序，采用定课题、定人员、定措施、定进度、定目标、定奖励的措施，在管理上保证研发开发工作的有效推进。

（2）建立激励竞争机制：一是在对研发人员实行政策倾斜的基础上建立岗位级别工资与绩效考核相结合的分配机制；二是建立优胜劣汰机制，定期对研发人员进行一次综合评定，不胜任成员及时调离。具体措施包括：a、将科研开发经费列入专项预算，保证足额并及时到位，使科研开发有足够的资金支持；b、调整薪酬制度，向研发人员倾斜；研发人员在学历提高、职称评定、成果报奖等方面优先；c、定期召开科技工作会议，对做出突出贡献的研发人员进行重奖；d、制定鼓励创新、允许失败的技术创新制度；e、定期选派专业技术人员出国学习、考察、培训；工会定期组织在科技创新工作中有突出成绩的科技人员旅游、考察；f、保证研发人员每年的教育和培训经费投入。

（3）引进国内外半导体业界的高级技术专家和高端人才，充实公司的技术研发队伍，提升技术创新的实力，提高公司在同行业中的技术领先地位。

（4）建立良好的人才培养机制，采用选派技术骨干到国内外接受培训、参与技术研讨会等形式，培养技术拔尖人才，以多种形式提高技术队伍的专业素质。具体措施包括：a、通过外部引进培养人才。几年来，公司以“优厚的待遇吸引人，创新的精神感染人，和谐的环境留住人”，广泛吸纳新人加入到科研开发技术创新活动中来，从而使科研队伍迅速壮大，科研水平不断提高。b、通过企业内部自主培养。结合公司生产技术和科研项目的开展，重点培养一批具有较强实际研发能力和科技素质的骨干人员，通过设立杰出科技人才、技术能手、质量标兵等竞赛活动，充分激励和调动技术人员的积极性，增强创新意识，提高实践水平。

（5）制定了新品研发和重大技改成果奖励办法，对在新品开发、工艺改进、设备改造和专利申报等方面做出突出贡献的组织或个人授予技术奖，并根据办法的具体规定给予相当的物质奖励。

（六）公司对核心技术采取的保密措施

公司为了防止核心技术的泄密主要采取了以下几个方面保护措施：

1、专利和非专利保护：对于适宜公开披露的核心技术，公司通过专利申请使技术得到法律保护；对于不适宜公开披露的核心技术，公司通过制定严格的保密制度来防止创新技术的泄密。

2、签订保密协议：公司与技术研发人员都签订了长期的工作保密合同，对研发成果的所有权、使用权等都作了约定，使公司技术资产的管理有了法律上的保证。

3、核心技术人才的保留：为减少核心技术人员的流动，发行人采取了核心技术人才持股的措施，降低了技术泄密的风险。

4、制定保密制度：公司制定了严格的保密制度，该制度对保密的职责、范围及管理措施均做出了详细的规定。公司还不定期组织员工学习技术保密的法律法规和公司保密规定，以提高全体员工的保密意识。

5、此外，公司的核心技术体系完备，个别技术失密或技术人员的离职不会造成公司整个核心技术体系的失密，公司历史上也未出现过因技术人员流动而造成

成公司技术泄密之情形。

从公司成立以来，公司未发生过与他人或实体发生专利技术侵权的事实，也未发生过非专利技术侵权的重大纠纷，技术保密措施取得了显著效果。

七、发行人质量控制情况

（一）质量控制概况

公司一直坚持“产品质量就是企业生命”的理念，遵循“立东光志气、创一流品牌”的质量方针。公司已通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证，产品通过美国 UL 安全认证、欧洲 RoHS 认证、PAHS 认证、德国莱茵 TUV 安规认证等。

公司建立了完整的质量控制体系——采购管理制度、品质管理制度、产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正及预防措施控制程序、生产现场管理制度、安全文明管理制度等。通过各部门自查、质管部门监督、公司内部质量审核及认证机构审查等多种方式对质量体系的各个要素进行监控和持续改善，保证质量管理体系的有效运行。

（二）质量控制措施

1、严格执行供应商管理制度和原材料进厂检验程序

一是对供应商的选择，要综合考量供应商的质量、价格、产能、售后服务和管理水平等资质，经重复批次的试产合格后，并经公司技术部、使用部门、采购部、法律顾问、财务部、品质检验部门等部门会签确认，最终确定成为公司合格供应商，并且对合格供应商进行定期评价。二是建立原材料技术质量标准和检验方法，并进行严格的进厂检验。对单晶硅等重要的原材料进行进厂全检，从产品源头控制质量。

2、对外协封装进行严格的质量把关

公司制定了严格的封装成品交收检验及考核办法，对封装的材料、产品的符合性、外观、例行试验、电压、压降等方面都作了详细的规定。公司选择外协封装厂，从初期接触到确定由其为公司进行批量封装加工，大约需要半年到一年的时间。首先由公司送样给封装厂进行试封装，然后由品质部对试封装产品进行检

测，达到公司封装要求的标准后，公司会先期交付其一些封装形式较为简单的产品进行封装，然后逐步扩大封装产品的种类。在与不同的封装厂接触的过程中，公司会逐步挑选出在不同形式的封装上具有不同优势的封装厂，然后针对各种封装形式的产品分别选择最佳的封装厂进行封装。

3、强化生产过程的质量控制

一是严格按照产品生产环节流程图制定车间作业指导书，一个车间（班组）配备一个巡检员，实时全程巡检整个产品生产过程，每完成一道工序就进行检验分析，并对关键工序的质量参数进行直方图、连线图、鱼刺图、排列图、因果图等方法及时掌握、分析质量状态。二是推行“6S”管理制度，全面提升管理，从细节着手促进质量管理水平的提升。三是推行节能降耗的“QCC 行动”管理，成立专门的 QCC 小组，采取一系列措施降低不合格品检测的准确性，达到节能降耗的目的。四是加强员工培训，对新员工进行逐级培训，经考核合格后上岗，并通过对在岗作业人员的定期培训考、换岗前培训、专业技能培训等提高人员素质和操作熟练水平。五是推行安全生产责任制，将责任细化到个人，保障生产安全。六是重视生产危机管理，制定应急预案，积极应对因自然灾害等原因导致的断水、断电等情况，最大限度地保全生产设备和保证产品质量。

4、严格实施产品出厂前的质量保证程序

公司不仅在生产环节对成品进行全检，而且在出厂发货前进行例行产品质量试验，并根据客户要求视不同客户进行不同的抽检，产品质量有充分的保证。公司具有先进完备的检测分析仪器和可靠性试验设备，能够自主承担产品的可靠性试验和质量分析工作。

5、注重对客户的售后服务

通过定期回访客户、技术交流和客户满意度调查等方式，多方面了解客户对产品质量的意见和需求。对客户的质量意见建立快速反应机制，即快速回复客户、快速分析原因、快速纠正预防。为保证应用售后服务质量，公司专门聘请一定数量的下游应用领域的应用工程师，定期走访客户，充分利用应用工程师的专业能力，协同客户改进优化设计方案。

（三）质量控制效果

通过改进结构版图设计、提高工艺水平、推广技术经验和操作诀窍、培训提高员工熟练程度等全方位的措施，公司的质量管理水平不断提高，产品全线合格率不断提升，产品质量得到众多客户的一致信赖。防护器件的产品质量已经达到了国际先进水平，其他产品亦达到国内先进水平。

公司 2001 年 8 月获得江苏省质量技术监督局授予的“省级产品质量监督检查合格证书”；2002 年 1 月获得宜兴市经贸局评定的“2001 年度安全生产先进集体”；2006 年 11 月获得江苏省产品质量监督调查办与江苏省 315 维权投诉监督跟踪办等单位评定的“江苏省名优企业”；2006 年 12 月获得江苏无锡市质量监督局、无锡工商行政管理局等部门联合颁发的“06 年度争创守信用、讲信誉、重信义企业先进单位”证书。

（四）产品质量纠纷情况

公司近三年未出现过重大产品质量纠纷。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争情况

（一）本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

目前沈建平先生持有本公司34.70%的股份，为本公司控股股东及实际控制人。沈建平先生除持有本公司的股权外，没有其他对外投资或从事其他业务，因此控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争。

（二）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免在今后的经营活动中与本公司产生同业竞争，维护本公司中小股东合法权益，2010年3月7日，公司控股股东及实际控制人沈建平先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“对于发行人正在经营的业务、产品，保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与发行人业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品；保证不利用其股东地位损害发行人及其它股东的合法权益，同时将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的公司遵守上述承诺。”

（三）公司章程对同业竞争的规定

《公司章程》第三十七条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

《公司章程》第一百零三条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并对公司负有下列忠实义务：……（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；……董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

二、关联方、关联关系和关联交易

（一）关联方和关联关系

1、持有公司 5%以上股份的关联方

序号	股东名称	关联关系
1	沈建平	公司控股股东、实际控制人，持有公司 34.70%的股份；公司董事长、总经理
2	中比基金	公司股东，持有公司 25.51%的股份
3	詹文陆	公司股东，持有公司 8.50%的股份；公司董事
4	丁达中	公司股东，持有公司 7.08%的股份
5	徐志祥	公司股东，持有公司 5.10%的股份；公司副董事长

2、公司控股子公司

宜兴市东晨电子科技有限公司为公司全资子公司，成立于 2009 年 12 月 1 日，注册资本及实收资本均为 1,800 万元人民币，法定代表人沈建平，主要生产经营地与注册地均为宜兴市新街街道百合工业园，经营范围：半导体、集成电路的技术设计、开发、推广应用、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

3、最近三年与公司存在关联交易的其他关联方

梁夕芬，系发行人控股股东、实际控制人沈建平的妻子。

沈建琴，系发行人控股股东、实际控制人沈建平的妹妹。

无锡市盛泰电子器件有限公司，成立于 2007 年 4 月 23 日，注册资本及实收资本均为 51 万元人民币，由沈建平之妹沈建琴和公司职工朱静燕各持股 50%，法定代表人为朱静燕。无锡盛泰注册地为宜兴环科园南岳村，经营范围：电子器件的加工；五金电器、电线电缆的销售（前述范围涉及专项审批的按审批意见生产经营）。该公司为沈建琴与他人共同控制的公司，已于 2009 年 12 月 28 日办理工商注销手续。该公司注销的原因是：2008 年起，发行人为减少销售方面的关联交易而不再向无锡盛泰销售产品，无锡盛泰业务量相应萎缩，因此于 2009 年 12 月 28 日办理了工商注销手续。

4、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员详见本招股说明书“**第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介**”。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

2007 年，公司向关联方无锡盛泰销售可控硅，主要型号产品销售明细如下表：

型号	芯片尺寸	销售金额(万元)	占关联交易总额比例（%）	占营业收入比例（%）
BTA12	T330	121.74	32.63	1.10
BTA16	T400	197.52	52.94	1.79
其他型号		53.81	14.43	0.49
合计		373.07	100.00	3.38

2007 年，本公司向关联方无锡盛泰销售比重较小，占当年营业收入的 3.38%。

关联销售采用市场定价原则，主要型号产品销售价格与同期其他非关联方比较如下：

型号	芯片尺寸	无锡盛泰			其他非关联方客户		
		不含税销售均价（元）	销售数量（万只）	销售金额（万元）	不含税销售均价（元）	销售数量（万只）	销售金额（万元）
BTA12	T330	1.50	81.16	121.74	1.52	225.08	342.12
BTA16	T400	1.74	113.52	197.52	1.73	350.37	606.14

公司通过关联方进行销售的价格公允，与非关联方无明显差别。

自 2008 年开始，公司停止向关联方无锡盛泰销售，公司已经消除了与关联方在销售方面的关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司偶发性关联交易为公司控股股东、实际控制人沈建平及其妻子梁夕芬为公司银行贷款提供信用担保；公司开具银行承兑汇票给无锡盛泰，具体情况如下：

（1）2007 年度

①沈建平为公司向兴业银行股份有限公司无锡分行借款人民币 2,000 万元提供连带责任担保，期限为 2007 年 1 月 18 日至 2008 年 1 月 17 日。

②沈建平为公司向中国银行股份有限公司宜兴支行借款人民币 2,000 万元提供连带责任担保，期限为 2007 年 3 月 2 日至 2008 年 3 月 2 日。

③沈建平为公司向中信银行无锡分行借款人民币 1,000 万元提供连带责任担保，期限为 2007 年 11 月 2 日至 2008 年 7 月 2 日。

（2）2008 年度

①沈建平为公司向兴业银行股份有限公司无锡分行借款人民币 2,000 万元提供连带责任担保，期限为 2008 年 1 月 15 日至 2009 年 1 月 14 日。

②沈建平、梁夕芬夫妇为公司向中信银行股份有限公司无锡分行借款人民币 1,000 万元提供连带责任担保，期限为 2008 年 7 月 8 日至 2009 年 1 月 8 日。

③沈建平、梁夕芬夫妇为公司向中国银行股份有限公司宜兴支行借款人民币 5,000 万元提供连带责任担保，期限为 2008 年 3 月 5 日至 2010 年 3 月 4 日。

（3）2009 年度

沈建平、梁夕芬夫妇为公司向中国银行股份有限公司宜兴支行借款提供连带责任担保，期限为 2009 年 2 月 25 日至 2011 年 2 月 25 日，截至 2009 年 12 月 31 日担保金额为人民币 3,880 万元。

2009 年，公司开具银行承兑汇票共计 10,000 万元给无锡盛泰。

3、关联方应收、应付款项余额

单位：万元

项目	关联方	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
应收账款	无锡盛泰	-	-	-3.23	207.49
应付票据	无锡盛泰	-	6,000.00	-	-

报告期内公司经常性关联交易金额较小，对公司经营不构成重大影响。公司经营规模扩张较快，资金需求量较大，关联方对公司的担保有助于公司获得正常

生产经营所需的资金，对本公司经营效益的提高起到较好的作用。

（三）公司规范关联交易的制度安排

为了避免和消除可能出现的控股股东或其他关联方利用其对公司经营和财务决策的影响，在有关商业交易中有损害公司及其他股东的利益的行为，公司在制度上做了严格的规定。

1、《公司章程》对规范关联交易的主要制度安排

《公司章程》第八十三条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

董事会应当在决定提交有关关联交易提案的同时，通知关联股东不得参与该项提案的投票表决，当出现是否为关联股东的争议时，由二分之一以上独立董事决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避。

股东大会作出的有关关联交易事项的决议，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。”

《公司章程》第一百二十七条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

2、公司《关联交易决策规则》对规范关联交易的主要制度安排

《关联交易决策规则》第十一条规定：“公司与关联自然人之间关联交易的决策权限：（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下（不含 30 万元）的关联交易（公司提供担保除外），以及公司与关联自然人就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币 30 万元（不含 30 万元），由公司总经理审批同意后执行。（2）公司与关联自然人发生的单笔交易金额在 30 万元以上（含 30 万元）—300 万元以下（不含 300 万元）的关联交易（公司提供担保除外）；公司与关联自然人就同一标的或者公

公司与同一关联自然人在连续 12 月内达成的关联交易累计金额在人民币 30 万元以上（含 30 万元）—300 万元（不含 300 万元）以下，由公司董事会审议批准。（3）公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额在 300 万元以上（含 300 万元），以及公司与关联自然人就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 300 万元以上，由公司股东大会审议批准。（4）公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且占公司最近经审计净资产绝对值 5%以上的，应聘请具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所或资产评估事务所对交易标的进行审计或评估。”

《关联交易决策规则》第十二条规定：“公司与关联法人之间关联交易的决策权限：（1）公司与关联法人之间的单笔关联交易金额低于人民币 300 万元（不含 300 万元），且低于公司最近经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易；公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币 300 万元，且低于公司最近经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，由公司总经理审批同意后执行。（2）公司与关联法人之间的单笔关联交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）—3,000 万元以下（不含 3,000 万元），且占公司最近经审计净资产绝对值 0.5%-5%之间的关联交易；公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 300 万元以上—3,000 万元以下，且占公司最近经审计净资产绝对值 0.5--5%之间的关联交易，经独立董事认可后，由公司董事会审议批准。（3）公司与关联法人之间的单笔关联交易金额在人民币 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且占公司最近经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联人同一标的或者公司与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近经审计净资产绝对值 5%以上的，应聘请具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所或资产评估事务所对交易标的进行审计或评估，并将该交易事项提交公司股东大会审议。”

《关联交易决策规则》第十四条规定：“公司拟与关联自然人达成的金额在 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易；拟与关联法人达成的金额在 300 万元以上（含 300 万元），或占公司最近经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机

构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据，聘请中介机构的费用由公司承担。”

《关联交易决策规则》第十五条规定：“公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

《关联交易决策规则》第二十条规定：“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。”

《关联交易决策规则》第二十一条规定：“公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。其措施如下：（1）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东、列席监事有权向股东大会提出关联股东回避申请；（2）当出现是否为关联股东的争议时，由股东大会作为程序性问题进行临时审议和表决，决定其是否应当回避；（3）股东大会对有关关联交易事项表决时，不将关联股东所代表的有表决权的股份数计算在内，由出席股东大会的非关联股东按《公司章程》和《江苏东光微电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定表决；（4）如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，公司应当在股东大会会议中对此做出详细说明，同时对非关联人的股东投票情况进行专门统计，并在决议中披露。”

3、公司《独立董事工作制度》对规范关联交易的主要制度安排

《独立董事工作制度》第十三条规定：“独立董事除具有法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的赋予董事的职权外，独立董事可行使以下职权：（1）重大关联交易由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；……独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。”

（四）关联交易执行情况及独立董事意见

公司报告期内发生的关联交易均履行了《公司法》、《公司章程》规定的相关程序。

公司独立董事施毅、史勤、叶树理经过认真核查公司报告期内关联交易情况，向公司出具了《独立董事意见》，结论如下：

- 1、公司近三年的重大关联交易合同或协议的履行，不存在任何争议或纠纷；
- 2、公司近三年重大关联合同和交易协议的签订遵循了平等、自愿、公平、公正的原则，合同条款公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
- 3、公司近三年的重大关联交易程序符合法律、法规及公司《关联交易决策规则》和公司章程的有关规定。

（五）发行人减少关联交易的措施

公司历来重视经营的独立性，避免关联交易对公司独立运作的影响，今后公司将继续实施相关减少关联交易的措施：

- 1、公司在《公司章程》中规定了关联交易决策权力和程序、关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避表决制度。根据《公司章程》的要求，公司制定了《关联交易决策规则》，该规则从关联交易的内容范围、审核权限和表决回避制度等方面作出了具体规定。
- 2、公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，对关联交易的审议程序作出了规定。
- 3、公司已建立独立董事制度，独立董事有权对公司发生的关联交易进行监督和检查，发挥独立董事对重大关联交易决策的作用，规范关联交易，避免和减少关联交易。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留权。

（一）董事会成员

公司董事会现由 9 名董事组成，董事任期三年，本届董事任期为 2009 年 5 月至 2012 年 5 月。各董事简历如下：

1、**沈建平先生**，董事长兼总经理。生于 1959 年 12 月，大专学历，曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记，宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记，宜兴市林副业局副局长，宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记，宜兴市东大微电子有限公司董事长兼总经理，2003 年至今任公司董事长兼总经理。

2、**徐志祥先生**，副董事长。生于 1948 年 2 月，大学学历，曾任东南大学机械系教师，江苏省太仓县科技副县长，珠海经济特区东南实业公司总经理，东南大学机械学院教师、高级工程师，宜兴市东大微电子有限公司董事，2003 年至今任公司副董事长。

3、**钱旭锋女士**，董事、副总经理兼财务总监。生于 1971 年 4 月，大专学历，曾任宜兴丝绸厂会计、财务科副科长，宜兴市东大微电子有限公司财务科长、财务总监兼副总经理，2003 年至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

4、**陈俊标先生**，董事兼副总经理。生于 1965 年 4 月，大学学历，曾任宜兴市无线电一厂副厂长，宜兴市东大微电子有限公司董事、副总经理，2003 年至今任公司董事、副总经理。

5、**詹文陆先生**，董事。生于 1949 年 11 月，大专学历，曾任南京钢铁厂修建部能源办干部，江苏省农行科技处干部，宜兴市东大微电子有限公司董事，2003 年至今任公司董事。

6、顾弘先生，董事。生于1968年4月，经济学博士学历，曾任中国新技术创业投资公司首席交易员，上海敏东律师事务所执业律师，上海实业集团副董事长特别助理，扬子特别状况基金高级副总裁、首席代表，世邦魏理仕投资基金执行董事，海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监。2008年起任公司董事。

7、施毅先生，独立董事。生于1962年9月，博士研究生学历，南京大学电子科学与工程学院院长，博士生导师，2008年起任公司独立董事。

8、史勤女士，独立董事。生于1963年10月，主任会计师，曾任宜兴市农资公司财务科主办会计，无锡宜信会计师事务所项目经理，江苏天华大彭会计师事务所无锡分所所长，2008年起任公司独立董事。

9、叶树理先生，独立董事。生于1962年7月，博士研究生学历，东南大学法学院教授，江苏致邦律师事务所兼职律师，2008年起任公司独立董事。

（二）监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名，任期三年，本届监事任期为2009年5月至2012年5月。各监事简历如下：

1、林钢先生，监事会主席。生于1951年11月，初中学历，曾任宜兴市无线电一厂供销科科长、副厂长、厂长兼党支部书记，宜兴市东大微电子有限公司副总经理、董事，2003年至今任公司监事会主席。

2、李国华女士，监事。生于1950年8月，中专学历，曾任宜兴丝绸厂行政科科长、工会主席，宜兴市东大微电子有限公司董事、副总经理，2003年至今任公司监事。

3、许志峰先生，职工代表监事。生于1965年3月，大学学历，历任扬州晶体管厂工程师，扬州晶来高级工程师，现任公司高级工程师，2007年经职工大会选举成为职工代表监事。

（三）高级管理人员

截至本招股说明书签署日，本公司共有高级管理人员6名，其基本情况如下：

- 1、沈建平先生，公司总经理。简历请参见本节“**董事会成员**”中相关内容。
- 2、钱旭锋女士，公司副总经理兼财务总监。简历请参见本节“**董事会成员**”中相关内容。
- 3、陈俊标先生，公司副总经理。简历请参见本节“**董事会成员**”中相关内容。
- 4、钱荣军先生，公司副总经理。生于 1964 年 12 月，高中学历，曾任宜兴市西渚供销社副主任，2006 年至今任公司副总经理。
- 5、王全先生，公司副总经理。生于 1967 年 11 月，本科学历，曾任无锡锡山市无线电二厂技术质量科科长，东南大学无锡应用与工程研究院电子器材公司总工程师、副总经理，江苏天渊通讯设备有限责任公司副总经理，公司总经理助理，2006 年至今任公司副总经理。
- 6、周玲燕女士，公司董事会秘书。生于 1981 年 4 月，大专学历，曾任宜兴市东大微电子有限公司质检员、车间主任，公司行政部副部长，2006 年至今任公司董事会秘书。

（四）核心技术人员

截至本招股说明书签署日，本公司共有核心技术人员 5 名，其基本情况如下：

- 1、刘光廷先生，教授，原中国电子工业学会会员，原江苏省半导体集成电路专业协会副主任。生于 1936 年 3 月，1960 年毕业于清华大学无线电系，毕业后返回南京工学院任教，1960 年至 1986 年任南京工学院电子工程系微电子学专业教研室主任，1978 年至 1988 年任江苏省集成电路学会副主任，中国集成电路学会委员，电子工业部工程师再教育微电子学组组长，教育部微电子学科教学改革小组副组长。1980 年至 1995 年主要研究半导体光伏器件、声表波集成电路、VDMOS 和 IGBT 等大功率器件，在国内一级刊物上发表论文 20 余篇，国外专业杂志发表论文 6 篇。2003 年至今任公司总工程师、公司南京研发中心主任，主持研发的 SA-230 半导体放电管、CLP200M 集成电路、DLCP180S 等大功率器件及集成电路，获得三项国家专利、多项省级科技进步奖及省级科技成果三等奖。
- 2、沈克强先生，副教授，江苏省集成电路学会副主任委员、中国集成电路

学会委员、电子工业部工程师再教育微电子学组长、教育微电子学科教学组副组长。生于1960年3月，1993年毕业于东南大学和日本东北大学电子工程系半导体器件与微电子专业，获博士学位。曾任电子工业部第49研究所助理工程师，东南大学电子工程系半导体器件与微电子学教研室主任；1982年参加了SOS加速度传感器的研发，该课题获电子科技部科技进步二等奖；1984年至1993年，对Si栅CMOS磁敏传感器和CMOS流量传感器进行了器件模拟，并对RFIC中的VCO电路进行了研究，开发了新型的栅控SOIMOS可变电容，并将成果发表在《IEEE Trans. Electron Devices》上。2003年至今任公司南京研发中心副主任，主持研发了中高压功率场效应管。

3、李泽宏，副教授、硕士生导师。生于1970年10月，1997年毕业于四川大学半导体器件专业，获得硕士学位，2004年毕业于成都电子科技大学微电子技术专业，获得博士学位。曾任四川仪器仪表集团公司研究所技术所长，主持和参与了朗讯接口电路、华为通讯接口电路、华为电气开关电源系列、武汉洲际大功率程控电源控制等项目的研制。在重庆航伟光电科技有限公司工作期间，主持了光通讯接收发送模块的研发工作；在无锡华润上华半导体有限公司工作期间，参与了FAIRCHILD和DIODES等公司的BCD工艺和器件工艺的开发。从2000年到现在，一直从事功率器件和智能功率集成电路的研究。研究内容包括：二极管、三极管、VDMOS、IGBT等常规和新结构功率器件的设计、工艺、封装、测试和可靠性分析；智能功率集成电路和功率集成系统的设计、工艺和测试等。目前为止发表论文40余篇，其中被SCI、EI收录20余篇；申请专利18项，已经获得授权5项。2009年至今任公司工程师。

4、陈俊标先生，中国半导体行业协会分立器件分会理事，主持研发了DLCP180S 功率集成电路、YDCLP200MX 过电压过电流保护集成电路、CSC1A02GT 过电流过电压保护集成电路、半导体抑制栅、一种改进的抗浪涌保护器件、台面固体放电管管芯、荧光灯用电子启辉器等产品。其他情况请参见本节“**董事会成员**”中相关内容。

5、王全先生，工学学士，主持研发 P61089 可调型过电压保护集成电路、一种改进的抗浪涌保护器件、改良的半导体抗浪涌器件、低电容过电压保护模块等

产品。其他情况请参见本节“高级管理人员”中相关内容。

二、董事、监事的提名和选聘情况

（一）董事提名和选聘情况

2009年5月25日，本公司召开2008年度股东大会，选举沈建平、徐志祥、詹文陆、陈俊标、钱旭锋、顾弘、施毅、叶树理、史勤九位为公司第三届董事会董事，其中施毅、叶树理、史勤为公司独立董事。

2009年5月25日，本公司召开第三届董事会第一次会议，选举沈建平先生为公司董事长、徐志祥先生为副董事长。

（二）监事提名和选聘情况

2007年8月28日，公司召开2007年度第二次职工代表大会，选举许志峰为监事会职工代表监事。

2009年5月25日，本公司召开2008年度股东大会，选举林钢、李国华为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的监事许志峰组成第三届监事会。

2009年5月25日，本公司召开第三届监事会第一次会议，选举林钢为公司监事会主席。

三、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有发行人股份的情况及近三年及一期所持股份的增减变动情况如下：

姓名	职务	2007年5月		2007年6月至今	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
沈建平	董事长、总经理	23,699,941	29.63	27,760,070	34.70
徐志祥	副董事长	5,099,700	6.37	4,079,760	5.10

姓名	职务	2007年5月		2007年6月至今	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
詹文陆	董事	8,496,654	10.62	6,797,323	8.50
陈俊标	董事、副总经理	2,833,641	3.54	2,833,641	3.54
钱旭锋	董事、副总经理、财务总监	943,125	1.18	943,125	1.18
顾弘	董事	0	0	0	0
施毅	独立董事	0	0	0	0
史勤	独立董事	0	0	0	0
叶树理	独立董事	0	0	0	0
林钢	监事会主席	4,250,461	5.31	3,400,369	4.25
李国华	监事	2,453,830	3.07	1,963,064	2.45
许志峰	监事	0	0	0	0
周玲燕	董事会秘书	0	0	0	0
钱荣军	副总经理	0	0	0	0
王全	副总经理、核心技术人员	0	0	100,000	0.13
沈克强	核心技术人员	0	0	100,000	0.13
刘光廷	核心技术人员	0	0	0	0
李泽宏	核心技术人员	0	0	0	0

（二）公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的亲属持有本公司股份情况

公司核心技术人员刘光廷为董事詹文陆的姐夫，除此之外，截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员最近三年及一期所持股份的质押或冻结情况

截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员最近三年及一期所持股份无质押或冻结情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况

截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除持有本公司股份外，不存在其他对外投资情况，也不存在与发行人利益冲突的情况。

五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及关联企业领取报酬情况

姓 名	职 务	2009年年薪（元）	领薪单位
沈建平	董事长、总经理	60,000.00	发行人
徐志祥	副董事长	--	未在公司领薪
詹文陆	董事	--	未在公司领薪
陈俊标	董事、副总经理	48,000.00	发行人
钱旭锋	董事、副总经理、财务总监	48,000.00	发行人
顾弘	董事	--	未在公司领薪
施毅	独立董事	30,000.00	发行人
史勤	独立董事	30,000.00	发行人
叶树理	独立董事	30,000.00	发行人
林钢	监事会主席	48,000.00	发行人
李国华	监事	48,000.00	发行人
许志峰	监事	36,000.00	发行人
周玲燕	董事会秘书	40,000.00	发行人
钱荣军	副总经理	48,000.00	发行人
王全	副总经理、核心技术人员	48,000.00	发行人
沈克强	核心技术人员	48,000.00	发行人
刘光廷	核心技术人员	48,000.00	发行人
李泽宏	核心技术人员	48,000.00	发行人

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓名	职务	兼职单位	兼职情况	兼职单位与发行人关系
顾弘	董事	海富产业投资基金管理有限公司	副总经理兼投资总监	发行人股东“中比基金”资产管理人
		西安富士达科技股份有限公司	董事	无关系
		宁波摩士集团股份有限公司	董事	无关系

		江西赣锋锂业股份有限公司	董事	无关系
		无锡华东可可股份有限公司	董事	无关系
		浙江海利得新材料股份有限公司	董事	无关系
		南京朗光电子股份有限公司	董事	无关系
		天目湖旅游股份有限公司	董事	无关系
		武汉中元华电科技股份有限公司	董事	无关系
施毅	独立董事	南京大学	教授	无关系
史勤	独立董事	江苏天华大彭会计师事务所无锡分所	所长	无关系
叶树理	独立董事	东南大学	教授	无关系
		江苏致邦律师事务所	兼职律师	无关系
沈克强	核心技术人员	东南大学	副教授	无关系
李泽宏	核心技术人员	成都电子科技大学	副教授	无关系

除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有兼职情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

公司核心技术人员刘光廷为董事詹文陆的姐夫，除此之外，本公司其余的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

八、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其履行情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议

公司全体高级管理人员与核心技术人员均在本公司任职，均与公司签订了《劳动合同》或《聘任协议》，按照《公司章程》的有关规定明确任职责任与义务、辞职规定及离职后持续义务。

除此之外，公司与核心技术人员签订《保密协议》，约定对其接触、知悉的技术秘密和其他商业秘密信息承担保密义务。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺

公司董事长、总经理沈建平承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员詹文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王全承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

（三）有关协议或承诺的履行情况

截至目前，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺及与公司签订的协议仍处于承诺期和履行期内，未出现违背上述承诺和协议的情形。

九、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

公司董事、监事、高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格，未有下列情况发生：

1、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

2、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算之日起未逾三年。

3、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

5、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的。

6、最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责。

7、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，尚未有明确结论意见。

十、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）报告期内董事的变动情况

2006年5月，公司进行董事会换届选举，公司控股股东沈建平作为提名人，提名沈建平、徐志祥、詹文陆、陈俊标、钱旭锋、赵永良为董事候选人；公司股东中比基金作为提名人，提名郑万祥、朱庆莲为董事候选人。2006年5月11日，公司股东大会作出决议选举上述候选人为公司第二届董事会董事。

2008年1月，赵永良、朱庆莲辞去董事职务，公司控股股东沈建平作为提名人，提名施毅、史勤、张志高为独立董事候选人。2008年1月18日，公司股东大会作出决议，选举上述候选人为公司独立董事。

2008年5月，张志高辞去独立董事职务，公司控股股东沈建平作为提名人，提名叶树理为独立董事候选人。2008年5月20日，公司股东大会作出决议，选举叶树理为公司独立董事。

2008年6月，郑万祥辞去董事职务，公司股东中比基金作为提名人，提名顾弘为董事候选人，2008年7月1日，公司股东大会作出决议，选举顾弘为公司董事。

2009年5月，公司进行董事会换届选举，公司控股股东沈建平作为提名人，提名沈建平、徐志祥、詹文陆、陈俊标、钱旭锋为董事候选人，施毅、叶树理、

史勤为独立董事候选人；公司股东中比基金作为提名人，提名顾弘为董事候选人。2009年5月25日，公司股东大会作出决议，选举上述候选人为公司第三届董事会成员。

（二）报告期内监事的变动情况

2006年5月11日，公司召开2006年第一次临时股东大会，选举林钢、李国华为监事，与职工代表大会选举产生的监事潘宪平组成第二届监事会。

2007年4月20日，公司召开2007年度第一次职工代表大会，同意潘宪平辞去监事职务，同时选举庄亚平为监事会职工代表监事。

2007年8月28日，公司召开2007年度第二次职工代表大会，同意庄亚平辞去监事职务，同时选举许志峰为监事会职工代表监事。

2009年5月25日，公司召开2008年度股东大会，选举林钢、李国华为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的监事许志峰组成第三届监事。

（三）报告期内高级管理人员的变动情况

2006年5月，公司经营层任期届满，公司控股股东沈建平作为公司董事长，向董事会提名了经营层组成人员。2006年5月11日，公司董事会作出决议，聘任沈建平为总经理，根据总经理的提名，聘请钱旭锋、陈俊标、王全、钱荣军为副总经理，钱旭锋兼任财务负责人，周玲燕为董事会秘书。

2009年5月，公司经营层任期届满，公司控股股东沈建平作为公司董事长，向董事会提名了经营层组成人员。2009年5月25日，公司董事会作出决议，继续聘任沈建平为总经理，根据总经理的提名，聘请钱旭锋、陈俊标、王全、钱荣军为副总经理，钱旭锋兼任财务负责人，周玲燕为董事会秘书。

第九节 公司治理

公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构。公司已逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的标准，完善了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度等组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，建立了比较科学和规范的法人治理结构，为本公司高效经营提供了制度保证。

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

2003年5月12日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》，2008年3月25日，公司召开2007年度股东大会，审议修订了《股东大会议事规则》，进一步完善了股东大会的运行规范。

1、股东权利和义务

公司建立了股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、

财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

公司股东承担以下义务：遵守法律、行政法规和公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会议事规则

（1）股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：董事人数不足6人时；公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；单独或者合计持

有公司10%以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前通知各股东。

（2）股东大会的提案

提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

（3）股东大会的表决

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

股东大会就选举董事、监事进行表决时可以实行累积投票制。

除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一

个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

（4）股东大会的决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；股权激励计划；法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

4、股东大会运行情况

报告期内公司共召开了13次股东大会会议：其中2007年召开了4次会议；2008年召开了5次会议；2009年召开了3次会议；2010年上半年召开了1次会议。报告期内公司股东大会决议中，不存在否决会议议案的情形，且公司其他股东与控股股东沈建平在相关会议决议的表决意见相一致。

截至本招股说明书签署日，本公司历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方式符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议记录完整规范，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

2008年3月25日，公司2007年度股东大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

1、董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。依据公司章程，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人、副董事长一人。

2、董事会的职权

董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或本章程赋予的其他职权。

3、董事会议事规则

董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，董事长认为必要时、1/2 以上独立董事提议、总经理提议、公司章程规定的其他情形，可以提议召开董事会临时会议。董事长应自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议必须经过全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时

作出书面说明。必要时可以发表公开声明。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、董事会运行情况

报告期内公司共召开了14次董事会会议：其中2007年召开了4次会议；2008年召开了5次会议；2009年召开了4次会议；2010年上半年召开了1次会议。报告期内公司董事会决议中，不存在否决会议议案的情形，且公司其他董事与董事长沈建平在相关会议决议的表决意见相一致。

截至本招股说明书签署日，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围对公司的各项事务进行讨论决策。历次董事会议的通知、召开、表决等方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

2008年3月25日，公司召开2007年度股东大会审议通过了《监事会议事规则》，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》执行权力，规范运行。

1、监事会构成

公司设监事会，监事会由三名监事组成，监事会设主席一名，监事会主席由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2、监事会的职责

监事会行使下列职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

监事会每6个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：任何监事提议召开时；股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；公司章程规定的其他情形。

监事会会议由全体监事过半数出席方可举行。监事会决议的表决，实行一人一票制，监事会决议应当经半数以上监事通过。

4、监事会运行情况

截至本招股说明书签署日，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。历次监事会议的通知、召开、表决等方式符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事情况

2008年1月18日，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，选举施毅、张志高和史勤为公司独立董事。2008年5月20日，公司召开2008年第二次临时股东大会，同意张志高辞去独立董事职务，同时选举叶树理担任公司独立董事。目前，公司董事会成员9人，其中有3名独立董事，占董事会成员总数的三分之一，其中史勤为会计专业人士。

2、独立董事的制度安排

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的相关要求，公司于2007年度股东大会审议通过了《独立董事工作制度》。主要制度规定如下：

独立董事应符合下列基本条件：根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任公司董事的资格；具备法律、法规要求的独立性；具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上的法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

独立董事除具有法律、法规、规范性文件或公司章程规定的赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬；公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施收回欠款；独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；《公司章程》规定的其他事项。

公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二分之一以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

3、独立董事参与公司决策的情况

公司独立董事自聘任以来，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》要求，认真履行独立董事职责。独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护中小股东利益、科学决策等方面提供了制度保障。独立董事对本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会秘书工作制度》。公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应当履行如下职责：负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证交易所可以随时与其取得工作联系；负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；出席股东大会会议，列席董事会会议，制作股东大会会议记录、董事会会议记录并签名；负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向交易所报告；负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等，负责保管董事会印章；保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其

他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，立即向交易所报告；《公司法》和交易所要求履行的其他职责。

本公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定，认真履行了各项职责。

（六）专门委员会的设置情况

2008年3月25日，公司2007年度股东大会通过决议，设立审计、战略与投资、薪酬与考核三个专门委员会。目前钱旭锋、叶树理、史勤担任审计委员会成员，沈建平、叶树理、施毅担任战略与投资委员会成员，陈俊标、叶树理、史勤担任薪酬与考核委员会成员，各个专门委员会的主要职责如下：

审计委员会行使下列职权：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；对重大关联交易进行审查和评价；公司董事会授权的其他事宜。

战略与投资委员会行使下列职权：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会行使下列职权：根据公司行业特点、董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制订并执行适合市场环境变化的绩效评价体系，具备竞争优势的薪酬政策以及与经营业绩相关的奖惩激励措施。上述薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励（包括股权激励）和惩罚的主要方案和制度等；

审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

二、发行人近三年及一期违法违规行为情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

三、发行人近三年及一期资金占用和对外担保的情况

发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

发行人的《公司章程》和 2008 年 3 月 25 日通过的《对外担保管理制度》中已明确对外担保的审批权限和审议程序。近三年及一期不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

发行人其他对外担保情况详见“**第十五节 其他重要事项/三、发行人对外担保的情况**”。

四、发行人内部控制制度情况

（一）公司管理层的自我评估意见

股份公司设立后，公司内部建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为公司重大事项的经营决策机构、监事会为公司监督机构的法人治理结构。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度保证三会的规范运作。公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，能够有效地计划、协调和控制经营活动。此外，为确保公司生产经营正常进行，加强内部管理，提高管理水平，公司还制定了《对外投资管理制度》、《关联交易决策规则》、《对外担保管理制度》等一系列制度。

公司已按《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充

规定的要求制定了适合公司的会计核算制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。现有内控制度达到了完整性、合理性和有效性的要求，能够及时发现和纠正错误，保证公司会计资料的真实、准确、完整，从而促进公司经营效率的提高及经营目标的实现。

随着公司的不断发展，管理层也将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善和提高。

公司管理层对内部控制制度合理性、完整性及有效性进行了评估，认为：“公司在2010年6月30日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。”

（二）注册会计师对公司内部控制制度的评价意见

立信会计师事务所有限公司对公司内部控制制度进行了评估，出具了信会师报字（2010）第24717号《内部控制鉴证报告》，认为“公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于2010年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字（2010）第 24716 号）。本节的财务会计数据及有关的分析反映了公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月经审计的财务报告及其附注的主要内容。投资者若想详细了解公司财务会计信息，请阅读本招股说明书所附的财务报告及其附注和审计报告全文。

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	71,008,364.62	113,689,944.44	90,349,343.10	58,229,279.78
交易性金融资产				
应收票据	9,089,425.92	2,667,617.08	5,320,250.63	3,747,519.00
应收账款	86,359,475.56	83,082,428.17	77,278,223.36	53,555,773.03
预付款项	2,154,226.60	6,673,192.02	4,646,747.17	48,232,433.00
应收利息	6,256.25	301,950.00		
应收股利				
其他应收款	2,037,173.40	2,573,372.64	669,067.27	594,032.64
存货	33,470,948.04	39,651,901.79	27,584,445.17	23,442,448.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	204,125,870.39	248,640,406.14	205,848,076.70	187,801,485.52
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	200,632,640.38	198,027,638.42	182,548,123.82	25,794,127.11

在建工程	13,368,806.54	15,422,752.25	39,999,482.46	111,379,344.38
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,967,684.54	19,172,844.70	19,005,986.02	4,926,068.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	595,159.68	583,919.04	588,746.13	
其他非流动资产				
非流动资产合计	233,564,291.14	233,207,154.41	242,142,338.43	142,099,540.05
资产总计	437,690,161.53	481,847,560.55	447,990,415.13	329,901,025.57

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：				
短期借款	93,000,000.00	76,800,000.00	117,678,350.63	93,247,519.00
交易性金融负债				
应付票据	2,000,000.00	60,000,000.00	38,000,000.00	
应付账款	37,074,774.09	35,423,586.00	39,482,323.11	32,148,489.51
预收款项	139,048.75	117,086.74	730,122.09	581,755.10
应付职工薪酬	2,649,040.28	2,002,492.16	2,531,048.79	1,445,186.21
应交税费	5,873,172.69	7,469,193.07	2,593,897.26	2,132,908.44
应付利息	141,895.00	166,662.50	484,527.23	211,875.00
应付股利				
其他应付款	596,815.10	2,491,343.30	2,532,033.30	1,957,435.80
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			20,000,000.00	
流动负债合计	141,474,745.91	184,470,363.77	224,032,302.41	131,725,169.06
非流动负债：				
长期借款		29,500,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	40,124,327.04	26,757,692.43	6,000,000.00	
非流动负债合计	40,124,327.04	56,257,692.43	6,000,000.00	
负债合计	181,599,072.95	240,728,056.20	230,032,302.41	131,725,169.06

所有者权益：				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	39,836,444.12	39,836,444.12	39,836,444.12	39,836,444.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,823,072.28	21,823,072.28	18,348,863.54	15,381,525.11
一般风险准备				
未分配利润	114,431,572.18	99,459,987.95	79,772,805.06	62,957,887.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	256,091,088.58	241,119,504.35	217,958,112.72	198,175,856.51
少数股东权益				
所有者权益合计	256,091,088.58	241,119,504.35	217,958,112.72	198,175,856.51
负债和所有者权益总计	437,690,161.53	481,847,560.55	447,990,415.13	329,901,025.57

2、合并利润表

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业总收入	102,683,748.55	162,112,176.89	145,068,686.12	110,484,140.74
其中：营业收入	102,683,748.55	162,112,176.89	145,068,686.12	110,484,140.74
二、营业总成本	84,947,696.14	139,769,743.21	125,168,526.14	80,883,359.65
其中：营业成本	69,359,288.89	109,532,304.54	99,770,835.85	66,613,831.13
营业税金及附加	956,476.52	1,058,935.79	1,095,711.78	865,772.09
销售费用	1,788,610.20	3,504,097.03	2,958,056.82	3,052,146.76
管理费用	9,082,485.25	17,187,288.46	14,312,390.73	9,206,800.43
财务费用	3,670,910.20	8,525,734.03	6,822,509.62	1,682,343.99
资产减值损失	89,925.08	-38,616.64	209,021.34	-537,534.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,736,052.41	22,342,433.68	19,900,159.98	29,600,781.09
加：营业外收入	149,639.79	3,739,897.67	549,462.82	957,190.19
减：营业外支出	689,858.23	820,561.86	1,256,112.72	876,406.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	17,195,833.97	25,261,769.49	19,193,510.08	29,681,564.94

号填列)				
减：所得税费用	2,224,249.74	2,100,377.86	-588,746.13	20,521.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,971,584.23	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	14,971,584.23	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.29	0.25	0.39
（二）稀释每股收益	0.19	0.29	0.25	0.39
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,971,584.23	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,971,584.23	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73
归属于少数股东的综合收益总额				

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	110,180,394.20	185,595,809.86	138,888,133.52	135,766,520.30
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	14,722,975.18	26,381,819.55	8,631,923.61	14,111,938.48
经营活动现金流入小计	124,903,369.38	211,977,629.41	147,520,057.13	149,878,458.78
购买商品、接受劳务支付的现金	47,539,931.72	113,177,601.73	85,837,285.94	65,635,192.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7,454,499.16	14,640,604.43	12,675,661.86	10,803,303.75
支付的各项税费	13,499,576.88	8,385,942.91	11,005,162.26	9,521,170.13
支付其他与经营活动有关的现金	9,129,204.34	16,474,474.53	11,113,015.27	6,868,697.17
经营活动现金流出小计	77,623,212.10	152,678,623.60	120,631,125.33	92,828,364.01
经营活动产生的现金流量净额	47,280,157.28	59,299,005.81	26,888,931.80	57,050,094.77
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,189.06			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	18,189.06			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,169,778.96	14,546,893.97	67,883,331.45	97,485,433.41
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,169,778.96	14,546,893.97	67,883,331.45	97,485,433.41
投资活动产生的现金流量净额	-14,151,589.90	-14,546,893.97	-67,883,331.45	-97,485,433.41
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				25,046,708.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	57,500,000.00	324,300,000.00	225,430,831.63	141,947,519.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	57,500,000.00	324,300,000.00	225,430,831.63	166,994,227.00
偿还债务支付的现金	90,300,000.00	334,678,350.63	143,000,000.00	88,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,999,605.50	11,529,381.61	9,316,368.66	3,282,270.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	94,299,605.50	352,707,732.24	185,316,368.66	91,982,270.88
筹资活动产生的现金流量净额	-36,799,605.50	-28,407,732.24	40,114,462.97	75,011,956.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,541.70	-3,778.26		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,681,579.82	16,340,601.34	-879,936.68	34,576,617.48
加：年初现金及现金等价物余额	73,689,944.44	57,349,343.10	58,229,279.78	23,652,662.30
六、年末现金及现金等价物余额	70,008,364.62	73,689,944.44	57,349,343.10	58,229,279.78

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	54,180,568.62	95,689,944.44	90,349,343.10	58,229,279.78
交易性金融资产				
应收票据	9,009,425.92	2,667,617.08	5,320,250.63	3,747,519.00
应收账款	86,359,475.56	83,082,428.17	77,278,223.36	53,555,773.03
预付款项	2,154,226.60	6,673,192.02	4,646,747.17	48,232,433.00
应收利息	6,256.25	301,950.00		

应收股利				
其他应收款	2,037,173.40	2,573,372.64	669,067.27	594,032.64
存货	33,528,373.14	39,651,901.79	27,584,445.17	23,442,448.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	187,275,499.49	230,640,406.14	205,848,076.70	187,801,485.52
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	199,428,668.85	198,027,638.42	182,548,123.82	25,794,127.11
在建工程	13,368,806.54	15,422,752.25	39,999,482.46	111,379,344.38
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,967,684.54	19,172,844.70	19,005,986.02	4,926,068.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	595,159.68	583,919.04	588,746.13	
其他非流动资产				
非流动资产合计	250,360,319.61	251,207,154.41	242,142,338.43	142,099,540.05
资产总计	437,635,819.10	481,847,560.55	447,990,415.13	329,901,025.57

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：				
短期借款	93,000,000.00	76,800,000.00	117,678,350.63	93,247,519.00
交易性金融负债				
应付票据	2,000,000.00	60,000,000.00	38,000,000.00	
应付账款	37,024,850.09	35,423,586.00	39,482,323.11	32,148,489.51
预收款项	139,048.75	117,086.74	730,122.09	581,755.10
应付职工薪酬	2,553,785.88	2,002,492.16	2,531,048.79	1,445,186.21
应交税费	5,878,080.17	7,469,193.07	2,593,897.26	2,132,908.44
应付利息	141,895.00	166,662.50	484,527.23	211,875.00
应付股利				

其他应付款	589,850.30	2,491,343.30	2,532,033.30	1,957,435.80
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			20,000,000.00	
流动负债合计	141,327,510.19	184,470,363.77	224,032,302.41	131,725,169.06
非流动负债：				
长期借款		29,500,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	40,124,327.04	26,757,692.43	6,000,000.00	
非流动负债合计	40,124,327.04	56,257,692.43	6,000,000.00	
负债合计	181,451,837.23	240,728,056.20	230,032,302.41	131,725,169.06
所有者权益：				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	39,836,444.12	39,836,444.12	39,836,444.12	39,836,444.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,823,072.28	21,823,072.28	18,348,863.54	15,381,525.11
一般风险准备				
未分配利润	114,524,465.47	99,459,987.95	79,772,805.06	62,957,887.28
所有者权益合计	256,183,981.87	241,119,504.35	217,958,112.72	198,175,856.51
负债和所有者权益总计	437,635,819.10	481,847,560.55	447,990,415.13	329,901,025.57

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	102,744,027.99	162,112,176.89	145,068,686.12	110,484,140.74
减：营业成本	69,483,869.44	109,532,304.54	99,770,835.85	66,613,831.13
营业税金及附加	955,042.02	1,058,935.79	1,095,711.78	865,772.09
销售费用	1,788,436.20	3,504,097.03	2,958,056.82	3,052,146.76
管理费用	8,919,240.44	17,187,288.46	14,312,390.73	9,206,800.43
财务费用	3,704,983.08	8,525,734.03	6,822,509.62	1,682,343.99
资产减值损失	89,925.08	-38,616.64	209,021.34	-537,534.75
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”填列）	17,802,531.73	22,342,433.68	19,900,159.98	29,600,781.09
加：营业外收入	149,422.79	3,739,897.67	549,462.82	957,190.19
减：营业外支出	688,841.44	820,561.86	1,256,112.72	876,406.34
其中：非流动资产处置损失	23,730.94			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,263,113.08	25,261,769.49	19,193,510.08	29,681,564.94
减：所得税费用	2,198,635.56	2,100,377.86	-588,746.13	20,521.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,064,477.52	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.29	0.25	0.39
（二）稀释每股收益	0.19	0.29	0.25	0.39
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	15,064,477.52	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	110,180,394.20	185,595,809.86	138,888,133.52	135,766,520.30
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	14,688,264.80	26,381,819.55	8,631,923.61	14,111,938.48
经营活动现金流入小计	124,868,659.00	211,977,629.41	147,520,057.13	149,878,458.78
购买商品、接受劳务支付的现金	47,582,234.12	113,177,601.73	85,837,285.94	65,635,192.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7,372,564.29	14,640,604.43	12,675,661.86	10,803,303.75
支付的各项税费	13,482,895.62	8,385,942.91	11,005,162.26	9,521,170.13
支付其他与经营活动有关的现金	9,182,702.51	16,474,474.53	11,113,015.27	6,868,697.17
经营活动现金流出小计	77,620,396.54	152,678,623.60	120,631,125.33	92,828,364.01
经营活动产生的现金流量净额	47,248,262.46	59,299,005.81	26,888,931.80	57,050,094.77
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210,277.56			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	1,210,277.56			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,157,768.64	14,546,893.97	67,883,331.45	97,485,433.41
投资支付的现金		18,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,157,768.64	32,546,893.97	67,883,331.45	97,485,433.41
投资活动产生的现金流量净额	-12,947,491.08	-32,546,893.97	-67,883,331.45	-97,485,433.41
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				25,046,708.00
取得借款收到的现金	57,500,000.00	324,300,000.00	225,430,831.63	141,947,519.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	57,500,000.00	324,300,000.00	225,430,831.63	166,994,227.00
偿还债务支付的现金	90,300,000.00	334,678,350.63	143,000,000.00	88,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,999,605.50	11,529,381.61	9,316,368.66	3,282,270.88
支付其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	94,299,605.50	352,707,732.24	185,316,368.66	91,982,270.88
筹资活动产生的现金流量净额	-36,799,605.50	-28,407,732.24	40,114,462.97	75,011,956.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,541.70	-3,778.26		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,509,375.82	-1,659,398.66	-879,936.68	34,576,617.48
加：年初现金及现金等价物余额	55,689,944.44	57,349,343.10	58,229,279.78	23,652,662.30
六、年末现金及现金等价物余额	53,180,568.62	55,689,944.44	57,349,343.10	58,229,279.78

二、审计意见类型

公司委托立信会计师事务所有限公司对 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 6 月 30 日公司的资产负债表， 2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年 1-6 月公司的利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计。立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字（2010）第 24716 号）。

三、财务报告的编制基础、合并财务报表范围

（一） 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 合并财务报表范围及变化情况

2009年度公司新增合并单位1家，系宜兴市东晨电子科技有限公司。东晨电子成立于2009年12月1日，注册资本1,800万元，为江苏东光的全资子公司。

四、报告期公司采用的主要会计政策和会计估计

（一） 收入确认原则

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二）金融工具的核算方法

1、金融工具的分类

管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（3）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：占应收账款余额 10%以上且金额在 800 万元以上。单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据：账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。根据信用风险特征组合确定的计提方法：应收款项余额百分比法计提的比例为：3-4 年按 50%，4-5 年按 80%，5 年以上按 100%计提坏账准备。

其他不重大应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

账龄分析法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

（三） 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、委托加工物资、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（四） 长期股权投资核算办法

1、 初始投资成本确定

（1） 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存

收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照

权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对

被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（五） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产的分类及初始计量

固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，

固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

3、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	10	5	9.50

4、固定资产减值准备

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（六） 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（七） 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1） 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

一般按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2） 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	按土地使用权的可使用年限	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（八） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能

达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本

化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（九） 外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（十） 政府补助

1、 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

（十一） 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由

可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（十二） 适用的主要税种税率及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种和税率

（1） 母公司主要税种和税率

税 种	计税依据	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度	
		法定税率	实际税率	法定税率	实际税率	法定税率	实际税率	法定税率	实际税率
增值税	营业收入	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
营业税	营业收入	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%	12.5%	25%	12.5%	25%	0%	33%	0%
城市建设维护税	流转税额	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%

（2） 2009 年内新增子公司 1 家：宜兴市东晨电子科技有限公司，企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

（1） 江苏省科学技术厅认定公司为高新技术企业，发证日期为 2008 年 9 月 24 日，证书编号为 GR200832000261，有效期 3 年。根据相关规定，公司企业所得税自 2008 年起三年内将减按 15% 的税率征收。

（2） 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）“对生产线宽小于 0.8 微米（含）集成电路产品的生产企业，经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”、财政部、国家税务总局《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税 [2009]69 号）的有关规定，以及根据（2009）宜地税评字第 910022 号《纳税评估报告》，公司经税局认定后享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，即公司 2007 年度、2008 年度为免征期，2009 年度、2010 年度、2011 年度为减半征收期。

（3）根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的相关规定，“企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受，且一经选择，不得改变。”公司2007年度、2008年度免征企业所得税，2009年度、2010年度、2011年度减半按12.5%计征企业所得税。

（十三）报告期内会计政策和会计估计变更事项

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

3、其他

根据（2009）宜地税评字第910022号《纳税评估报告》，公司经宜兴市地方税务局第九税务分局认定后享受集成电路生产企业所得税“两免三减半”的优惠政策，即公司2007年度、2008年度为免征期，2009年度、2010年度、2011年度为减半征收期。根据《纳税评估报告》所退回款项分别按其归属年度调减2007年度、2008年度的所得税费用，即公司在2007年度、2008年度实际适用的企业所得税税率为0%。

上述事项对报告期内财务报表的影响如下（增加+，减少-）：

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
对递延所得税资产的影响	-	-117,749.21	-680,069.17
对年初度留存收益的影响	2,063,939.43	-422,268.70	-767,358.35
其中：对年初未分配利润的影响	1,754,348.51	-358,928.40	-652,254.60
对净利润的影响	-2,063,939.43	2,486,208.13	345,089.65

五、应予披露的分部信息

（一）按产品列示的营业收入

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度
----	--------------	---------

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入				
防护器件	30,904,114.61	30.10	53,371,436.39	32.92
VDMOS	33,606,967.80	32.73	41,617,396.11	25.67
可控硅	24,663,682.79	24.02	39,551,347.22	24.40
1300X	13,508,983.35	13.16	27,571,997.17	17.01
主营业务收入小计	102,683,748.55	100.00	162,112,176.89	100.00
其他业务收入				
其他业务收入小计	-	-	-	-
营业收入合计	102,683,748.55	100.00	162,112,176.89	100.00

项目	2008 年度		2007 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入				
防护器件	41,675,619.45	28.73	27,286,772.78	24.70
VDMOS	19,489,613.80	13.43	-	-
可控硅	46,103,032.01	31.78	53,679,756.52	48.59
1300X	37,800,420.86	26.06	29,517,611.44	26.72
主营业务收入小计	145,068,686.12	100.00	110,484,140.74	100.00
其他业务收入				
其他业务收入小计	-	-	-	-
营业收入合计	145,068,686.12	100.00	110,484,140.74	100.00

（二）按地区列示的营业收入

项目	2010 年 1-6 月		2009 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
浙江	29,660,217.61	28.89	59,674,908.19	36.81
广东	44,177,063.48	43.02	48,234,210.65	29.75
江苏	19,684,324.69	19.17	34,975,070.58	21.57
山东	50,905.97	0.05	4,037,465.81	2.49
安徽	1,420,902.90	1.38	3,071,536.30	1.89
江西	961,594.87	0.94	2,609,211.96	1.61
重庆	534,607.03	0.52	2,455,528.90	1.51
福建	623,739.31	0.61	1,353,230.69	0.83
上海	1,174,403.00	1.14	1,352,526.46	0.83
湖南	454,829.07	0.44	1,340,307.70	0.83
其他	1,868,376.89	1.82	1,464,420.61	0.90
国外	2,072,783.73	2.02	1,543,759.04	0.95
营业收入合计	102,683,748.55	100.00	162,112,176.89	100.00

项目	2008 年度		2007 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
浙江	59,551,520.95	41.05	52,056,940.80	47.12
广东	38,447,003.84	26.50	13,626,840.76	12.33
江苏	28,479,031.66	19.63	22,894,718.30	20.72
山东	1,134,854.69	0.78	2,728,287.20	2.47
安徽	1,102,426.40	0.76	751,138.47	0.68
江西	2,355,502.56	1.62	3,351,410.25	3.03
重庆	7,490,881.45	5.16	11,624,993.56	10.52
福建	1,358,544.87	0.94	235,532.47	0.21
上海	2,861,458.91	1.97	1,205,743.52	1.09
湖南	327,777.79	0.23	640,555.56	0.58
其他	1,945,906.60	1.34	1,367,979.85	1.24
国外	13,776.40	0.01	-	-
营业收入合计	145,068,686.12	100.00	110,484,140.74	100.00

六、最近一年及一期收购兼并情况

本公司最近一年及一期无收购兼并情况。

七、最近三年及一期非经常性损益

依据立信会计师事务所有限公司核验的非经常性损益表，本公司报告期内非经常性损益和扣除非经常性损益后公司的净利润情况如下表所示：

单位：元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动性资产处置损益	-23,730.94	-	-	30,750.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	146,665.39	3,725,707.57	516,000.00	770,000.00
债务重组损益	-	-	13,683.52	-2,684.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,525.60	4,190.10	-299,722.99	56,107.19
所得税影响额	19,654.94	-72,687.21	-	-
非经常性损益合计	-5,936.21	3,657,210.46	229,960.53	854,172.84
归属于公司普通股股东的净利润	14,971,584.23	23,161,391.63	19,782,256.21	29,661,043.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14,977,520.44	19,504,181.17	19,552,295.68	28,806,870.89
非经常性损益净影响数占净利润的比例	-0.04%	15.79%	1.16%	2.88%

公司近三年及一期非经常性损益发生额对净利润的影响比例分别为2007年2.88%、2008年1.16%、2009年15.79%和2010年1-6月-0.04%。2007年、2008年和2010年1-6月非经常性损益发生额对公司净利润影响很小。2009年，由于公司取得的政府补助计入营业外收入金额为372.57万元，比2008年的51.60万元大幅提高，导致当期非经常性损益对净利润的影响增大。

八、最近一期末的主要资产情况

（一） 固定资产

截至2010年6月30日，发行人固定资产情况列示如下：

单位：万元

类 别	折旧年限	原价	累计折旧	减值准备	净值/净额
房屋及建筑物	20 年	4,336.12	892.46	-	3,443.66
机器设备	5 年-10 年	21,937.22	5,685.01	-	16,252.21
电子设备	5 年	404.46	289.70	-	114.75
运输设备	10 年	405.24	152.60	-	252.64
合 计	-	27,083.04	7,019.77	-	20,063.26

截至2010年6月30日，不存在固定资产可收回金额低于其账面价值而需计提固定资产减值准备的情形。

（二） 在建工程

截至2010年6月30日，发行人在建工程情况列示如下：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产	期末数	资金来源	完工进度
VDMOS 生产	352.87	149.69	280.34	222.23	自筹资金	98%
三期工程	1,113.45	310.97	1,249.57	174.85	金融机构贷款 及自筹资金	83%
其他零星工程	75.95	412.80	59.71	429.05	自筹资金	81%
防护器件项目	-	510.75	-	510.75	自筹资金	51%
合 计	1,542.28	1,384.22	1,589.61	1,336.88	-	-

（三） 无形资产

截至2010年6月30日，发行人无形资产情况列示如下：

名 称	取得方式	初始金额 (万元)	累计摊销 (万元)	期末余额 (万元)	剩余摊销 期限
宜国用(2003)字第 000548 号、 宜国用(2003)字第 000549 号	出让	57.58	9.98	47.60	496 个月
宜国用(2003)字第 000596 号	出让	133.77	20.07	113.71	510 个月
宜国用(2006)字第 000089 号	出让	328.45	23.50	304.95	545 个月
宜国用(2009)第 28600002 号	出让	1,500.67	70.15	1,430.52	563 个月
合计	-	2,020.47	123.70	1,896.77	-

九、最近一期末的主要债项

截至2010年6月30日，公司的负债合计为18,159.91万元，主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、其他非流动负债等负债，无重大或有负债。

（一） 短期借款

截至2010年6月30日，公司银行短期借款具体明细如下：

单位：万元

借款类别	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
抵押借款	4,580.00	3,580.00	3,850.00	3,730.00
保证借款	4,720.00	4,100.00	7,600.00	5,220.00
银行承兑汇票贴现	-	-	317.84	374.75
合 计	9,300.00	7,680.00	11,767.84	9,324.75

（二） 应付票据

截至2010年6月30日，公司应付票据具体明细如下：

单位：万元

票据种类	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	200.00	6,000.00	3,800.00	-
合 计	200.00	6,000.00	3,800.00	-

（三） 应付账款

截至2010年6月30日，公司应付账款具体明细如下：

单位：万元

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
材料采购款	2,359.96	2,307.41	1,706.47	1,127.74

工程款	121.66	226.80	1,390.04	207.39
设备采购款	283.15	252.68	99.96	57.73
加工费	942.71	755.47	751.76	1,821.99
合计	3,707.48	3,542.36	3,948.23	3,214.85

（四） 应交税费

截至2010年6月30日，公司应交税费为587.32万元，其中应交增值税202.01万元，企业所得税221.96万元，营业税0.11万元，城市维护建设税64.35万元，个人所得税-2.45万元，综合规费30.14万元，教育费附加36.77万元，土地使用税27.61万元，房产税6.77万元，印花税0.06万元。

（五） 长期借款

截至2010年6月30日，公司银行长期借款具体明细如下：

单位：万元

借款类别	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
保证借款	-	2,950.00	-	-
合计	-	2,950.00	-	-

（六） 其他非流动负债

截至2010年6月30日，公司其他非流动负债具体明细如下：

单位：万元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
研发资助 (DSC3X00)	267.43	280.77	600.00	-
研发资助 (DCLP19E)	1,000.00	1,000.00	-	-
技术改造	800.00	800.00	-	-
科技创新与成果转化	525.00	525.00	-	-
技术创新项目资助	70.00	70.00	-	-
研发资助(支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路)	650.00			
现代服务业发	200.00			

展专项引导资金				
新型电力电子器件研发及产业化项目资助	500.00			
合计	4,012.43	2,675.77	600.00	-

（七） 逾期未偿还的负债

截至2010年6月30日，本公司无逾期未偿还的负债。

十、 股东权益

报告期内公司各会计期末的股东权益情况如下：

单位：万元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
股本	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
资本公积	3,983.64	3,983.64	3,983.64	3,983.64
盈余公积	2,182.31	2,182.31	1,834.89	1,538.15
未分配利润	11,443.16	9,946.00	7,977.28	6,295.79
归属于母公司所有者权益合计	25,609.11	24,111.95	21,795.81	19,817.59

十一、 现金流量情况

单位：万元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	4,728.02	5,929.90	2,688.89	5,705.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,415.16	-1,454.69	-6,788.33	-9,748.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,679.96	-2,840.77	4,011.45	7,501.20
期末现金及现金等价物余额	7,000.84	7,368.99	5,734.93	5,822.93

十二、 期后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 期后事项

截至2010年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二） 或有事项

截至2010年6月30日，公司无需要披露的或有事项。

（三） 其他重要事项

截至 2010 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十三、财务指标

（一） 主要财务指标

主要财务指标	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
流动比率（倍）	1.44	1.35	0.92	1.43
速动比率（倍）	1.21	1.13	0.80	1.25
资产负债率（%）（母公司）	41.46	49.96	51.35	39.93
应收账款周转率（次/年）	1.15	1.91	2.08	1.78
存货周转率（次/年）	1.90	3.25	3.91	3.05
息税折旧摊销前利润（元）	34,606,838.29	57,764,357.82	40,974,500.03	36,133,746.59
利息保障倍数（倍）	5.33	3.25	3.00	6.27
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.59	0.74	0.34	0.71
每股净现金流量（元/股）	-0.05	0.20	-0.01	0.43
无形资产占净资产的比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00

注：①2010年1-6月、2009年度、2008年度和2007年度 “每股经营活动产生的现金流量”

和“每股净现金流量”的计算股本均为8,000万股；无形资产为扣除土地使用权后的无形资产，报告期无形资产全部为土地使用权。

②以上指标计算公式为：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

息税折旧摊销前利润=归属于公司普通股股东的净利润+企业所得税+折旧摊销+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+财务费用利息支出-财务费用利息收入

利息保障倍数=（归属于公司普通股股东的净利润+企业所得税+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

无形资产(不含土地使用权)占净资产的比例=无形资产(不含土地使用权)/公司股东权益

（二） 每股收益和净资产收益率

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率

和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司2007年至2010年6月的净资产收益率及每股收益如下：

1、2010年1-6月

2010年1-6月	金额（元）	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14,971,584.23	6.02	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14,977,520.44	6.02	0.19	0.19

2、2009年度

2009年度	金额（元）	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23,161,391.63	10.09	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19,504,181.17	8.50	0.24	0.24

3、2008年度

2008年度	金额（元）	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19,782,256.21	9.51	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19,552,295.68	9.40	0.24	0.24

4、2007年度

2007年度	金额（元）	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29,661,043.73	16.88	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28,806,870.89	16.39	0.38	0.38

（1）加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2）基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（3）稀释每股收益

本公司报告期无稀释性潜在普通股。

十四、盈利预测

本公司未编制盈利预测报告。

十五、资产评估情况

本公司在设立时及报告期内未进行资产评估。

十六、历次验资情况

历次验资情况详见“第五节 发起人基本情况/四、发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性”。

第十一节 管理层讨论与分析

公司董事会提请投资者注意，以下讨论分析应结合公司经审计的财务报表及报表附注和本招股说明书揭示的其他财务信息一并阅读。非经特别说明，以下数据均为经审计的合并会计报表口径。

一、财务状况分析

（一）资产结构

公司资产结构如下表所示：

项 目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	占总资产比例（%）	金额（万元）	占总资产比例（%）
流动资产	20,412.59	46.64	24,864.04	51.60
非流动资产	23,356.43	53.36	23,320.72	48.40
其中：固定资产	20,063.26	45.84	19,802.76	41.10
在建工程	1,336.88	3.05	1,542.28	3.20
无形资产	1,896.77	4.33	1,917.28	3.98
资产总计	43,769.02	100.00	48,184.76	100.00

项 目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	占总资产比例（%）	金额（万元）	占总资产比例（%）
流动资产	20,584.81	45.95	18,780.15	56.93
非流动资产	24,214.23	54.05	14,209.95	43.07
其中：固定资产	18,254.81	40.75	2,579.41	7.82
在建工程	3,999.95	8.93	11,137.93	33.76
无形资产	1,900.60	4.24	492.61	1.49
资产总计	44,799.04	100.00	32,990.10	100.00

1、资产总额及变化趋势

报告期内，伴随着公司经营规模的扩张，资产总额也呈现出不断上升趋势，由2007年12月31日的32,990.10万元增长到2010年6月30日的43,769.02万元，增长幅度为32.67%。公司资产总额的增长主要原因是，随着营业收入的增长及业务规模的扩大，公司增加了固定资产和无形资产的投入。2010年6月30日公司资产总

额下降的原因是应付票据到期支付导致货币资金减少。

2、流动资产构成

公司流动资产构成情况如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
货币资金	7,100.84	34.79	11,368.99	45.72
应收票据	908.94	4.45	266.76	1.07
应收账款	8,635.95	42.31	8,308.24	33.41
预付款项	215.42	1.06	667.32	2.68
应收利息	0.63	0.00	30.20	0.12
其他应收款	203.72	1.00	257.34	1.03
存货	3,347.09	16.40	3,965.19	15.95
流动资产总计	20,412.59	100.00	24,864.04	100.00

项 目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
货币资金	9,034.93	43.89	5,822.93	31.01
应收票据	532.03	2.58	374.75	2.00
应收账款	7,727.82	37.54	5,355.58	28.52
预付款项	464.67	2.26	4,823.24	25.68
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	66.91	0.33	59.40	0.32
存货	2,758.44	13.40	2,344.24	12.48
流动资产总计	20,584.81	100.00	18,780.15	100.00

报告期内，公司流动资产 2008 年 12 月 31 日较 2007 年 12 月 31 日增长 9.61%，2009 年 12 月 31 日较 2008 年 12 月 31 日增长 20.79%，2010 年 6 月 30 日较 2009 年 12 月 31 日减少-17.90%，原因是应付票据到期支付导致货币资金减少。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货组成，近三年及一期末上述四项资产合计占流动资产的比例分别为 97.69%、97.09%、97.76% 和 94.56%。

（1）货币资金分析

公司货币资金构成情况如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
现金	0.80	0.01	0.46	0.00
银行存款	7,000.03	98.58	7,368.54	64.81
其他货币资金	100.00	1.41	4,000.00	35.18
合计	7,100.84	100.00	11,368.99	100.00

项 目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
现金	0.05	0.00	1.87	0.03
银行存款	5,734.89	63.47	5,821.06	99.97
其他货币资金	3,300.00	36.52	-	-
合计	9,034.93	100.00	5,822.93	100.00

近三年及一期末，公司货币资金余额分别为 5,822.93 万元、9,034.93 万元、11,368.99 万元和 7,100.84 万元，货币资金占流动资产的比例分别为 31.01%、43.89%、45.72%和 34.79%。

报告期末公司货币资金余额总体变动较大，主要原因是随着产品种类的增加，生产规模的扩大，公司对资金的需求不断增加所致。随着应付票据到期支付，作为保证金的其他货币资金减少，导致 2010 年 6 月 30 日货币资金余额减少。除不作为现金及现金等价物的其他货币资金外的货币资金呈现稳定上升的趋势，对该趋势分析如下：

2008 年末除其他货币资金外的货币资金余额较上年末基本持平。

2009 年末除其他货币资金外的货币资金余额比上年末增加 1,634.06 万元，主要原因是当年经营活动产生的现金流量净额 5,929.90 万元除满足投资活动现金支出 1,454.69 万元外，结余 4,475.21 万元，为到期借款提供现金支持，2009 年筹资活动产生的现金流量为-2,840.77 万元。

2010 年 6 月 30 日除其他货币资金外的货币资金余额较上年末基本持平。

（2）应收账款分析

近三年及一期末，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2010 年 6 月 30 日
----	-----------------

	账面余额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	9,038.66	99.39	451.93
1 至 2 年	51.40	0.56	5.14
2 至 3 年	2.56	0.03	0.51
3 至 4 年	1.83	0.02	0.91
4 至 5 年	-	0.00	-
5 年以上	-	0.00	-
合 计	9,094.45	100.00	458.50
净 额	8,635.95		

账龄	2009 年 12 月 31 日		
	账面余额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	8,577.19	97.95	428.86
1 至 2 年	171.98	1.96	17.20
2 至 3 年	4.02	0.05	0.80
3 至 4 年	3.83	0.04	1.91
4 至 5 年	-	0.00	-
5 年以上	-	0.00	-
合 计	8,757.02	100.00	448.78
净 额	8,308.24		

账龄	2008 年 12 月 31 日		
	账面余额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	7,803.13	95.50	390.16
1 至 2 年	243.97	2.99	24.40
2 至 3 年	116.15	1.42	23.23
3 至 4 年	2.65	0.03	1.33
4 至 5 年	5.11	0.06	4.09
5 年以上	-	0.00	-
合 计	8,171.02	100.00	443.20
净 额	7,727.82		

账龄	2007 年 12 月 31 日		
	账面余额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	4,928.15	85.18	246.41
1 至 2 年	561.34	9.70	56.13
2 至 3 年	88.72	1.53	17.74
3 至 4 年	187.92	3.25	93.96
4 至 5 年	18.46	0.32	14.77
5 年以上	1.00	0.02	1.00

合 计	5,785.59	100.00	430.01
净 额	5,355.58		

2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，应收账款净额分别为5,355.58万元、7,727.82万元、8,308.24万元和8,635.95万元，占各期末流动资产的比例分别为28.52%、37.54%、33.41%和42.31%。虽然公司应收账款占各期末流动资产的比例较大，但公司管理层认为应收账款流动性良好，资产质量较高，坏账风险很小。具体分析如下：

①从账龄构成看，公司应收账款的账龄普遍较短，账龄在1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例逐年提高，说明公司应收账款管理趋于严格，发生坏账的可能性进一步降低。截至2010年6月30日，账龄在1年以内的应收账款余额合计9,038.66万元，占应收账款余额的99.39%，账龄超过1年的应收账款余额合计55.79万元，仅占应收账款余额的0.61%。公司为保持财务数据的稳健性，已依据会计政策计提了相应的坏账准备。

②应收账款占各期末流动资产的比例符合公司所处的行业特点

根据账期长短的不同，可以将公司客户分为电信系统供货商和其他产品的生产商。

防护器件的直接客户为电信、网通的设备供应商，终端客户为电信、网通各地的分支机构。电信、网通作为成熟的产业终端，该领域内的设备供应商基本稳定，公司产品在该领域内有很高市场占有率和认同度，因此防护器件市场非常稳定。受电信、网通对设备供应商账期较长的影响，公司对该领域的客户账期较长，一般为3-9个月。该领域客户与公司常年合作，且其最终客户为电信、网通，回款有充分保障，因此发生坏账的可能性非常小。

其他三类产品是公司在防护器件取得稳定市场地位后，为规避产品单一的风险而拓展的产品，账期较短，一般不超过四个月。

截至2010年6月30日，应收账款前五名如下：

单位名称	金额（万元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南京八达通信设备有限公司	470.58	1年以内	5.17
深圳市申欣电子有限公司	382.88	1年以内	4.21
深圳市杰坤电子有限公司	378.23	1年以内	4.16

深圳市盈源电子有限公司	357.54	1 年以内	3.93
浙江万马集团电子有限公司	357.27	1 年以内	3.93
合 计	1,946.49	-	21.40

公司应收账款前五名均为公司主要客户，信用良好。从以往合作经验看，发生坏账的风险较小。

③报告期内公司应收账款绝大部分在信用期内

公司报告期内各年末应收账款信用期情况如下表所示：

单位：万元

项目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信用期内应收账款余额	8,714.30	95.82%	8,283.27	94.59%	7,425.36	90.87%	4,974.21	85.98%
信用期外应收账款余额	380.15	4.18%	473.75	5.14%	745.66	9.13%	811.38	14.02%
应收账款余额合计	9,094.45	100.00%	8,757.02	100.00%	8,171.02	100.00%	5,785.59	100.00%

从上表可以看出，报告期内公司应收账款绝大部分在信用期内，2008年至今，信用期内的应收账款占应收账款余额的比例均超过90%，并呈逐年上升趋势。对于信用期外的应收款，公司也采取了较为严格的管理措施，2010年6月末账龄超过一年的应收账款只有55.79万元，比2009年末的179.83万元减少了124.04万元。从公司历年应收账款回收情况来看，预计2010年6月末应收账款发生坏账的可能性很小。

④公司非常重视应收账款的管理工作，建立了行之有效的应收账款管理制度。主要包括：一是客户资信管理机制。在与客户建立供销关系前，由市场业务人员填报客户资信调查表，经营销部核定、分管领导审批后交公司存档保管。公司根据资信调查表有效信息，确定合理账期，并作为业务人员谈判依据。二是按月召开应收账款账龄分析和合同评审会议。公司规定，财务部每月对应收账款余额进行账龄分析，并由公司财务总监召集财务、营销、法务等相关部门召开应收账款分析及合同评审会议，对客户逐个分析处置。会议上还由公司法务部对近期合同签订过程中碰到的问题进行分析评判。三是制定了坏账责任追究制度。公司规定对于超过追收期限尚未追回的坏账损失，要追究业务员、分管领导责任，将依据实际情况，进行不同比例的赔偿。四是执行严格的对账制度。根据公司规定，

财务按计划定期组织对账工作，遇特殊情况，随时核对往来，即时处置应收账款，防范风险。通过对应收账款严格的过程管理确保了货款的安全，从公司历年应收账款回收情况看，发生坏账的可能性极小。

⑤近三年及一期末，应收账款有所增加，主要由于近年来公司业务规模持续扩大，主营业务收入增长迅速所致。应收账款余额与营业收入增长的配比情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2010年1-6月	2009年度	增长比例	2008年度	增长比例	2007年度
营业收入	10,268.37	16,211.22	11.75%	14,506.87	31.30%	11,048.41
应收账款余额	9,094.45	8,757.02	7.17%	8,171.02	41.23%	5,785.59
应收账款余额占收入的比例	88.57%	54.02%	-	56.33%	-	52.37%

2008年12月31日公司应收账款余额占当年营业收入的比例为56.33%，比2007年末增加3.96%，主要有两个原因：①2008年第四季度市场环境恶化，下游客户不能按时支付货款，导致付款期延长；②2008年新产品VDMOS正式投产，为加强推广力度，扩大销售规模，公司增加了客户信用额度，允许一定比例的赊销。随着2009年市场回暖，下游客户资金紧张情况有所好转，VDMOS产品成功推广，其销售政策趋于常规化，2009年应收账款余额占当年营业收入的比例为54.02%，比2008年降低2.31%。2010年6月30日应收账款余额较2009年末基本保持稳定，由于对应半年的营业收入，当期应收账款余额占收入的比例与前三年比例不具有可比性。

⑥公司应收账款坏账准备计提比例同行业比较分析

公司与同行业上市公司应收账款坏账准备计提比例如下表所示：

账龄	应收账款计提比例（%）			
	江苏东光	华微电子	士兰微	苏州固锝
1年以内（含1年）	5	2	5	5
1—2年	10	5	10	20
2—3年	20	10	30	100
3—4年	50	50	100	100
4—5年	80	50	100	100
5年以上	100	90	100	100

通过比较可以看出，公司2年以内的应收账款坏账计提比例等于或高于同行

业可比上市公司平均水平。而各公司2年以上应收账款坏账计提比例相差较大，公司的计提比例高于华微电子，低于士兰微和苏州固锴。

公司应收账款账龄主要集中在2年以内，特别是2009年12月31日和2010年6月30日，2年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为99.91%和99.95%，而账龄超过2年的应收账款金额很小，分别仅为7.85万元和4.39万元，如果上述应收账款全额计提坏账准备，影响2009年度利润总额5.14万元，影响2010年上半年利润总额2.97万元，对公司净利润的影响非常小。

因此，公司应收账款坏账准备计提比例适中，符合行业特点，公司应收账款坏账准备计提比例是谨慎、合理的，公司应收账款质量较高。

（3）预付款项分析

近三年及一期末，公司预付款项如下所示：

账龄	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
1年以内	215.42	100.00	667.32	100.00	462.22	99.47	4,823.24	100.00
1年以上	-	-	-	-	2.46	0.53	-	-
合计	215.42	100.00	667.32	100.00	464.67	100.00	4,823.24	100.00

2008年12月31日公司预付账款比上年减少4,358.57万元。2007年，预付款项主要为宜国用（2009）字第28600002号地块土地款及建设VDMOS生产项目预付款项，共计4,391.00万元，其余部分为与日常经营相关的款项；2008年预付款项主要为与日常经营相关的款项。

2009年12月31日公司预付账款比上年增加202.65万元，主要原因是公司产品市场需求旺盛，产量提高，预付设备、材料采购款及委托加工封装测试环节的预付加工费比上年有所提高。

2010年6月30日公司预付账款比上年减少451.90万元，主要原因是随着公司封装需求的增加，更多采用赊购的结算方式，逐步减少对外协加工单位的预付账款所致。

（4）存货分析

近三年及一期末，公司存货账面价值分别为2,344.24万元、2,758.44万元、

3,965.19万元和3,347.09万元，分别占公司流动资产的12.48%、13.40%、15.95%和16.40%。

公司与同行业可比上市公司存货占流动资产比例指标比较如下：

公司	2009 年	2008 年	2007 年
华微电子	20.72%	36.25%	17.94%
士兰微	33.72%	40.05%	38.47%
苏州固锔	34.20%	38.33%	29.12%
平均	29.55%	38.21%	28.51%
江苏东光	15.95%	13.40%	12.48%

注：同行业上市公司数据来源于巨潮资讯。

从上表可以看出，公司存货占流动资产比例远低于同行业上市公司平均水平，说明公司存货管理能力较强，具体说明如下：

公司根据成熟客户群的需求和新客户开发进度，每月初制定销售计划，并以此为依据制定生产计划。除此之外，公司每周组织生产、采购及销售部门召开产销协调会议，根据每周的市场变化，对生产、采购和销售计划进行微调。

根据各类存货的特点，公司财务部每月对存货情况进行分析——原材料超过一个月未流动的，库存商品三个月未流动，在产品芯片超过正常生产流程周期的（防护器件30天左右，VDMOS1-2个月，可控硅及1300X2-3个月），将分析原因，落实相关责任人，调整后续存货计划。

公司销售采取框架合同与订单相结合的方式。对于长期合作的客户，一般年初签订框架合同，根据客户单笔订单要求，公司安排发货；部分客户以条款详细的订单代替框架合同，直接按订单要求发货。

综上所述，由于公司对存货的高效、精确的管理，使存货在保证正常生产经营的前提下，保持较高流动性。

① 存货构成如下表所示：

项 目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
原材料	290.39	8.68	376.40	9.49	311.71	11.30	244.54	10.43
库存商品	1,378.88	41.20	1,751.40	44.17	773.78	28.05	1,323.92	56.48
自制半成品	270.35	8.08	131.57	3.32	142.08	5.15	270.78	11.55
委托加工物资	268.20	8.01	381.38	9.62	202.57	7.34	108.71	4.64
在产品	1,139.27	34.04	1,324.44	33.40	1,328.30	48.15	396.29	16.90

合计	3,347.09	100.00	3,965.19	100.00	2,758.44	100.00	2,344.24	100.00
----	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------

存货主要包括在产品和库存商品，报告期内未计提存货跌价准备。

截至 2008 年 12 月 31 日，存货余额较上年末增加 414.20 万元，主要是由在产品和库存商品的变动引起的。其中，公司在产品余额 1,328.30 万元，较 2007 年末 396.29 万元增加 235.18%，系当年 VDMOS 生产线投产所致，2008 年 12 月 31 日，VDMOS 在产品余额为 826.39 万元；公司库存商品余额 773.78 万元，较 2007 年末 1,323.92 万元减少 41.55%，系公司在 2008 年面临订单数量下降的情况，为避免市场风险和资金占用，及时减少库存商品所致。

截至 2009 年 12 月 31 日，存货余额较上年末增加 1,206.75 万元，主要是由库存商品的变动引起的。库存商品 2009 年末余额 1,751.40 万元，较 2008 年末 773.78 万元增加 126.34%，系 2009 年末市场需求旺盛，加大备货数量所致。其中 VDMOS 为主要影响因素，当年 VDMOS 成功开拓市场，销量大幅上升，产品供不应求，因此 VDMOS 备货比上年大幅增加，库存商品增加 612.20 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日，存货余额较上年末减少 618.10 万元，主要是进一步加强存货管理引起的。面对旺盛的市场需求，公司一方面积极销售，另一方面加强存货管理，减少存货资金占用，提高资金使用效率，库存商品较上年末减少 372.52 万元，在产品较上年末减少 185.17 万元。

公司管理层认为存货规模与主营业务规模相匹配，流动性良好，资产质量较高。

②公司业务规模的逐年增长使存货亦同步增长

报告期内公司处于高速发展的阶段，营业收入和营业成本的逐年大幅增长使存货亦相应大幅增长，具体情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	增长比例	2008 年度	增长比例	2007 年度
营业收入	10,268.37	16,211.22	11.75%	14,506.87	31.30%	11,048.41
营业成本	6,935.93	10,953.23	9.78%	9,977.08	49.77%	6,661.38
存货账面价值	3,347.09	3,965.19	43.75%	2,758.44	17.67%	2,344.24
存货占成本的比例%	48.26%	36.20%	-	27.65%	-	35.19%

由上表可见，最近三年公司存货占营业成本的比重比较稳定，保持在30%左

右。2008年公司营业收入较2007年增长31.30%，营业成本增长49.77%，2008年末存货账面价值较2007年末的增长17.67%，增长比例小于营业成本增长比例，系公司为抵御市场变化的风险，调整生产节奏所致；2009年公司营业收入较2008年增长11.75%，营业成本增长9.78%，2009年末存货账面价值较2008年末增长43.75%，系市场需求扩大，公司为把握市场机遇，加紧组织生产，适度增加存货所致。

3、固定资产分析

（1）固定资产总体情况

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备等，均为经营所必备的资产，公司近三年及一期末固定资产净值及其分类情况如下：

名 称	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
房屋建筑物	3,443.66	17.16	2,349.74	11.87	2,338.78	12.81	1,105.94	42.88
机器设备	16,252.21	81.00	17,069.79	86.20	15,600.37	85.46	1,109.36	43.01
电子设备	114.75	0.57	111.21	0.56	107.55	0.59	129.74	5.03
运输设备	252.64	1.26	272.02	1.37	208.12	1.14	234.38	9.09
合 计	20,063.26	100.00	19,802.76	100.00	18,254.81	100.00	2,579.41	100.00

随着生产规模的扩大，报告期公司固定资产规模快速增长，固定资产净值从2007年12月31日的2,579.41万元增长到2010年6月30日的20,063.26万元，增长了677.82%。

公司所处的半导体行业为资本密集型行业，报告期内固定资产净额大幅增长，主要是公司自筹资金建设的VDMOS生产线逐年转固所致，其中，2010年上半年VDMOS生产项目自在建工程转入固定资产280.34万元，2009年VDMOS生产项目自在建工程转入固定资产2,240.38万元，2008年VDMOS生产项目自在建工程转入固定资产16,860.15万元，另外还有生产线配套房屋建筑物建造完成，三期工程、防护器件项目和其他零星工程相继转固。

公司的多数固定资产尚处于良好运行阶段，固定资产整体成新率为74.08%，短期内不存在大幅跌价的可能，但需要根据业务的发展情况做适度的更新。

（2）固定资产折旧情况：

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日
	金额（万元）	金额（万元）	增长比例（%）	金额（万元）	增长比例（%）	金额（万元）
固定资产净值	20,063.26	19,802.76	8.48	18,254.81	607.71	2,579.41
	2010 年 1-6 月	2009 年度		2008 年度		2007 年度
当期折旧金额	1,357.68	2,365.50	58.51	1,492.35	219.08	467.71

2009年末公司固定资产净值增加1,547.95万元，固定资产折旧增加873.15万元，固定资产折旧增长比例大幅高于固定资产净值增长比例，主要是受VDMOS生产线折旧的影响：

①公司VDMOS生产线2008年和2009年折旧情况如下表所示：

资产项目	折旧年限	2008 年计提折旧（万元）	2009 年计提折旧（万元）	折旧增加金额（万元）
进口生产线（含调试费）	8 年	584.81	1,360.04	775.23
配套生产设备	5-10 年	39.15	40.72	1.57
配套基础设施	5-10 年	324.25	467.14	142.89
房屋建筑物	20 年	49.29	65.72	16.43
合计	-	997.49	1,933.62	936.13

其中，2008年3月公司新建的VDMOS生产线部分设备达到可使用状态，转入固定资产，包括进口生产线设备4,932.49万元和翻新调试费1,632.69万元，此部分固定资产2008年计提折旧期为9个月；2008年12月调试费5,024.00万元转入固定资产，此部分固定资产当年没有计提折旧。

由于VDMOS生产线分期转固，使得2008、2009年度VDMOS生产线折旧变化较大。

②除VDMOS生产线的固定资产折旧，2008年公司固定资产折旧494.86万元，2009年固定资产折旧431.88万元，变化较小。2009年比2008年固定资产折旧减少，主要是因为公司2008年、2009年分别有435.69万元、205.33万元的固定资产折旧到期，使得2009年其他固定资产折旧比2008年减少。

③VDMOS生产线调试费的内容

VDMOS生产线的调试费包括进口设备的搬运、安装、翻新、调试，以及在翻新、调试过程中更换的设备零部件、支出的相关的人工服务费、软件费、水电费等各项杂费。公司VDMOS生产线配备了先进的进口生产设备，由于国内不具

备相应的生产设备制造技术，只有少数几个公司能够完成相关设备的翻新、安装、调试，并且二手设备调试周期长，导致调试费比较昂贵。

截止2008年12月31日，公司累计支出VDMOS生产线调试费6,656.69万元。

下表为调试费在在建工程中的主要项目明细及其转固情况：

单位：万元

项目	2008 年	2007 年	2006 年	2005 年	合计
工资	17.02	59.38	44.69	10.28	131.38
贷款利息	104.59	221.18	-	-	325.77
工程材料及设备配件	12.07	86.12	255.16	86.37	439.72
水、电、蒸汽费	39.68	138.11	68.93	-	246.72
专业调试费	5,024.00	286.11	167.99	35.00	5,513.10
合计	5,197.36	790.90	536.77	131.65	6,656.69

所有调试费用中，除了专业调试费2008年5,024.00万元在2008年12月转固，其他调试费均在2008年3月转固。

（4）截至2010年6月30日，公司固定资产作为银行贷款的担保，抵押情况如下：

资产类别	抵押资产原值（万元）	全部固定资产原值（万元）	比例（%）
房屋建筑物	1,622.28	4,336.12	37.41
机器设备	3,616.89	21,937.22	16.49
电子设备	316.71	404.46	78.30
运输设备	170.64	405.24	42.11
合 计	5,726.52	27,083.04	21.14

4、在建工程分析

近三年及一期末，公司在建工程情况如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）
VDMOS 生产项目	222.23	16.62	352.87	22.88	2,159.90	54.00	10,854.76	97.46
三期工程	174.85	13.08	1,113.45	72.20	761.18	19.03	-	-
防护器件项目	510.75	38.20	-	-	-	-	-	-
其他零星工程	429.05	32.09	75.95	4.92	1,078.87	26.97	283.18	2.54
合 计	1,336.88	100.00	1,542.28	100.00	3,999.95	100.00	11,137.93	100.00

随着公司研发实力的增强，生产规模的扩大，公司从奥地利引进了VDMOS

生产线，该生产线于2008年转固16,860.15万元，2009年转固2,240.38万元，2010年上半年转固280.34万元。

三期工程主要是在宜国用（2009）字第28600002号土地上建设封装车间、成品测试车间及仓库。

防护器件项目主要是在现有防护器件生产线的基础上，对部分设备进行更新改造，以提升产能，满足目前市场需求。

其他零星工程主要包括除VDMOS生产线、三期工程和防护器件项目以外的设备及厂房的更新改造等零星工程。

5、无形资产分析

近三年及一期末，公司无形资产如下表所示：

项目	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
土地使用权	1,896.77	100.00	1,917.28	100.00	1,900.60	100.00	492.61	100.00
合计	1,896.77	100.00	1,917.28	100.00	1,900.60	100.00	492.61	100.00

截至2010年6月30日，公司无形资产账面价值为1,896.77万元，全部为土地使用权，系公司厂区用地及募投项目储备用地，均为公司根据经营需要而购入。

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司积极落实新增土地。公司于2006年2月22日通过出让方式取得宜国用（2006）字第000089号土地，作为VDMOS生产线的项目用地；于2009年1月16日通过出让方式取得宜国用（2009）字第28600002号土地，作为三期工程及募投项目用地。

截至2010年6月30日，公司无形资产作为银行贷款担保，已全部抵押。

6、主要资产减值准备情况

报告期内，公司按照稳健性原则，对各类资产的减值情况进行了核查，并足额计提了减值准备，主要资产的减值准备提取情况如下：

单位：万元

资产减值准备项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
一、坏账准备合计	476.13	467.14	471.00	450.10
其中：应收账款	458.50	448.78	443.20	430.01

其他应收款	17.63	18.36	27.80	20.08
二、存货跌价准备	-	-	-	-
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
四、在建工程减值准备	-	-	-	-
五、无形资产减值准备	-	-	-	-
合 计	476.13	467.14	471.00	450.10

（1）鉴于应收账款和其他应收款均不符合单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准，因此根据账龄分析法对其计提坏账准备，详见“第十节 财务会计信息/三、财务报告的编制基础、合并财务报表范围/（二）金融工具的核算方法”。

（2）存货、固定资产、在建工程、无形资产均不存在减值的情况，故未计提资产减值准备。

公司管理层认为，公司已按照《企业会计准则》制定了各项资产减值准备的计提政策，严格按照公司制定的会计政策计提各项减值准备，公司计提的各项资产减值准备是公允和稳健的，各项资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符，客观反映了公司的资产价值。

7、公司管理层对资产结构的评价

公司管理层认为：公司资产结构符合公司所处行业的实际情况，货币资金、应收账款及固定资产金额虽增长较快，但均与主营业务增长规模匹配，处于合理范围内并得到有效管理。公司制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备计提充分、合理，公司未来不会因为资产不良而导致财务风险。

（二）负债结构

1、负债结构

近三年及一期末，公司的负债结构如下表所示：

项 目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债合计	14,147.47	77.90	18,447.04	76.63	22,403.23	97.39	13,172.52	100.00
非流动负债合计	4,012.43	22.09	5,625.77	23.37	600.00	2.61	-	-
合计	18,159.91	100.00	24,072.81	100.00	23,003.23	100.00	13,172.52	100.00

近三年及一期，与公司资产总额增长趋势一致，负债也呈增长趋势，从2007

年12月31日的13,172.52万元增长到2010年6月30日的18,159.91万元。从负债结构来看，公司流动负债占全部负债的比例逐年下降，相应非流动负债占全部负债的比例逐年上升，负债结构逐步趋于合理，财务风险逐年降低。

2、流动负债构成

近三年及一期末，公司流动负债构成如下：

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
短期借款	9,300.00	65.74	7,680.00	41.63	11,767.84	52.53	9,324.75	70.79
应付票据	200.00	1.41	6,000.00	32.53	3,800.00	16.96	-	-
应付账款	3,707.48	26.21	3,542.36	19.20	3,948.23	17.62	3,214.85	24.41
预收款项	13.90	0.10	11.71	0.06	73.01	0.33	58.18	0.44
应付职工薪酬	264.90	1.87	200.25	1.09	253.10	1.13	144.52	1.10
应交税费	587.32	4.15	746.92	4.05	259.39	1.16	213.29	1.62
应付利息	14.19	0.10	16.67	0.09	48.45	0.22	21.19	0.16
其他应付款	59.68	0.42	249.13	1.35	253.20	1.13	195.74	1.49
其他流动负债	-	-	-	-	2,000.00	8.93	-	-
流动负债合计	14,147.47	100.00	18,447.04	100.00	22,403.23	100.00	13,172.52	100.00

近三年及一期末，影响流动负债的主要科目为短期借款、应付票据、应付账款和其他流动负债，各期末上述四项合计占流动负债的比例分别为95.20%、96.04%、93.36%和93.36%。公司流动负债呈现以下特点：短期借款金额大，主要原因为公司营运资金需求大；融资渠道多样化，通过银行贷款、在银行间债券市场发行短期融资券筹集资金等多种形式筹集资金。主要流动负债项目的分析如下：

（1）短期借款分析

近三年及一期末，公司短期借款余额分别为9,324.75万元、11,767.84万元、7,680.00万元和9,300.00万元。

2008年12月31日公司短期借款余额较2007年末余额增加2,443.09万元，系VDMOS生产线建设占用公司大量自有资金，公司日常经营所需资金通过增加短期借款满足所致。2009年12月31日公司短期借款余额较2008年下降4,087.84万元，系公司2009年拓宽融资渠道，增加了应付票据和长期借款在负债总额中的比例，2009年末应付票据和长期借款较上年增加5,150.00万元。2010年6月30日公司短期

借款余额较2009年末增加1,620.00万元。

截至本招股说明书签署日，公司没有到期未还的短期借款。

（2）应付票据分析

①应付票据基本情况

近三年及一期末，公司应付票据余额分别为0.00万元、3,800.00万元、6,000.00万元和200.00万元。

报告期内，公司为降低融资成本，通过与旭日电子和无锡盛泰之间开具了部分无真实贸易背景的银行承兑汇票，之后通过银行贴现获得融资，其中旭日电子为本公司供应商，无锡盛泰为本公司关联方。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司银行承兑汇票发生金额分别为389.74万元、4,800.00万元、15,000.00万元和200.00万元，其中无真实贸易背景的银行承兑汇票分别为0万元、4,120万元、14,550万元和0万元。

近三年及一期，公司向旭日电子开具的银行承兑汇票的金额分别为55万元、4,800万元、5,000万元和200万元，其中无真实贸易背景的银行承兑汇票的金额分别为0万元、4,120万元、4,550万元和0万元；公司向无锡盛泰开具的银行承兑汇票的金额分别为0万元、0万元、10,000万元和0万元，其中无真实贸易背景的银行承兑汇票的金额分别为0万元、0万元、10,000万元和0万元。报告期内，旭日电子和无锡盛泰均不存在向公司开具无真实贸易背景的银行承兑汇票的情形。

报告期内，公司共利用票据融资20,389.74万元（保证金16,289.74万元，差额4,100万元），共支付贴现利息178.33万元，获得保证金利息收入189.08万元，财务费用为-10.76万元；如果当时采取流动资金贷款方式融资4,100万元，按照当时公司一年期贷款利率测算，贷款利息支出应为118.43万元，两者差异额129.19万元。

②无真实贸易背景银行承兑汇票权利义务的消灭情况

截至2010年3月22日，公司向旭日电子和无锡盛泰开具的无真实贸易背景的银行承兑汇票均已到期，公司在银行承兑汇票到期前已将票款足额交存其开户银行，开户银行（即委托付款人）也已向持票人付款，上述银行承兑汇票上的权利义务均已消灭。

③公司开具无真实贸易背景银行承兑汇票所履行的程序

2008年2月28日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司与宜兴市旭日电子有限公司开具承兑汇票的议案》。

2008年3月25日，公司召开2007年度股东大会，审议通过《关于公司与宜兴市旭日电子有限公司开具承兑汇票的议案》。

2009年4月30日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司与关联方无锡市盛泰电子器件有限公司开具承兑汇票的议案》和《关于公司与宜兴市旭日电子有限公司开具承兑汇票的议案》。审议《关于公司与关联方无锡市盛泰电子器件有限公司开具承兑汇票的议案》时，关联董事沈建平回避表决。

2009年5月25日，公司召开2008年度股东大会，审议通过《关于公司与关联方无锡市盛泰电子器件有限公司开具承兑汇票的议案》和《关于公司与宜兴市旭日电子有限公司开具承兑汇票的议案》。审议《关于公司与关联方无锡市盛泰电子器件有限公司开具承兑汇票的议案》时，关联股东沈建平回避表决。

④无锡盛泰注销后公司仍对其存在6,000万元应付票据的原因以及处理方法

2009年2月12日至2009年9月22日期间，公司向无锡盛泰开具了17张银行承兑汇票，共计10,000万元，其中6,000万元在2009年12月31日尚未到期，反映在应付票据科目中。无锡盛泰取得票据后，将总额为9,900万元的银行承兑汇票背书给江苏东光（江苏东光不支付背书对价），江苏东光取得票据后向银行贴现取得资金；将总额为100万元的银行承兑汇票背书给江苏东光指定的供货商（供应商不支付背书对价），作为江苏东光向该供货商采购商品的对价。此后，无锡盛泰已不持有上述票据，公司的债权人变为持有上述应付票据的不特定对象。2009年12月28日，无锡盛泰在无锡市宜兴工商行政管理局办理了注销登记。

截至2010年3月22日，上述6,000万元银行承兑汇票均已到期，江苏东光在银行承兑汇票到期前已将票款足额交存其开户银行，开户银行（即委托付款人）也已向持票人付款，上述银行承兑汇票上的权利义务均已消灭。

⑤公司规范票据行为采取的规范措施

为规范票据使用，杜绝今后不规范使用票据的行为，公司采取了以下措施：

A、组织学习相关法律法规。公司组织全体高管人员及财务人员认真学习《中华人民共和国票据法》等票据法律法规，由北京市天银律师事务所的执业律师向

上述人员详细讲述了《票据法》的立法背景、行为规范、权利义务和法律责任。通过培训学习，公司全体高管人员及财务人员法律意识得到提高，对票据相关法律法规的认识和理解得到深化。此外，公司拟从外部引进熟悉经济领域法律的员工，充实到财务部和证券法务部，进一步提高员工整体专业胜任能力。

B、进一步完善内部控制制度。公司已修订《财务管理制度》，明确规定了开立各类票据的原则、程序，并且强化了公司货币资金内部控制制度，严格执行有关资金使用的财务制度。同时，公司建立健全财务考核及奖罚制度、关联交易决策制度等，积极发挥审计委员会和独立董事的监督作用，通过进一步完善内部控制制度来杜绝不规范的票据行为。

C、强化董事、监事和高级管理人员职责。未来如果公司董事、监事或高级管理人员擅自批准发生新的不规范票据行为，公司董事会均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。

D、加强与中介机构的沟通。公司将在以后的经营过程中加强与审计机构等中介机构的沟通和协调，及时咨询相关政策法规，做到事前化解。

E、公司承诺：今后将严格按照《票据法》的有关规定使用票据，不从事任何不规范、不合法的票据行为。

F、公司控股股东和实际控制人沈建平先生承诺：本人将通过江苏东光股东大会、董事会依法行使股东和董事的职责，督促江苏东光规范运作，彻底杜绝不规范使用票据的行为；如江苏东光因以往不规范使用票据而须承担赔偿责任或给江苏东光造成损失、引发不利影响，本人将全额承担该等责任或补偿江苏东光损失、积极消除不良影响，并放弃向江苏东光追偿的权利。

保荐人认为：发行人过往期间不规范使用票据的行为不符合《中华人民共和国票据法》的有关规定，但发行人已及时履行了票据付款义务且未造成任何经济纠纷和损失，不存在票据欺诈的情况，未给相关银行造成任何实际损失，亦未因此受到任何行政处罚；发行人已对过往期间不规范使用票据的行为采取了积极的补救措施和一系列整改措施以确保该等情况不再发生，发行人过往期间所发生的不规范使用票据的行为对本次发行上市不构成法律障碍。

发行人律师认为：发行人过往期间不规范使用票据的行为不构成重大违法行为，且未对发行人的财务和生产经营产生不利影响；发行人的上述不规范行为业

已规范，不会对发行人的本次发行构成障碍。

（3）应付账款分析

单位：万元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
材料采购款	2,359.96	2,307.41	1,706.47	1,127.74
工程款	121.66	226.80	1,390.04	207.39
设备采购款	283.15	252.68	99.96	57.73
加工费	942.71	755.47	751.76	1,821.99
合计	3,707.48	3,542.36	3,948.23	3,214.85

近三年及一期末，公司应付账款余额分别为 3,214.85 万元、3,948.23 万元、3,542.36 万元和 3,707.48 万元，占流动负债的比例分别为 24.41%、17.62%、19.20% 和 26.21%。

2008 年 12 月 31 日公司应付账款余额较 2007 年末增加 733.38 万元，增加 22.81%，主要原因是：①从 2008 年起，公司主要原材料单晶硅片市场供应过剩，公司争取到延长付款期限以减少资金占用，引起应付账款中的材料采购款出现一定程度的增加；②2008 年 VDMOS 生产线部分工程款尚未结算完毕，导致当年应付账款中的工程款比上年大幅增加；③从 2008 年起，公司为降低加工费用，增加了外协加工的付款力度，因此 2008 年和 2009 年应付账款中的加工费比 2007 年有大幅降低。

2009 年 12 月 31 日公司应付账款余额较 2008 年末减少 405.87 万元，减少 10.28%，主要原因是：①由于业务规模扩大，导致公司原材料需求增加，加之公司争取到较长付款期限，相应 2009 年 12 月 31 日应付账款中的材料采购款比 2008 年末增加 600.94 万元；②随着 VDMOS 生产线工程款结算完毕，2009 年 12 月 31 日应付账款中的工程款比 2008 年末减少 1,163.24 万元。

2010 年 6 月 30 日公司应付账款余额较 2009 年末增加 165.12 万元，主要原因是，随着委托加工的增加和公司对外协单位议价能力的增强，应付加工费增加。

（4）其他流动负债分析

2008 年 10 月 20 日，公司在全国银行间债券市场面对机构投资者发行了 2,000.00 万元，期限为 365 天的短期融资券，募集资金用于补充流动资金、优化负

债结构、降低财务费用。2009年10月21日，公司偿付短期融资券本息共计2,140.40万元。通过发行本期短期融资券，拓宽了融资渠道，改善了当期负债结构。

3、非流动负债构成

近三年及一期末，公司非流动负债构成如下：

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
长期借款	-	-	2,950.00	52.44	-	-	-	-
其他非流动负债	4,012.43	100.00	2,675.77	47.56	600.00	100.00	-	-
非流动负债合计	4,012.43	100.00	5,625.77	100.00	600.00	100.00	-	-

报告期内，公司非流动负债增长较快，主要是公司通过使用部分非流动负债置换流动负债，控制财务风险，增强经营稳健性。

近三年及一期末，公司其他非流动负债余额分别为0万元、600.00万元、2,675.77万元和4,012.43万元，全部为政府补助，具体情况如下：

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
研发资助(DSC3X00)	267.43	280.77	600.00	-
研发资助(DCLP19E)	1,000.00	1,000.00	-	-
技术改造	800.00	800.00	-	-
科技创新与成果转化	525.00	525.00	-	-
技术创新项目资助	70.00	70.00	-	-
研发资助(支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路)	650.00			
现代服务业发展专项引导资金	200.00			
新型电力电子器件研发及产业化项目资助	500.00			
合计	4,012.43	2,675.77	600.00	-

①2008年依据信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得DSC3X00网络安全保护用集成电路研究与开发项目研发资助600.00万元；2009年项目完成，其中280.77万元用于购买设备，作为递延收益，以后在资产折旧年限内逐年结转营业外收入。2010年1-6月结转营业外收入减少递延收益13.34万元；

②2009年依据信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业

研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得DCLP19E通信安全保护用集成电路的研究与开发项目研发资助1,000.00万元；

③2009年依据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2009]1168号），公司取得技术改造项目投资800.00万元；

④2009年依据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅《江苏省科技技术厅、江苏省财政厅关于下达2009年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（苏科计[2009]320号、苏财教[2009]141号），取得科技创新与成果转化专项引导资金525.00万元；

⑤2009年依据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、江苏省科技厅《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，取得项目资助70.00万元。

⑥2010年依据工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2009年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财[2009]601号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路的研发资助650.00万元。

⑦2010年依据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于下达2009年度省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》（苏财建[2009]332号），公司取得新一代移动通信网络系统功率防护模块产业化专项引导资金200.00万元。

⑧2010年依据财政部《财政部关于下达2010年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2010]305号）、工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2010年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2010]301号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，公司取得新型电力电子器件研发及产业化项目资助资金500.00万元。

近几年，随着国家对集成电路产业的扶持力度加大，公司作为高新技术企业，在集成电路产业的研发实力不断提升，获得了国家发展和改革委员会、工业和信息化部、江苏省科学技术厅和江苏省财政厅对公司重点研发项目的大力支持，这将进一步促进公司自主研发能力的提升，促使半导体前沿技术早日实现国产化。

4、公司管理层对负债结构的评价

公司管理层认为：公司负债结构与资产结构相匹配，符合公司经营特点，公司将根据未来的经营情况适当增加非流动负债。

（三）公司偿债能力分析

1、报告期内，公司的主要财务指标如下：

财务指标	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
流动比率（倍）	1.44	1.35	0.92	1.43
速动比率（倍）	1.21	1.13	0.80	1.25
资产负债率（母公司）（%）	41.46	49.96	51.35	39.93
息税折旧摊销前利润（万元）	3,460.68	5,776.44	4,097.45	3,613.37
利息保障倍数（倍）	5.33	3.25	3.00	6.27

报告期公司流动比率和速动比率与业务发展规划相适应，受行业景气程度的影响，流动比率和速动比率略有波动，基本保持稳定。随着行业快速复苏以及公司主动调整负债结构，公司流动比率和速动比率将进一步提高。

近三年及一期末，公司资产负债率（母公司）分别为39.93%、51.35%、49.96%和41.46%，主要是由短期借款、应付票据、应付账款和非流动负债变动引起的，变动原因详见本节“一、财务状况分析/（二）负债结构”。

报告期公司息税折旧摊销前利润逐年大幅提高，表明公司盈利能力不断增强，即使面临不利的外部环境，依然能够保持自身快速发展。

由于VDMOS生产线价值较高，2008年转固后产生大额的折旧费用，而该产品处于市场培育期，未能产生效益，加之2008年起经济危机席卷全球，半导体行业市场环境恶化，上述三个原因造成2008年归属于公司普通股股东的净利润较2007年下降987.88万元，由此导致2008年利息保障倍数较2007年大幅下降。伴随2009年四季度半导体行业转暖，当年VDMOS实现毛利25.62万元，2009年归属于公司普通股股东的净利润较2008年增长337.91万元，当年利息保障倍数随之提

高。2010年上半年，VDMOS实现毛利256.23万元。今后几年，VDMOS能够创造更大的经济效益，而公司其他产品随着行业复苏将贡献更多的利润，公司整体盈利能力将大大增强，利息保障倍数将继续上升。

公司自成立至今从未发生过逾期未偿还贷款的现象，在银行间树立了良好的企业信用。公司将继续与各合作银行保持良好的合作关系，本着合理调配资金、节约资金成本的原则，根据项目的预算和运作周期统筹安排银行借款的使用和还款周期。

公司与同行业可比上市公司偿债能力指标比较如下：

公司	流动比率（倍）			速动比率（倍）			资产负债率（母公司）（%）		
	2009年	2008年	2007年	2009年	2008年	2007年	2009年	2008年	2007年
华微电子	1.08	1.24	1.54	0.85	0.79	1.26	41.75	40.64	41.55
士兰微	0.98	0.82	0.75	0.65	0.49	0.46	44.37	47.95	39.67
苏州固锴	1.74	2.44	2.41	1.15	1.51	1.71	29.05	18.25	25.08
平均	1.27	1.50	1.57	0.88	0.93	1.14	38.39	35.61	35.43
江苏东光	1.35	0.92	1.43	1.13	0.80	1.25	49.96	51.35	39.93

注：同行业上市公司数据来源于巨潮资讯。

2007年，公司流动比率略低于与同行业可比上市公司平均水平，速动比率高于同行业可比上市公司平均水平，表明公司资产流动性强，实际偿债能力较强。2007年，公司资产负债率略高于同行业可比上市公司平均水平。

2008年，由于生产经营的需要，公司流动负债增加，导致资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平。因此，流动比率较上年有所降低；鉴于公司资产流动性较好，当年速动比率与同行业可比上市公司差距远小于流动比率的差距。

2009年，公司资产负债率保持稳定，通过调整资产负债结构，使流动比率和速动比率回升，且均高于同行业可比上市公司平均水平。

公司处于经营规模快速扩张时期，负债融资较多，但总体看来偿债能力较强。

2、管理层对公司偿债能力的评价

公司管理层认为：公司债务总体规模适度，目前的资产负债率水平充分体现了公司利用财务杠杆适度举债经营的原则；公司的负债结构与公司的资产结构相

匹配，资产的流动性较强。同时，因公司银行信用较好，间接融资能力较强，不存在无法偿还债务本息的风险。

（四）经营活动现金流量分析

1、公司近三年及一期经营活动产生的现金流量净额及净利润情况如下：

单位：万元

项 目	合 计	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动现金净流量	19,051.82	4,728.02	5,929.90	2,688.89	5,705.01
净利润	8,757.63	1,497.16	2,316.14	1,978.23	2,966.10
差 额	10,294.19	3,230.86	3,613.76	710.66	2,738.91

近三年及一期，公司经营活动现金净流量均为正数，且大于净利润。

2007年，经营活动现金净流量与净利润的差额产生的主要原因是：当年收入较上年大幅增长，为了支持经营规模的快速扩张，公司加大了经营性融资以满足营运资金的需求，加大了对客户的收款力度，导致应收账款减少868.35万元；同时增加了对供货商的赊购金额，应付账款增加956.33万元。

2008年，经营活动现金净流量较上年减少3,016.12万元，主要是由应收账款余额增加2,385.43万元引起的。2008年，受金融危机的影响，下游厂商的支付能力普遍下降，导致应收账款增加。

2009年，经营活动现金净流量回到正常水平，主要由于公司营业收入比上年度增加1,704.35万元，同时公司作为国家扶持的高新技术企业取得政府补助2,395.00万元。

2010年上半年，公司经营活动现金净流量与净利润的差额进一步增加，主要由于应收账款余额和应收票据合计增加979.61万元，以及取得政府补助1,351.33万元。

2、管理层对公司经营活动现金流量的评价

公司管理层认为：公司经营活动现金净流量基本保持稳定。报告期内，公司通过调整经营策略，为公司带来了较充分的经营现金流量，保障了公司扩张经营规模的资金需要。

（五）资产周转能力分析

报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率如下：

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
存货周转率（次）	1.90	3.25	3.91	3.05
应收账款周转率（次）	1.15	1.91	2.08	1.78

1、存货周转情况

公司最近三年及一期的存货周转率分别为3.05、3.91、3.25和1.90，随着公司销售规模的扩大和存货管理水平的提高，公司存货周转速度呈上升趋势。公司与同行业可比上市公司的存货周转率比较如下：

公司	2009 年度	2008 年度	2007 年度
华微电子	2.34	2.05	3.21
士兰微	2.30	2.38	2.87
苏州固得	4.33	4.50	4.29
平均	2.99	2.98	3.46
江苏东光	3.25	3.91	3.05

注：同行业上市公司数据来源于巨潮资讯。

2、应收账款周转情况

公司最近三年及一期的应收账款周转率分别为 1.78、2.08、1.91 和 1.15，处于稳步上升的趋势。公司 2010 年 6 月 30 日应收账款余额为 9,094.45 万元，这些客户属于通信、电器、照明等行业配套企业，与公司长期合作，规模较大、实力强、信誉好，根据以往应收账款回收情况来看，应收账款的安全性有良好的保证。公司与同行业可比上市公司应收账款周转率比较如下：

公司	2009 年度	2008 年度	2007 年度
华微电子	2.89	2.10	2.06
士兰微	2.99	3.33	4.14
苏州固得	4.74	5.39	4.97
平均	3.54	3.61	3.72
江苏东光	1.91	2.08	1.78

注：同行业上市公司数据来源于巨潮资讯。

3、管理层对公司资产周转能力的评价

公司管理层认为：公司存货及应收账款周转速度处于合理水平，符合行业特征和公司实际情况。

二、盈利能力分析

报告期内，公司全部营业收入来源于防护器件、VDMOS、可控硅和1300X产品的销售，公司收入和利润指标变动情况如下所示：

项目	2010年1-6月	2009年度		2008年度		2007年度
	金额 (万元)	金额 (万元)	增长率 (%)	金额 (万元)	增长率 (%)	金额 (万元)
营业收入	10,268.37	16,211.22	11.75	14,506.87	31.30	11,048.41
营业利润	1,773.61	2,234.24	12.27	1,990.02	-32.77	2,960.08
归属母公司所有者的净利润	1,497.16	2,316.14	17.08	1,978.23	-33.31	2,966.10

报告期内公司营业收入增长迅速，2008年营业收入较上年增长31.30%，2009年较上年增长11.75%。

影响公司报告期利润的主要因素有两个：一是行业景气程度，2008年四季度，全球半导体市场受到金融危机的强烈冲击，2009年第四季度，受益于经济复苏，半导体行业也走出谷底，开始复苏。二是公司为开拓半导体行业高端市场，自筹资金近2亿元建设了VDMOS生产线，导致2008年和2009年固定资产折旧大幅增加，对公司利润有较大影响，随着VDMOS效益逐步显现，折旧对利润的影响将明显减弱，详见本节“二、盈利能力分析/（二）公司利润主要来源、可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素/2、影响公司盈利连续性和稳定性的主要因素”。

本节下文将从营业收入、毛利率、期间费用等几方面分析报告期内公司盈利情况的变化。

（一）主营业务收入构成及比例分析

1、分产品主营业务收入及构成分析

近三年及一期公司主营业务收入分产品构成情况见下表：

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
防护器件	3,090.41	30.10	5,337.14	32.92	4,167.56	28.73	2,728.68	24.70
VDMOS	3,360.70	32.73	4,161.74	25.67	1,948.96	13.43	-	-

可控硅	2,466.37	24.02	3,955.13	24.40	4,610.30	31.78	5,367.98	48.59
1300X	1,350.90	13.16	2,757.20	17.01	3,780.04	26.06	2,951.76	26.72
合计	10,268.37	100.00	16,211.22	100.00	14,506.87	100.00	11,048.41	100.00

（1） 防护器件

防护器件作为公司的传统优势产品，销售收入实现跨越式增长。

公司在通讯领域防护器件市场占有绝对的优势地位，公司生产的SA系列半导体固体放电管在国内程控交换机一级保护（即总配线架保安单元）方面，市场占有率常年居于第一位，并呈逐年上升趋势，竞争优势非常显著。公司DP系列固体放电管主要应用于机顶盒、Modem、xDSL、路由器等民用器件防护；58S、P61089功率集成电路应用于程控交换机二级防护（即用户板保护电路），在同类产品市场上也具有明显的领先优势。考虑到今后许多省市电信领域正在使用的气体放电管将逐步被固体放电管所替代，因此未来十年固体放电管将仍保持较高的需求量。

随着 3G 网络、宽带通讯、网络电视和计算机技术的发展，将直接带动半导体防护功率器件在程控交换机、机顶盒、Modem、ADSL、路由器、宽带交换设备等领域的应用。此外，国内半导体防护功率器件在家电、家用电路、电表等领域的应用非常少，而欧美发达国家在该些领域应用非常普遍。随着国内防护意识的不断加强和安防要求的提高，半导体防护功率器件在民用领域的应用将随之扩大。

（2） VDMOS

VDMOS作为高端功率器件的代表，因其性能先进，又具有明显的节能、功能驱动作用，在绿色电源、通信及计算机电源、变频调速、感应加热、新型家电、电动交通工具等领域都有巨大的应用前景。受计算机及游戏平台、上网本销售的推动，功率器件市场仍保持相对强势，而其中VDMOS 用量相当可观。与消费市场相比，工业控制、电信行业受金融危机冲击相对小，加上政府大笔资金投入基础建设，因而需求不减反增。对要求更高能效的应用领域来说（例如网络服务器和电信应用），改善能源效率已经成为许多客户的重要目标。未来随着我国及全球经济的不断恢复，消费电子行业对VDMOS的需求将不断恢复，工业控制、电信行业、汽车电子行业则将保持较快的增长，计算机领域增速将不断回升。此外，

LED照明也是VDMOS的一个重要应用领域。目前发展低碳经济已成全球共识，节能将在碳减排过程中发挥主导作用，因此未来LED照明将成为照明领域的发展趋势，同时也将促进VDMOS产品市场的发展。

由于产业发展阶段的不同，目前VDMOS的巨大市场几乎完全被国外厂商占据，国内半导体企业对VDMOS的研制还处于起步阶段，但发展势头迅猛。由于国内企业在价格上的突出优势，VDMOS市场竞争格局极有可能将重新洗牌。

公司VDMOS的性能指标已达到国内外先进水平，产品型号齐全，技术优势明显，已成功打开市场。自2008年正式投产以来，VDMOS对主营业务收入的贡献逐年提高，带动了营业收入的增长，并将成为重要的盈利增长点。

（3）可控硅

可控硅主要应用于摩托车、吸尘器、电动工具、电扇、空调、冰箱等终端产品。面对摩托车用可控硅毛利率逐年下降的情况，公司从2008年及时调整市场重点，着力开拓利润率更高的家用电器市场，应用于摩托车的可控硅由2007年的1,162.50万元降至2010年上半年的53.46万元，而应用于吸尘器、冰箱的可控硅由2007年的128.69万元升至2010年上半年的1,320.45万元。目前吸尘器、冰箱用可控硅是公司重点发展的产品，其中吸尘器市场占有率在国内吸尘器用可控硅生产厂商中排名领先，并率先进入冰箱、豆浆机用可控硅市场。公司还在发展洗衣机等高端可控硅市场，未来市场发展前景广阔。

（4）1300X

1300X是节能灯的主要原材料，随着节能灯的推广，小功率家用节能灯需求逐步增加，公司相应调整产品结构，小功率1300X占全部1300X销售比例提高；由于规模化生产和市场参与者增加，节能灯出现价格下降的情况，1300X的利润空间亦受到挤压。上述两个原因共同导致1300X平均单价从2007年0.41元/只降至2009年0.32元/只，其营业收入亦逐年下降。

1300X还可应用于电源适配器，该领域的客户与新产品VDMOS的客户重合，通过向客户提供配套服务，有利于VDMOS的市场开拓，带动VDMOS销售的增长。

2、分地区主营业务收入及构成分析

近三年及一期公司主营业务收入分地区构成情况如下：

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
浙江	2,966.02	28.89	5,967.49	36.81	5,955.15	41.05	5,205.69	47.12
广东	4,417.71	43.02	4,823.42	29.75	3,844.70	26.50	1,362.68	12.33
江苏	1,968.43	19.17	3,497.51	21.57	2,847.90	19.63	2,289.47	20.72
山东	5.09	0.05	403.75	2.49	113.49	0.78	272.83	2.47
安徽	142.09	1.38	307.15	1.89	110.24	0.76	75.11	0.68
江西	96.16	0.94	260.92	1.61	235.55	1.62	335.14	3.03
重庆	53.46	0.52	245.55	1.51	749.09	5.16	1,162.50	10.52
福建	62.37	0.61	135.32	0.83	135.85	0.94	23.55	0.21
上海	117.44	1.14	135.25	0.83	286.15	1.97	120.57	1.09
湖南	45.48	0.44	134.03	0.83	32.78	0.23	64.06	0.58
其他	186.84	1.82	146.44	0.90	194.59	1.34	136.80	1.24
国外	207.28	2.02	154.38	0.95	1.38	0.01	-	-
合计	10,268.37	100.00	16,211.22	100.00	14,506.87	100.00	11,048.41	100.00

公司主营业务收入主要来源于国内，主要集中于浙江、广东和江苏三省，并保持持续增长的趋势；随着公司产品结构的调整，除上述重点区域之外的其他国内地区实现的主营业务收入出现一定程度调整，主要是减少了对摩托车主产区——重庆的可控硅销售，将可控硅的重点销售对象定位于家用电器领域。2008年开始，公司尝试直接拓展国际市场，目前所占比重很小。

3、主营业务收入增长情况分析

项目	2010年1-6月	2009年度		2008年度		2007年度
	金额（万元）	金额 (万元)	同比增长 (%)	金额 (万元)	同比增长 (%)	金额 (万元)
防护器件	3,090.41	5,337.14	28.06	4,167.56	52.73	2,728.68
VDMOS	3,360.70	4,161.74	113.54	1,948.96	-	-
可控硅	2,466.37	3,955.13	-14.21	4,610.30	-14.11	5,367.98
1300X	1,350.90	2,757.20	-27.06	3,780.04	28.06	2,951.76
合计	10,268.37	16,211.22	11.75%	14,506.87	31.30%	11,048.41

报告期，公司主要产品呈现持续增长的态势，公司主营业务收入分别为11,048.41万元、14,506.87万元、16,211.22万元和10,268.37万元，2008年较2007年增长31.30%，2009年较2008年增长11.75%，2010年上半年更是达到历史最好水平，公司近三年及一期主营业务收入持续增长的原因为：

（1） 市场需求增长带动公司产品销量增加

近年来，随着国内下游产业需求的高速增长推动了我国半导体分立器件和集成电路行业行业发展。金融危机以来，虽然美国这个重要市场的需求增速减缓，但国内市场的高速增长在一定程度上对总需求做出了弥补。尤其是汽车电子、照明电子等新兴领域未来数年对半导体器件需求的年均增速均在30%左右，将是未来拉动半导体产业发展的重要动力。2009年国务院发布了《电子信息产业调整振兴规划》，其中明确提出扶持中小创新型企业，加大财税、金融政策支持力度，增强集成电路产业的自主发展能力，加快电子元器件产品升级。2009年第四季度起，全球半导体行业及我国电子元器件行业呈现逐步复苏的状态，行业景气度持续回升。公司在这种宏观经济环境中通过与国内科研院所紧密合作加强研发，明确产品市场定位，加快产品升级，扩大销售等方式，提升了公司竞争实力，从而促进了公司营业收入的提高。

（2） 公司准确的市场定位和品牌效应促进销售收入快速增长

公司在激烈的市场竞争环节中，通过对市场的深入研究，不断开发新兴市场，采取关注高毛利的产品、在细分市场寻求突破的蓝海战略，成功在防护器件、可控硅以及VDMOS几个产品系列上做出了自己的特色。由于公司产品质量过硬，售后服务良好，逐步提升了市场地位，建立了品牌效应，在半导体行业细分市场奠定了重要地位，并依靠老产品带动新产品的销量，打开新产品市场。

公司立足优势产品，不断发掘新的盈利增长点，调整已有产品结构，以抵御产品单一造成的经验风险，保证公司长期稳定的发展。

（3） 报告期内各类产品产能、产量增加支撑营业收入增长

报告期内，公司各大类产品产能及产量的变化情况如下：

单位：万只

产品	2010年1-6月		2009年		2008年		2007年	
	产能	产量	产能	产量	产能	产量	产能	产量
防护器件	6,500.00	6,723.01	12,000.00	12,606.48	8,600.00	8,628.11	6,000.00	5,748.10
VDMOS	5,000.00	3,112.53	10,000.00	5,018.46	8,000.00	1,897.86	-	-
可控硅	4,000.00	3,449.52	8,000.00	5,521.36	8,000.00	6,117.23	8,000.00	7,493.03
1300X	6,000.00	3,687.07	12,000.00	8,925.69	12,000.00	9,150.46	10,000.00	7,815.76

近三年及一期，通过新建、更新设备，优化布图设计，公司主导产品防护器

件产能从2007年6,000.00万只增加到2009年的12,000.00万只，增幅为100%；2010年上半年产能继续提升，半年产能为6,500.00万只。防护器件产能的扩大为其产量增加提供了基础，其产量从2007年5,748.10万只增加至2009年12,606.48万只，增幅为119.32%。产量上升幅度高于产能上升幅度，源于产品市场需求旺盛，产能利用率提高，防护器件产能利用率从2007年95.80%上升到2009年的105.05%。上述因素为报告期内防护器件销量增加提供了支持，防护器件销量从2007年5,636.64万只增加到2009年的11,878.31万只，增幅为110.73%。2010年上半年销量为7,046.85万只，产销率为104.82%。

VDMOS完全依靠公司自主核心技术研发制造，随着生产技术不断成熟和市场不断拓展，于投产第二年，即2009年，产能利用率就达到了50.18%，2010年上半年产能利用率达到62.25%。在公司被确定为合格供应商之前，需通过下游客户的供应商资质认定，需要进行谈判、参数确认、小批量试样、测试等一系列过程，整个认证过程一般需要半年到一年。一旦被确认为合格供货商，即与对方开始紧密合作，不会轻易更换。针对客户需求研发的VDMOS的销量，随着下游客户产品销量的提高而提高。随着公司新客户的不断开发，产能利用率将进一步提高。

报告期，公司可控硅产能维持在8,000.00万只，其产能利用率有所下降，从2007年的93.66%下降到2009年的69.02%，可控硅产量从2007年的7,493.03万只下降到2009年的5,521.36万只。这种变化趋势主要源于可控硅的客户结构调整。2008年开始，公司将市场重点从需求量大但利润率相对较低的摩托车行业，调整为利润率更高的家用电器市场。2010年上半年，在可控硅客户结构继续调整的情况下，产能利用率升至86.24%。

受节能灯市场规模扩大的影响，公司于2008年通过更新设备，优化布图设计，将产能从2007年的10,000.00万只增加到2008年的12,000.00万只，产能利用率基本保持稳定。由于1300X产品价格不断下降，公司在保持目前销售量的情况下，并未进行大规模市场拓展。

（二）公司利润主要来源、可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

1、公司利润的主要来源

近三年及一期，公司营业毛利额呈现增长态势，营业毛利额分别为4,387.03万元、4,529.79万元、5,257.99万元和3,332.45万元，2008年较2007年增长3.25%，2009年较2008年增长16.08%。2008年毛利增长缓慢主要是受半导体市场环境的影响，半导体市场于2009年第四季度回暖，公司盈利能力迅速回升，2010年盈利能力进一步增强。

（1）分产品营业毛利及构成分析

公司近三年及一期产品的毛利及占毛利总额的比例如下：

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
防护器件	1,709.77	51.31	2,940.87	55.93	2,165.33	47.80	1,495.23	34.08
VDMOS	256.23	7.69	25.62	0.49	-322.92	-7.13	-	-
可控硅	1,061.56	31.86	1,700.28	32.34	1,741.30	38.44	2,129.95	48.55
1300X	304.88	9.15	591.22	11.24	946.08	20.89	761.85	17.37
合计	3,332.45	100.00	5,257.99	100.00	4,529.79	100.00	4,387.03	100.00

从上表可知，公司利润主要来源于防护器件和可控硅的生产、销售。这两类产品实现的毛利合计占公司近三年及一期毛利总额分别为82.63%、86.24%、88.27%和83.16%，其中：防护器件毛利分别占毛利总额的34.08%、47.80%、55.93%和51.31%，可控硅毛利分别占毛利总额的48.55%、38.44%、32.34%和31.86%。

防护器件毛利占比逐年提高，2009年和2010年上半年占毛利总额超过50%，主要原因是公司在防护器件领域有极高的市场占有率和强大的品牌效应，随着工业、民用设备日益精细，防护需要不断提高，原有市场空间和新增市场空间不断扩大所致。

VDMOS作为公司近两年开发的新产品，尽管目前毛利占比较低，但该产品技术含量高，拥有广阔的市场前景，随着生产技术不断成熟和市场不断拓展，预计将来VDMOS实现的毛利占公司毛利总额的比例会逐渐上升，成为公司重要的盈利增长点。

可控硅毛利占比逐年降低，主要原因是公司为提高毛利率，从2008年起调整可控硅客户结构，转型成果正在逐步体现。

（2）分地区营业毛利及构成分析

公司近三年及一期分地区营业毛利构成情况如下：

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
浙江	1,191.73	35.76	2,064.69	39.27	1,796.30	39.66	1,919.37	43.75
广东	925.69	27.78	863.52	16.42	772.80	17.06	563.68	12.85
江苏	926.14	27.79	1,605.56	30.54	1,336.13	29.50	1,144.23	26.08
山东	2.57	0.08	192.93	3.67	63.30	1.40	113.60	2.59
安徽	31.09	0.93	42.14	0.80	28.19	0.62	15.57	0.35
江西	58.22	1.75	161.19	3.07	145.18	3.21	207.26	4.72
重庆	6.90	0.21	40.30	0.77	143.87	3.18	246.44	5.62
福建	40.58	1.22	76.51	1.46	51.43	1.14	12.83	0.29
上海	35.36	1.06	49.41	0.94	80.84	1.78	61.02	1.39
湖南	23.14	0.69	73.39	1.40	19.35	0.43	39.53	0.90
其他	70.49	2.12	68.90	1.31	91.65	2.02	63.52	1.45
国外	20.54	0.62	19.44	0.37	0.75	0.02	-	-
合计	3,332.45	100.00	5,257.99	100.00	4,529.79	100.0	4,387.03	100.00

从上表可知，公司利润主要来源于浙江、广东和江苏三省，其毛利合计占公司近三年及一期毛利总额分别为82.68%、86.22%、86.23%和91.33%，表明公司不断巩固在重点区域的优势地位。

2、影响公司盈利连续性和稳定性的主要因素

（1）市场因素

半导体行业的发展情况决定了公司的盈利能力。金融危机以来，虽然国外需求增速减缓，但国内计算机及外设、网络通信、消费电子等领域的市场高速增长在一定程度上对总需求作出了弥补。2009年国务院发布了《电子信息产业调整振兴规划》，其中明确提出扶持中小创新型企业，加大财税、金融政策支持力度，增强集成电路产业的自主发展能力，加快电子元器件产品升级。2009年第四季度起，全球半导体行业及我国电子元器件行业呈现逐步复苏的状态，行业景气度持续回升。公司在立足传统产品的基础上，加快产品升级，已进入了高端芯片制造领域。VDMOS等产品由于资金投入大、技术壁垒越高，进入者相对较少，利润率水平能在较长的一段时期内保持稳定，确保了公司的盈利能力。

（2）新产品开发情况

公司自成立以来一直重视产品的研发，技术开发和持续创新是公司的核心竞争力。公司在占有通信行业防护器件市场后，不断进行技术完善和产品升级，一

是对原有的产品进行技术更新，产品的性能不断完善。二是不断研发出各种新型防护器件产品，其应用领域从单一的程控交换机领域向其他电子电器设备的防护领域发展。在程控交换级二级防护领域，公司开发生产的58S型号产品适用于48伏固定电压的程控交换机，目前公司在此基础上又设计研发了P61089型号产品，其优点在于可编程，对各种电压的系统都可以保护。截止本招股说明书出具日，该产品芯片设计已完成，预计未来能取得较前代产品更为广阔的市场空间。

2005年底，公司从奥地利微系统公司（AMS）引进一条4英寸0.5微米新型功率半导体器件生产线，用于生产VDMOS、IGBT系列产品。目前依托自身强大的科研力量，形成了一套具有完整自主知识产权的VDMOS生产技术，已成功开发出18种型号的系列产品，产品性能达到同行业先进水平。

公司未来将通过不断地开发新产品，提高产品的性能和质量，为公司创造新的盈利增长点。

（3）市场开拓情况

经过多年的发展，公司产品已取得了相当的美誉度，特别在优势产品防护器件上市场份额相当稳定。公司立足优势产品，不断开拓VDMOS、DP、P61089等新产品的市场；对已有产品，公司不断调整客户结构，以期获得更大的收益。公司未来市场的开拓情况将影响到公司的持续发展能力。

（4）固定资产折旧、无形资产摊销

从2008年起，公司固定资产和无形资产大幅增加，相应固定资产折旧和无形资产摊销也大幅增加，具体见下表：

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日
	金额（万元）	金额（万元）	增长比例（%）	金额（万元）	增长比例（%）	金额（万元）
固定资产	20,063.26	19,802.76	8.48	18,254.81	607.71	2,579.41
无形资产	1,896.77	1,917.28	0.88	1,900.60	285.82	492.61
合计	21,960.03	21,720.04	7.76	20,155.41	556.10	3,072.02
	2010年1-6月	2009年度		2008年度		2007年度
固定资产折旧	1,357.68	2,365.50	58.51	1,492.35	219.08	467.71
无形资产摊销	20.52	41.03	17.36	34.96	231.69	10.54
合计	1,378.20	2,406.53	57.57	1,527.31	219.35	478.25

由上表可以看出，固定资产折旧和无形资产摊销逐年大幅增加，对净利润有较大影响。报告期新增非流动资产主要是VDMOS生产线，其中2008年增加16,860.15万元，2009年增加2,240.38万元，2010年1-6月增加280.34万元。

VDMOS自2008年正式投产，2009年毛利率0.62%，2010年上半年毛利率7.62%，随着市场的进一步开拓，该产品实现的利润将超过其生产线的折旧费用，成为公司新的盈利增长点。

（5）原材料价格变动情况

公司产品的主要原材料为单晶硅片、极片、化学试剂、引线框架等。其中单晶硅片为公司最为主要的原材料，近三年及一期受市场需求变动和单晶硅片产量增加等多方面因素影响，单晶硅片价格呈下降态势，特别是2009年降幅达到20%左右，导致了公司原材料成本及生产成本的下降。公司另一主要原材料极片、引线框架均为铜加工产品，2008年第四季度铜价格大幅下跌，一度跌至27,139元/吨，2009年末铜价格基本回升至下跌前的水平。未来单晶硅片和铜价格的变动情况将影响到公司的生产成本及最终的盈利能力。

（6）所得税优惠政策因素

2008年9月24日，公司被认定为高新技术企业，有效期3年。根据相关规定，公司企业所得税自2008年起三年内将减按15%的税率征收。

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）“对生产线宽小于0.8微米（含）集成电路产品的生产企业，经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”、财政部、国家税务总局《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69号）的有关规定，以及根据（2009）宜地税评字第910022号《纳税评估报告》，公司经宜兴市地方税务局第九税务分局认定后享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，即公司2007年度、2008年度为免征期，2009年度、2010年度、2011年度为减半征收期。

根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的相关规定，“企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存

在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受，且一经选择，不得改变。”公司2007年度、2008年度免征企业所得税，2009年度、2010年度、2011年度减半按12.5%计征企业所得税。

根据宜地税政技审（2006）第5号《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，公司自2006年度开始抵免1300系列电子器件生产线技术改造项目购置的国产设备。

根据宜地税政技审（2007）第17号《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，公司自2007年度开始抵免线宽0.8微米集成电路VDMOS生产线技术改造项目购置的国产设备。

公司报告期内享受的税收优惠金额及其占净利润的比例如下表所示：

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
税收优惠合计（万元）	397.66	608.84	974.67
净利润（万元）	2,316.14	1,978.23	2,966.10
税收优惠占当期净利润比例（%）	17.17	30.78	32.86

由上表可知，公司2007年、2008年和2009年享受的税收优惠占当期净利润的比例分别为32.86%、30.78%和17.17%，对公司净利润有一定影响。2012年，公司享受完毕“两免三减半”的企业所得税优惠政策后，如公司被继续认定为高新技术企业，将继续享受税率为15%的企业所得税优惠政策。

（7）获得政府补助情况

截至2010年6月30日，其他非流动负债余额4,012.43万元，均为政府补助。半导体行业为技术密集型和资金密集型行业，是国家鼓励的行业。公司作为高新技术企业，技术处于行业领先水平，承担了一些项目的研究与开发任务。

报告期内公司计入营业外收入的政府补助明细如下：

单位：万元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发资助（DSC3X00）	13.34	319.23	-	-
科技项目奖励经费	0.83	-	-	-
外贸扶持资金	0.50	-	-	-
科技项目奖励经费	-	2.00	-	-
外贸扶持金	-	0.60	-	-

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
财税贡献奖励	-	10.00	-	-
专利申请奖励	-	0.24	-	-
进口设备贴息资金	-	2.00	-	-
2008 年中小企业国际市场开拓资金	-	1.50	-	-
科技项目奖励经费	-	37.00	-	-
进口设备贴息资金	-	-	3.00	-
CSC 过电流过电压保护集成电路的 专项引导资金	-	-	20.00	-
地方规费补助	-	-	28.38	-
专利申请奖励	-	-	0.22	-
项目财政补助	-	-	-	60.00
技改项目奖励资金	-	-	-	17.00
合计	14.67	372.57	51.60	77.00

①2008年依据信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得DSC3X00网络安全保护用集成电路研究与开发项目研发资助600.00万元；2009年项目完工，扣除形成固定资产部分，结转营业外收入319.23万元；2010年1-6月形成固定资产计入递延收益的部分结转营业外收入13.34万元；

②2010年依据宜兴市科学技术局、宜兴市财政局《关于下达2009年度宜兴市科学技术进步奖和2009年度无锡市腾飞奖的通知》（宜科字[2010]18号、宜财企[2010]21号）以及宜兴市科学技术局、宜兴市财政局《关于奖励2009年下半年度专利申请、发明专利授权、无锡市知识产权示范企业的通知》（宜科字[2010]9号、宜财企[2010]18号），取得科技项目奖励经费0.83万元，当期全部结转营业外收入；

③2010年依据宜兴市委、宜兴市人民政府《中共宜兴市委 宜兴市人民政府关于鼓励发展开放性经济工作的意见》，取得外贸扶持资金0.50万元，当期全部结转营业外收入；

④2009年依据宜兴市科学技术局、宜兴市财政局《关于下达宜兴市2008年度江苏省、无锡市科技项目匹配及奖励经费的通知》（宜科计[2008]77号、宜财企[2008]43号），取得科技项目奖励经费2.00万元，当期全部结转营业外收入；

⑤2009年取得宜兴市财政局外贸扶持金0.60万元，当期全部结转营业外收入；

⑥2009年依据宜兴市经济贸易局、宜兴市财政局《关于下达宜兴市2008年<

关于促进宜兴经济又好又快发展的若干政策意见>奖励资金的通知》（宜经贸运行（2009）25号、宜财企（2009）7号），取得财税贡献奖励10.00万元，当期全部结转营业外收入；

⑦2009年取得宜兴市科学技术局专利申请奖励0.24万元，当期全部结转营业外收入；

⑧2009年依据宜兴市财政局《江苏省财政厅关于追加拨付2007年度进口设备贴息资金的通知》（苏财企[2009]23号），取得进口设备贴息资金2.00万元，当期全部结转营业外收入；

⑨2009年依据江苏省财政厅《江苏省财政厅关于拨付2008年度中小企业国际市场开拓资金的通知》（苏财企[2009]112号），取得2008年中小企业国际市场开拓资金1.50万元，当期全部结转营业外收入；

⑩2009年依据宜兴市科学技术局、宜兴市财政局《关于下达宜兴市2009年度国家、江苏省、无锡市科技项目匹配及奖励经费的通知》（宜科计[2009]77号、宜财企[2009]61号），取得科技项目奖励经费37.00万元，当期全部结转营业外收入；

⑪2008年依据江苏省财政厅《江苏省财政厅关于拨付2007年度进口设备贴息资金的通知、关于下拨部分省级外贸扶持资金的通知》（苏财企[2008]207号），取得进口设备贴息资金3.00万元，当期全部结转营业外收入；

⑫2008年依据江苏省财政厅、江苏省中小企业局《江苏省财政厅 江苏省中小企业局关于下达2008年度省级中小科技型企业发展专项引导资金（第一批中小）的通知》（苏财企[2008]231号、苏中小综[2008]86号），取得CSC过电流过电压保护集成电路的专项引导资金20.00万元，当期全部结转营业外收入；

⑬2008年取得宜兴环保科技工业园管理委员会财政审计局地方规费补助28.38万元，当期全部结转营业外收入；

⑭2008年取得宜兴市科学技术局专利申请奖励0.22万元，当期全部结转营业外收入；

⑬2007年依据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅《关于下达2006年江苏省技术改造项目专项资金计划的通知》（苏经贸投资[2006]936号、苏财企[2006]117号），取得项目财政补助60.00万元，当期全部结转营业外收入；

⑭2007年依据宜兴市经济贸易局、宜兴市对外贸易经济合作局、宜兴市财政局《关于下达宜兴市2006年工业重大项目及内资企业技改项目奖励资金的通知》（宜经贸投资（2007）25号、宜外经贸（2007）17号、宜财企（2007）5号），取得技改项目奖励资金17.00万元，当期全部结转营业外收入。

公司报告期内计入营业外收入的政府补助及其剔除所得税影响后占净利润的比例如下表所示：

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
计入营业外收入的政府补助(万元)	14.67	372.57	51.60	77.00
净利润（万元）	1,497.16	2,316.14	1,978.23	2,966.10
计入营业外收入的政府补助剔除所得税影响后占当期净利润比例（%）	0.86	14.08	2.61	2.60

由上表可知，公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月计入营业外收入的政府补助剔除所得税影响后占当期净利润的比例分别为2.60%、2.61%、14.08%和0.86%，对公司净利润影响较小。

3、公司盈利能力与同行业可比上市公司的比较

单位：万元

项目	公司	2009 年	2008 年度	2007 年度
总资产	华微电子	276,551.48	271,070.26	259,644.12
	士兰微	179,945.01	176,300.12	213,502.23
	苏州固锴	70,676.60	57,581.02	61,104.62
	平均	175,724.37	168,317.13	178,083.66
	江苏东光	48,184.76	44,799.04	32,990.10
收入	华微电子	108,046.64	108,739.93	115,109.08
	士兰微	95,986.54	93,309.58	97,181.88
	苏州固锴	55,506.31	52,426.54	47,409.77
	平均	86,513.16	84,825.35	86,566.91
	江苏东光	16,211.22	14,506.87	11,048.41
归属于母公司所有者的净利润	华微电子	2,603.70	5,585.03	15,818.26
	士兰微	7,662.51	1,355.94	2,158.20
	苏州固锴	3,746.81	1,679.48	2,677.39
	平均	4,671.00	2,873.49	6,884.62
	江苏东光	2,316.14	1,978.23	2,966.10

总资产收益率 (%)	华微电子	0.95	2.10	7.02
	士兰微	4.30	0.70	1.16
	苏州固锴	5.84	2.83	4.69
	平均	3.70	1.88	4.29
	江苏东光	4.98	5.09	10.70

现有上市公司中，没有与公司主营业务一致的公司，公司选取的三家可比上市公司虽然和公司同属半导体电子器件制造企业，但是业务均不尽相同。

华微电子现有业务主要集中于传统双极型分立器件领域；士兰微主要产品为电源和功率驱动、混合信号与射频、数字音视频、MCU、安防监控、分立器件和LED器件；苏州固锴主营业务为各种二极管、桥堆产品和QFN/DFN封装集成电路，东光微电子则主要从事防护器件、VDMOS、可控硅和1300X四大类产品的生产和销售。

2007-2009年度同行业上市公司毛利率比较：

公司	2009 年度	2008 年度	2007 年度
华微电子	20.34%	28.43%	30.27%
士兰微	28.13%	24.02%	20.33%
苏州固锴	17.01%	12.09%	14.34%
平均	21.83%	21.51%	21.66%
江苏东光	32.43%	31.23%	39.71%
其中：防护器件	55.10%	51.96%	54.80%
VDMOS	0.62%	-16.57%	-
可控硅	42.99%	37.77%	39.68%
1300X	21.44%	25.03%	25.81%

从上表可以看出，由于同行业上市公司从事业务不尽相同，毛利率差距均较大，毛利率绝对值可比性不大。2008年度受宏观经济影响，公司和同行业上市公司毛利率呈现下滑的趋势，2009年度均有所恢复，报告期内公司和同行业上市公司毛利率变化趋势基本一致。

公司防护器件产品凭借着较强的市场竞争能力，毛利率水平高于同行业水平；可控硅产品因为公司及时调整了产品策略，逐步向高端产品转型，毛利率也保持着较高的水平；1300X产品由于市场竞争较为充分，毛利率水平较低，和同行业上市公司毛利率差距不大；VDMOS生产线由于投产不久，目前毛利率较低。

与同行业上市公司相比，公司规模相对较小，总资产和业务收入较小，但是凭借着防护器件的较好的盈利能力以及可控硅业务向盈利能力较高的家用电器

转型，公司净利润水平和同行业相差相对较小，总资产收益率指标各年度均高于同行业上市公司平均水平。

2008年和2009年公司总资产收益率比2007年有所下降，主要原因是随着营业收入的增长及业务规模的扩大，公司增加了固定资产和无形资产的投入，使得2008年末和2009年末公司总资产比2007年末大幅增长所致，预计随着VDMOS业务的进一步拓展，公司净利润和总资产收益率会得到较大的提升。

（三）经营成果的变化及原因分析

1、营业收入分析

近三年及一期公司营业收入情况请详见本节“（一）主营业务收入构成及比例分析”的相关内容。

2、营业成本分析

报告期内营业成本处于上升趋势，公司营业成本 2008 年度较 2007 年度增长 3,315.69 万元，增幅 49.77%；2009 年度较 2008 年度增长 976.15 万元，增幅 9.78%。

报告期内公司营业成本增长的主要原因是公司营业收入不断增加，导致营业成本出现相应增长。报告期内营业收入、营业成本及其变动如下表所示：

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度		2008 年度		2007 年度
	金额（万元）	金额（万元）	同比增长（%）	金额（万元）	同比增长（%）	金额（万元）
营业收入	10,268.37	16,211.22	11.75	14,506.87	31.30	11,048.41
营业成本	6,935.93	10,953.23	9.78	9,977.08	49.77	6,661.38

原材料采购价格的波动也是影响公司营业成本变化的重要因素。报告期公司主要原材料采购价格如下表所示：

原材料类别	计量单位	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度
		平均单价（元）	同比变动（%）	平均单价（元）	同比变动（%）	平均单价（元）	同比变动（%）	平均单价（元）
单晶片 3'	片	19.80	-14.69	23.21	-28.38	32.41	1.06	32.07
单晶片 4'	片	34.26	-16.93	41.24	-30.60	59.42	1.94	58.29
4'抛光片	片	N/A	N/A	100.25	-4.82	105.33	N/A	N/A
外延片	片	135.70	-3.98	141.33	-15.92	168.09	-4.53	176.07
化学试剂	升	8.37	0.00	8.37	-9.32	9.23	-1.8	9.40
配套试剂	升	36.16	0.00	36.16	-12.47	41.31	-12.09	46.99
化学试剂	升	22.40	0.00	22.40	-1.75	22.80	N/A	N/A

引线框架	只	0.13	8.33	0.12	-14.29	0.14	-6.67	0.15
极片	只	0.026	-7.14	0.028	-9.68	0.031	-6.06	0.033
电力	度	0.68	6.25	0.64	3.23	0.62	-3.13	0.64
氮气	吨	693.03	-1.12	700.85	0.99	693.99	1.50	683.76
氧气	吨	715.78	-0.30	717.95	0.003	717.93	0.006	717.89

可以看出，2009 年原材料价格大幅下降，导致公司营业成本增幅低于营业收入增幅，2010 年上半年主要原材料价格继续下降。如果单晶硅片或其他原材料价格未来波动幅度增大，将对公司经营造成一定的影响。

3、期间费用分析

报告期内，公司期间费用情况如下表所示：

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度		2008 年度		2007 年度
	金额（万元）	金额（万元）	变动比例	金额（万元）	变动比例	金额（万元）
销售费用	178.86	350.41	18.46%	295.81	-3.08%	305.21
其中大额明细：						
业务招待费	67.01	122.14	6.78%	114.39	-4.11%	119.29
运输费	69.93	139.61	9.18%	127.87	37.63%	92.91
管理费用	908.25	1,718.73	20.09%	1,431.24	55.45%	920.68
其中大额明细：						
新品开发	427.88	844.01	52.55%	553.27	128.80%	241.81
工资	98.88	165.45	-5.10%	174.34	23.37%	141.31
劳动保险费	93.87	190.71	19.48%	159.62	80.77%	88.30
折旧费	52.87	97.02	-5.96%	103.17	5.46%	97.83
业务招待费	14.17	46.09	-11.91%	52.32	28.24%	40.80
财务费用	367.09	852.57	24.96%	682.25	305.55%	168.23
其中大额明细：						
利息支出	397.48	1,062.35	24.35%	854.31	149.40%	342.55
减：利息收入	34.58	218.62	7.42%	203.52	15.91%	175.59

（1）销售费用

报告期内公司销售费用明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
销售费用	178.86	350.41	295.81	305.21
其中大额明细：				
业务招待费	67.01	122.14	114.39	119.29
运输费	69.93	139.61	127.87	92.91

近三年及一期，公司销售费用占营业收入的比例分别为 2.76%、2.04%、2.16%

和 1.74%，变动幅度较小，比例处于合理水平。

2008 年公司销售费用比 2007 年降低 3.08%，主要原因是市场需求低迷，公司为控制成本，缩减了销售人员差旅费和其他费用等支出，将销售的重点放在当年推出的 VDMOS 上。

2009 年公司销售费用比 2008 年增长 18.46%，主要原因是：①随着市场回暖及产品销量的提升，运输费用有所增加，同时公司增加了销售人员的差旅费、销售办事处的办公支出和展览费等销售费用的支出；③公司为了推广 VDMOS 和 DP，增强了市场推广力度，导致销售费用增加。

2010 年上半年，公司销售费用占营业收入的比例比往年有所降低。

（2）管理费用

报告期内公司管理费用明细情况如下表：

单位：万元

项目	2010 年 1-6 月	2009年度	2008年度	2007年度
管理费用	908.25	1,718.73	1,431.24	920.68
其中大额明细：				
新品开发	427.88	844.01	553.27	241.81
工资	98.88	165.45	174.34	141.31
劳动保险费	93.87	190.71	159.62	88.30
折旧费	52.87	97.02	103.17	97.83
业务招待费	14.17	46.09	52.32	40.80

近三年及一期，随着营业收入的增加，公司管理费用呈逐步上升趋势，公司管理费用占营业收入的比例分别为 8.33%、9.87%、10.60%和 8.85%，呈逐年上升趋势，主要原因是公司加大了对新产品的开发力度，研发费用增长较快。扣除新品开发费用后，近三年及一期管理费用占营业收入的比例分别为 6.14%、6.05%、5.40%和 4.68%，呈逐年下降趋势，表明公司管理水平不断提高，公司规模效应逐步显现。

2008 年和 2009 年，公司管理费用中新品开发费用较上年分别增加 128.80%和 52.55%，主要原因是以 VDMOS 为主的新产品开发规模持续扩大，主要内容包括 VDMOS 生产线样品试制和工艺改进。2008 年管理人员工资较上年增加 23.37%，主要是由于 VDMOS 生产线投产，所需管理人员增加，2009 年管理人

员工工资较 2008 年变化较小。由于社会保险费的缴纳基数和缴纳比例调整和员工数量变化，导致劳动保险费逐年增大。2010 年上半年新品开发费用基本稳定。

（3）财务费用

报告期内公司财务费用如下表所示：

单位：万元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
财务费用	367.09	852.57	682.25	168.23
其中大额明细：				
利息支出	397.48	1,062.35	854.31	342.55
减：利息收入	34.58	218.62	203.52	175.59

近三年及一期，公司财务费用分别为 168.23 万元、682.25 万元、852.57 万元和 367.09 万元，财务费用分别占营业收入的比例分别为 1.52%、4.70%、5.26% 和 3.57%。公司财务费用逐年增加主要是随着公司经营规模的扩大，公司增加了银行借款，导致利息支出逐年增加。

4、期间费用率同行业比较

公司和同行业上市公司期间费用率比较情况如下表所示：

项目	公司	2009 年	2008 年度	2007 年度
销售费用率	华微电子	3.69%	2.89%	1.72%
	士兰微	2.45%	2.81%	2.15%
	苏州固锟	1.37%	1.56%	1.39%
	平均	2.50%	2.42%	1.75%
	江苏东光	2.16%	2.04%	2.76%
管理费用率	华微电子	10.98%	10.71%	8.59%
	士兰微	15.64%	17.66%	17.85%
	苏州固锟	7.65%	6.66%	7.68%
	平均	11.42%	11.67%	11.37%
	江苏东光	10.60%	9.87%	8.33%
财务费用率	华微电子	3.78%	4.81%	4.18%
	士兰微	4.17%	5.83%	4.01%
	苏州固锟	0.64%	-1.44%	0.03%
	平均	2.86%	3.07%	2.74%
	江苏东光	5.26%	4.70%	1.52%
期间费用率	华微电子	18.45%	18.41%	14.49%
	士兰微	22.25%	26.30%	24.01%
	苏州固锟	9.65%	6.78%	9.09%
	平均	16.79%	17.17%	15.87%

项目	公司	2009 年	2008 年度	2007 年度
	江苏东光	18.02%	16.61%	12.62%

总体来看，2007 年，公司期间费用率低于同行业上市公司平均水平；2008 年，由于财务费用增加，公司期间费用率趋近于同行业上市公司平均水平；2009 年，财务费用进一步增加，公司期间费用率超过了同行业上市公司平均水平。

近三年，公司销售费用率和管理费用率均低于同行业上市公司平均水平，说明公司管理严格，成本控制高效。

报告期内固定资产投资较大，目前公司只能通过银行融资的方式满足资金需求，导致财务费用逐年增加，若能采用直接融资方式进行融资，可降低财务费用，进一步增加公司盈利能力。

（四）毛利率的变动趋势及原因分析

1、公司报告期内毛利率情况

公司近三年及一期分产品销售毛利率和综合毛利率情况如下表所示：

项 目	2010 年 1-6 月		2009 年度	
	毛利率（%）	对综合毛利率的贡献（%）	毛利率（%）	对综合毛利率的贡献（%）
防护器件	55.33	16.65	55.10	18.14
VDMOS	7.62	2.50	0.62	0.16
可控硅	43.04	10.34	42.99	10.49
1300X	22.57	2.97	21.44	3.65
综合毛利率	32.45	32.45	32.43	32.43

项 目	2008 年度		2007 年度	
	毛利率（%）	对综合毛利率的贡献（%）	毛利率（%）	对综合毛利率的贡献（%）
防护器件	51.96	14.93	54.80	13.53
VDMOS	-16.57	-2.23	-	-
可控硅	37.77	12.00	39.68	19.28
1300X	25.03	6.52	25.81	6.90
综合毛利率	31.23	31.23	39.71	39.71

注：对综合毛利率的贡献=毛利率×该产品销售收入占主营业务收入的比例

2008 年公司综合毛利率较 2007 年下降 8.48%，2009 年公司综合毛利率较 2008 年上升 1.20%，2010 年上半年公司综合毛利率较 2009 年上升 0.02%。公司毛利主要来源于防护器件和可控硅，这两类产品实现的毛利合计占公司近三年及一期

毛利总额的 82.63%、86.24%、88.27%和 83.16%。

毛利率变动的主要原因是：2008 年受金融危机的影响，防护器件、可控硅和 1300X 的毛利率均出现下降，而当年投产的 VDMOS 进一步拉低了综合毛利率。2009 年，随着市场好转和原材料价格的下跌，防护器件和可控硅的毛利率均出现回升，可控硅受益于调整客户结构，毛利率回升更为明显，1300X 受下游节能灯价格下跌，毛利率进一步走低，当年 VDMOS 扭亏为盈。2010 年 VDMOS 毛利率进一步上升。公司技术水平不断提高，生产工艺不断完善，使合格率提高，对毛利率亦有贡献。

2、防护器件毛利率分析

（1）防护器件毛利率

报告期内，防护器件毛利率分别为 54.80%、51.96%、55.10%和 55.33%，2008 年毛利率比 2007 年下降了 2.84%，2009 年毛利率较 2008 年上升了 3.14%，2010 年上半年毛利率较 2009 年上升了 0.23%，毛利率的变化主要与销售价格和单位成本的变化相关。报告期防护器件的单价、单位成本及成本性态构成如下：

2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度	
平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)
0.44	0.20	0.45	0.20	0.47	0.23	0.48	0.22

项目	2010 年 1-6 月		2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)
原料及主要材料	0.109	55.61	0.119	58.91	0.145	63.71	0.139	63.47
燃料及动力	0.014	7.14	0.010	4.95	0.010	4.27	0.010	4.56
工资	0.027	13.78	0.026	12.87	0.025	11.16	0.025	11.42
制造费用	0.046	23.47	0.047	23.27	0.048	20.86	0.045	20.55
合计	0.196	100.00	0.202	100.00	0.228	100.00	0.219	100.00
其中：变动成本	0.190	96.94	0.199	98.51	0.225	98.68	0.215	98.17
其中：固定成本	0.006	3.06	0.003	1.49	0.003	1.32	0.004	1.83

2008 年平均单价较 2007 年下降 2.08%，单位成本上升 4.55%，导致毛利率较 2007 年下降 2.84%。单价变动主要是产品结构变化所致，单位成本上升主要是单晶硅片价格上涨所致。

2009年平均单价较2008年下降4.26%，单位成本下降13.04%，导致毛利率较2008年上升3.14%。单位成本大幅下降主要原因是单晶硅片价格大幅下降所致，同时化学试剂、铜等原材料也有不同程度的下跌。公司根据单位成本的变化情况适度降低产品售价，下降幅度小于单位成本下降幅度。

2010年上半年平均单价较2009年下降2.22%，单位成本下降2.97%，导致毛利率较2009年上升0.23%。单位成本下降主要原因是主要原材料价格下降所致。

（2）防护器件毛利率的敏感性分析

2010年影响防护器件毛利率的因素众多，现以产品销售价格和原材料价格两个主要影响因素的变动对2010年毛利率的变动作敏感性分析如下：

假定原材料价格、销量、人工成本及折旧不变，则公司产品售价变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

产品售价变动幅度	产品毛利率变动幅度
10%	7.34%
-10%	-8.97%

假定产品售价、销量、人工成本及折旧不变，则公司原材料价格变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

单晶硅片价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	23%	-1.86%
-10%		1.86%
极片价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	22%	-1.78%
-10%		1.78%

注：所列原材料为占该类产品比例最高的两类原材料。

由上表可见，防护器件销售价格对毛利率的敏感系数大于原材料价格对毛利率的敏感系数，表明防护器件销售价格的变动引起的毛利率变动大于原材料价格变动引起的毛利率变动。公司防护器件在通讯应用领域拥有极高的市场占有率，因此公司防护器件毛利率能够得到保证。

3、VDMOS毛利率分析

（1）VDMOS毛利率

VDMOS于2008年投入生产，2008年、2009年和2010年1-6月VDMOS毛利率

分别为-16.57%、0.62%和7.62%，2009年毛利率较2008年上升了17.19%，2010年上半年毛利率较2009年上升了7.00%，毛利率的变化主要与销售价格和单位成本的变化相关。报告期VDMOS的单价、单位成本及成本性态构成如下：

2010年1-6月		2009年度		2008年度	
平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)
1.01	0.93	0.96	0.95	1.04	1.22

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度	
	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)
原料及主要材料	0.199	21.31	0.180	18.93	0.223	18.34
燃料及动力	0.098	10.49	0.101	10.62	0.138	11.35
工资	0.050	5.35	0.052	5.47	0.073	6.00
制造费用	0.587	62.85	0.618	64.98	0.782	64.31
合计	0.934	100.00	0.951	100.00	1.216	100.00
其中：变动成本	0.586	62.74	0.504	53.00	0.692	56.91
其中：固定成本	0.348	37.26	0.447	47.00	0.524	43.09

2009年平均单价较2008年下降7.69%，单位成本下降22.13%，导致毛利率较2008年上升17.19%。单位成本大幅下降主要原因是：①原材料市场价格下降；②随着生产规模的扩大，原材料采购优势逐渐体现；③经过一年的摸索，VDMOS生产工艺不断完善，产品布图设计日益合理，产品合格率不断提高；④2009年VDMOS产量比上年大幅提高，单个产品分担的生产线折旧成本有所降低。公司根据单位成本的变动趋势，适度下调了产品价格。

2010年上半年VDMOS平均单价较2009年上升5.21%，单位成本下降1.79%，使毛利率较2009年上升了7%。平均单价上升的原因系公司VDMOS产品规格型号结构发生变化所致，2010年上半年生产的大规格产品较多，使平均单价上升；大规格产品较多使单个产品耗用的原材料增加，单位成本中原料及主要材料成本上升，同时2010年上半年VDMOS产销量较2009年同期有较大幅度的增长，使单个产品分摊的制造费用—折旧成本有所降低，在上述两个主要因素共同影响下使2010年上半年VDMOS单位成本较2009年略有下降。

（2）VDMOS毛利率的敏感性分析

2010年影响VDMOS毛利率的因素众多，现以产品销售价格和原材料价格两

个主要影响因素的变动对2010年毛利率的变动作敏感性分析如下：

假定原材料价格、销量、人工成本及折旧不变，则公司产品售价变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

产品售价变动幅度	产品毛利率变动幅度
10%	110.15%
-10%	-134.62%

假定产品售价、销量、人工成本及折旧不变，则公司原材料价格变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

封装加工费价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	23%	-27.87%
-10%		27.87%
外延片价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	17%	-20.60%
-10%		20.60%

注：所列原材料为占该类产品比例最高的两类原材料。

VDMOS销售价格对毛利率的敏感系数大于原材料价格对毛利率的敏感系数，表明VDMOS销售价格的变动引起的毛利率变动大于原材料价格变动引起的毛利率变动。VDMOS的毛利率较敏感，是由于2010年上半年VDMOS盈利较少导致的。随着VDMOS盈利能力的增强，对产品售价和原材料价格变动的敏感性将大幅降低。

4、可控硅毛利率分析

（1）可控硅毛利率

报告期内，可控硅毛利率分别为39.68%、37.77%、42.99%和43.04%，2008年毛利率比2007年下降了1.91%，2009年毛利率较2008年上升了5.22%，2010年上半年毛利率较2009年上升了0.05%，毛利率的变化主要与销售价格和单位成本的变化相关。报告期可控硅的单价、单位成本及成本性态构成如下：

2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)
0.72	0.41	0.71	0.40	0.68	0.43	0.66	0.40

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	单位成本(元)	比例(%)	单位成本(元)	比例(%)	单位成本(元)	比例(%)	单位成本(元)	比例(%)

原料及主要材料	0.095	23.00	0.108	26.80	0.144	34.07	0.141	34.87
燃料及动力	0.019	4.60	0.022	5.46	0.021	4.83	0.016	4.06
工资	0.026	6.30	0.028	6.95	0.029	6.70	0.027	6.83
制造费用	0.273	66.10	0.245	60.79	0.232	54.40	0.217	54.24
合计	0.413	100.00	0.403	100.00	0.426	100.00	0.401	100.00
其中：变动成本	0.395	95.64	0.381	94.54	0.404	94.84	0.383	95.51
其中：固定成本	0.018	4.36	0.022	5.46	0.022	5.16	0.018	4.49

2008年平均单价较2007年上升3.03%，单位成本上升7.50%，导致毛利率较2007年下降1.91%。平均单价由0.66元/只上涨到0.68元/只，主要原因是公司调整销售对象，增加了单价较高的家用电器可控硅的销售，相应降低了单价较低的摩托车可控硅的销售；单位成本上升的原因除单晶硅片价格上涨外，家用电器可控硅的规格更大，成本更高也是影响因素之一。

2009年平均单价较2008年上升4.41%，单位成本下降6.98%，导致毛利率较2008年上升5.22%。平均单价上涨的原因是进一步扩大了对下游家用电器厂商的销售，单位成本下降主要原因是与防护器件相同。

2010年上半年平均单价、单位成本和毛利率变化较小。

（2）可控硅毛利率的敏感性分析

2010年影响可控硅毛利率的因素众多，现以产品销售价格和原材料价格两个主要影响因素的变动对2010年毛利率的变动作敏感性分析如下：

假定原材料价格、销量、人工成本及折旧不变，则公司产品售价变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

产品售价变动幅度	产品毛利率变动幅度
10%	12.03%
-10%	-14.70%

假定产品售价、销量、人工成本及折旧不变，则公司原材料价格变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

封装加工费价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	57%	-7.54%
-10%		7.54%
单晶硅片价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	17%	-2.25%
-10%		2.25%

注：所列原材料为占该类产品比例最高的两类原材料。

由上表可见，可控硅销售价格对毛利率的敏感系数大于原材料价格对毛利率的敏感系数，表明可控硅销售价格的变动引起的毛利率变动大于原材料价格变动引起的毛利率变动。因此公司及时调整可控硅产品结构，将重点放在高毛利率的家用电器用可控硅上，确保了可控硅产品的盈利能力。

5、1300X毛利率分析

（1）1300X毛利率

报告期内，1300X毛利率分别为25.81%、25.03%、21.44%和22.57%，2008年毛利率比2007年下降了0.78%，2009年毛利率较2008年下降了3.59%，2010年上半年毛利率较2009年上升了1.13%，毛利率的变化主要与销售价格和单位成本的变化相关。报告期1300X的单价、单位成本及成本性态构成如下：

2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)	平均单价 (元/只)	单位成本 (元/只)
0.34	0.27	0.32	0.25	0.37	0.28	0.41	0.30

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)	单位成本 (元)	比例 (%)
原料及主要材料	0.044	16.54	0.044	17.78	0.067	23.79	0.074	24.17
燃料及动力	0.014	5.26	0.011	4.59	0.011	4.13	0.009	3.07
工资	0.015	5.64	0.013	5.00	0.016	5.63	0.016	5.38
制造费用	0.193	72.56	0.182	72.63	0.184	66.45	0.205	67.38
合计	0.266	100.00	0.250	100.00	0.278	100.00	0.304	100.00
其中：变动成本	0.242	90.98	0.230	92.00	0.262	94.24	0.285	93.75
其中：固定成本	0.024	9.02	0.020	8.00	0.016	5.76	0.019	6.25

（2）1300X毛利率的敏感性分析

2010年影响1300X毛利率的因素众多，现以产品销售价格和原材料价格两个主要影响因素的变动对2010年毛利率的变动作敏感性分析如下：

假定原材料价格、销量、人工成本及折旧不变，则公司产品售价变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

产品售价变动幅度	产品毛利率变动幅度
10%	31.19%
-10%	-38.12%

假定产品售价、销量、人工成本及折旧不变，则公司原材料价格变动对产品毛利率的敏感性影响如下表所示：

封装加工费价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	61%	-20.93%
-10%		20.93%
单晶硅片价格变动幅度	占营业成本的比例	产品毛利率变动幅度
10%	9%	-3.09%
-10%		3.09%

注：所列原材料为占该类产品比例最高的两类原材料。

由上表可见，1300X销售价格对毛利率的敏感系数大于原材料价格对毛利率的敏感系数，表明1300X销售价格的变动引起的毛利率变动大于原材料价格变动引起的毛利率变动。

6、公司和同行业上市公司毛利率比较

公司和同行业上市公司毛利率比较情况如下：

公司	2009 年度	2008 年度	2007 年度
华微电子	20.34%	28.43%	30.27%
士兰微	28.13%	24.02%	20.33%
苏州固锴	17.01%	12.09%	14.34%
平均	21.83%	21.51%	21.66%
江苏东光	32.43%	31.23%	39.71%
其中：防护器件	55.10%	51.96%	54.80%
VDMOS	0.62%	-16.57%	-
可控硅	42.99%	37.77%	39.68%
1300X	21.44%	25.03%	25.81%

注：同行业上市公司数据来源于巨潮资讯。

通过以上比较可以看出，公司每年毛利率均大幅高于同行业上市公司，其中2007年毛利率高于同行业上市公司平均值18.05%，2008年毛利率高于同行业上市公司平均值9.72%，2009年毛利率高于同行业上市公司平均值10.60%。具体原因：虽然公司与华微电子、士兰微、苏州固锴同为以半导体芯片生产为主的制造企业，但在产品品种销售收入结构和应用领域上存在着较大差异，使公司毛利率高于同行业上市公司。

公司利润主要来源于防护器件和可控硅的生产、销售，这两类产品实现的毛利合计占公司近三年毛利总额分别为82.63%、86.24%和88.27%。近三年，公司防护器件产品主要应用于通讯领域，主要终端客户为电信运营商等大型通信企业，公司在通讯领域防护器件市场占有绝对的优势地位，公司生产的SA系列半

导体固体放电管在国内程控交换机一级保护（即总配线架保安单元）方面，市场占有率常年居于第一位，并呈逐年上升趋势，竞争优势非常显著，使公司防护器件产品获得了较高的毛利率。公司可控硅产品主要应用于毛利率较高的家用电器、小家电应用领域，使公司获得了较高的毛利率。2007年起公司新开发出了吸尘器用可控硅产品，相比较而言吸尘器用可控硅毛利率明显高于摩托车用产品，因此自2008年起公司对可控硅的产品结构做了调整，逐步退出毛利率较低的摩托车市场，开始转向毛利率较高的家用电器、小家电应用领域可控硅产品市场。

华微电子现有业务主要集中于传统双极型分立器件领域；士兰微主要产品为电源和功率驱动、混合信号与射频、数字音视频、MCU、安防监控、分立器件和LED器件；苏州固锴主营业务为各种二极管、桥堆产品和QFN/DFN封装集成电路。

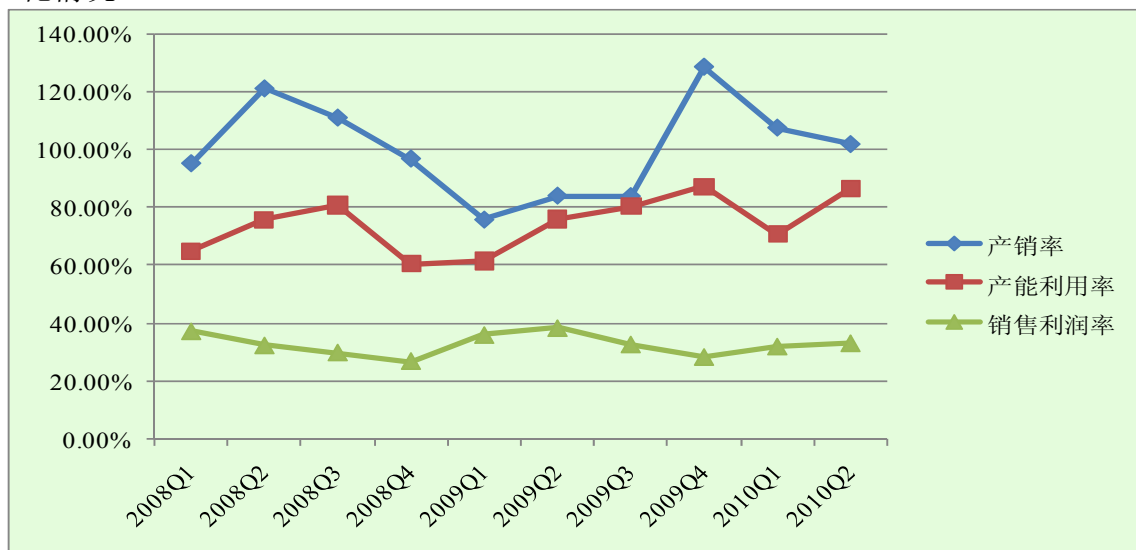
由于公司善于发现和把握市场机会，选择盈利能力强的产品，以高质量和低成本占领市场，使公司能够得以发展壮大，同时不断继续寻找新的市场机遇，并依靠自身积累，对新领域进行开发，从而使公司产品结构进一步丰富，以更好的抵御市场风险，以实现长期、稳定、快速的发展。

（五）发行人主要经营指标受金融危机影响的情况

2008年起，金融危机席卷全球，受此影响，公司主要经营指标亦出现波动。

1、产销率、产能利用率和毛利率

下图为2008年-2010年上半年各季度公司产销率、产能利用率和毛利率的变化情况：

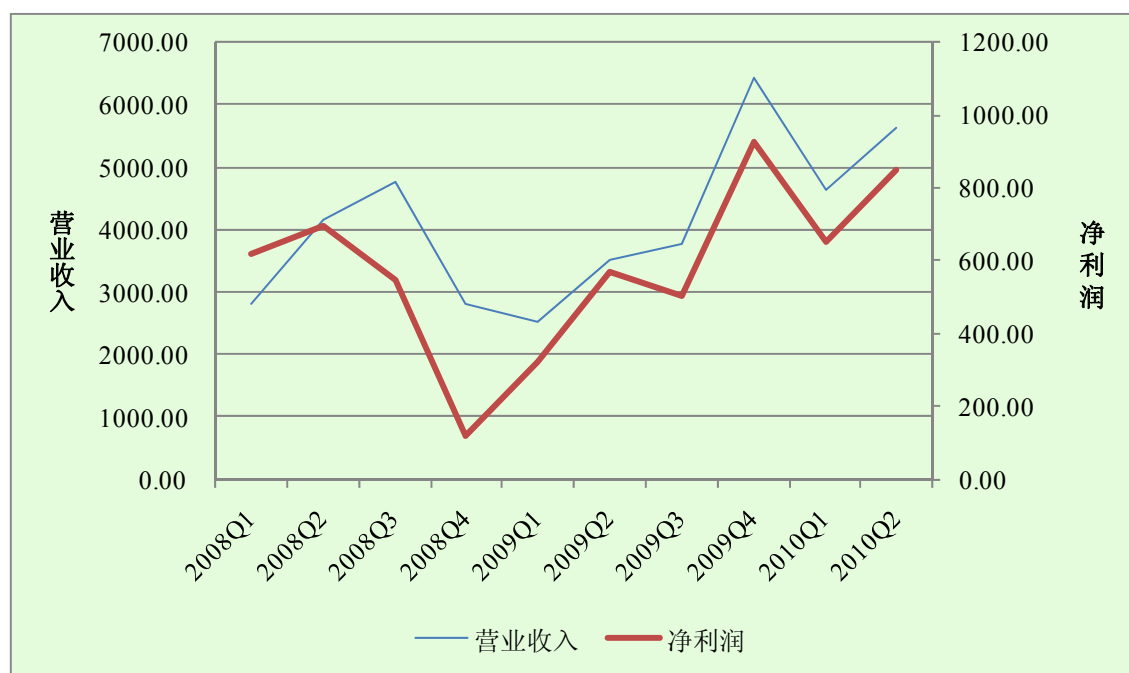


2008年上半年公司产销率不断提高，为满足客户需求，产能利用率也相应提高。2008年3季度，受金融危机影响，产销率出现下降趋势，公司相应调整生产节奏，除防护器件外的其它三类产品产能利用率均有所下降。由于防护器件的市场需求旺盛，其产能利用率始终保持在100%左右。2009年前3个季度市场需求达到谷底，4季度开始大幅回升。公司产能利用率绝对值较低主要是受2008年新投产的VDMOS影响，随着VDMOS生产线的产能利用率从2008年的23.72%提高至2010年上半年的62.25%，综合产能利用率亦逐渐恢复到正常水平。

从季度数据看，公司毛利率出现小幅波动。防护器件的毛利率各季度均保持在50%以上；由于可控硅目标市场调整，可控硅毛利率呈稳步上升的态势；1300X毛利率受金融危机影响略有下降；VDMOS刚刚投放市场即遭遇金融危机，毛利率受到较大影响，受上述四类产品共同影响，公司2008年毛利率略有下降。尽管2009年末VDMOS实现盈利，2009年其他三类产品毛利率均保持稳定或略有上升，但VDMOS的收入占当年销售收入的比重从2008年的13.43%上升到2009年的25.67%，其对毛利率的影响增大，导致2009年的综合毛利率呈下降趋势。随着VDMOS实现预期效益，公司毛利率将逐步回升。

2、营业收入和净利润

下图为2008年-2010年上半年各季度公司营业收入和净利润的变化情况：



2008年上半年市场需求旺盛，公司营业收入提高，利润水平也较高。2008年3季度，受金融危机影响，产品销售出现下降趋势，由于固定资产规模扩大，折旧成本增加，导致利润下滑幅度超过营业收入。

由于防护器件销售规模扩大、VDMOS市场成功拓展和可控硅目标市场调整效果显现，从2009年初开始，各季度营业收入和利润节节攀升。2009年第四季度公司营业收入和利润均已超过金融危机前的水平。

2010年上半年，受经营周期性影响，营业收入和净利润虽然出现小幅回落，但仍维持较高水平。

（六）公司2008年净利润下滑的原因

公司2008年净利润1,978.23万元，较2007年2,966.10万元，下降33.31%。公司净利润下降的主要原因为：

1、产品毛利下降

2007、2008年公司产品的毛利情况如下：

项目	2008 年度		2007 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
防护器件	2,165.33	47.80	1,495.23	34.08
VDMOS	-322.92	-7.13	-	-
可控硅	1,741.30	38.44	2,129.95	48.55
1300X	946.08	20.89	761.85	17.37
合计	4,529.79	100.00	4,387.03	100.00

其中：

VDMOS于2008年部分投产，市场开拓刚刚起步，产品生产线折旧较大，销售收入低于销售成本，当年实现毛利为-322.92万元。

2008年，公司主动调整可控硅市场，进一步拓展利润率更高的家用电器用可控硅市场，减少毛利率较低的摩托车用可控硅。由于新客户开拓需要较长的认证时间，导致可控硅收入下降，因此2008年可控硅毛利较上年下降388.65万元。

2、期间费用增加

2008年管理费用较上年增加510.56万元，增加的主要原因是随着VDMOS生

产线的投产，新品开发费和管理人员工资较上年有所增加。

2008年财务费用较上年增加514.02万元，增加的主要原因是随着公司经营规模的扩大，公司增加了银行借款，导致利息支出有所增加。

（七）非经常性损益、投资收益及少数股东损益分析

报告期内，公司非经常性损益、投资收益及少数股东损益情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非经常性损益	-0.59	365.72	23.00	85.42
投资收益	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利	1,497.16	2,316.14	1,978.23	2,966.10
非经常性损益、投资收益及少数股东损益占归属于母公司所有者的净利润的比例	-0.04	15.79	1.16	2.88

从上表可见，报告期内非经常性损益占公司净利润的比例较小，主要为公司取得的政府补助。

报告期内的非经常性损益、投资收益及少数股东损益，未对发行人净利润产生重大影响。

三、资本性支出

（一）公司最近三年及一期的重大资本性支出情况

公司近三年及一期的重大资本性支出主要为新增设备、新建生产车间、新征土地支出，相关情况如下：

单位：万元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度	合计
固定资产	1,622.37	3,913.45	17,184.46	621.71	23,341.99
在建工程	1,384.22	1,292.79	9,930.84	4,168.13	16,775.98
无形资产—土地使用权	-	57.72	1,442.95	-	1,500.67

公司处于快速发展时期，报告期内固定资产、在建工程和土地购置的资金主要来源于公司盈利和经营性借款，由于发展资金紧缺，公司目前的发展规模受到了一定的限制。

（二）未来可预见的重大资本支出

根据公司发展规划，公司将投资①扩建年产2.22亿只半导体防护功率器件生产线项目，②投资年产1.4亿只新型功率半导体器件（VDMOS）生产线技改项目，③投资新建年产6.5亿只半导体封装生产线项目，项目总投资规模18,082万元。上述项目已经列入募集资金运用项目，详细情况请参见“第十三节 募集资金运用”。

四、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的较大差异比较

公司重大会计政策或会计估计与可比上市公司目前不存在较大差异。

五、主要财务优势及困难

（一）根据公司的财务状况、经营成果与现金流量情况，结合上述分析，公司认为目前存在如下财务优势：

- 1、公司报告期内经营业绩良好，盈利能力强，产品毛利率高。
- 2、资产结构合理，资产质量优良，固定资产成新率高，机器设备所占固定资产比例相对较高，资产盈利能力强。
- 3、公司致力于建立健全财务管理体系，规范财务管理制度，充分发挥财务的监督和管理职能，加强内部控制制度的建设，实行稳健的财务管理政策，最大程度控制财务风险。
- 4、公司的产品质量高，在市场具有竞争优势，主要客户群体多为实力较强的通讯行业、电器行业的固定配套厂商，因而产品需求量逐渐增长，从而在一定程度上降低了风险。
- 5、公司产品技术含量高，获得了各级政府的大力支持，不仅有各种税收优惠、政府补助，还获得了融资政策倾斜，对企业发展起到了促进作用。

（二）虽然公司拥有以上优势，但是从公司历年的经营情况看，还存在以下财务困难：

公司所处行业为资金密集型行业，需要在设备、技术研发、人力资源等方面有较高的资金投入。公司历来重视技术提升，不断对设备进行更新改造，购置具

有行业先进水平的设备，公司业务发展所需资金基本上通过自有资金和借款解决。公司为了开拓半导体行业高端市场，自筹资金近2亿元建设了VDMOS生产线。尽管该投资为公司开拓新领域，增强市场竞争力和抗风险能力打下了坚实的基础，但由于投资金额大，导致资金需求压力较大。尽管公司经营状况良好，经营活动产生的现金净流入额较高，但仅依靠公司自身积累将很难满足企业快速发展的需要。若本次股票能成功发行，可为公司扩大业务规模提供宝贵的项目建设资金，从而有力地提升公司竞争能力和盈利能力。

六、财务状况和盈利能力未来趋势分析

近年来，公司经营业务呈现出持续快速发展的态势，经营规模不断扩大，营业收入持续增长，核心业务和产品的竞争力、市场地位和盈利能力持续提升。

未来很长的一段时间内，公司仍将坚持现有主业，努力提高在行业中的地位。公司将立足传统的优势产品，抓住时机调整产品结构，进一步拓展产品应用领域。公司以技术创新为驱动力，逐步提升产品层次，着重发展利润率较高的产品。

公司目前融资渠道较少，业务发展所需资金基本上通过自有资金和借款解决，在一定程度上制约了公司的快速发展和业务规模的进一步扩大。公司成功公开发行股票并上市，将从资本市场获取资金以满足公司今后业务发展需要，一方面有利于改善公司的财务结构，另一方面募集资金投资项目将为公司带来新的利润增长点。

第十二节 业务发展目标

一、总体发展战略及目标

公司成立以来依托技术优势、依靠创新思维，从只有单一固体放电管产品的一家业内小厂商逐步发展为分立器件和集成电路行业若干领域细分市场的重要企业。

公司在半导体制造行业飞速发展的过程中清醒的认识到，不能满足于既有产品的市场占有率不断扩大，企业现阶段的设计、生产制造水平也不能完全代表企业的能力，而是要以发展的眼光来制定长远的经营计划，进一步拓展主要产品的种类和应用市场，把品种做宽，这样企业生存发展的空间才会更宽广，企业的抗风险能力也就更强，从而不断保持企业发展的活力。

作为集芯片设计、芯片制造、封装测试、直销、售后服务于一体半导体器件制造企业，公司自身的优势在于不仅树立了自有品牌，又可以不断提高自身的研发、设计和生产能力，因此在市场竞争中抵御市场风险能力更强。未来公司将进一步强化这种垂直整合的一体化生产经营模式，一方面加大研发力度，发掘更多的新市场，从四大系列产品逐步发展出更多系列的主打产品；同时在既有的产品系列下向更多应用领域拓展，例如从通讯防护逐步发展到网络防护、电力防护等领域，从家用电器用可控硅向电力用、大功率可控硅方向发展。另一方面，积极提升公司的封装能力，以实现在封装环节进一步加强质量控制并降低成本，增强市场竞争力。最后，在售后服务环节上延续长期以来对客户差异化需求快速响应的优势，并进一步提供更优异的服务，夺下更多市场占有率。

公司的发展目标是：继续扩大半导体防护功率器件市场的领先优势，加强VDMOS产品研发和市场拓展力度，以产品结构调整来推动可控硅、1300X系列功率器件盈利能力及市场占有率的提高，积极提升公司的封装能力，力争成为在细分市场上国际一流的半导体分立器件和集成电路供应商。

二、发行人当年和未来两年的发展计划

（一）产品开发、技术研发创新计划

在现有产品和技术的基础上，公司将不断进行新产品研发和技术创新，优化产品结构和提高产品技术含量，丰富产品种类和拓展应用领域，进一步提升公司的核心竞争力。

公司计划在未来两年的产品开发计划有：丰富半导体防护功率器件的规格和品种，形成多品种、系列化，扩大在通讯防护领域的市场份额，开发在民用领域的应用；完成 VDMOS 的技术升级和系列化，形成高、中、低压，各电流等级的产品系列，研发 IGBT 等新型高端功率器件；继续优化可控硅、1300 系列的产品结构，提升产品的性能、质量和成本等优势；发展封装生产线，形成公司新的利润增长点。

具体到设计研发领域，未来两年的计划有：（1）完成低电容通讯保护器件的工艺优化，达到稳定量产；（2）完成可编程通讯防护集成电路的工艺定型和产业化；（3）完成具有抗 ESD、EAS 能力、高密度 VDMOS 的研发和量产；（4）完成高电压大电流可控硅的研发，向高端应用领域拓展；（5）掌握 LED 照明驱动芯片的设计技术；（6）提高模拟电路的设计水平，掌握有一定复杂程度的系统开发能力。

在工艺领域，未来两年的计划有：（1）完善 VDMOS 芯片专用工艺；（2）建立 0.5 μ m 的 VDMOS 芯片工艺平台；（3）掌握一些特殊工艺，提高公司现有产品的技术质量水平；（4）完善功率开关器件网络结构工艺；（5）建立工艺线的工艺参数和模型参数库，为设计过程的仿真研发服务。

在研发过程中，在充分利用目前已掌握的设计与工艺技术基础上，拟通过与高等院校、研究所、国内外同行、下游整机厂家的合作，进一步掌握与产品研发目标相关的核心技术，为公司新产品的开发和芯片生产积累技术资源，以实现计划目标。

在原有四大系列产品之外，公司要求工程技术人员努力开发其他系列的产品，例如 IGBT 系列产品等，未来公司的主要产品会逐步增多。多产品系列、多应用领域的开发计划，使得企业能够应对单一应用领域的市场风险，例如在金融危机下节能灯应用领域的功率器件市场需求下降，但防护器件市场情况良好，因此公司通过多产品的经营结构就能在不同的应用市场之间得到平衡补充。

（二）人力资源开发计划

1、人员扩充计划

根据公司发展战略与发展目标，在未来两年将重点引进包括产品设计，设备维护在内的具有丰富经验的专业人才，培养一批具有高学历和实践经验的优秀青年；在经营管理人才的任用上，注重外部招聘与内部培训相结合，抓好青年干部的培养。

2、人才培训规划

公司制定了完善的人才培训计划，包括一般员工的岗前培训（如公司规章制度、6S管理规范、安全教育等）、特定岗位员工的业务培训（如培训、采购培训、营销培训、财务培训等）、中高层管理人员的管理培训（如时间与团队管理、目标管理、生产管理、领导与授权等）、所有员工参加的通识培训（如人际交往与人际沟通、语言表达与语言技巧、网络与电子邮件应用技巧等）。同时，可由部门主管提出申请，为优秀员工提供专项外训。

根据培训计划拟订相应的培训方案，包括具体的培训时间、地点和人员及培训师。对培训师进行严格的筛选，保证培训课程质量。内部培训师由公司内部的管理人员、专业技术人员与人力资源部培训专员担任；外部培训师聘请优秀的企管咨询师担任。

3、人才激励计划

完善公司现有制度，包括招聘制度、培训制度、奖惩制度、晋升制度、社会保障制度及考核制度，逐步建立员工职业生涯管理系统，为员工职业生涯进行规划，做到人尽其材。

（三）市场开发与营销网络建设计划

公司的市场开发与销售网络建设计划重点是开拓新产品市场、发展优质客户、扩大市场占有率，并围绕以下三个方面健全营销体系：

1、营销网络

加强市场推广能力，在各办事处建立地区负责人制，逐步建立较完善的市场营销体系，在巩固成熟市场的同时，要加大新产品、新领域的开拓工作，进一步拓展营销渠道和市场覆盖区域。

2、市场开发

加快市场开发能力，随着公司产品档次的不断提升，公司将十分重视建立与整机厂商的战略伙伴关系，积极探索新的销售渠道与合作方式，通过多渠道、低成本、顺畅的销售模式，促进销售增长，促进公司的业务快速发展。

3、提高销售业务能力，加强售后服务

加强本公司销售团队的培训，提高销售人员的业务能力，提高市场策划水平，在市场规模、推广、服务、信息反馈等每个环节为客户提供专业化、标准化的服务和优秀的解决方案，赢得客户的长期信赖。

（四）再融资计划

公司在本次发行上市后，将按相应的募集资金管理规定认真管理和合理使用募集资金。公司亦将不断加强资产运营管理，提高资金使用水平，提高股东收益。

在未来融资方面，公司将根据产品研发和市场开拓的情况，依靠对外融资和自身积累的方式继续扩大生产规模。公司将本着对所有股东负责的态度，充分合理利用财务杠杆，保持多形式、低成本、顺畅的融资渠道，择时择优采纳银行借款、配股、增发和发行可转债等方式的再融资方案。

三、拟订发展计划所依据的假设条件

实现公司发行当年及未来两年内的发展规划所依据的假设条件是：

1、国家宏观经济、政治、法律和社会环境比较稳定，在计划期内没有对公司发展产生重大不利的事件出现；

2、国家对电子信息产业和集成电路产业的导向政策、扶持鼓励政策不发生重大变化，并能较好的执行；

3、半导体功率器件市场继续保持稳定的增长速度，没有出现重大的市场突发情形；

4、本次股票发行能够在预定时间内完成，且募集资金到位。如果募集资金不能及时到位，公司通过其它渠道融资将会延误时间，将会影响到投资项目的实施。

四、实施发展计划面临的主要困难

公司为实现上述发展计划面临较大的资金需求。若公司不能开辟直接融资渠道，仅通过银行借款等间接融资方式获取资金，将延缓公司的发展。股票发行成功与否，对公司发展计划的实施具有决定性的意义。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划很难如期实现。

另一方面，公司在规模快速扩张的情况下，生产能力不断扩大，公司现有的管理模式、资源配置体系将面临更大的挑战，需要大量管理、营销、技术方面的人才，公司面临一定的人力资源压力。

五、发展计划与现有业务关系

上述计划是在现有主营业务的基础上，按照公司的发展战略和目标制定的，是现有业务的进一步深化和更大范围的拓展；产品开发和技术创新计划、人员扩充计划、市场开发与营销网络建设计划都将促进现有业务在产品质量、技术含量、营销服务和销售收入上的大幅提高；而融资计划将为主业发展提供雄厚的资金保障。

总之，发展计划如能顺利实施，将极大提高公司现有业务水平和产业规模，提升公司的核心竞争力，促成公司长远发展战略的实现。

第十三节 募集资金运用

一、本次发行募集资金情况

（一）预计募集资金数额

经公司2010年3月24日召开的2009年年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，募集资金总额根据询价结果确定。

（二）募集资金使用计划和核准情况

根据投资项目的轻重缓急，本次募集资金投资将用于以下项目：

项目名称	项目投资金额 (万元)	建设期	项目核准情况
半导体防护功率器件生产线项目	4,816	1 年	宜兴市发展和改革委员会宜发改许（2010）73 号
新型功率半导体器件生产线技改项目	6,123	1 年	宜兴市发展和改革委员会宜发改许（2010）72 号
半导体封装生产线项目	7,143	1.5 年	宜兴市发展和改革委员会宜发改许（2010）74 号
合 计	18,082		-

半导体防护功率器件生产线项目和新型功率半导体器件生产线技改项目的实施主体为本公司，半导体封装生产线项目的实施主体为公司全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司。东晨电子计划自筹部分资金先投入半导体封装生产线项目，待本次募集资金到位后，东晨电子将用募集资金继续投入项目剩余款项，并置换届时已累计投入的建设资金。

（三）募集资金数量产生差异的安排

本次募集资金投资项目总投资额为18,082万元，如本次募集资金不能满足拟投资项目所需的资金要求，不足部分由公司通过银行贷款及其它方式筹集，若本次募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流动资金。

二、募集资金投资项目情况

（一）半导体防护功率器件生产线项目

1、项目概况

本项目为公司新建1条4英寸半导体防护功率器件生产线，目前公司已有产能1.3亿只/年，项目建成后公司将新增防护功率器件2.22亿只/年的产能。半导体防护功率器件是公司的主要优势产品，在通讯领域防护功率器件市场占有绝对的优势地位，本次募集资金的投入将有利于公司进一步扩大现有优势产品的市场规模，满足日益增长的市场需求，提升公司在半导体防护功率器件领域的市场地位和公司整体盈利能力。

2、项目背景

电子电气产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和电流浪涌，从而导致产品的损坏。损坏的原因是电子电气产品线路中半导体元器件被烧毁或击穿，因此电压瞬变和电流浪涌是电子产品的隐形致命杀手，防护的必要性由此而来。

半导体防护功率器件能够起到对电子电气产品防护的作用，因此其重要性在日益显现。具体而言，首先从安全性和可靠性要求来看，电子电气产品都需要防止雷击及电力线碰触与电力线感应等干扰问题，以保证其正常工作和用户人身安全。其次，从质量保障要求来看，在电子电气产品出现的故障中，有75%是由于过电流、过电压造成的，计算机电源的故障中更有88.50%是由于过电流、过电压造成的，因此也必须大量采用电路保护元器件。最后，从应用领域的扩展来看，手机、PDA、笔记本电脑、摄录机、数码相机、光盘机等移动电子产品越来越多，都需要电池组件作为电源，在电池组件和电池充电器中都必须配置保护元器件；高档汽车中的电子设备越来越多，而且工作条件比一般的电子产品更为恶劣，在为这些电子设备配套的电源适配器中，一般都需要同时安装过电流和过电压保护元器件；随着电子技术的发展和电子电气产品的更新换代，电子电气产品逐渐多样化和复杂化，IC的功能和集成度越来越强，其价值也越来越贵，这种高科技微电子设备的损坏，其后果可能使整个系统运行中断，其损失远远超过设备本身的经济价值，造成难以估量的经济损失。因此，过电流、过电压保护元器件的需求

呈上升趋势，并日益发展成为一个品类繁多的新兴电子元器件领域，有着良好的市场和应用前景。

3、项目建设的必要性

（1）扩大公司防护功率器件的产能，以满足市场需求的扩大

半导体防护功率器件产品是公司的主打产品，最近三年的销售收入呈现稳步增长的趋势，由于防护功率器件市场需求的不断增加以及公司防护功率器件产品市场占有率的不断提升，公司现有的产能已经全部利用，有限的产能限制了公司未来在半导体防护功率器件市场的进一步发展，制约了公司盈利能力的提升。

公司半导体防护功率器件近三年及一期的产能利用率和产销率情况如下：

项目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
产能（万只）	6,500.00	12,000.00	8,600.00	6,000.00
产量（万只）	6,723.01	12,606.48	8,628.11	5,748.10
产能利用率	103.43%	105.05%	100.33%	95.80%
销量（万只）	7,046.85	11,878.31	8,794.72	5,636.64
产销率	104.82%	94.22%	101.93%	98.06%

从上表可以看出，最近三年公司防护功率器件的产量持续快速上升，2008年产量比2007年增长50.10%，2009年产量比2008年增长46.11%。尽管公司通过技术改造、更新设备、优化布图设计等措施，将防护器件生产线产能从2007年6,000万只增加到2009年的12,000万只，增幅为100%，2010年上半年又通过技改新增产能500万只，但仍不能满足快速增长的市场需求。公司2008年的产能利用率已经达到了100%，在2009年产能持续扩大的情况下产能利用率达到了105.05%，2010年上半年产能继续扩大的情况下产能利用率达到了103.43%，出现了超负荷生产的情况，且公司的产销率也一直保持在一个较高的水平，因此公司现有的产能已经成为公司快速发展的瓶颈。本次利用募集资金新建1条年产2.22亿只半导体防护功率器件生产线，将有利于公司迅速提升防护功率器件的产能，满足日益增长的市场需求，进一步提升市场占有率。

（2）从以通讯防护为主向“大防护”的概念发展

公司的防护功率器件主要包括固体放电管、过电压过电流保护IC和过电压保护IC，目前主要应用于通讯用程控交换机保护领域、信息传输终端的机顶盒、

Modem、传真机、电话机过电压、过电流保护领域。

公司在占优势地位的通讯用防护器件领域不断研发新产品的同时，也在不断开拓新的应用市场，提出“大防护”的概念，从通讯防护向网络防护、家电防护、电力防护等方向发展。

公司生产的半导体防护功率器件产品品种逐年增加，从程控交换机一级防护用 SA 固体放电管，发展出程控交换机二级防护用集成电路 P61089。与前几代半导体抗浪涌保护器件的性能相比，P61089 的性能大大提高。其特点在于可对保护电压进行硬件编程，因此可用在各种电压下。目前 P61089 几乎能被所有的程控交换机用来对 SLIC 板实现保护，但基本上都是国外进口产品。

此外，公司自主研发的网络安全防护 DP 系列产品近年来成为新的利润增长点，该系列产品于 2007 年研发成功并投入生产，主要应用于第二代互联网、第三代移动通信、网络电视宽带交换接入设备及高频网络通讯终端等防雷保护领域。由于 3G 网络、宽带通讯、网络电视等先进技术不断推广普及，这一领域的市场将不断扩大。

未来公司还将继续开发家电、家用电路（插座）、电表等领域的防护器件产品。随着公司半导体防护功率器件产品品种日益丰富、使用领域逐步拓展，江苏东光将发展成为国内产品最全面、最有竞争力的防护器件生产厂商。

4、市场容量

防护器件未来的市场容量主要包括两大部分：一部分是现有应用领域的市场容量——包括通讯防护、网络防护、信息传输终端设备防护三大应用市场，另一部分是新增应用领域的市场容量——包括家用电器防护、家用电路防护、电表防护等民用设备的应用市场。

（1）现有应用领域市场

公司生产的防护功率器件主要包括固体放电管、过电压过电流保护 IC 和过电压保护 IC，产品应用领域及使用防护功率器件的数量情况如下表：

产品名称	产品系列	应用领域	使用个数
固体放电管	SA 系列	程控交换机一级保护	2 个/线

	DP系列	机顶盒、传真机、电话、Modem、路由器、电视机	1个/台
		宽带交换设备	28-128个/台
过电压过电流保护IC	CSC系列	程控交换机一级保护	1个/线
过电压保护IC	58S系列、P61089系列	程控交换机二级保护	1个/线

就现有应用领域而言，各应用领域对半导体防护功率器件的需求量如下（以下预测数据来自公司《半导体防护功率器件生产线建设项目可行性研究报告》）：

①程控交换机

A、新增用量

程控交换机新增用量包括一级保护及二级保护两部分新增用量。一级保护需要用到固体放电管2个/线或者过电压过电流保护IC1个/线；二级保护需要用到过电压保护IC1个/线。

根据国家统计局资料，2008年程控交换机产量4,583万线，2009年1-11月程控交换机产量3,776万线，预计2010年我国程控交换机产量将恢复到2008年产量，达到4,600万线，预计2012年可达6,000万线。

因此，按照一级保护、二级保护对防护器件的各自需要量，预计2010年，程控交换机一级保护用防护器件新增用量为9200万只固体放电管，或者4600万只过电压过电流保护IC；而2012年程控交换机二级保护用防护器件新增用量为4600万只过电压保护IC。上述新增用量总体合计为0.92亿只—1.38亿只防护器件。

B、更新用量

我国2001年前安装的程控交换机一级保护用防护器件多为气体放电管，目前全国很多省市电信系统都在逐步开展将气体放电管更换为固体放电管的工作。根据《2009年电信业统计公报》，2009年我国固定电话为31,368.8万户，每户电话匹配一线程控交换机，按照现有程控交换机的利用率达到60%来估计，目前我国程控交换机保有量约5.23亿线（31368.8万/60%），按照每年10%的更换率，则每年有5230万线的更换数量。由于每线程控交换机一级保护需要两只固体放电管，因此，预计未来每年固体放电管的更换用量约为1.05亿只。

综上，预计2010年程控交换机用防护器件（含一级保护、二级保护）需要量大约在1.97亿只至2.43亿只，具体计算如下表：

一级保护	新增用量	固体放电管 9200 万只	过电压过电流保护 IC 4600 万只
	更换用量	固体放电管 10500 万只	
二级保护	新增用量	过电压保护 IC4600 万只	
	合计用量	24,300 万只	19,700 万只

②宽带接入交换设备

2002年以来，我国宽带市场取得了快速的发展，随着市场规模的不断扩大，宽带交换设备市场需求量逐年增加，2008年我国宽带设备市场容量不断上升，市场容量为3,573万线，同比2007年增长11%。在我国移动通信领域，语音业务占据90%以上的市场份额，数据业务潜力巨大，随着移动通信和互联网的合作更加密切和规范，未来移动数据业务将快速增长，数据业务的增长，需要大规模的宽带接入和交换设备。

此外，防护器件产品还拥有潜力巨大的海外市场。中兴通讯、华为是公司防护器件产品的固定客户，公司通过向中兴通讯、华为的指定供应商供货间接形成与上述两家公司的采购关系。近几年，中兴通讯、华为的海外销量稳步上升，在亚太、中东北非、南部非洲、独联体地区巩固了已有的市场地位，市场份额取得大幅提升，还在欧洲、拉丁美洲、北美地区取得了令人瞩目的战略突破，奠定了新的全球市场格局。中兴通讯、华为海外市场开拓力度的加大，对公司半导体防护功率器件产品的需求具有直接拉动作用。

中兴通讯和华为在全球宽带接入（xDSL）市场占有较高的市场比例，根据华为公司官方网站披露的数据，2008年华为 xDSL 终端累计出货 3800 多万台，全球份额排名第二。目前宽带接入交换设备每线使用 1 只 DP 系列防护功率器件，国内宽带交换设备的主流产品一般为 28-128 线，随着通讯技术的发展，将来几年内，256 线、512 线甚至更大容量的宽带交换设备将投放市场并替代现有产品。

不考虑其他方面的用途，2010 年，按照中兴通讯和华为海外及国内市场新增需求量预计，对宽带接入设备需求可达到约 4,200 万台/年，以平均每台用 50 个 DP 系列防护功率器件的保守估计，至 2010 年，仅宽带接入交换设备领域对 DP

系列防护功率器件需求可达 21 亿只/年。

与此同时，我国现有庞大的宽带用户即将进入更新期。据工信部公布的数据，2009 年10月我国互联网宽带接入用户总数首次突破了1亿大关，达到1.01 亿户。预计2010 年，我国互联网宽带接入用户将达到1.3亿户。按现有宽带用户每年更新8%计算，由此形成的需求量达到约800万线，对DP 系列防护类功率器件的更新用量达到4亿只/年。

综上，2010年后，预计每年宽带接入设备所需的防护器件新增用量及更新用量总计达到25亿只/年。

③电话机、传真机、机顶盒、Modem等信息传输终端

2009年，全国电话用户净增7,946.7万户，总数达到106,107.2万户，这意味着该市场还拥有巨大的增长空间。

中国是全球最大的机顶盒生产制造大国，据iSuppli公司分析，2009年受益于对STB-C、DTMB和ABS-S的需求，国内机顶盒出货量有所上升，随着国内对高端产品如高清机顶盒的研制成功，2010年以后高清机顶盒的出货量也将迅速增加。预计2010年出货量为1.245亿个。

据工信部公布的数据，2009年10月我国互联网宽带接入用户总数首次突破1亿大关，达到1.01亿户，中国市场还拥有巨大的增长空间，预计2010年，我国互联网宽带接入用户将达到1.3亿户。

预计2010年机顶盒、传真机、电话、Modem总产量约4.3亿部。按照在机顶盒、传真机、电话、Modem应用领域中使用DP系列固体放电管1个/台计算，则2010年DP系列产品的市场需求量将达到4.3亿只。

综上所述，仅就半导体防护功率器件目前的三大应用领域来看，2010年后我国对半导体防护功率器件（固体放电管、过电压过电流保护IC、过电压保护IC）年需求量保守估计达到31.27亿只—31.73亿只左右。

（2）新增应用领域市场

目前国内半导体防护功率器件在家电、家用电路、电表等领域的应用非常少，

而欧美等发达国家则应用非常普遍，随着我国安防意识和安防要求的提高，半导体防护功率器件在民用领域的应用将随之扩大，预计新领域未来将新增半导体防护功率器件9-10亿只。

综上所述，未来半导体防护功率器件的市场潜力巨大，而由于产能所限，目前公司仅在通讯用防护器件市场占有率有80%以上的市场占有率，在网络防护、信息传输终端设备用防护器件市场上未进行大力开拓，市场占有率还不高，国外进口防护器件产品在该市场占主要份额。考虑到未来迅速增长的市场容量，公司的质量、技术、成本优势，以及公司目前防护器件产能利用率已达到100%以上的情况，公司防护器件生产线建设项目有其必要性。

5、项目实施的有利条件

（1）技术优势

公司具有多年生产半导体防护功率器件的生产经验，拥有一支熟悉半导体防护功率器件产品开发的技术队伍，公司研制的多项半导体防护功率器件产品成功替代了国外进口产品，达到了国际先进技术水平。公司在防护器件领域获得的技术奖项有：2001年公司的SA230-J”半导体放电管获江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》；“58S半导体抑制栅”防护类功率集成电路于2001年被国家科技部列入第五批科技型中小企业创新基金项目，2002年获江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，2003年获国家级火炬计划项目证书；2002年，防护类功率集成电路“YDCLP200M-X 过电压过电流保护集成电路”被认定为国家电子信息产业发展基金第三批重点项目；“DSC3X00网络安全保护用集成电路研究与开发”被信息产业部列入2007年度集成电路研究与开发专项资金使用计划；“DCLP19E通信安全保护用集成电路的研究与开发”被信息产业部列入2008年度集成电路研究与开发专项资金使用计划；“高速网络用片式功率防护模块”获科学技术部科技型中小企业技术创新基金；2008年，“高速网络通信用功率集成电路”获国家火炬计划项目证书；“支持下一代互联网高频传输低电容功率防护模块研究与产业”获2009年江苏省科技成果转化专项资金；“低电容功率防护集成电路DP”获2009年江苏省高新技术产品称号。

2010年2月11日，中国半导体协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用

设备工业协会、中国电子报社联合发布了“第四届（2009年度）中国半导体创新产品和技术”评选结果，该项目评选共分六大类，有三十六家公司获选，其中半导体器件类获选项目仅有两个，江苏东光的“高速网络安全保护用功率防护模块DP3X00”名列其中。

（2）销售渠道优势

公司具有良好的销售渠道，半导体防护功率器件产品是公司的主要优势产品，经过多年的经营已经建立了畅通的销售渠道，公司生产的半导体防护功率器件被中国电信和中国网通的多个省局下文明确要求作为其设备供应商的指定采购产品，其他省份电信企业虽没有明确下文必须采购江苏东光的防护器件产品，但是公司通过所合作的众多电信设备供应商，实际已间接取得了这些省份电信防护市场的领先优势。长期以来，公司与电信运营商的国内主要设备供应商，如华为安捷信、中兴新地、日海通讯、八达通信、新海宜、恒利通讯、普天凯特、万马集团、世纪人等建立了良好的合作关系，产品质量得到充分认可，已成为他们的防护器件独家或主要供应商。

（3）质量控制优势

公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，产品通过美国UL安全认证、欧洲ROHS认证、PAHS认证、德国莱茵TUV安规认证等，多年来通过改进结构版图设计、提高工艺水平、推广技术经验和操作诀窍、培训提高员工熟练程度等全方面的措施，公司的质量管理水平不断提高，产品全线合格率不断提升，产品质量得到众多客户的一致信赖。

公司目前采取的集芯片设计-芯片制造-封装测试-直销-售后服务于一体的垂直整合的生产经营模式有助于公司在质量控制上进行严格把握，并对产品性能改进快速响应。

（4）品牌效应优势

公司自成立以来秉承“立民族志气，创东光品牌”的经营理念，坚持走自有品牌路线，在市场上成功塑造了东光品牌的影响力。公司在不断开发新的系列产品的过程中，依靠品牌知名度，用老产品带新产品，打开新产品市场，同时以技

术过关、产品性能稳定作为保障。本项目实施后可以利用公司现有品牌效应，尽快实现新增产能的经济效应。

（5）成本优势

目前公司生产的防护产品主要集中于通讯防护领域，而在网络防护、信息传输终端设备用防护产品领域市场占有率还不高，这部分市场目前主要由国外防护器件生产厂商占据，如意法半导体（ST）公司、柏恩斯（BOURNS）公司等。公司本次募投项目扩产以后，会有更多用于网络防护、信息传输终端设备防护的产品推向市场，与上述国外厂商的同类产品相比，具有显著的成本优势，质量上亦相差无几，未来有望再次替代进口，改变既有市场格局。

（6）实施本项目不需另征用土地，可在现有公司的空地上建设。

6、项目具体介绍

（1）项目投资概算情况

本项目总投资估算为 4,816 万元，其中建设投资 3,878 万元，铺底流动资金 938 万元，具体如下：

序号	项目	投资金额（万元）	所占比例
1	建筑工程费	1,089.00	22.61%
2	设备购置费	2,071.75	43.02%
3	安装工程费	136.54	2.84%
4	工具器具费	26.43	0.55%
5	其他费用	267.02	5.54%
6	预备费	287.26	5.96%
建设投资合计		3,878.00	80.52%
铺底流动资金		938.00	19.48%
项目总投资		4,816.00	100.00%

（2）产品技术水平、工艺流程和主要设备选择情况

①产品技术水平

本项目新建一条 4 英寸防护功率器件生产线，沿用公司现有工艺生产技术，不存在生产技术障碍。公司生产的半导体防护功率器件整体性能达到了国际同期先进技术水平。

②工艺流程

本项目的生产方法和工艺流程具体参见本招股说明书“第六节 业务和技术/四、发行人主营业务的具体情况/（二）主要产品的工艺流程图。

③主要设备选型及投资估算情况

本项目拟新增主要生产设备及仪器共计 90 台，具体如下：

序号	设备名称	生产厂家	数量 (台)	单价 (万元)	金额 (万元)
1	抛光机	兰州瑞德实业集团公司	3	21.00	63.00
2	扩散炉	青岛圣豪微电子有限公司	7	15.00	105.00
3	双面光刻机	四川南光真空科技有限公司	1	23.00	23.00
4	单面光刻机	四川南光真空科技有限公司	7	17.50	122.50
5	玻璃钝化设备	青岛圣豪微电子有限公司	1	20.00	20.00
6	离子注入机	美国伊通公司半导体设备分公司	1	100.00	100.00
7	蒸发台	CHA MARK-50	2	150.00	300.00
8	自动清洗机	中国电子科技集团公司第四十五研究所	6	12.00	72.00
9	甩干机	中国电子科技集团公司第四十五研究所	3	17.00	51.00
10	划片机	迪思科科技有限公司	3	45.00	135.00
11	涂源、涂胶机	上海学泽光学设备有限公司	8	2.50	20.00
12	烘箱	宁波志圣烘箱有限公司	6	0.80	4.80
13	超声波清洗机	无锡超声波设备有限公司	2	2.00	4.00
14	全自动芯片测试仪	深圳矽电半导体设备有限公司	6	10.00	60.00
15	测试检测设备	JUNO株式会社	3	16.00	48.00
16	全自动测试仪	江阴金仕达科技有限公司	6	12.00	72.00
17	四探针测试仪	广州半导体材料研究所	1	2.30	2.30
18	膜厚测试仪	日本精工公司	1	5.00	5.00
19	显微镜	日本尼康公司仪器分公司	2	2.40	4.80
20	图示仪	北京北科普源电子技术服务中心	20	0.45	9.00
21	硅管及工夹具	上海强华石英有限公司	1	100.00	100.00
总 计			90		1,321.40

(3) 主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目所需的原材料主要为单晶硅片、试剂、极片等，全部在国内采购，供

应渠道畅通，市场价格结算。

本项目消耗的能源主要为电、氮气、氧气。

① 供电

本项目总用电装设功率为 2,200KW。本工程供电电源由园区变电站高压系统引来，采用两回 10KV 专用电缆线路供电。容量可以满足本项目用电需求。

② 氮气

普氮采用液氮汽化的方式供应，液氮贮槽和汽化器均放置室外，主厂房设有气体纯化间，高纯氮由普氮经纯化后制得。

③ 氧气

高纯液氧采用汽化的方式供应，液氧贮槽和汽化器均放置室外，主厂房设有气体纯化间设终端气体纯化装置。

（4）环保情况

本项目加工过程中使用酸碱溶液、有机溶剂和烷类等特种气体，对环境构成污染的主要有废水、废气、固体废弃物和噪声。

① 废水处理

氢氟酸废水：采用投加氯化钙-凝聚剂-助凝剂化学沉淀法处理工艺。经过反应、凝聚、沉淀、过滤，最终达到要求的排放标准。

酸碱废水：采用中和凝聚沉淀法处理。经过 PH 调节、凝聚、沉淀，最终达到要求（使 PH 值在 6-9 范围内）的排放标准。

生活污水经化粪池处理，食堂排出含油污水经隔油池处理，通过厂区室外污水管网直接排入产业园区污水管网。

② 废液处理

化学废液包括高浓度化学药液废液和溶剂废液（包括硫酸废液、磷酸废液、含氮废液、HF 废液、光刻胶废液），这些废液由专门的废液处理公司回收，进行

再利用或销毁。

③废气处理

对产生有毒有害气体的工艺设备及房间，分别采取局部排风和全室通风。排出的气体分成两大类，一类为符合排放标准的可直接排出室外；一类为超过或接近排放标准而需要进行处理后才能排出室外，需处理类排风采用淋洗处理、喷化学液化学喷淋处理和吸附处理等方法，经处理后可达到国家规定的排放标准。

④噪声治理

本项目的噪声源主要来自后封装部分工艺设备以及冷冻机、各种泵、冷却塔和空调机组，按国家对噪声防治的要求，采取的主要措施有：设计中尽量选用高效能、低能耗、低噪声的设备；冷却塔、水泵等设备选用低噪声产品，需符合国家噪声标准；在水泵吸水管和出水管上设置可曲挠橡胶接头；选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头，对转速高的风机，采取隔声罩降低噪音；通风、空调系统风管上均安装消声器或消声弯头；空调机、冷冻机、离心式排风机设减振台座；动力设备对环境的影响主要设备在运行过程中产生的噪声和振动，设计中采取设备减振、接管处设有橡胶或金属软管接头隔振，在吸气、排气处设置消声过滤器等措施；利用墙体屏蔽、建筑隔声降噪，对噪声较大的房间的门窗、墙采取隔音，以减少室内噪声和震动的传递，冷冻机、水泵等噪声较大的设备设在有隔声措施的隔间内。

⑤固体废弃物处理

化工原材料：由原材料供应厂家负责回收；对工艺中产生的废瓶、含毒废器皿等，收集在专用容器中，集中封存在化学品库中的废弃物暂存内，定期送有相关资质的单位进行处理或委托焚烧处理或安全填埋；污泥：污水处理产生的污泥、沉淀物，经过脱水、干燥和压滤，定期送有资质的单位处置；其他废料和废弃包装物：将集中送废品收购站回收利用；办公、生活垃圾由产业园区的环卫部门统一清运。

本项目已经宜兴市环境保护局审查批准，并由宜兴市环境保护局于 2010 年 3 月 19 日出具宜环发（2010）第 17 号《关于江苏东光微电子股份有限公司半导

体防护功率器件生产线项目环境影响报告审批意见》，从环保角度同意江苏东光该项目建设。

（5）项目选址及土地使用情况

本项目将在公司现有土地上进行建设，土地已取得《土地使用权证》（宜国用 2009 字第 28600002 号），土地取得方式为出让，用途为工业用地。

（6）项目的组织方式及实施进展

公司成立项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试等工作。

项目建设完成投产后，共需人员200人，其中管理人员5人、技术人员15人、生产及辅助人员共计180人，生产线实行三班倒生产。

本项目建设期为1年，生产第一年达产率约为70%，生产第二年以后各年达产率100%。预计实施进度如下：

实 施 进 度 表

序号	时间（1个月/格）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	名称																		
1	可研报告编制及审批																		
2	环评报告编制及审批																		
3	初步设计及审批																		
4	施工图设计																		
5	工程施工																		
6	设备订货																		
7	设备验收																		
8	设备安装调试																		
9	人员培训																		
10	系统试运行																		
11	项目投产																		

（7）项目经济效益分析

经测算，项目达产后的正常年销售收入 9,990 万元，年利润总额 2,748 万元；税后财务内部收益率为 38.44%；税后财务净现值为 6,742 万元；税后投资回收期为 4 年。

本项目主要经济指标详见下表：

序号	项目	单位	指标	备注
1	项目总投资	万元	4,816.00	
1.1	建设投资	万元	3,878.00	
1.2	铺底流动资金	万元	938.00	
2	营业收入	万元	9,690.00	各年平均值
3	营业税金及附加	万元	85.00	各年平均值
4	总成本费用	万元	6,966.00	各年平均值
5	利润总额	万元	2,640.00	各年平均值
6	所得税	万元	396.00	各年平均值，按15%税率计算
7	净利润	万元	2,244.00	各年平均值
8	总投资收益率	%	54.81	税前利润/总投资
9	总投资利税率	%	72.58	
10	资本金净利润率	%	46.59	
11	总成本利润率	%	37.90	
12	销售利润率	%	27.24	
13	盈亏平衡点	%	34.81	达产年值
14	投资回收期	年	3.65	所得税前
		年	4.00	所得税后
15	财务净现值	万元	7,761.00	i=12%所得税前
		万元	6,742.00	i=12%所得税后
16	财务内部收益率	%	45.41	所得税前
		%	38.44	所得税后

综上所述，本项目经济效益显著。

（二）新型功率半导体器件生产线技术改造项目

1、项目概况

本项目为公司现有的新型功率半导体器件生产线技术改造项目，本项目技改不改变原有生产线产品方案，仍为VDMOS和IGBT产品。目前该生产线年产能为1亿只VDMOS产品，技改后该生产线将打破产能瓶颈，新增产能1.4亿只，总产能达到2.4亿只/年。

VDMOS 目前是公司现阶段重点发展的产品，2005 年底，公司从奥地利微系统公司（AMS）引进一条 4 英寸 0.5 微米新型功率半导体器件生产线，用于生产 MOSFET、IGBT 系列产品。目前依托自身强大的科研力量，形成了一套具有完整自主知识产权的 VDMOS 生产技术，已成功开发出 18 种型号的系列产品，产品性能达到同行业先进水平。IGBT 产品现处于试制阶段，具体参数有待改进。

2、项目背景

（1）行业发展趋势

受金融危机以及半导体行业低迷的双重影响，2009 年中国功率器件和集成电路市场首次出现了负增长的局面。但 MOSFET 依旧占据市场最大的比重。尽管 2009 年市场发展环境较为恶劣，但在计算机以及液晶电视等亮点产品的带动下，MOSFET 市场发展要好于其他功率器件产品，全年市场规模仅略微下降 0.6%。

以 MOSFET 为代表的功率器件市场的突出表现主要得益于产品升级这一主要因素的带动。近年来，电子整机对节能、环保的需求不断提升，明显带动了以功率晶体管为代表的高端器件和集成电路产品的需求增长，带动市场的产品结构快速升级。

就全球半导体功率器件和集成电路的技术发展趋势来看，同样作为电力开关器件，VDMOS 与双极功率器件相比具有诸多优良性能，如高输入阻抗、低驱动电流、开关速度快、工作频率高、有负的电流温度系数，热稳定性好，安全工作区大，高度线性的跨导、放大失真小等。因此未来的发展趋势是以 1300X 为代表的双极晶体管产品将被 VDMOS 产品逐步取代，但考虑到各应用领域的更换成本问题，这需要一个渐进的过程。

（2）行业扶持政策

半导体功率器件，尤其是以 MOSFET、IGBT 为代表的电力电子器件和各种电源管理集成电路是利用半导体技术生产可以节能降耗和减排的各种终端产品的很重要的关键组成部分。

早在 2007 年 10 月 5 日，国家发展改革委办公厅《关于组织实施新型电力电子器件产业化专项有关问题的通知》，提出为贯彻落实“十一五”高技术产业发展规划和信息产业发展规划，推进节能降耗，促进电力电子技术和产业的发展，组织实施新型电力电子器件产业化专项。专项目标：提高新型电力电子器件技术和工艺水平，促进产业发展，满足市场需求，以技术进步和产业升级推进节能降耗；突破核心基础器件发展的关键技术，完善电力电子产业链，促进具有自主知识产权的芯片和技术的推广应用；培育骨干企业，增强企业自主创新能力。支持

重点中包括绝缘栅双极晶体管（IGBT）、金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）的芯片设计、制造、封装测试和模块组装的产业化。

2008年1月8日，信息产业部发布《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》，提出大力发展新型半导体器件，重点发展半导体电力电子器件，包括纵向双扩散型场效应管 VDMOS，绝缘栅双极型晶体管 IGBT，静电感应晶体管系列 SIT、BSIT、SITH，栅控晶闸管 MCT，巨型双极晶体管 GTR 等。

2008年1月10日，财政部、国家发展改革委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》（财建 20071027 号），这是我国政府加大力度推广高效照明产品，促进实现节能减排目标的又一重要举措。国家发展改革委、财政部将分批下达高效照明产品财政补贴推广任务，确保实现“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品 1.5 亿只，可节电 290 亿千瓦时，减少二氧化碳排放 2900 万吨。财政补贴的高效照明产品主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯（T8、T5 型）和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品，半导体（LED）照明部品，以及必要的配套镇流器。MOSFET 产品即受惠于 LED 照明及配套镇流器的补贴政策。

3、项目建设的必要性

（1）市场需求扩大将导致产能不足

目前公司新型功率半导体器件生产线的产能利用率情况如下：

产品类别	项目	2010 年 1-6 月	2009 年	2008 年
VDMOS	产能（万只）	5,000.00	10,000.00	8,000.00
	产量（万只）	3,112.53	5,018.46	1,897.86
	产能利用率（%）	62.25%	50.18%	23.72%

VDMOS生产线于2008年初开始投产，最近两年产能利用率逐步提升，2009年产能利用率为50.18%，2010年上半年产能利用率为62.25%。主要原因在于：首先公司购买的这条进口生产线原用于生产CMOS，CMOS生产线的设备用于生产VDMOS，有些工序的设备不适用，需要改造，还有些工序的设备需要添加，因此对个别设备的改造、调整需要一定的时间；其次，VDMOS生产线引进以后，公司技术人员需要有对生产线的熟悉过程，生产员工也需要进行相关培训；第三，VDMOS产品在销售给客户的时候，每家客户都会对其各种性能参数指标

进行检测，检测合格后才会下订单，有些还要经终端客户检测合格方可进行采购，这个过程往往需要半年，大的厂商甚至需要一年的时间。因此，2008年投产当年的产能利用率只有23.72%。但随着公司生产设备不断调试理想，VDMOS产品性能、质量的改进和提高，客户对VDMOS产品检测程序的完成，VDMOS的客户量和客户采购量不断提升，该生产线的产量也迅速上升，2009年产能利用率上升为50.18%，2010年上半年进一步上升到62.25%。预计随着市场开拓的进一步加强，产能利用率将进一步提升。

（2）现有生产线存在瓶颈制约产能进一步扩大

在VDMOS生产线达到现有产能后，整条生产线由于部分设备不适配的原因仍存在瓶颈，导致其他设备不能满产，制约产能的进一步扩大。主要原因在于公司购买的这条进口生产线原用于生产CMOS，CMOS和VDMOS在制程上存在一定区别，导致其设备配置有所差异，因此在用于生产VDMOS的时候，由于各工序的产能不匹配，出现了明显的瓶颈。其中主要的瓶颈之一是该生产线只有一台高能高束流离子注入机，而生产VDMOS要进行多次高能注入，至少需要配置两台高能高束流离子注入机。瓶颈之二在于刻蚀环节，由于VDMOS芯片表面的氧化层比CMOS的氧化层厚，在制造VDMOS所需的刻蚀时间更长，因此也导致产能不足。此外，原CMOS生产线的设备用于生产VDMOS，有些工序的设备不适用，需要改造，还有些工序的设备需要添加。例如，公司目前这条CMOS生产线没有减薄这道工艺环节，公司另行配置了减薄设备。因此，上述瓶颈制约了整条生产线产能的发挥。公司一方面通过不断的设备改造来提高现有产能，另一方面，拟利用募集资金对VDMOS生产线进行技术改造，以充分发挥生产线各个工序的作用，改变目前由于部分设备瓶颈造成其他设备不能满产开工的生产成本浪费现象。

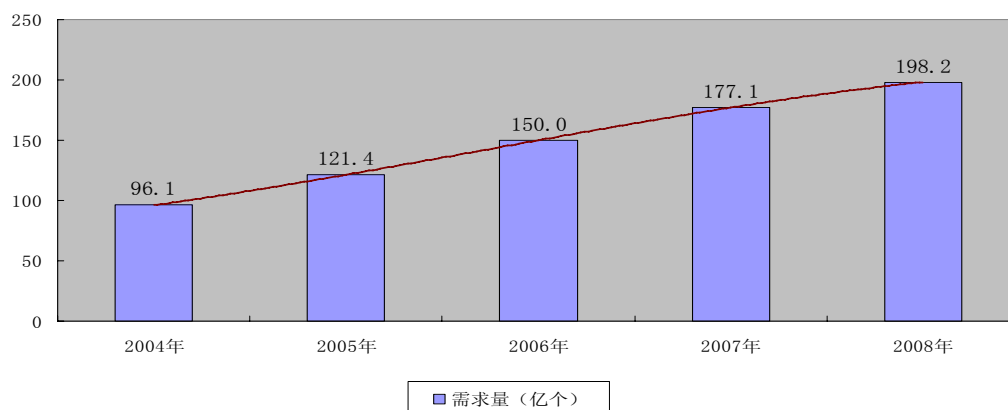
4、市场前景

（1）市场总容量巨大

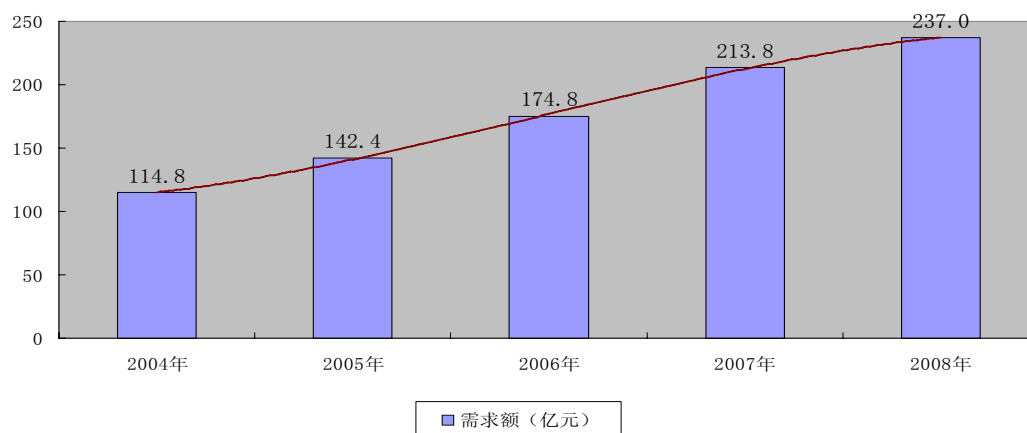
在半导体功率器件中，MOSFET是其最重要、发展速度最快的产品，市场规模也仅小于电源管理IC。而VDMOS是MOSFET的一种主要结构形式，目前国内MOSFET市场几乎等同于VDMOS市场。

受到下游电子制造业快速发展的影响，2004 年到 2008 年中国 MOSFET 市场快速增长，2008 年，中国 MOSFET 市场（主要是 VDMOS 产品）需求量为 198.2 亿个，比 2007 年增长了 11.9%，市场需求额为 237.0 亿元，比 2007 年增长 10.9%。

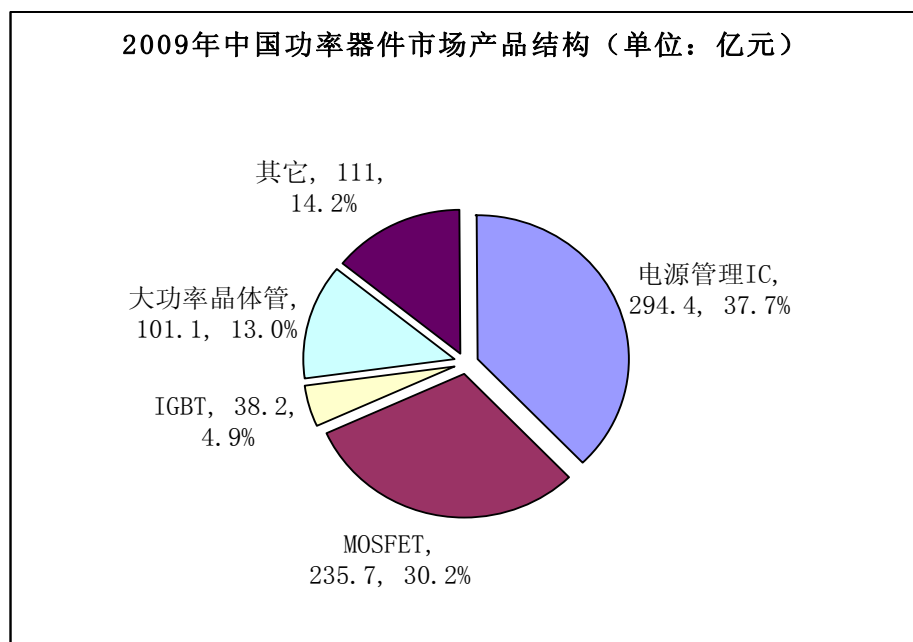
2004-2008 年中国 MOSFET 市场规模（数量）



2004-2008 年中国 MOSFET 市场规模（金额）



虽然 2009 年国内半导体行业受到金融危机的影响出现一定程度下降，但 2009 年中国 MOSFET 市场的需求额仍然达到了 235.7 亿元，占 2009 年中国功率器件市场容量的 30.2%，仅比 2008 年市场需求额下降了 0.55%，下降程度远低于其他半导体器件产品市场。从绝对数来看，国内 MOSFET 市场需求额仍是一个巨大的空间。



（2）替代进口机会

由于产业发展阶段的不同，目前国内半导体器件厂商与国外厂商在技术水平上还存在较大差距，特别是在高端半导体功率器件领域，因此上述 MOSFET 的巨大市场目前几乎完全被国外厂商占据，国内半导体企业生产的 VDMOS 产品基本上投放市场不久，还没有形成规模。

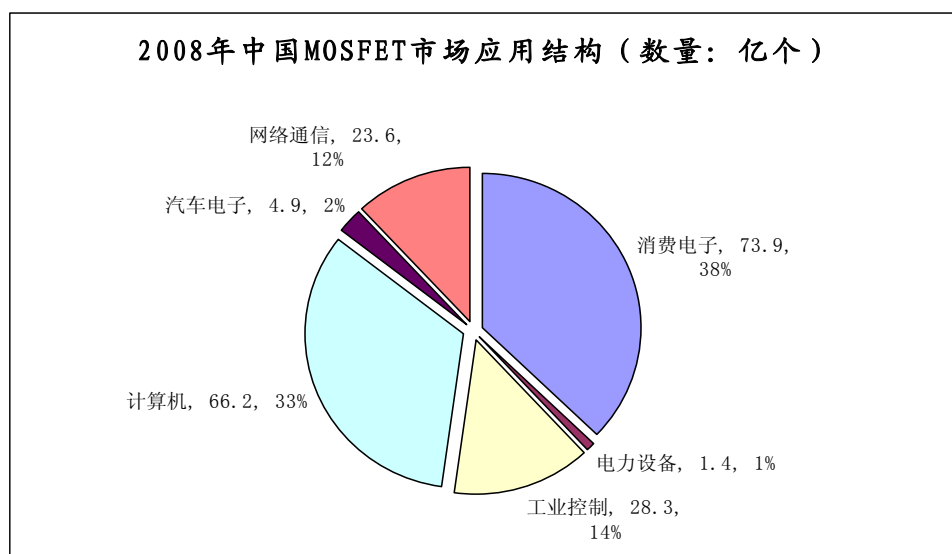
虽然国内企业对 MOSFET 的研制还处于起步阶段，但发展势头迅猛，由于本土企业在价格上的突出优势，在一些领域中本土企业的 MOSFET 产品有望快速切入。在本土企业的冲击下，市场竞争格局极有可能将重新洗牌。

（3）应用领域广泛

MOSFET 功率器件因其性能先进，又具有明显的节能、功能驱动作用，在绿色电源、通信及计算机电源、变频调速、感应加热、新型家电、电动交通工具等领域都有巨大的应用前景。

由于 MOSFET 在便携式产品、LCD 液晶显示器等消费电子产品中的广泛应用，使得消费电子成为 MOSFET 最大的应用市场。未来，中国笔记本产量仍将保持快速增长，电脑主板仍将成为中国 MOSFET 市场快速发展的主要推动力。因此，凭借着在电脑主板中的大量应用，计算机领域的 MOSFET 应用排在第二位，工业控制则是第三大应用领域。2008 年，这三大应用市场需求量达到 168.4 亿个，

占MOSFET市场容量的84.9%。



2009年，3G也成为MOSFET市场发展的亮点。随着3G市场的逐步启动，各大运营商也开始了3G基站的建设，直接带动了3G基站及相关通信电源和UPS对MOSFET的市场需求，市场在2009年出现了较快的增长，预计未来将会成为通信领域发展中的亮点。

除3G应用外，照明也成为MOSFET市场的又一发展亮点。随着世界各地都在努力减少温室气体的排放，各个国家正在逐步淘汰低效的白炽灯，积极推广节能灯和LED照明等高效节能产品。受此带动，电子整流器用MOSFET市场需求保持了较快的发展。而照明市场的另一个亮点则是LED照明，这其中LED路灯市场表现得最为突出。在LED路灯产品中，MOSFET主要用于电源系统。未来，随着LED发光效率的不断提升以及显色性能和散热问题的逐步改善，LED照明市场将逐步扩大。

根据产业研究机构LEDinside统计，中国2009年对LED路灯的总体需求量约20万到30万盏；由于LED路灯有节能及环保的优势，加之政府“十城万盏”（半导体照明应用工程）计划的逐步推广实施，预计2010年中国LED路灯的市场需求量可望超过40万盏，估计2012年后会更大规模采用，这将极大带动MOSFET市场的增长。

（4）未来市场发展迅速

据赛迪顾问预测，随着能源需求的不断增长和环境保护意识的不断提升，高效节能产品将成为市场发展的新趋势，未来 MOSFET 凭借着在计算机、消费电子、工业控制、通讯、照明等领域的广泛应用，到 2011 年市场容量将达到 342 亿元，比 2009 年实现大幅增长。

5、项目实施的有利条件

（1）技术优势

本项目主要产品都拥有自主知识产权，生产技术在沿用原有成熟的工艺生产技术的同时，加强新产品的研发生产。

公司的 18 名技术人员在奥地利 AMS 公司工艺现场接受了为期 30 天的技术培训，基本掌握了 VDMOS 超大规模集成电路制造工艺技术。此外，公司拥有多年制造微电子大功率器件和功率集成电路的技术和经验，加上自主研发的新工艺技术，为 VDMOS 的研发及产业化提供了有力的技术保障。

公司率先研制出 18 个型号的 VDMOS 系列产品并于 2008 年 3 月即实现销售，在国内众多的半导体生产厂商中脱颖而出，显示了公司在技术领先方面的优势。同行业开发 VDMOS 产品的几家上市公司中，华微电子于 2008 年 11 月完成了新型功率半导体器件项目（即 VDMOS）的通线任务，中环股份募投项目的功率器件生产线用于生产 MOSFET、肖特基二极管、整流二极管多个产品，2009 年 5 月完成建设了平面整流器件生产线建设并开始投产形成销售，6 月开发出适应于太阳能电池产业的大功率平面整流器件并开始投产，2009 年开始功率 6 吋芯片产品销售。

目前公司生产的 VDMOS 产品的性能指标已达到国内外先进技术水平，公司的产品性能已接近国际主要半导体器件生产厂家，个别产品性能指标优于部分国际先进厂家。目前，公司生产的 900V 的 VDMOS 产品、抗静电（ESD）的 VDMOS 产品、抗冲击（EAS）的 VDMOS 产品是工艺水平先进性较为突出的几种代表性产品。此外，随着公司对 VDMOS 不断进行深入研究，公司生产的 VDMOS 产品型号品种更加齐全，技术优势更加明显。

（2）成本优势

此外，公司的成本控制意识和能力较强，对已有产品不断精益求精进行工艺创新和改良，因此能始终保持显著的性能成本优势。目前公司研发人员在第一代 VDMOS 产品方案的基础上又改进了新的设计方案：采用了条形元胞结构，相对于采用其他元胞结构的器件，在抗 EAS 能力方面具有较大的优势；引入了多晶硅/体硅结构形成的二极管来泄放 ESD 电流，大大提高了器件抗 ESD 能力；并通过优化元胞的尺寸及工艺，降低了产品的导通电阻和输入电容，降低了产品工作时的温升，提高了整机系统的转换效率；此外，还采用了尺寸较小的场限环作为其保护环。这样，在相同规格的条件下，产品芯片面积较上一代降低了 25%，有效地降低了单只管芯的成本。

（3）销售渠道优势

公司采取以品牌、技术推产品的直销策略，能够对客户提出的产品设计需求、性能改进进行快速响应，有利于保持客户的稳定性，明显优于采取代理销售模式的半导体器件生产厂家。目前 VDMOS 产品已拥有了一百多家客户，随着公司在该产品市场上的品牌影响力不断增加，客户数量还在继续增加。

此外，公司在 VDMOS 产品的销售策略上采取新老产品之间进行互相促进的方法：由于 1300X 和 VDMOS 产品的客户有重合性，公司在 1300X 系列产品的营销过程中，也同时替公司的 VDMOS 产品做宣传，并成功发展出如晨怡(浙江)电子实业有限公司、杭州斌翔照明有限公司、安徽万德福电子有限公司等客户，因此能迅速打开 VDMOS 产品市场。

（4）质量控制优势

公司已通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证，产品通过美国 UL 安全认证、欧洲 ROHS 认证、PAHS 认证、德国莱茵 TUV 安规认证等，多年来通过改进结构版图设计、提高工艺水平、推广技术经验和操作诀窍、培训提高员工熟练程度等全方位的措施，公司的质量管理水平不断提高，产品全线合格率不断提升，产品质量得到众多客户的一致信赖。

公司目前采取的集芯片设计-芯片制造-封装测试-直销-售后服务于一体的垂直整合的生产经营模式有助于公司在质量控制上进行严格把握，并能根据客户的

需要对产品的性能改进、参数修正实现快速响应。

6、项目具体介绍

（1）项目投资概算情况

本项目总投资估算为 6,123 万元，其中建设投资 4,874 万元，铺底流动资金 1,249 万元，具体如下：

序号	项目	投资金额（万元）	所占比例
1	建筑工程费	0	0.00%
2	设备购置费	3,913	63.91%
3	安装工程费	580	9.47%
4	工具器具费	25	0.41%
5	其他费用	124	2.03%
6	预备费	232	3.79%
建设投资合计		4,874	79.60%
铺底流动资金		1,249	20.40%
项目总投资		6,123	100.00%

（2）产品技术水平、工艺流程和主要设备选择情况

①产品技术水平

本项目为技改项目，均利用公司现有技术进行。公司依托自身强大的科研力量，形成了一套具有完整自主知识产权的 VDMOS 生产技术，已成功开发出 18 种型号的系列产品，产品性能达到同行业先进水平。

②工艺流程

本项目的生产方法和工艺流程具体参见本招股说明书“**第六节 业务和技术/四、发行人主营业务的具体情况/（二）主要产品的工艺流程图**”。

③主要设备选型及投资估算情况

本项目在原有 182 台设备的基础上新增主要生产设备 20 台，其中关键生产设备需要进口，清单如下：

序号	设备名称	生产厂家	数量 （台）	单价 （万元）	金额 （万元）
----	------	------	-----------	------------	------------

1	*清洗机	Mercury	1	200	200
2	*刻蚀机	美国LAM研究公司	2	270	540
3	*离子注入机（高束）	美国伊通公司半导体设备分公司	2	400	800
4	*减薄机	迪思科科技有限公司	1	240	240
5	*扩散炉（3管）	布鲁斯国际技术公司	1	100	100
6	*溅射台（物理气相淀积）	美国材料研究公司	1	300	300
7	甩干机	北京华林伟业技术有限公司	3	3	9
8	显微镜	日本尼康公司仪器分公司	3	5	15
9	去离子水设备	江苏林格纯水设备有限责任公司	1	100	100
10	30m ³ 液氮储罐	张家港圣达因化工机械有限公司	1	65	65
11	空压机	阿特拉斯·科普柯公司	1	40	40
12	干燥机	纽曼泰克公司	1	10	10
13	真空泵	上海华盛真空设备	1	1	1
14	冷水机组	南京五洲制冷集团有限公司	1	48	48
总 计			20	-	2,468

注：*为进口二手设备

（3）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目所需的原材料主要为单晶外延片、引线框架、环氧树脂、光刻胶、扩散源、蒸发源、化学试剂等，全部在国内采购，供应渠道畅通，市场价格结算。

本项目消耗的能源主要为电、氮气、氧气。

①供电

本项目改造总用电装设功率为 2,461KW。本工程供电电源由园区变电站高压系统引来，采用两回 10KV 专用电缆线路供电。容量可以满足本项目用电需求。

②氮气

普氮采用液氮汽化的方式供应，液氮贮槽和汽化器均放置室外，主厂房设有气体纯化间，高纯氮由普氮经纯化后制得。

③氧气

高纯液氧采用汽化的方式供应，液氧贮槽和汽化器均放置室外，主厂房设有气体纯化间设终端气体纯化装置。

（4）环保情况

本项目加工过程中使用酸碱溶液、有机溶剂和氮、氢、氧等气体，对环境构成污染的主要有废水、废气、固体废弃物和噪声。

①废水处理

氢氟酸废水：采用投加氯化钙-凝聚剂-助凝剂化学沉淀法处理工艺。经过反应、凝聚、沉淀、过滤，最终达到要求的排放标准。

酸碱废水：采用中和凝聚沉淀法处理。经过 PH 调节、凝聚、沉淀，最终达到要求（使 PH 值在 6-9 范围内）的排放标准。

生活污水经化粪池处理，食堂排出含油污水经隔油池处理，通过厂区室外污水管网直接排入产业园区污水管网。

②废液处理

化学废液包括高浓度化学药液废液和溶剂废液（包括硫酸废液、磷酸废液、含氨废液、HF 废液、光刻胶废液），这些废液由专门的废液处理公司回收，进行再利用或销毁。

③废气处理

对产生有毒有害气体的工艺设备及房间，分别采取局部排风和全室通风。排出的气体分成两大类，一类为符合排放标准的可直接排出室外；一类为超过或接近排放标准而需要进行处理后才能排出室外，需处理类排风采用淋洗处理、喷化学液化学喷淋处理和吸附处理等方法，经处理后可达到国家规定的排放标准。

④噪声治理

本项目的噪声源主要来自后封装部分工艺设备以及冷冻机、各种泵、冷却塔和空调机组，按国家对噪声防治的要求，采取的主要措施有：设计中尽量选用高效能、低能耗、低噪声的设备；冷却塔、水泵等设备选用低噪声产品，需符合国家噪声标准；在水泵吸水管和出水管上设置可曲挠橡胶接头；选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头，对转速高的风机，采取隔声罩降低噪音；通风、空调系统风管上均安装消声器或消声弯头；空调机、冷冻机、离心式

排风机设减振台座；动力设备对环境的影响主要设备在运行过程中产生的噪声和振动，设计中采取设备减振、接管处设有橡胶或金属软管接头隔振，在吸气、排气处设置消声过滤器等措施；利用墙体屏蔽、建筑隔声降噪，对噪声较大的房间的门窗、墙采取隔音，以减少室内噪声和震动的传递，冷冻机、水泵等噪声较大的设备设在有隔声措施的隔间内。

⑤固体废弃物处理

化工原材料：由原材料供应厂家负责回收；对工艺中产生的废瓶、含毒废器皿等，收集在专用容器中，集中封存在化学品库中的废弃物暂存内，定期送有相关资质的单位进行处理或委托焚烧处理或安全填埋；污泥：污水处理产生的污泥、沉淀物，经过脱水、干燥和压滤，定期送有资质的单位处置；其他废料和废弃包装物：将集中送废品收购站回收利用；办公、生活垃圾由产业园区的环卫部门统一清运。

本项目已经宜兴市环境保护局审查批准，并由宜兴市环境保护局于 2010 年 3 月 19 日出具了宜环发（2010）第 16 号《关于江苏东光微电子股份有限公司新型功率半导体器件生产线技改项目环境影响报告表审批意见》，从环保角度同意该项目建设。

（5）项目选址及土地使用情况

本项目为技改项目，不需要新征用地，在公司现有新型功率半导体器件生产线区域内。

（6）项目的组织方式及实施进展

公司成立项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织设备采购，安装调试等工作。

本次技改实施后需新增员工100人，其中管理人员10人、生产人员90人，生产线实行三班倒生产。

本项目建设期为1年，生产第一年达产率约为70%，生产第二年以后各年达产率100%。预计实施进度如下：

实 施 进 度 表

序号	时间（1个月/格） 名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	初步设计及审批														
2	施工图设计														
3	设备订货														
4	设备验收														
5	设备安装调试														
6	人员培训														
7	系统试运行														
8	项目投产														

(7) 项目经济效益分析

经测算，项目达产后的正常年销售收入 13,300 万元，年利润总额 3,657 万元；税后财务内部收益率为 42.23%；税后财务净现值为 10,755 万元；税后投资回收期为 3.84 年。

本项目主要经济指标详见下表：

序号	项目	单位	指标	备注
1	项目总投资	万元	6,123	
1.1	建设投资	万元	4,874	
1.2	铺底流动资金	万元	1,249	
2	营业收入	万元	12,901	各年平均值
3	营业税金及附加	万元	109	各年平均值
4	总成本费用	万元	9,267	各年平均值
5	利润总额	万元	3,525	各年平均值
6	所得税	万元	529	各年平均值，按15%的税率计算
7	净利润	万元	2,996	各年平均值
8	总投资收益率	%	57.57	税前利润/总投资
9	总投资利税率	%	75.57	
10	资本金净利润率	%	48.94	
11	总成本利润率	%	38.04	
12	销售利润率	%	27.32	
13	盈亏平衡点	%	31.40	达产年值
14	投资回收期	年	3.51	所得税前
		年	3.84	所得税后
15	财务净现值	万元	11,933	i=12%所得税前
		万元	10,755	i=12%所得税后
16	财务内部收益率	%	49.37	所得税前
		%	42.23	所得税后

综上所述，本项目经济效益显著。

（三）半导体封装生产线项目

1、项目概况

本项目为公司新建一条半导体封装生产线，项目建成后公司将新增半导体封装测试能力6.5亿只/年，主要用于公司内部配套。

公司于2009年12月1日设立了一家全资子公司——宜兴市东晨电子科技有限公司，注册资本1,800万元，主要从事半导体芯片封装业务，公司计划未来的封装工序全部由东晨电子来完成。本募投项目半导体封装生产线项目的实施主体为东晨电子，公司将通过增资的方式将募集资金注入东晨电子。

公司目前的主要产品分四大系列，包括电子电器设备用半导体防护功率器件系列产品、VDMOS列产品、可控硅系列产品和1300X系列产品，各自的年产能分别为1.3亿只、1亿只、0.8亿只和1.2亿只，共计4.3亿只。而公司目前仅有一条小型封装生产线，现有封装能力极为有限，仅为1.3亿只/年，2009年公司自行完成封装1.26亿只，仅占公司现有产能的30%，防护器件产品中只有SA型号的放电管在公司内部自行完成封装，可控硅系列产品只有13.80%由公司自行封装，1300X系列产品仅有0.09%由公司自行封装；其余的芯片均需要委托专业封装厂进行加工。另外，公司本次募集资金投资项目之一为新建一条半导体防护功率器件生产线，将新增产能2.22亿只/年；募集资金投资项目之二为对VDMOS产品生产线的产能瓶颈进行技改，将释放产能1.4亿只/年。因此上述项目全部建成投产后，公司的总体产能将达到7.92亿只/年，公司现有的封装产能与公司前道芯片生产工序的生产能力严重不匹配。公司本次募集资金投资的半导体封装生产线能够在现有封装能力1.3亿只/年的基础上新增6.5亿只/年，公司的封装能力将达到7.8亿只/年，能够整体满足公司扩产后对封装的需求。

公司生产的半导体防护功率器件系列产品中SA系列半导体固体放电管采用夹持式封装形式，DP系列固体放电管采用DO-214贴片封装形式，过电压过电流保护IC和过电压保护IC主要采用TO-220系列和TO-126系列封装形式，VDMOS列产品、可控硅系列产品和1300X系列产品主要采用TO-220系列和

TO-126 系列封装形式。根据公司的实际情况以及市场需求，本次新建的半导体封装生产线仍采用夹持式、DO-214、TO-126 和 TO-220 的封装形式，各种封装形式计划的封装数量如下：

序号	封装形式	数量（亿只/年）
1	夹持式	0.5
2	DO-214	1.5
3	TO-126	1.5
4	TO-220	3.0
	合计	6.5

2、项目建设的必要性

（1）降低生产成本，提高公司盈利能力

封装测试工序是公司半导体器件产品重要的制造环节，由于公司自身封装能力的严重不足，大部分产品不得不委托专业封装企业进行封装加工，因此公司的封装成本相对较高，2007 年、2008 年和 2009 年封装成本占公司当期采购总额的比重分别为 42.36%、37.40%和 39.81%。

假设新增年封装 6.5 亿只芯片的生产能力，委外封装和自行封装的费用对比如下：

芯片委外封装加工费用表

封装形式	数量	加工单价（含税）	总价	备注
夹持式	0.5 亿只	0.12 元/只	600 万元	
DO-214	1.5 亿只	0.15 元/只	2,250 万元	
TO-126	1.5 亿只	0.15 元/只	2,250 万元	
TO-220	3 亿只	0.27 元/只	8,100 万元	
合计	6.5 亿只	0.203 元/只	13,200 万元	
单只均价			0.203 元/只	含税价
			0.174 元/只	不含税价

芯片自行封装加工费用表

封装形式	数量	生产成本（不含税）	总价	备注
夹持式	0.5 亿只	0.07 元/只	350 万元	
DO-214	1.5 亿只	0.10 元/只	1,500 万元	
TO-126	1.5 亿只	0.10 元/只	1,500 万元	
TO-220	3 亿只	0.18 元/只	5,400 万元	
合计	6.5 亿只	0.135 元/只	8,750 万元	

单只均价	0.135 元/只	不含税价
------	-----------	------

从以上两表的对比可以看出，本项目的实施，每年将为公司节约成本 $(0.174-0.135) \times 6.5 = 0.2535$ 亿元。此外，以上外协加工的价格为原有长年合作外包企业提供给公司的常年合作封装价格，价格相对优惠，随着公司产能的扩大，原有合作方的封装能力可能无法满足扩产后的产能需要，公司必须寻找新的封装企业，封装价格可能要提高 5%~10%。以 TO-220 形式的封装为例，若委托非公司合作方的封装企业封装，其外协加工单价为 0.35 元/只（含税价），不含税价为 0.30 元/只，而自行加工单价仅为 0.18 元/只，成本优势极为显著。

（2）加强产品质量控制，提高公司核心竞争力

产品质量是公司赖以生存的源泉，公司自设立以来就非常重视公司产品质量的控制，也正是由于严格的产品质量控制，公司才能在国内半导体器件行业的防护功率器件和 VDMOS 等领域的细分市场保持领先地位。一直以来由于受到资金的限制，公司没有新增半导体封装生产线，扩大封装的产能，公司现有封装能力仅为 1.3 亿只/年，公司大部分产品的封装需要通过委托专业封装厂进行加工封装。尽管公司在对委托加工方的选择，委托加工产品质量检查等方面进行了严格的控制和把关，但是由于公司无法直接控制委托加工产品的具体生产过程，因此无法全面控制产品的质量。本项目实施后，公司的封装能力能够完全满足扩产后公司全部产品的封装需求，公司生产的产品全部可以由公司自行封装，进一步加强了产品质量控制，增强了公司的竞争力。

（3）加强封装时间进度控制，有效提升公司产品的生产效率

公司的大部分产品需要委托专业封装厂进行加工封装，因此在封装时间的进度上很难控制，特别是在封装需求旺盛的时候，会出现由于封装厂订单已满无法为公司的产品马上进行封装的现象，以至于耽误公司产品的完工和销售。例如 2009 年四季度开始，半导体行业开始步出金融危机的影响，市场需求快速增长，很多封装厂由于订单已满，公司出现短时间内找不到封装厂封装的情况，对公司经营产生了一定的影响。本项目实施后，公司的封装能力能够完全满足扩产后公司全部产品的封装需求，公司生产的产品全部可以由公司自行封装，进一步加强了封装时间进度的控制，有效提升了公司产品的生产效率。

3、项目建设的可行性

（1）公司产品市场需求较大

本项目建成后公司新增的半导体封装测试年产能6.5亿只，主要用于公司产品的内部配套。公司主要产品包括电子电器设备用半导体防护功率器件系列产品、VDMOS系列产品、可控硅系列产品和1300X系列产品，均具有较好的市场前景，市场需求较大。

防护功率器件系列产品是公司的主打产品，在国内通讯领域防护器件市场占有率有绝对的优势地位，2009年该领域市场占有率达到80%以上。就通讯用防护器件本身的市场前景而言，短期来看，未来几年固体放电管将逐步替代电信领域正在使用的气体放电管，因此公司生产的固体放电管具有较大的市场需求；另外公司新开发的产品P61089即将投入市场，开拓程控交换机二级防护市场，替代国外进口产品，公司半导体功率防护器件产品的市场需求将进一步扩大。长期来看，随着3G网络、宽带通讯、网络电视和计算机技术的发展，半导体防护功率器件在程控交换机、机顶盒、Modem、ADSL、路由器、宽带交换设备等领域的应用和需求越来越大；同时，随着国内防护意识的不断加强和安防要求的提高，半导体防护功率器件在家电、家用电路、电表等领域的应用将随着扩大，将直接带动防护功率器件的市场需求大幅增长。

VDMOS系列产品是公司现阶段重点发展的产品，也是半导体器件行业的高端产品，市场需求较大，而目前国内绝大部分依赖于进口。2008年、2009年、2010年1-6月公司VDMOS产品的销量分别为1,867.95万只、4,349.50万只、3,325.56万只，拥有客户一百多家。目前由于公司VDMOS生产线存在生产工序设备瓶颈问题无法实现大规模生产，待VDMOS解决产能瓶颈后，预计未来市场发展前景广阔。

（2）技术成熟

本项目的封装形式主要包括DO-214、TO-220系列、TO-126系列和夹持式，均为非常成熟的封装工艺，目前公司已有一条小型封装生产线，能够进行上述封装形式的封装，因此公司已经完全掌握了此种封装技术。

（4）实施本项目不需另征用土地，在现有公司的空地上建设。

4、项目具体介绍

（1）项目投资概算情况

本项目总投资估算为 7,143 万元，其中建设投资 6,150 万元，铺底流动资金 993 万元，具体如下：

序号	项目	投资金额（万元）	所占比例
1	建筑工程费	1,575	22.05%
2	设备购置费	3,460	48.44%
3	安装工程费	205	2.87%
4	工具器具费	48	0.67%
5	其他费用	406	5.68%
6	预备费	456	6.38%
建设投资合计		6,150	86.10%
铺底流动资金		993	13.90%
项目总投资		7,143	100.00%

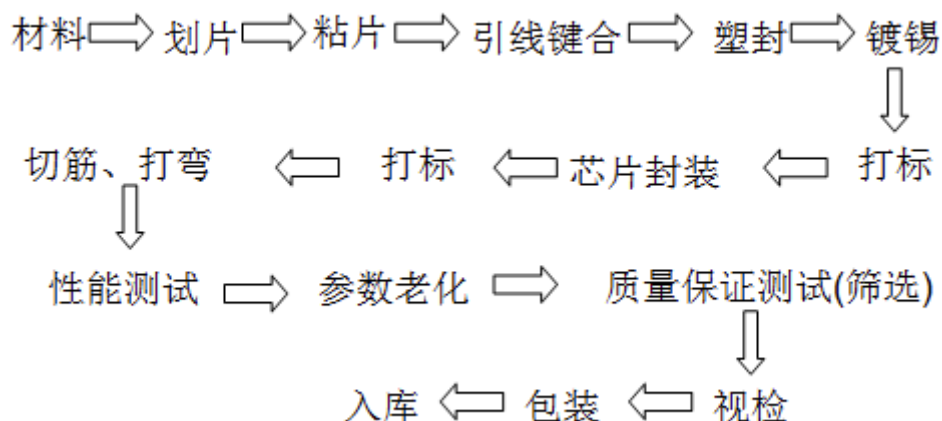
（2）产品技术水平、工艺流程和主要设备选择情况

①产品技术水平

本项目的封装形式为DO-214、TO-126、TO-220和夹持式四种，均为非常成熟的封装工艺，公司目前已有一条小型封装生产线，能够生产上述四种封装形式，本次募投项目没有新增封装形式，只是产能规模的扩张，因此可以沿用公司现有工艺生产技术，不存在技术障碍问题。

②工艺流程

半导体芯片封装测试典型工艺流程如下：



注：镀锡采用外协加工方式完成。

④ 要设备选型及投资估算情况

本项目拟新增主要生产设备及仪器共计 137 台，具体如下：

序号	设备名称	生产厂家	数量 (台)	单价 (万元)	金额 (万元)
1	贴片机	大连佳峰电子有限公司	17	32.00	544.00
2	键合机（半自动）	深圳市微迅自动化设备有限公司	55	5.40	297.00
3	键合机（全自动）	Oerlikon ESEC 半导体公司	6	80.00	480.00
4	激光打印机	南京中南激光设备有限公司	4	12.00	48.00
5	注塑机	上海日申机械设备有限公司	10	22.00	220.00
6	预热机	上海日申机械设备有限公司	10	2.50	25.00
7	切筋机（半自动）	上海日申机械设备有限公司	6	3.00	18.00
8	切筋机（全自动）	上海日申机械设备有限公司	4	35.00	140.00
9	模具	安徽铜凌模具有限公司	17	20.00	340.00
10	去毛刺机	上海新阳半导体材料股份有限公司	4	20.00	80.00
11	焊结炉	青岛圣豪微电子有限公司	2	15.00	30.00
12	全自动测试编带一贯机	台湾健鼎科技股份有限公司	2	85.30	170.60
总 计			137	-	2,392.60

（3）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目所需的原材料主要为引线框架、环氧树脂、焊丝和电镀外协等，供应渠道畅通，市场价格结算。

本项目消耗的能源主要为电、水、压缩空气、氮气和真空。

①供电

本项目总用电装设功率为 2,292KW。本工程供电电源由园区变电站高压系统引来，采用两回 10KV 专用电缆线路供电。容量可以满足本项目用电需求。

②给水

项目生产生活用水由市政自来水供水管网供应。厂区拟从市政接入两条给水管线，管径 DN200，市政给水压力按照 0.2MPa 考虑。本期工程全厂日用水量约为 150m³/d。

所需工艺冷却水直接使用冷冻机换热。所需初级纯水由公司纯水站提供，并设置纯水抛光系统，车间配水管道采用大循环供水方式。

③压缩空气

设空压站，选用冷无油螺杆式空压机及后处理装置、过滤器过滤后管道供应。

④氮气

普氮采用液氮汽化的方式供应，液氮贮槽和汽化器均放置室外，主厂房设有气体纯化间，高纯氮由普氮经纯化后制得。

⑤真空

设真空泵房，内设真空泵，管道供应。

（4）环保情况

本项目主要污染源为：废水、废气、固体废弃物和噪声。

废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要包括划片废水、废气洗涤塔排水、纯水制备废水、冷却塔排水和洗衣废水。废水的处理措施：生活污水经化粪池处理，通过厂区室外污水管网直接排入工业区污水管；车间生产废水经处理后回用到纯水制备系统，部分生产废水经处理达标后排放至市政污水管道。

生产过程中产生的废气主要为一般废气、塑料废气。废气体的处理措施：设

置一般排风系统为消除工艺设备等散发的热气；对于其他废气如塑封废气，塑封工序设备密闭，不会散发到空气中，塑封工序产生的异味，设计中加强塑封车间的设备局部排风。

本项目生产工艺设备均置于洁净厂房内，且噪声级较小，其噪声源主要是冷冻机组、空压机、真空泵、风机、水泵等辅助动力设备，噪声级分别在 75-95dB（A）范围之间。噪声处理措施：设计中尽量选用高效能、低能耗、低噪声的设备；冷却塔、水泵等设备选用低噪声产品，需符合国家噪声标准；在水泵吸水管和出水管上设置可曲挠橡胶接头；纯水站 RO 供给泵噪声稍大些，可采取隔声措施，放在隔间内；选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头，对转速高的风机，采取隔声罩降低噪音；通风、空调系统风管上均安装消声器或消声弯头，对冷却塔安装隔声屏；空调机、冷冻机、离心式排风机设减振台座；利用墙体屏蔽、建筑隔声降噪，对噪声较大的房间的门窗、墙采取隔音，以减少室内噪声和震动的传递，冷冻机、水泵等噪声较大的设备设在有隔声措施的隔间内。

固体废物主要为生活垃圾和一般工业固废。固体废弃物的处置措施：一般工业固废：切筋成型工序产生的边角料、不合格品等由专业公司回收；对工艺中产生的危险废物：废机油、废水处理污泥、废环氧树脂等由专业公司处理。对生活垃圾由产业园区的环卫部门统一清运。

本项目已经宜兴市环境保护局审查批准，并由宜兴市环境保护局于 2010 年 3 月 19 日出具了宜环发（2010）第 18 号《关于江苏东光微电子股份有限公司半导体封装生产线项目环境报告表审批意见》，从环保角度同意该项目建设。

（5）项目选址及土地使用情况

本项目将在公司现有土地上进行建设，土地已取得《土地使用权证》（宜国用 2009 字第 28600002 号），土地取得方式为出让，用途为工业用地。

（6）项目的组织方式及实施进展

公司成立项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试

等工作。

项目建设完成投产后，共需人员400人，其中管理人员10人、技术人员30人、生产及辅助人员共计360人，生产线实行三班倒生产。

本项目建设期为1.5年，第二年下半年投产，生产第一年达产率约为70%，生产第二年以后各年达产率100%。预计实施进度如下：

实 施 进 度 表

序号	时间（1个月/格） 名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	可行性研究报告编制及审批	■	■																						
2	环评报告编制及审批	■	■																						
3	初步设计及审批			■	■	■																			
4	施工图设计				■	■	■	■	■																
5	工程施工							■	■	■	■	■	■	■	■										
6	设备订货							■	■	■	■	■	■	■											
7	设备验收												■	■	■										
8	设备安装调试														■	■	■	■	■						
9	人员培训															■	■	■	■	■					
10	系统试运行																		■	■	■				
11	项目投产																				■	■	■	■	■

（7）项目经济效益分析

经测算，项目达产后的正常年销售收入 11,050 万元，年利润总额 1,713 万元；税后财务内部收益率为 17.59%；税后财务净现值为 2,082 万元；税后投资回收期为 6.78 年。

本项目主要经济指标详见下表：

序号	项目	单位	指标	备注
1	项目总投资	万元	7,143.00	
1.1	建设投资	万元	6,150.00	
1.2	铺底流动资金	万元	993.00	
2	营业收入	万元	10,719.00	各年平均值
3	营业税金及附加	万元	76.00	各年平均值
4	总成本费用	万元	9,029.00	各年平均值
5	利润总额	万元	1,613.00	各年平均值
6	所得税	万元	242.00	各年平均值，按15%税率计算
7	净利润	万元	1,371.00	各年平均值

8	总投资收益率	%	22.58	税前利润/总投资
9	总投资利税率	%	33.38	
10	资本金净利润率	%	19.19	
11	总成本利润率	%	17.86	
12	销售利润率	%	15.05	
13	盈亏平衡点	%	56.51	达产年值
14	投资回收期	年	6.23	所得税前
		年	6.78	所得税后
15	财务净现值	万元	2,909.00	i=12%所得税前
		万元	2,082.00	i=12%所得税后
16	财务内部收益率	%	20.62	所得税前
		%	17.59	所得税后

综上所述，本项目经济效益显著。

三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投入使用并产生预期效益后，有利于优化本公司的资产负债结构，并进一步提升公司的盈利能力。

（一）对财务状况的影响

1、对净资产和每股净资产的影响

本次募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增加，增强公司资金规模和实力，能够提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。

2、对资产负债率的影响

本次募集资金到位后，公司资产负债率将显著降低，可以优化资本结构，提高公司长期偿债能力，减少经营风险。

3、对净资产收益率的影响

本次募集资金到位后，由于净资产大幅增加，而盈利能力不会即时显现，因此短期资产收益率在短期内将会降低。预计随着募集资金投资项目投产并产生效益，公司的销售收入和利润总额将以较快速度增长，净资产收益率也将回升至较高水平。

（二）对经营成果的影响

本次募集资金的运用将新增公司半导体防护功率器件的产能，半导体防护功率器件产品是公司的主要优势产品，在通讯领域防护器件市场占有绝对的优势地位，且该产品具有较高的毛利率，产能的扩大有利于公司进一步扩大防护器件产品的市场规模，提高市场占有率，提升公司的盈利水平。

本次募集资金的运用将解决 VDMOS 生产线工序设备的瓶颈问题，释放 VDMOS 的产能。VDMOS 产品是半导体器件行业的高端产品，市场需求较大，VDMOS 产能释放后，有利于公司发挥规模效应，降低生产成本，进一步提升公司的盈利能力和市场地位。

本次募集资金的运用将提升公司半导体封装能力，满足公司自行封装需求，有利于公司进一步加强产品质量控制和时间进度控制，降低生产成本，从而有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

（三）新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次募集资金投资于新建一条半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目和新建一条半导体封装生产线项目，分别将形成固定资产 3,878 万元、4,874 万元和 6,150 万元，共计 14,902 万元，根据公司目前的固定资产折旧政策（建筑物折旧年限为 20 年，生产设备折旧年限 10 年，净残率均为 5%），项目建成后每年新增固定资产折旧分别为 308 万元、463 万元和 497 万元，共计 1,268 万元。由于短期内募投项目建成后完全达产需要一定的时间，因此在建成投产后的一段时间内新增固定资产折旧将影响到公司净利润水平。

项目完全达产后，上述三个募集资金投资项目将年新增营业利润总计 8,118 万元，远远超过三个项目新增固定资产折旧费用，因此新增固定资产折旧对公司未来经营成果不产生影响。

第十四节 股利分配政策

一、公司最近三年股利分配政策

本公司的股利分配遵循同股同利的原则，按各股东所持股份数额分配股利。股利分配采取现金、股票等形式。在每个会计年度结束后的六个月内，由董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出股利分配方案，经股东大会批准后实施。

本公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。本公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序和比例分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%。

二、最近三年实际股利分配情况

本公司最近三年未进行利润分配。

三、发行前滚存利润的分配安排

本公司2009年年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成后以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由股票发行后的新老股东共享。

四、发行后的股利分配政策

本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。股利的具体分配方式和比例，董事会将根据实际盈利情况和公司发展对资金的需求提交分配预案，由股东大会审议通过后执行。

第十五节 其他重要事项

一、有关信息披露和投资者关系的联系方式

为保护投资者的合法权利，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定：董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露制度，接待来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露。

本公司董事会秘书周玲燕，对外联系电话：0510—87138930，传真：0510—87138931。

二、重要合同

截至本招股说明书签署之日，本公司正在履行的交易金额在500万元以上或者虽未超过500万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）销售合同

1、VDMOS产品销售合同

（1）2009年12月15日，发行人与深圳市杰坤电子有限公司签订《2010年合作计划合同》，约定发行人2010年向需方提供场效应晶体管、三极管产品的年度销售总金额约1200万元，具体单价、数量及交货期按照双方具体签订的合同执行，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（2）2010年1月5日，发行人与帝闻电子（深圳）有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供VDMOS产品，付款方式为需方在收货后满60天的一周内付清货款，合同总金额为723万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（3）2010年1月12日，发行人与禾祥电子（深圳）有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供VDMOS产品，付款方式为需方在收货后满30天的一周内付清货款，合同总金额为910万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（4）2010年2月2日，发行人与深圳欧陆通电子有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供VDMOS产品，付款方式为需方在收货后满60天的一周内付清货款，合同总金额为650万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（5）2010年3月10日，发行人与深圳利能达实业有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单的规格型号、数量提供VDMOS产品，付款方式为需方在收货后满90天的一周内付清货款，合同总金额为605万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

2、防护器件产品销售合同

（1）2010年2月1日，发行人与深圳市菲菱科思通信技术有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供固体放电管产品，付款方式为需方在收货后满90天的一周内付清货款，合同总金额为1,075万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（2）2010年2月1日，发行人与深圳市中兴新地通信器材有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供固体放电管产品，付款方式为需方在收货后满120天的一周内付清货款，合同总金额为1,680万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（3）2010年2月1日，发行人与深圳日海通讯技术股份有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供固体放电管产品，付款方式为需方在收货后满150天的一周内付清货款，合同总金额为1,170万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（4）2010年3月1日，发行人与江苏安华通信设备有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单的规格型号、数量提供SA产品，付款方式为需方在收货后满90天的一周内付清货款，合同总金额为789万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

3、可控硅产品销售合同

（1）2010年1月1日，发行人与江苏金鼎电器有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供可控硅产品，付款方式为需方在收货后满90天后的一周内付清货款，合同总金额为550万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（2）2010年2月25日，发行人与深圳市申欣电子有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供不少于550万只的可控硅产品，付款方式为需方在收货后满90天的一周内付清货款，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（3）2010年2月28日，发行人与常熟市天银机电有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供1500万只的可控硅产品，付款方式为需方在收货后满90天的一周内付清货款，合同总金额为1500万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（4）2010年2月28日，发行人与苏州意得贸易有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供400万只的可控硅产品，付款方式为需方在收到供方的增值税专用发票后满90天后的一周内付清货款，合同总金额为564万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（5）2010年3月1日，发行人与苏州工业园区华丰电子有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供400万只的可控硅产品，付款方式为需方在收到供方的增值税专用发票后满90天后的一周内付清货款，合同总金额为610万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

4、1300X系列产品销售合同

（1）2010年1月5日，发行人与晨怡（浙江）电子实业有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供三极管产品，付款方式为需方在收到供方的增值税专用发票后满90天的一周内付清货款，合同总金额为1000万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（2）2010年3月9日，发行人与嵊州市明升照明电子有限公司签订《买卖合同》，约定发行人按照需方订单要求的规格型号、数量提供三极管产品，付款方式为需方在收到供方的增值税专用发票后满14天后的一周内付清货款，合同总金额为500万元，合同有效期为1年，到期日30天前双方若均无终止合同的意思表示，本合同可自动延续。

（二）采购合同

1、2010年1月，发行人与河北普兴电子科技股份有限公司签订《硅外延片销售合同》，约定发行人向供方采购硅外延片，单价为158元/片，采购数量5000片/月，价格随市场调节，通过银行予以结算，合同有效期为2010年1月至2010年12月。

2、2010年1月5日，发行人与南京国盛电子有限公司签订《2010年销售合同》，约定发行人向供方采购VDMOS用外延片，单价为160元/片，采购数量5000片/月，价格随市场调节，付款方式为开票之日起净90日内银行承汇或电汇付款，合同有效期为2010年1月至2010年12月。

3、2010年3月7日，发行人与杭州海纳半导体有限公司签订《产品购销合同》，约定发行人按每月经供方确认的订单向对方采购单晶硅片物料，价格随市场调节，付款期限为月结75天，结算方式为电汇或支付银行承兑汇票，合同有效期为1年。

4、2010年3月11日，发行人与中国电子科技集团公司第四十六研究所签订《2010年供货合同》，约定发行人向供方采购硅磨片，单价为27.5/片，采购数量18000片/月，价格随市场调节，通过银行予以结算。

（三）委托加工合同

1、2010年2月1日，发行人与品捷电子（苏州）有限公司签订《委托加工技术协议书》，约定由发行人提供符合生产工艺的合格芯片，以封装加工单的形式提供所加工产品的技术标准、测试参数，委托对方加工，协议对封装的形式及单价做出了明确规定，加工费每月计算一次，全年预计加工费为800万元，结算账期为当月开票，月结30天，结算方式为20%电汇，其余支付承兑汇票。

2、2010年2月1日，发行人与无锡市勋达无线电厂签订《委托加工技术协议书》，约定由发行人提供符合生产工艺的合格芯片，以封装加工单的形式提供所加工产品的技术标准、测试参数，委托对方加工，协议对封装的形式及单价做出了明确规定，加工费每月计算一次，全年预计加工费为800万元，结算账期为票到3个月，每月10日为付款日期。

3、2010年3月1日，发行人与无锡市三日电子有限公司签订《委托加工技术协议书》，约定由发行人提供符合生产工艺的合格芯片，以封装加工单的形式提供每个产品的加工数量、技术标准、测试参数，委托对方加工，协议对封装的形式及单价做出了明确规定，加工费每月计算一次，全年预计加工费为1500万元，结算账期为票到3个月，每月10日为付款日期。

4、2010年3月1日，发行人与宜兴市旭日电子有限公司签订《委托加工技术协议书》，约定由发行人提供符合生产工艺的合格芯片，以封装加工单的形式提供所加工产品的技术标准、测试参数，委托对方加工，协议对封装的形式及单价做出了明确规定，加工费每月计算一次，全年预计加工费为2000万元，结算账期为票到45天，每月10日为付款日期。

（四）借款合同

1、2010年7月20日，发行人与中国建设银行股份有限公司宜兴支行签订编号GLDK-C4062-2010-JB07的《人民币资金借款合同》，约定贷款人自2010年7月20日至2011年7月19日，向发行人提供金额为2000万元的借款，用于流动资金周转，按浮动利率计息。

2010年7月20日，江苏远方迪威尔容器有限公司与中国建设银行股份有限

公司宜兴支行签订编号 GLDK-C4062-2010-JB07 的《保证合同》，为发行人上述借款提供 1000 万元借款连带责任保证担保。

2010 年 7 月 20 日，江苏宏盛化学有限公司与中国建设银行股份有限公司宜兴支行签订编号 GLDK-C4062-2010-JB07 的《保证合同》，为发行人上述借款提供 1000 万元借款连带责任保证担保。

2、2009 年 11 月 19 日，发行人与中国建设银行股份有限公司宜兴支行签订编号 GLDK-C4062-2009-JB1102 的《人民币资金借款合同》，约定贷款人自 2009 年 11 月 24 日至 2010 年 11 月 23 日，向发行人提供金额为 800 万元的借款，用于购买材料，借款利率为固定利率，起息日基准利率下浮 10%。

2009 年 11 月 19 日，发行人与中国建设银行股份有限公司宜兴支行签订编号为 GLDK-C4062-2009-JB1102 的《抵押合同》，约定发行人为上述借款项下本金 800 万元及利息等提供抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用(2006)字第 000089 号）和房产所有权（房产证号为宜房权证宜城字第 1000012760 号、宜房权证宜城字第 1000012761 号、宜房权证宜城字第 1000012764 号、宜房权证宜城字第 1000012770 号、宜房权证宜城字第 1000012775 号）。

3、2010 年 1 月 19 日，发行人与中国建设银行股份有限公司宜兴支行签订编号 GLDK-C4062-2010-JB0102 的《人民币资金借款合同》，约定贷款人自 2010 年 1 月 19 日至 2011 年 1 月 18 日，向发行人提供金额为 1000 万元的借款，用于流动资金周转，借款利率为固定利率，起息日基准利率下浮 10%。

2010 年 1 月 19 日，发行人与中国建设银行股份有限公司宜兴支行签订编号为 GLDK-C4062-2010-JB0102 的《最高额抵押合同》，约定发行人为上述借款项下本金 1000 万元及利息等提供抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用(2009)字第 28600002 号）。

4、2009 年 9 月 30 日，发行人与江苏宜兴农村合作银行新世纪支行签订编号（63）宜合银借字[2009]第 A026 号的《最高额借款合同》，约定贷款人自 2009 年 9 月 30 日至 2011 年 9 月 30 日，根据发行人的需要、资信状况和担保情况等

向发行人提供最高贷款余额不超过 2000 万元的贷款，每笔借贷款的种类、金额、期限、用途、利率、和还款方式以借款凭证为准，按月结息，结息日为每月的第 20 日。

2009 年 9 月 30 日，江苏南方涂装环保股份有限公司、李爱军、吴菊芳与江苏宜兴农村合作银行新世纪支行签订了编号为（63）宜合银高保字【2009】第 A026-1 号《最高额保证合同》，为发行人自 2009 年 9 月 30 日至 2011 年 9 月 30 日止发生的最高余额限定为 1000 万元的借款提供连带责任保证担保。

5、2010 年 3 月 10 日，发行人与江苏宜兴农村合作银行新世纪支行签订了编号为（63）宜合银借字【2010】第 A012 号《最高额借款合同》，约定贷款人自 2010 年 3 月 10 日至 2012 年 3 月 10 日，根据发行人的需要、资信状况和担保情况等向发行人提供最高贷款余额不超过 1000 万元的贷款，每笔借贷款的种类、金额、期限、用途、利率、和还款方式以借款凭证为准，按月结息，结息日为每月的第 20 日。

2010 年 3 月 10 日，江苏宏盛化学有限公司与江苏宜兴农村合作银行新世纪支行签订了《最高额保证合同》，为发行人上述借款提供连带责任担保。

6、2010 年 8 月 4 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 0360190D10080301 的《人民币借款合同（短期）》，约定贷款人向发行人提供金额为 500 万元的借款，用途为流动资金，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，借款利率为固定利率，年利率 5.31%。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-1 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12 月 9 日起至 2011 年 12 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 810.37 万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第 000596 号）。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-2 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12

月9日起至2011年12月9日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为172.57万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第000548号）。

2009年12月9日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68200911032-3号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自2009年12月9日起至2011年12月9日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为397.88万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第000549号）。

2010年6月22日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68201006005号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为G-68-D-2009-014、0360190D09121101的《人民币借款合同（短期）》及自2010年6月22日起至2012年6月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为1,460.80万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的厂房。

2009年12月30日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68200912013号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为0360190D09121101的《人民币借款合同（短期）》及自2009年12月30日起至2011年12月30日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为35,003,100元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分设备。

7、2009年12月14日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号0360190D0121101的《人民币借款合同（短期）》，约定贷款人向发行人提供金额为870万元的借款，用途为补充企业流动资金，借款期限为12个月，自实际提款日起算，借款利率为固定利率，年利率5.31%。

2009年3月3日，沈建平、梁夕芬与中国银行股份有限公司宜兴支行签订了编号为68200902004号《最高额保证合同》，为发行人2009年2月25日至2011

年 2 月 25 日止签署的最高本金余额为 4500 万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任保证。

2010 年 6 月 22 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68201006005 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为 G-68-D-2009-014、0360190D09121101 的《人民币借款合同（短期）》及自 2010 年 6 月 22 日起至 2012 年 6 月 21 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 1,460.80 万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的厂房。

2009 年 12 月 30 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200912013 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为 0360190D09121101 的《人民币借款合同（短期）》及自 2009 年 12 月 30 日起至 2011 年 12 月 30 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 35,003,100 元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分设备。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-1 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12 月 9 日起至 2011 年 12 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 810.37 万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第 000596 号）。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-2 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12 月 9 日起至 2011 年 12 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 172.57 万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第 000548 号）。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-3 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12

月9日起至2011年12月9日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为397.88万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第000549号）。

2009年12月30日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68200912013号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为0360190D09121101的《人民币借款合同（短期）》及自2009年12月30日起至2011年12月30日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为35,003,100元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分设备。

8、2010年3月9日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号0360190D10030801的《人民币借款合同（短期）》，约定贷款人向发行人提供金额为1,380万元的借款，用途为补充流动资金，借款期限为12个月，自实际提款日起算，借款利率为固定利率，年利率5.31%。

2009年12月31日，沈建平、梁夕芬与中国银行股份有限公司宜兴支行签订了编号为68201002001的《最高额保证合同》，为发行人自2009年12月31日至2011年12月31日止签署的最高本金余额为4500万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任保证。

2009年12月31日，江苏远方迪威尔容器有限公司与中国银行股份有限公司宜兴支行签订了编号为68201002002号《最高额保证合同》，为发行人自2009年12月31日至2010年12月31日止签署的最高本金余额为2950万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任保证。

2010年6月22日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68201006005号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为G-68-D-2009-014、0360190D09121101的《人民币借款合同（短期）》及自2010年6月22日起至2012年6月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为1,460.80万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的厂房。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-1 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12 月 9 日起至 2011 年 12 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 810.37 万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第 000596 号）。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-2 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12 月 9 日起至 2011 年 12 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 172.57 万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第 000548 号）。

2009 年 12 月 9 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200911032-3 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自 2009 年 12 月 9 日起至 2011 年 12 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 397.88 万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第 000549 号）。

2009 年 12 月 30 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 68200912013 号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为 0360190D09121101 的《人民币借款合同（短期）》及自 2009 年 12 月 30 日起至 2011 年 12 月 30 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为 35,003,100 元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分设备。

9、2010 年 3 月 17 日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号 0360190D10031701 的《人民币借款合同（短期）》，约定贷款人向发行人提供金额为 530 万元的借款，用途为流动资金，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，借款利率为固定利率，年利率 5.31%。

2009年12月31日，沈建平、梁夕芬与中国银行股份有限公司宜兴支行签订了编号为68201002001的《最高额保证合同》，为发行人自2009年12月31日至2011年12月31日止签署的最高本金余额为4500万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任保证。

2009年12月9日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68200911032-1号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自2009年12月9日起至2011年12月9日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为810.37万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第000596号）。

2009年12月9日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68200911032-2号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自2009年12月9日起至2011年12月9日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为172.57万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第000548号）。

2009年12月9日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68200911032-3号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的自2009年12月9日起至2011年12月9日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为397.88万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分土地使用权（土地使用权证号为宜国用（2003）字第000549号）。

2009年12月30日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68200912013号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为0360190D09121101的《人民币借款合同（短期）》及自2009年12月30日起至2011年12月30日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为35,003,100元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的部分设备。

2010年6月22日，发行人与中国银行股份有限公司宜兴支行签订编号68201006005号的《最高额抵押合同》，约定发行人为双方签署的编号为G-68-D-2009-014、0360190D09121101的《人民币借款合同（短期）》及自2010年6月22日起至2012年6月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等所产生的全部债务的本金及利息等提供最高本金余额为1,460.80万元的抵押担保，抵押物为发行人拥有的厂房。

（五）对外担保合同

2010年4月26日，发行人与中国农业银行股份有限公司宜兴市支行签订编号为32901201000063956的《保证合同》，约定发行人为江苏南方涂装环保股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宜兴市支行签订的编号为32201201000015720的《商业汇票银行承兑合同》项下的债务提供金额为1,500万元的担保，保证期间为债务履行期限届满之日起2年，保证方式为连带保证责任。

（六）保荐及承销协议

2010年3月24日，发行人与保荐人签署了《东海证券有限责任公司与江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票保荐协议书》及《主承销协议》，约定发行人委托东海证券担任其股票发行上市的保荐人和主承销商，保荐费用及承销费用依照上述协议的约定支付。

三、发行人对外担保的情况

（一）发行人对外互保情况

截至本招股说明书出具日，公司对外担保金额1,500万元，被担保人为南方涂装。同时，上述被担保人及其关联方为公司银行借款4,950万元提供担保，担保合同情况见本节“二、重要合同/（四）借款合同/1、4、8”。公司与南方涂装不存在互保的总体协议。被担保人情况如下：

江苏南方涂装环保股份有限公司成立于1990年8月16日，注册资本及实收资本均为5,000万元，注册地址为江苏宜兴市徐舍镇振丰东路92号，经营范围为许可经营项目：普通货运。一般经营项目：涂装、环保、电器设备的设计、制

造、销售及配套安装，售后服务；空气滤芯生产、售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；按三级资质从事机电设备安装工程专业承包。

截至 2009 年 12 月 31 日，江苏南方涂装环保股份有限公司总资产 21,123.77 万元，净资产 12,923.67 万元，净利润 3,015.49 万元。

（二）发行人对外互保原因

公司作为民营企业借贷能力较弱，融资渠道相对单一，目前主要通过银行贷款来满足公司日常经营资金的需要。随着近几年经营规模的持续扩张，公司的资金需求量快速上升，公司的房产和土地已经全部抵押给银行取得贷款，只有采取互保的方式公司才能进一步取得银行贷款，故公司采取了对外互保方式取得银行贷款以满足经营资金的需求。

（三）发行人对外互保履行的程序

2009 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《公司 2010 年度为江苏远方迪威尔容器有限公司和江苏南方涂装环保股份有限公司不超过 4000 万元的银行贷款提供信用担保的议案》。

2009 年 11 月 30 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，审议通过《公司 2010 年度为江苏远方迪威尔容器有限公司和江苏南方涂装环保股份有限公司不超过 4000 万元的银行贷款提供信用担保的议案》。

四、发行人的诉讼与仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

五、关联方的重大诉讼与仲裁

截至本招股说明书签署日，不存在发行人的控股股东或实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

六、涉及刑事诉讼的情况

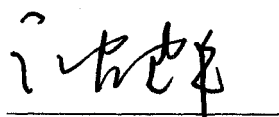
截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及刑事诉讼的情况。

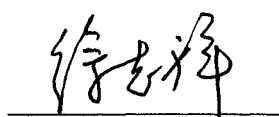
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

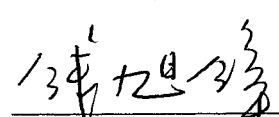
全体董事、监事、高级管理人员声明

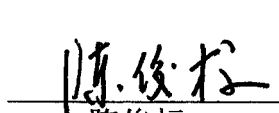
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

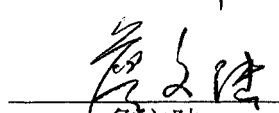
全体董事签字：

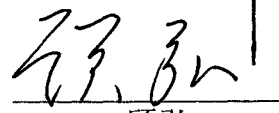

沈建平

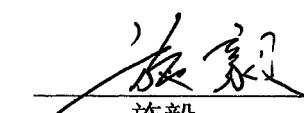

徐志祥

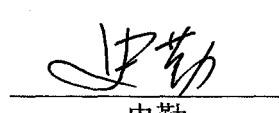

钱旭锋


陈俊标


詹文陆

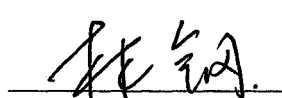

顾弘


施毅

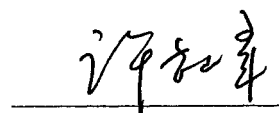

史勤


叶树理

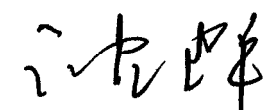
全体监事签字：

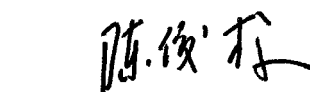

林钢

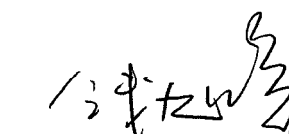

李国华

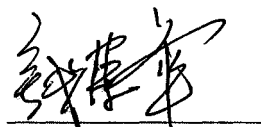

许志峰

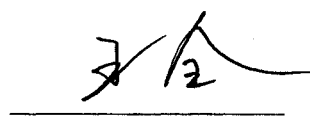
高级管理人员签字：


沈建平


陈俊标


钱旭锋


钱荣军


王全


周玲燕

江苏东光微电子股份有限公司

2010年9月13日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 张宜生
张宜生

保荐代表人： 张静
张静

王育贵
王育贵

法定代表人： 朱科敏
朱科敏

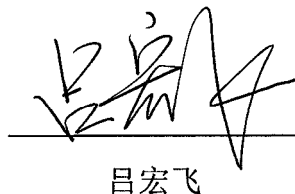


发行人律师声明

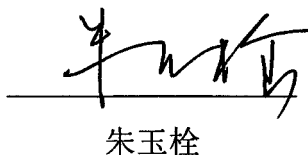
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


朱振武


吕宏飞

律师事务所负责人：

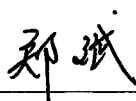

朱玉栓

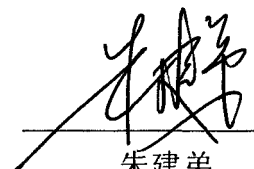


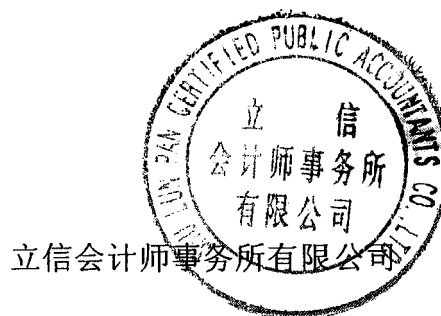
2010 年 9 月 13 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：    
孙冰 郑斌

会计师事务所负责人：  
朱建弟

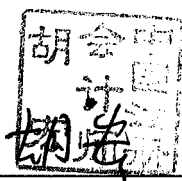


2010 年 9 月 13 日

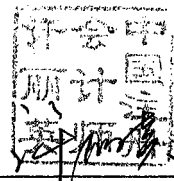
验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

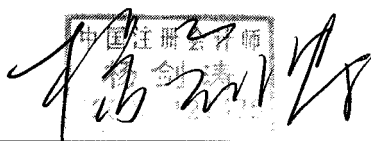


胡宏



许丽英

验资机构负责人：



杨剑涛

国富浩华会计师事务所有限公司



2010 年 9 月 13 日

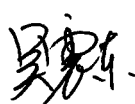
验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

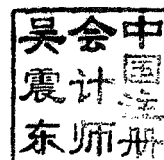
经办注册会计师：



糜平



吴震东



验资机构负责人：



朱建弟



仅供江苏东光微电子股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票之用

第十七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次发行有关的备查文件，该等文件也在指定网站上披露，具体包括以下文件：

- 1、发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制鉴证报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、公司章程（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

（一）查阅时间

本次发行期间工作日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。

（二）查阅地点

1、江苏东光微电子股份有限公司

联系地址：江苏省宜兴新街百合工业园区

电话：0510-87138930

传真：0510-87138931

联系人：周玲燕

2、东海证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼

电话：021—50586660

传真：021—50585607

联系人：王育贵、张静、张宜生